



# 深圳丹邦科技股份有限公司

Shenzhen Danbond Technology Co., Ltd.

(注册地址：深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼)

## 首次公开发行股票

### 招股说明书

(申报稿)

保荐机构（主承销商）



国信证券股份有限公司

(注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层)

**声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。**

## 发行概况

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 发行股票类型：人民币普通股                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 每股面值：1.00 元     |
| 发行股数：4,000 万股                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 每股发行价格： 元       |
| 发行后总股本：16,000 万股                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 预计发行日期： 年 月 日   |
| 拟上市证券交易所：深圳证券交易所                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| 本次发行前<br>股东所持股<br>份的流通限<br>制及自愿锁<br>定股份的承<br>诺 | <p>公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司、实际控制人刘萍及公司股东深圳市丹依科技有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。</p> <p>公司股东益关寿、深圳市信瑞鸿网络科技有限公司、深圳市华浩投资有限公司及深圳市百顺投资管理有限公司承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。</p> <p>除此之外，公司董事及高级管理人员刘萍、王李懿，监事邹盛和及核心技术人员刘文魁还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过本人直接及间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接及间接持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人直接及间接持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十。</p> |                 |
| 保荐机构（主承销商）                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 国信证券股份有限公司      |
| 招股说明书签署日期                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2011 年 6 月 22 日 |

## 发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

## **重大事项提示**

### **一、股份流通限制和自愿锁定股份的承诺**

本次发行前公司总股本 12,000 万股，本次拟发行 4,000 万股流通股，发行后总股本为 16,000 万股，16,000 万股均为流通股。

公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司、实际控制人刘萍及公司股东深圳市丹依科技有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

公司股东益关寿、深圳市信瑞鸿网络科技有限公司、深圳市华浩投资有限公司及深圳市百顺投资管理有限公司承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

除此之外，公司董事及高级管理人员刘萍、王李懿，监事邹盛和及核心技术人员刘文魁还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过本人直接及间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接及间接持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人直接及间接持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十。

### **二、发行前滚存利润的安排**

根据公司 2010 年 9 月 15 日通过的 2010 年第二次临时股东大会决议，公司本次公开发行股票前滚存的未分配利润由本次公开发行股票后的新老股东按持股比例共享。截至 2010 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 8,981.52 万元。

### **三、2007 年控股股东以无形资产出资 4,623 万元**

2007年5月，控股股东丹侬发展以“UV固化可剥离压敏胶膜”、“一种无胍刻蚀液”、“一种潜伏性固化剂的制造方法”及“用于芯片搭载及封装的电绝缘树脂浆”四项发明专利对丹邦有限出资。根据深圳中联岳华会计师事务所出具的深中岳评报字[2007]第007号资产评估报告书，四项发明专利于评估基准日2006年12月31日的评估值为4,843万元，经2007年1月28日丹邦有限董事会决议同意，丹侬发展以上述无形资产的评估值为参考作价4,623万元出资至丹邦有限，占此次增资完成后公司注册资本的46.23%。

关于本次无形资产出资的详细情况，请投资者阅读本招股说明书第四节“四、（二）关于2007年5月以无形资产出资的说明”。

#### **四、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险**

##### **（一）所得税优惠被追缴的风险**

2007年5月，公司经批准调整了股权结构，外资股权比例从25%变更为12.67%，成为“外资比例低于25%”的外商投资企业。根据国家税务总局有关规定，公司于2007年5月外资比例低于25%之后应补缴已免征、减征的企业所得税税款。

但根据深圳市人民政府1988年8月1日《关于深圳特区企业税收政策若干问题的规定》（深府[1988]232号）第六条及第八条规定，公司作为在深圳经济特区内设立的生产性企业，可享受按优惠税率及减半征收企业所得税的税收优惠政策。公司2006年为开始获利年度，据此2006年度至2007年度可免征企业所得税，2008年度至2010年度减半征收企业所得税。

根据深圳市南山区地方税务局于2011年1月24日出具确认函确认发行人“根据深府[1988]232号文《深圳市人民政府关于深圳特区企业税收政策若干问题的规定》第八条规定，该公司无需补缴2006年1月1日起至2010年12月31日期间已免征、减征的企业所得税税款。”深圳市南山区国家税务局的具体行政行为属有效的具体行政行为，但若该具体行政行为被国家有权机关作出撤销的决定或人民法院作出撤销或认定无效的判决，则发行人2006年1月1日起至2010年12月31日期间已免征、减征的企业所得税税款可能存在被追缴的风险。

公司的控股股东丹邦投资集团以书面形式作出承诺：“发行人公开发行股票并上市后，若税收主管部门要求发行人补缴因其享受有关税收优惠政策而免征及少征的企业所得税，本公司将无条件全额承担发行人在本次发行上市前应补缴的税款及因此所产生的所有相关费用。”

## **（二）资产抵押风险**

截至2010年12月31日，公司将主要生产用房屋建筑物、机器设备、发明专利等资产为公司的银行借款提供抵押或质押担保。其中，用于抵押的房屋建筑物账面净值为12,605.36万元，占公司房屋建筑物净值比例的100%；用于抵押的机器设备账面净值为3,917.18万元，占公司全部机器设备比例的18.52%；用于质押的专利权账面净值为3,665.19万元，占公司全部专利权账面净值的100.00%。

根据抵押合同及质押合同的约定，如果公司不能按合同约定足额偿还银行贷款本息，亦不能通过协商解决，上述公司资产将被依法拍卖、变卖或折价等方式处分。因此公司存在因不能按时偿还银行贷款而丧失对该房屋建筑物、机器设备及专利技术的所有权，进而影响正常生产经营的风险。

## 目 录

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| 释 义.....                                     | 9   |
| 第一节 概 览.....                                 | 13  |
| 一、发行人概况.....                                 | 13  |
| 二、发行人控股股东与实际控制人.....                         | 17  |
| 三、发行人的主要财务数据.....                            | 18  |
| 四、本次发行情况.....                                | 19  |
| 五、募集资金主要用途.....                              | 20  |
| 第二节 本次发行概况.....                              | 21  |
| 一、本次发行的基本情况.....                             | 21  |
| 二、本次发行有关机构.....                              | 21  |
| 三、与本次发行上市有关的重要日期.....                        | 23  |
| 第三节 风险因素.....                                | 24  |
| 一、市场风险.....                                  | 24  |
| 二、技术风险.....                                  | 24  |
| 三、控股股东用于出资的无形资产可能存在减值的风险.....                | 25  |
| 四、财务风险.....                                  | 26  |
| 五、募集资金投资项目风险.....                            | 27  |
| 六、企业所得税税收优惠政策变化的风险.....                      | 28  |
| 七、实际控制人控制风险.....                             | 29  |
| 第四节 发行人基本情况.....                             | 30  |
| 一、发行人基本情况.....                               | 30  |
| 二、发行人的历史沿革及改制重组情况.....                       | 30  |
| 三、发行人独立经营情况.....                             | 33  |
| 四、发行人的股本形成及重大资产重组情况.....                     | 36  |
| 五、发行人历次股本变化的验资情况.....                        | 63  |
| 六、发行人的内部组织结构.....                            | 64  |
| 七、发行人子公司情况.....                              | 66  |
| 八、发行人股东及实际控制人基本情况.....                       | 68  |
| 九、发行人股本情况.....                               | 74  |
| 十、发行人员工及其社会保障情况.....                         | 76  |
| 十一、持有发行人 5%以上股份的股东及作为股东的董事、监事及高管人员的重要承诺..... | 79  |
| 第五节 业务与技术.....                               | 81  |
| 一、发行人主营业务及其发展情况.....                         | 81  |
| 二、发行人所处行业的基本情况.....                          | 87  |
| 三、发行人在行业中的竞争地位.....                          | 115 |
| 四、发行人的主营业务.....                              | 125 |
| 五、与主要业务相关的固定资产和无形资产.....                     | 146 |
| 六、发行人的技术水平与研发情况.....                         | 154 |
| 七、发行人进行境外生产经营情况.....                         | 157 |
| 八、发行人的质量管理.....                              | 157 |

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| 九、公司冠名“科技”依据.....                                    | 158 |
| 第六节 同业竞争与关联交易.....                                   | 160 |
| 一、同业竞争.....                                          | 160 |
| 二、关联方与关联关系.....                                      | 166 |
| 三、关联交易.....                                          | 167 |
| 四、公司减少关联交易的措施.....                                   | 180 |
| 五、发行人近三年关联交易的执行情况及公司独立董事意见.....                      | 181 |
| 六、规范关联交易的制度安排.....                                   | 181 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.....                         | 183 |
| 一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员情况.....                         | 183 |
| 二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况.....                  | 185 |
| 三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的其他对外投资情况.....                  | 186 |
| 四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬.....                        | 187 |
| 五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况.....                      | 187 |
| 六、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员作出的重要承诺及与本公司签订的协议及其履行情况..... | 188 |
| 七、董事、监事、高级管理人员的任职资格.....                             | 188 |
| 八、公司董事、监事、高级管理人员的变动情况.....                           | 189 |
| 第八节 公司治理.....                                        | 191 |
| 一、公司法人治理制度建立健全情况.....                                | 191 |
| 二、公司三会、独立董事和董事会秘书制度的建立健全及规范运作情况.....                 | 192 |
| 三、发行人近三年违法违规行情况.....                                 | 200 |
| 四、发行人近三年资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用及担保的情况.....          | 201 |
| 五、公司内部控制制度的情况.....                                   | 202 |
| 第九节 财务会计信息.....                                      | 203 |
| 一、财务报表.....                                          | 203 |
| 二、财务报表编制的基础、合并报表范围及变化情况.....                         | 208 |
| 三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计.....                            | 209 |
| 四、非经常性损益.....                                        | 216 |
| 五、主要资产情况.....                                        | 217 |
| 六、主要债项及股东权益.....                                     | 218 |
| 七、现金流量情况.....                                        | 220 |
| 八、财务报表附注中的重要事项.....                                  | 220 |
| 九、近三年主要财务指标.....                                     | 221 |
| 十、历次验资、评估情况.....                                     | 223 |
| 第十节 管理层讨论与分析.....                                    | 226 |
| 一、财务状况分析.....                                        | 226 |
| 二、盈利能力分析.....                                        | 253 |
| 三、现金流量分析.....                                        | 277 |
| 四、资本性支出分析及其他事项说明.....                                | 279 |
| 五、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析.....                            | 280 |
| 第十一节 业务发展目标.....                                     | 283 |
| 一、公司中长期发展目标.....                                     | 283 |



|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| 二、实现上述发展规划拟采取的措施.....           | 283 |
| 三、发行人拟定上述计划所依据的假设条件.....        | 285 |
| 四、发行人实施上述计划将面临的主要困难.....        | 286 |
| 五、发行人确保实现上述计划拟采用的方式、方法或途径.....  | 286 |
| 六、上述业务发展规划与现有业务的联系.....         | 286 |
| 第十二节 募集资金运用.....                | 288 |
| 一、募集资金总量及其运用计划.....             | 288 |
| 二、募集资金投资项目的必要性与可行性.....         | 290 |
| 三、募集资金投资项目产品的市场前景分析.....        | 295 |
| 四、募集资金投资项目情况简介.....             | 303 |
| 五、固定资产投资及其对生产经营影响情况.....        | 312 |
| 六、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响.....      | 314 |
| 第十三节 股利分配政策.....                | 315 |
| 一、股利分配政策.....                   | 315 |
| 二、近三年的股利分配情况.....               | 315 |
| 三、本次发行前未分配利润的分配政策.....          | 315 |
| 四、本次发行后的股利分配政策.....             | 315 |
| 第十四节 其他重要事项.....                | 317 |
| 一、信息披露制度及投资者服务计划.....           | 317 |
| 二、重要合同.....                     | 317 |
| 三、重大诉讼及仲裁事项.....                | 320 |
| 第十五节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明..... | 322 |
| 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.....      | 323 |
| 二、保荐机构(主承销商)声明.....             | 324 |
| 三、发行人律师声明.....                  | 325 |
| 四、审计机构声明.....                   | 326 |
| 五、验资机构声明.....                   | 327 |
| 六、验资机构情况说明.....                 | 328 |
| 七、评估机构声明.....                   | 329 |
| 八、评估机构情况说明.....                 | 330 |
| 九、评估机构声明.....                   | 331 |
| 十、评估机构声明.....                   | 332 |
| 第十六节 备查文件.....                  | 333 |

## 释 义

在本招股说明书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：

### 一、普通术语

|                 |   |                                                       |
|-----------------|---|-------------------------------------------------------|
| 丹邦科技、本公司、公司、发行人 | 指 | 深圳丹邦科技股份有限公司                                          |
| 丹邦有限            | 指 | 深圳丹邦科技有限公司，系发行人前身                                     |
| 公司章程            | 指 | 深圳丹邦科技股份有限公司章程                                        |
| 股东大会            | 指 | 深圳丹邦科技股份有限公司股东大会                                      |
| 董事会             | 指 | 深圳丹邦科技股份有限公司董事会                                       |
| 监事会             | 指 | 深圳丹邦科技股份有限公司监事会                                       |
| 丹依发展            | 指 | 深圳市丹依科技发展有限公司，系丹邦投资集团于 2001 年 6 月成立至 2007 年 9 月期间的曾用名 |
| 丹邦投资            | 指 | 深圳市丹邦投资有限公司，系丹邦投资集团于 2007 年 9 月至 2009 年 6 月期间的曾用名     |
| 丹邦投资集团          | 指 | 深圳丹邦投资集团有限公司，系发行人控股股东                                 |
| 丹依科技            | 指 | 深圳市丹依科技有限公司                                           |
| 信瑞鸿网络           | 指 | 深圳市信瑞鸿网络科技有限公司                                        |
| 华浩投资            | 指 | 深圳市华浩投资有限公司                                           |
| 百顺投资            | 指 | 深圳市百顺投资管理有限公司                                         |
| 丹邦香港            | 指 | 丹邦科技（香港）有限公司                                          |
| 广东丹邦            | 指 | 广东丹邦科技有限公司                                            |
| 第比尔国际           | 指 | 第比尔国际（香港）有限公司                                         |
| 典邦科技            | 指 | 深圳典邦科技有限公司                                            |
| 广东东邦            | 指 | 广东东邦科技有限公司                                            |
| 典邦柔性            | 指 | 深圳典邦柔性电路有限公司                                          |
| 丹邦柔性            | 指 | 深圳丹邦柔性覆合铜板有限公司                                        |

|                |   |                                                                                    |
|----------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|
| 邦达集团           | 指 | BONDEX GROUP LIMITED\邦达集团有限公司                                                      |
| 四项发明专利         | 指 | UV 固化可剥离压敏胶膜、一种无胍刻蚀液、一种潜伏性固化剂的制造方法及用于芯片搭载及封装的电绝缘树脂浆                                |
| 公司法            | 指 | 中华人民共和国公司法                                                                         |
| 证券法            | 指 | 中华人民共和国证券法                                                                         |
| 中国证监会          | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                                        |
| 商务部            | 指 | 中华人民共和国商务部                                                                         |
| 国家发改委          | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会                                                                  |
| 科技部            | 指 | 中华人民共和国科学技术部                                                                       |
| 深交所            | 指 | 深圳证券交易所                                                                            |
| 本次发行、本次公开发行    | 指 | 发行人本次发行不超过 4,000 万股 A 股的行为                                                         |
| A 股            | 指 | 每股面值 1.00 元人民币之普通股                                                                 |
| 报告期、近三年        | 指 | 2008-2010 年                                                                        |
| 元（万元）          | 指 | 人民币元（万元）                                                                           |
| 国信证券、保荐机构、主承销商 | 指 | 国信证券股份有限公司                                                                         |
| 国浩律师、发行人律师     | 指 | 国浩律师集团（深圳）事务所                                                                      |
| 天健会计师          | 指 | 天健会计师事务所有限公司                                                                       |
| 开元信德会计师        | 指 | 开元信德会计师事务所有限公司                                                                     |
| 《资产收购协议书》      | 指 | 广东丹邦科技有限公司与广东东邦科技有限公司《关于收购工业用地及地上建筑物等资产之资产收购协议书》                                   |
| 《补充协议》         | 指 | 广东丹邦科技有限公司与广东东邦科技有限公司《关于收购工业用地及地上建筑物等资产之资产收购协议书之补充协议》                              |
| 02专项           | 指 | 国家科技重大专项，是为了实现国家目标，通过核心技术突破和资源集成，在一定时限内完成的重大战略产品、关键共性技术和重大工程。重大专项研究内容是我国科技发展的重中之重。 |

## 二、专业术语

|           |   |                                                                                                                                                                                       |
|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PCB       | 指 | 印制电路板（Printed Circuit Board），组装电子零件用的基板，是在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板。                                                                                                                  |
| FPC       | 指 | 柔性印制电路板（Flexible Printed Circuit），又称柔性电路板或柔性线路板，由柔性基材制成的印制电路板，其优点是可以弯曲，便于电器部件的组装。                                                                                                     |
| COF柔性封装基板 | 指 | 还未装联上芯片、元器件的封装型柔性基板，在芯片封装过程中，起到承载芯片、电路连通、绝缘支撑的作用。                                                                                                                                     |
| COF产品     | 指 | 搭载芯片的柔性基板（Chip on Flexible Printed Circuit），是用COF柔性封装基板作载体，将半导体芯片直接封装在柔性基板上形成的芯片封装产品。                                                                                                 |
| 邦定        | 指 | 芯片打线，是芯片生产工艺中一种打线的方式，一般用于封装前将芯片内部电路用金线或铝线与封装管脚或线路板镀金铜箔连接。                                                                                                                             |
| TAB       | 指 | 卷带自动结合（Tape Automated Bonding），将芯片或无源元件装配在承载体的一种工艺。                                                                                                                                   |
| COG       | 指 | 玻璃基板载芯片（Chip on Glass），芯片被直接邦定在玻璃上。                                                                                                                                                   |
| CCL       | 指 | 覆铜板（Copper Clad Laminate），又名基材，将补强材料浸以树脂，一面或两面覆以铜箔，经热压而成的一种板状材料，称为覆铜箔层压板。它是做PCB的基本材料，常叫基材。                                                                                            |
| FCCL      | 指 | 柔性覆铜板（Flexible Copper Clad Laminate），用增强材料，浸以树脂胶黏剂，通过烘干、裁剪、叠合成坯料，然后覆上铜箔，用钢板作为模具，在热压机中经高温高压成形加工而制成的。FCCL是FPC和COF柔性封装基板的加工基材，可按结构划分为两大类：传统胶粘剂三层型柔性覆铜板（3L-FCCL）与新型无胶粘剂两层型柔性覆铜板（2L-FCCL）。 |
| 3L-FCCL   | 指 | 三层型柔性覆铜板（Three-layer Flexible Copper Clad Laminate），是由铜箔、基膜、胶粘剂三种材料构成，胶粘剂起到粘合铜箔和基膜的作用。                                                                                                |
| 2L-FCCL   | 指 | 两层型柔性覆铜板（Two-layer Flexible Copper Clad Laminate），是由铜箔和基膜两种材料构成，2L-FCCL的基膜采用高粘合性的聚酰亚胺树脂材料，这种材料制成的基膜可以直接与铜箔粘合，无需使用额外的胶粘剂，胶粘剂的缺点是含有杂质。                                                  |
| 刚性PCB     | 指 | 由刚性覆铜板制成的PCB。                                                                                                                                                                         |
| PI        | 指 | 聚酰亚胺（Polyimide），综合性能最佳的有机高分子材料之一，耐高温达 400℃以上，长期使用温度范围                                                                                                                                 |

|          |   |                                                                                                                                                                                       |
|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |   | —200-300℃，特别适宜用作柔性印制电路板基材和各种耐高温电机电器绝缘材料,已广泛应用在航空、航天、微电子、纳米、液晶、分离膜、激光等领域。                                                                                                              |
| 铜箔       | 指 | 电子信息产业的基础原材料,可用来制作覆铜箔板。                                                                                                                                                               |
| 基板       | 指 | 基板是制造PCB的基本材料，一般PCB用基板材料可分为两大类：刚性基板材料和柔性基板材料。                                                                                                                                         |
| LCD      | 指 | 液晶显示器（Liquid Crystal Display）。                                                                                                                                                        |
| TFT-LCD  | 指 | 薄膜晶体管液晶显示器（Thin Film Transistor LCD），是液晶显示器的一种，它使用薄膜电晶体技术改善影像品质。                                                                                                                      |
| LCM      | 指 | 液晶显示模组（LCD Module），是将液晶显示器件、连接件、控制与驱动等外围电路、PCB电路板、背光源及结构件等装配在一起的组件。                                                                                                                   |
| ROHS     | 指 | 欧洲立法委员会通过的从2006年7月起实施的《关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令》（RoHS指令）。该指令在8大类123种电子电气产品中限制使用铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯（PBB）和多溴二苯醚（PBDE）等六种有害化学物质，是欧盟在环保领域推出的重大技术性贸易措施，影响巨大，引起包括我国在内的欧盟主要贸易伙伴国的强烈关注，并促使产业向绿色制造升级。 |
| UL认证     | 指 | UL是“Underwriters Laboratories Inc.”的缩写，指美国保险商试验所，是世界权威的产品安全测试和认证机构，UL是制造厂商最值得信赖的合格评估提供者之一。                                                                                            |
| CPCA     | 指 | 中国印制电路行业协会                                                                                                                                                                            |
| Prismark | 指 | 美国 Prismark Partners LLC                                                                                                                                                              |
| JMS      | 指 | 日本Japan Marketing Survey                                                                                                                                                              |
| mil      | 指 | 长度单位，1mil=0.0254mm                                                                                                                                                                    |
| μm       | 指 | 长度单位，1μm=1000nm（纳米）                                                                                                                                                                   |
| ppi      | 指 | 每英寸所拥有的像素数目（pixels per inch），是图像分辨率的单位，图像ppi值越高，画面的细节就越丰富，因为单位面积的像素数量更多。                                                                                                              |

## 第一节 概 览

声明：本概览仅对招股说明书全文做扼要提示，投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

### 一、发行人概况

#### （一）发行人基本情况

- 1、中文名称：深圳丹邦科技股份有限公司  
英文名称：Shenzhen Danbond Technology Co., Ltd.
- 2、注册资本：12,000 万元
- 3、法定代表人：刘萍
- 4、成立日期：2001 年 11 月 20 日
- 5、股份公司设立日期：2009 年 6 月 5 日
- 6、公司住所：深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼

#### （二）发行人设立情况

发行人前身为深圳丹邦科技有限公司，2009年2月23日，经丹邦有限2009年第2次董事会决议同意，丹邦有限全体股东签署《关于深圳丹邦科技有限公司按原账面净资产值折股整体变更为股份公司之发起人协议书》，一致同意将丹邦有限整体变更为外商投资股份有限公司，即以丹邦有限经审计的截至2008年12月31日的账面净资产人民币188,711,657.30元出资，按1:0.6359的比例折为股本12,000万股，每股面值人民币1元。

2009年5月7日，深圳市贸易工业局出具深贸工资复[2009]0944号批复，同意丹邦有限变更为外商投资股份有限公司。2009年5月13日，公司取得深圳市人民政府颁发的商外资粤深股资证字[2009]0002号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。2009年6月5日，深圳市工商行政管理局核准本次变更，并颁发了《企业法人营业执照》，公司更名为深圳丹邦科技股份有限公司。

### **（三）发行人特点及优势**

公司自成立以来专注于FPC、COF柔性封装基板及COF产品的研发、生产与销售，致力于在微电子领域为客户提供全面的柔性互连解决方案及基于柔性基板技术的芯片封装方案。

公司生产的FPC、COF柔性封装基板及COF产品具有配线密度高、厚度薄、重量轻、配线空间限制少、可折叠、灵活度高等优点，广泛应用于空间狭小、可移动、可折叠的各类电子信息产品。公司从事的业务属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》和《外商投资产业指导目录（2007年修订）》中的“鼓励类”产业。公司主要优势如下：

#### **1、领先的技术优势**

经过多年的技术攻关和生产实践，公司成功掌握具有国际先进水平的三项核心技术：高性能薄膜成型技术、高密度微细线路制造技术及基于柔性基板的芯片封装技术，并运用上述技术实现了高端2L-FCCL、COF柔性封装基板及COF产品的产业化，填补了我国在高端柔性覆铜板材料及柔性封装基板领域的技术空白，打破了日本、韩国等国家和地区企业对关键材料的技术垄断。

公司的技术水平在国内同行中处于领先地位，部分技术接近国际尖端水平。公司承担的“高性能特种挠性电路连接与封装技术”项目是为了满足国家航天、航空、舰艇、兵器等军事电子装备的应用需求，为我军武器装备的发展和进步提供技术支撑。公司的技术研发项目如线宽线距20  $\mu\text{m}$ 的超微细化线COF柔性封装基板和厚度小于10  $\mu\text{m}$ 的高端2L-FCCL基膜是根据国际上最新的技术发展方向所做的前瞻性研究，符合电子信息产品轻薄短小的发展趋势，是公司在未来几年内持续保持技术领先的保证。

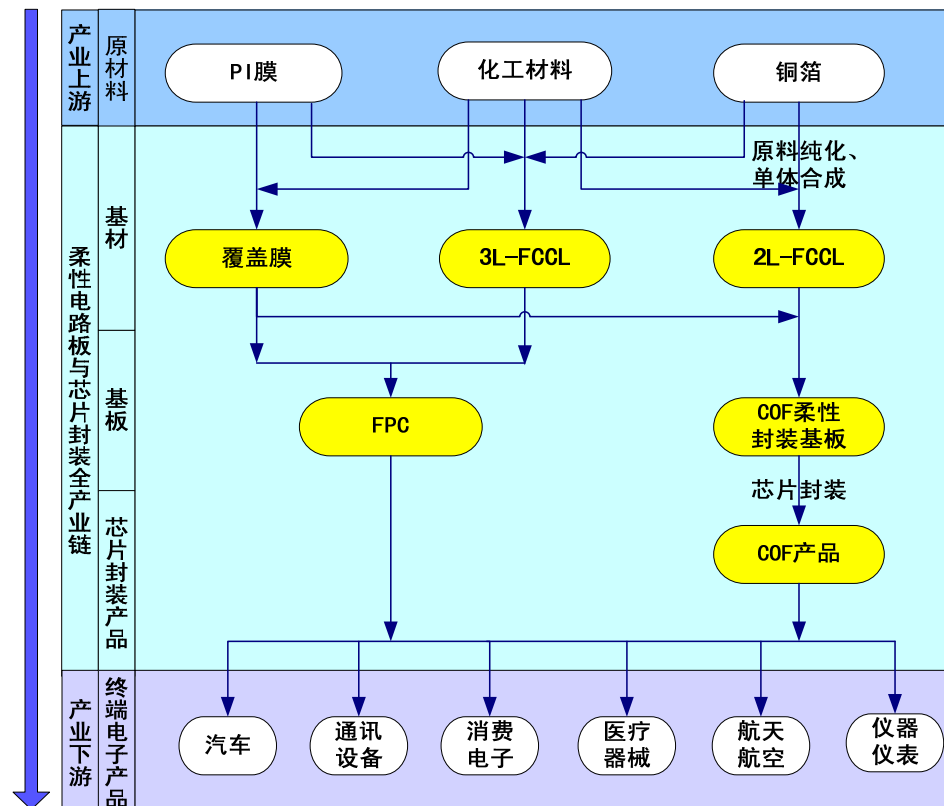
公司目前已获得发明专利9项，并且公司有多项产品和科技成果荣获国家级或省级新产品奖以及科技成果奖，其中：COF封装基板在2010年被国家科技部认定为“国家重点新产品”；先进COF超微线路及封装产业化项目被深圳市政府评为2006年度“深圳市科技创新奖”，并被广东省政府评为2007年度“广东省科学技术三等奖”。

2009年1月，公司作为项目联合单位开始承担国家科技重大专项（02专项）“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”项目下属的“芯片柔性封装基板技术与中试工艺开发”课题研究任务。2011年2月，公司子公司广东丹邦作为项目责任单位获批承担国家科技重大专项“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”项目下属的“三维柔性基板及工艺技术研发与产业化”项目。国家科技重大专项是为了实现国家目标，通过核心技术突破和资源集成，在一定时限内完成的重大战略产品、关键共性技术和重大工程。《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》确定了大型飞机、极大规模集成电路制造装备与成套工艺等16个重大专项，这些重大专项是我国到2020年科技发展的重中之重。

## 2、完整的全产业链布局

公司专注于微电子柔性互连与封装业务，形成了从 FCCL→FPC、FCCL→COF 柔性封装基板→COF 产品的完整产业链，是全球极少数产业链涵盖从基材、基板到芯片封装的企业之一。

公司在柔性电路板与芯片封装全产业链中的产品布局图如下：



FCCL是生产FPC及COF柔性封装基板的主要原材料，占整个产品成本的



40%-50%左右，但国内能够生产高档FCCL的企业非常少，特别是高端2L-FCCL基本靠进口。本公司打破日本、韩国等国对高端FCCL的技术垄断，实现了上游关键原材料柔性封装基板用高端2L-FCCL、FPC用3L-FCCL和普通2L-FCCL的自产，使得公司产品具有明显成本优势，增强了产品的市场竞争力，提升了公司的行业地位。同时，由于公司实现了上游关键原材料的自产，并严格控制产业链各个中间产品的质量，确保工艺流程的顺畅，使得公司产品能够长期保持稳定的质量水平，产品质量的稳定有利于公司形成稳定的客户关系。

### 3、优质的客户资源

公司先进的技术水平、稳定的产品质量和可靠的产品性能在下游客户中赢得了良好的声誉并获得客户的广泛认可，目前，公司与多家世界 500 强企业及全球知名的电子信息产品品牌制造商建立了持久稳定的客户关系，产品远销亚洲、欧洲、美洲等 20 多个国家和地区，在 FPC、COF 柔性封装基板及 COF 封装领域形成了较高的知名度和良好的信誉度。公司的客户按地区主要可划分为日本、欧美、东南亚及香港等国家和地区，主要包括国际顶尖电子信息产品生产或代理商，其中具有国际影响力的客户如下：

| 客户所在国家/地区 | 客户名称及所属行业                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日本        | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 夏普(Sharp)，电子、电器设备，世界500强</li> <li>● 日立(Hitachi)，电子、电器设备，世界500强</li> <li>● 佳能(Canon)，影像器材、办公设备，世界500强</li> <li>● 日本电产(NIDEC)，电机制造，2008年营业收入达到63亿美元</li> <li>● 松下(Panasonic)，电子、电气设备，世界500强</li> <li>● 三洋电机(SanyoElectric)，电子、电气设备，世界500强</li> <li>● 胜利公司(JVC)，视频、音频设备，世界500强</li> <li>● 欧姆龙(OMRON)，自动化控制及电子设备，亚洲500强</li> <li>● 阿尔卑斯电气(ALPS)，磁性模具、通信及汽车电子产品</li> <li>● 三美电子(Mitsumi Electric)，PC配件和元器件生厂商</li> <li>● 立志凯(NISCA)，ID卡打印机</li> </ul> |
| 亚洲其他地区    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 鸿富锦精密电子(Foxcoon)，消费类电子、精密电气连接器，世界500强</li> <li>● 元太科技(Prime View International)，TFT-LCD、LED显示和电子书</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

本公司的COF柔性封装基板及COF产品主要用于上述国际顶尖电子信息产品制造商的高端产品（比如本公司销售给佳能（Canon）影像器材用的COF柔性封装

基板及COF产品均是用于1,000万像素以上的照相机)。在与国际顶尖电子信息产品生产商的合作过程中,公司能够汲取最新的国际生产经营理念,把握行业动态和技术走向,为进一步开拓市场创造有利条件。

#### **4、突出的行业地位**

本公司坚持实施高端产品竞争战略,通过多年的技术创新和市场开拓,市场竞争能力不断增强,已经形成较为完整的产业链和合理的产品结构,是全球极少数产业链涵盖从基材、基板到芯片封装的企业之一。

公司2008-2010年COF柔性封装基板销售额分别为6,993.40万元、10,161.15万元、10,196.25万元,2008年、2009年连续两年成为中国最大的COF柔性封装基板生产商,全球市场占有率分别为1.1%、1.55%,全球市场占有率稳步提高,2009年成为全球第八大COF柔性封装基板生产商。

公司是国家级高新技术企业,是国家科技部认定的“国家高技术研究发展计划成果产业化基地”,拥有“国家挠性电路与材料研发中心”。2009年1月、2011年2月,公司及子公司广东丹邦先后获批承担国家科技重大专项(02专项)的课题研究任务及项目,国家科技重大专项是国家支持行业发展的具体举措,承担国家科技重大专项是国家对本公司技术研发水平、行业领先地位的肯定,对于公司产品档次升级和提升公司核心竞争力具有非常重要的意义。

## **二、发行人控股股东与实际控制人**

公司控股股东为丹邦投资集团,在本次发行前持有公司60.93%的股份。丹邦投资集团注册资本与实收资本均为9,000万元,法定代表人为刘萍,其主营业务为投资兴办实业。

刘萍先生持有控股股东丹邦投资集团100%的股权,是公司实际控制人,在本次发行前通过丹邦投资集团间接持有本公司60.93%的股份。刘萍先生现任本公司董事长、总经理。关于刘萍先生的基本情况,参见本招股说明书第七节之“一、(一)董事会成员”。

发行人自设立以来实际控制人未曾发生变化。

### 三、发行人的主要财务数据

根据经天健会计师事务所审计的财务报表，本公司主要财务数据如下：

#### （一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

| 项目          | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|-------------|------------|------------|------------|
| 流动资产        | 13,193.63  | 13,264.37  | 17,025.20  |
| 资产总计        | 56,469.32  | 50,817.81  | 48,645.42  |
| 流动负债        | 1,967.61   | 1,841.18   | 2,231.91   |
| 负债合计        | 28,182.69  | 27,813.18  | 30,303.91  |
| 归属于母公司所有者权益 | 28,286.63  | 23,004.63  | 18,341.51  |
| 所有者权益合计     | 28,286.63  | 23,004.63  | 18,341.51  |
| 负债及所有者权益总计  | 56,469.32  | 50,817.81  | 48,645.42  |

#### （二）合并利润表主要数据

单位：万元

| 项目           | 2010 年度   | 2009 年度   | 2008 年度   |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 营业收入         | 20,567.36 | 18,347.60 | 17,151.52 |
| 营业利润         | 4,987.47  | 4,330.09  | 3,609.21  |
| 利润总额         | 5,738.89  | 5,035.17  | 3,757.28  |
| 归属于母公司股东的净利润 | 5,268.05  | 4,663.14  | 3,514.35  |

#### （三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

| 项目               | 2010 年度    | 2009 年度   | 2008 年度   |
|------------------|------------|-----------|-----------|
| 经营活动产生的现金流量净额    | 10,774.78  | 9,251.43  | 4,698.07  |
| 投资活动产生的现金流量净额    | -12,192.10 | -4,413.70 | -6,662.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额    | -2,005.10  | -3,796.89 | 2,738.13  |
| 现金及现金等价物净增加（减少）额 | -3,439.34  | 1,025.46  | 643.41    |

#### （四）主要财务指标

| 项目               | 2010-12-31/<br>2010 年度 | 2009-12-31/<br>2009 年度 | 2008-12-31/<br>2008 年度 |
|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 流动比率             | 6.71                   | 7.20                   | 7.63                   |
| 速动比率             | 5.89                   | 5.97                   | 7.18                   |
| 母公司资产负债率         | 49.81%                 | 54.62%                 | 62.30%                 |
| 应收账款周转率（次/年）     | 4.04                   | 2.88                   | 3.36                   |
| 存货周转率（次/年）       | 4.93                   | 5.16                   | 8.42                   |
| 息税折旧摊销前利润（万元）    | 10,506.98              | 9,459.67               | 7,310.66               |
| 利息保障倍数           | 4.67                   | 3.99                   | 3.10                   |
| 每股经营活动产生的现金流量（元） | 0.90                   | 0.77                   | 0.46                   |

|                                   |        |        |        |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|
| 每股净现金流量（元）                        | -0.29  | 0.09   | 0.06   |
| 加权平均净资产收益率<br>（以归属于公司普通股股东的净利润计算） | 20.55% | 22.56% | 21.19% |
| 基本每股收益（元，以归属于公司普通股股东的净利润计算）       | 0.44   | 0.39   | -      |
| 稀释每股收益（元，以归属于公司普通股股东的净利润计算）       | 0.44   | 0.39   | -      |
| 无形资产（土地使用权除外）占净资产的比例              | 14.26% | 14.81% | 20.14% |

## 四、本次发行情况

### （一）本次发行概况

|          |                                                   |
|----------|---------------------------------------------------|
| 股票种类     | 人民币普通股（A股）                                        |
| 每股面值     | 1.00元                                             |
| 发行股数     | 4,000万股，占发行后总股本的25%                               |
| 每股发行价格   | 通过向询价对象初步询价，由发行人和主承销商根据初步询价情况直接确定发行价格             |
| 发行前每股净资产 | 2.36元（按照2010年12月31日经审计的净资产除以本次发行前总股本计算）           |
| 发行方式     | 采用向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式                 |
| 发行对象     | 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） |
| 承销方式     | 主承销商余额包销                                          |
| 预计募集资金   | [ ]亿元（扣除发行费用后）                                    |

### （二）本次发行前后的股本结构

公司本次拟发行人民币普通股4,000万股，发行前后的股本结构如下：

| 股份类型     | 发行前       |         | 发行后       |         |
|----------|-----------|---------|-----------|---------|
|          | 股数（万股）    | 股份比例（%） | 股数（万股）    | 股份比例（%） |
| 有限售条件的股份 | 12,000.00 | 100.00  | 12,000.00 | 75.00   |
| 本次发行的股份  | -         | -       | 4,000.00  | 25.00   |
| 合 计      | 12,000.00 | 100.00  | 16,000.00 | 100.00  |

## 五、募集资金主要用途

本次募集资金拟投资下述项目：

| 项 目                  | 募集资金投入总额（万元） |
|----------------------|--------------|
| 基于柔性封装基板技术的芯片封装产业化项目 | 42,500.00    |
| 其他与主营业务相关的营运资金       | -            |

若本次发行实际募集资金不能满足上述全部项目投资需要，资金缺口通过公司自筹解决；若募集资金满足上述项目投资后尚有剩余，则剩余资金补充公司流动资金。

## 第二节 本次发行概况

### 一、本次发行的基本情况

|             |                                                               |       |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| 1、股票种类      | 人民币普通股（A股）                                                    |       |
| 2、每股面值      | 1.00 元                                                        |       |
| 3、发行股数      | 4,000 万股，占发行后总股本的 25%                                         |       |
| 4、每股发行价格    | 通过向询价对象初步询价，由发行人和主承销商根据初步询价情况直接确定发行价格                         |       |
| 5、市盈率       | [ ]倍（每股收益按照 2010 年 12 月 31 日经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） |       |
| 6、发行前每股净资产  | 2.36 元（按照 2010 年 12 月 31 日经审计的净资产除以本次发行前总股本计算）                |       |
| 7、发行后每股净资产  | [ ]元（按照 2010 年 12 月 31 日经审计的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）      |       |
| 8、发行方式      | 采用向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式                             |       |
| 9、发行对象      | 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）             |       |
| 10、预计募集资金总额 | [ ]亿元                                                         |       |
| 11、预计募集资金净额 | [ ]亿元                                                         |       |
| 12、承销方式     | 主承销商余额包销                                                      |       |
| 13、发行费用概算   | 承销及保荐费用                                                       | [ ]万元 |
|             | 律师费用                                                          | [ ]万元 |
|             | 审计费用                                                          | [ ]万元 |
|             | 发行手续费用                                                        | [ ]万元 |

### 二、本次发行有关机构

#### （一）发行人：深圳丹邦科技股份有限公司

法定代表人：刘萍

地址：深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼

电话：0755-26511518

传真：0755-26511718

联系人：吴荔

**（二）保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司**

法定代表人：何如

住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16—26 层

电话：0755—82130833

传真：0755—82130620

保荐代表人：甘燕鲲鹏、崔威

项目协办人：卢绍锋

项目组成员：曾军灵、彭超、张云祥、陈驹

**（三）律师事务所：国浩律师集团（深圳）事务所**

负责人：张敬前

地址：深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24D. E

电话：0755—83515666

传真：0755—83515333

经办律师：王彩章、朱永梅

**（四）会计师事务所：天健会计师事务所有限公司**

法定代表人：胡少先

地址：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层

电话：0571-88216888 87559090

传真：0571-88216999 87559100

经办注册会计师：张希文、黄琼

**（五）资产评估机构：开元资产评估有限公司**

法定代表人：胡劲为

地址：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号院 1-4 号楼 B 座 15 层-15B

电话：010-62143639

传真：010-62156158

经办注册资产评估师：张云鹤、霍黎萍

**（六）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司**

住所：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

电话：0755-25938000

传真：0755-25988122

**（七）保荐机构（主承销商）收款银行：中国工商银行股份有限公司深圳市分行深港支行**

户名：国信证券股份有限公司

账号：4000029119200021817

**（八）申请上市证券交易所：深圳证券交易所**

法定代表人：宋丽萍

住所：深圳市深南东路 5045 号

电话：0755-82083333

传真：0755-82083164

发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

**三、与本次发行上市有关的重要日期**

- 1、询价推介时间：[ ]年[ ]月[ ]日～[ ]年[ ]月[ ]日
- 2、定价公告刊登日期：[ ]年[ ]月[ ]日
- 3、申购日期和缴款日期：[ ]年[ ]月[ ]日
- 4、预计股票上市日期：[ ]年[ ]月[ ]日



## 第三节 风险因素

投资者在评价本公司此次发售的股票时，除本招股说明书提供的其他各项资料外，应特别考虑下述各项风险因素。下述风险因素是根据重要性原则和可能影响投资者决策的程度大小排序，但并不表示风险因素会依次发生。

### 一、市场风险

公司凭借突出的技术研发实力及多年积累的客户优势，已成为国内极少数掌握高端2L-FCCL和COF柔性封装基板产业链各环节主要材料制造工艺并大批量生产的厂商，并已成为日本电产、夏普、佳能、日立、JVC、三洋电机等全球知名的电子信息产品品牌制造商的高端柔性电路板、COF柔性封装基板及COF产品的重要供应商之一。公司主要竞争对手为日本日立电线、日本三井金属矿业、韩国LG微电子、韩国STEMCO、日本住友金属矿山、日本新藤电子工业、韩国三星Gtechwin等跨国企业(资料来源：《柔性封装基板及芯片封装产业行业调研报告》，中国电子材料行业协会，2010年4月)。

日本、韩国及欧美等国家和地区是全球电子信息品主要生产地，这些国家和地区的主要竞争对手成立时间较早，且大多隶属于全球知名的跨国集团，在生产规模、资金规模、研发实力及技术水平等方面具有明显优势。未来，公司与国际竞争对手的竞争将日益激烈，公司可能面临因市场竞争能力下降导致盈利能力下滑的风险。

### 二、技术风险

#### (一) 技术开发风险

报告期内，公司把握行业技术发展趋势，紧密跟随下游需求的变动，在高端2L-FCCL、COF超微细化线路及COF封装等领域进行了重点研究，取得了一系列研发成果，部分技术达到国际先进水平。

随着IC产品的应用发展迅速，IC封装不断向小型化、微型化的方向发展，出

现了很多新的封装技术和封装形式。如果公司未来不能持续加大研发投入，不能实现高端2L-FCCL、COF超微细化线路及COF封装等技术的持续升级，不能持续提升产品加工技术及制造工艺，将难以保持公司在行业内的竞争优势，可能导致公司产品在技术先进性、产品可靠性及生产工艺技术滞后于市场发展要求或落后于竞争对手，使得公司产品的竞争力和市场份额下降。

## **（二）核心技术人员流失和核心技术失密风险**

公司产品和技术的升级换代、产品结构调整需要以公司的核心技术人员为主导，公司各项核心技术也是由以核心技术人员为主的研发团队通过与国外用户和同行进行广泛的技术交流、消化吸收国外先进技术、经过多年的自主技术开发和行业实践获得的。虽然公司已经同核心技术人员签订了保密合同，且公司的核心技术不严重依赖部分技术人员，但如果核心技术人员流失、关键技术失密，仍将对公司的生产经营和发展造成不利影响。因此，公司存在核心技术人员流失、核心技术失密的风险。

## **三、控股股东用于出资的无形资产可能存在减值的风险**

2007年5月，控股股东丹依发展以“UV固化可剥离压敏胶膜”、“一种无舂刻蚀液”、“一种潜伏性固化剂的制造方法”及“用于芯片搭载及封装的电绝缘树脂浆”四项发明专利评估作价对丹邦有限出资4,623万元，四项发明专利涉及的技术是公司产品的基础性和关键技术，普遍运用于公司产品的关键材料、重要工艺和主要生产环节，四项发明专利对于公司产业链协同优势、技术优势及成本优势等核心竞争力的形成起到了决定性的作用，直接促成了公司核心竞争力的形成。

受2008年全球金融危机影响，公司所属行业受到巨大冲击，FPC下游产品需求疲软，出于谨慎性原则，公司主动对2008年末的上述无形资产计提了507.54万元的减值准备，但对2009年末的上述无形资产的减值测试表明四项发明专利不存在减值情形。四项发明专利对公司核心竞争力的形成起到了决定性的作用，并且公司拥有的其他多项专利技术是在上述四项专利的基础上的延伸和发展，但由于上述无形资产收益年限比较长，如果未来出现新的重大技术突破或者全球经济

环境发生重大不利变化，四项发明专利存在减值的风险。

## **四、财务风险**

### **（一）资产抵押风险**

截至2010年12月31日，公司将主要生产用房屋建筑物、机器设备、发明专利等资产为公司的银行借款提供抵押或质押担保。其中，用于抵押的房屋建筑物账面净值为12,605.36万元，占公司房屋建筑物净值比例的100%；用于抵押的机器设备账面净值为3,917.18万元，占公司全部机器设备比例的18.52%；用于质押的专利权账面净值为3,665.19万元，占公司全部专利权账面净值的100.00%。

根据抵押合同及质押合同的约定，如果公司不能按合同约定足额偿还银行贷款本息，亦不能通过协商解决，上述公司资产将被依法拍卖、变卖或折价等方式处分。因此公司存在因不能按时偿还银行贷款而丧失对该房屋建筑物、机器设备及专利技术的所有权，进而影响正常生产经营的风险。

### **（二）应收账款回收风险**

2008-2010年末，公司应收账款净额分别为6,521.74万元、5,589.65万元、4,592.96万元，占流动资产的比例分别为38.31%、42.14%、34.81%，占总资产的比例分别为13.41%、11.00%、8.13%。2008-2010年，公司应收账款周转率分别为3.36、2.88、4.04。公司主要客户资金实力较强且信誉良好，资金回收有保障，报告期内未发生过坏账损失。但随着公司业务规模的进一步扩大，应收账款余额可能继续增长，应收账款数额较大可能影响到资金周转速度和经营活动的现金流量；同时若出现回款不顺利或欠款方财务状况恶化的情况，则可能给公司带来坏账风险。

### **（三）汇率波动风险**

报告期内，公司的主营业务收入绝大部分来源于境外市场，2008-2010年，公司外销收入占主营业务收入比例分别为99.44%、99.03%和、98.25%。公司产品出口的主要结算货币为美元，报告期内，公司汇兑损益占净利润的比例较小，对

公司盈利影响较小，公司汇兑损益与当期净利润的比例如下：

单位：万元

| 项目    | 2010 年度  | 2009 年度  | 2008 年度  |
|-------|----------|----------|----------|
| 汇兑损益  | 165.71   | 234.75   | 72.21    |
| 净利润   | 5,268.05 | 4,663.14 | 3,514.35 |
| 占比（%） | 3.15     | 5.03     | 2.05     |

注：汇兑损益中负数表示汇兑收益，正数表示汇兑损失

自2005年7月21日我国改革人民币汇率形成机制以来，人民币兑美元汇率总体呈上升趋势，未来人民币仍可能保持升值趋势。本公司自接受订单、材料采购、生产到出口的整个业务周期主要集中在3-5个月期间，且主要采用美元结算。若人民币持续不断升值，将导致本公司出现汇兑损益，可能影响本公司的经营业绩。

## 五、募集资金投资项目风险

### （一）募集资金投资项目的市场风险

本次募集资金拟投向“基于柔性封装基板技术的芯片封装产业化项目”。该项目是根据公司现有业务良好的发展态势和经过充分市场调查的基础上提出的，并且公司在技术工艺、市场开拓、人员安排等方面经过精心准备，项目产品下游市场应用广泛，需求持续增长，具有良好的市场前景。公司已基于当前国内外市场环境、技术发展趋势、产品价格、原材料供应和工艺技术水平等因素作出审慎的可行性分析，若项目能得到顺利实施将会对公司提高技术工艺、提升产品档次、调整产品结构及完善公司产业链产生较大的作用，可以进一步提高公司核心竞争力和盈利能力。

虽然公司已就本项目工艺技术、设备选型、投资收益、市场容量等方面进行了充分的可行性论证，但由于市场情况不断发展变化，如果募集资金不能及时到位、项目延期实施、市场环境突变、整体经济状况大幅下滑或行业竞争加剧等情况发生，将会导致产品市场需求低于预期或者供求失衡，从而加剧市场竞争，加大募投项目的市场压力，影响募投项目的投资收益率。

### （二）固定资产折旧增加的风险

本次募集资金投资项目建成后，公司将新增固定资产33,000万元，项目建成

后，年新增折旧费约2,070万元。若公司成功发行股票并上市，募投项目顺利实施，将进一步丰富并优化公司产品结构，扩大公司规模，完善公司的产业链，有效增强产品的市场竞争能力和公司盈利能力，有助于公司业绩继续保持稳定增长。但是，如果市场环境、生产经营等方面发生重大不利变化，募集资金投入后没有达到预期的效益，则公司存在因固定资产折旧大量增加而导致利润下滑的风险。

## **六、企业所得税税收优惠政策变化的风险**

公司为生产性外商投资企业，自获利年度起，第一年和第二年免缴企业所得税，第三年至第五年减半缴纳企业所得税（即2006年至2007年免缴企业所得税，2008年至2010年减半缴纳所得税）。2007年5月，公司经批准调整了股权结构，外资股权比例从25%变更为12.67%，成为“外资比例低于25%”的外商投资企业。

但根据深圳市人民政府1988年8月1日《关于深圳特区企业税收政策若干问题的规定》（深府〔1988〕232号）第六条及第八条规定的规定，公司作为在深圳经济特区内设立的生产性企业，可享受“两免三减半”的税收优惠政策。公司2006年为开始获利年度，据此2006年度至2007年度可免征企业所得税，2008年度至2010年度减半征收企业所得税。

深圳市南山区地方税务局于2011年1月24日出具确认函确认发行人“根据深府〔1988〕232号文《深圳市人民政府关于深圳特区企业税收政策若干问题的规定》第八条规定，该公司无需补缴2006年1月1日起至2010年12月31日期间已免征、减征的企业所得税税款。”深圳市南山区国家税务局的具体行政行为属有效的具体行政行为，但若该具体行政行为被国家有权机关作出撤销的决定或人民法院作出撤销或认定无效的判决，则发行人2006年1月1日起至2010年12月31日期间已免征、减征的企业所得税税款可能存在被追缴的风险。

为此，公司控股股东丹邦投资集团以书面形式作出承诺：“发行人公开发行股票并上市后，若税收主管部门要求发行人补缴因其享受有关税收优惠政策而免征及少征的企业所得税，本公司将无条件全额承担发行人在本次发行上市前应补缴的税款及因此所产生的所有相关费用。”

## 七、实际控制人控制风险

本次公开发行股票前，公司实际控制人刘萍通过丹邦投资集团间接持有公司7,311.60万股股份，占公司本次发行前股本总额的60.93%。本次发行后，刘萍控制的股份比例降为45.70%，仍旧为公司实际控制人。

根据《公司法》等法律法规，公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作条例》、《关联交易规则》和《总经理工作细则》等内部规范性文件，形成了较为完善的内部控制制度。这些措施都从制度上规范了公司的运作，减少了实际控制人操纵公司的风险。但不能排除未来实际控制人通过行使股东权利或采取其他方式影响本公司的重大经营决策，对公司经营活动和长远发展产生不利影响。

## 第四节 发行人基本情况

### 一、发行人基本情况

- 1、中文名称：深圳丹邦科技股份有限公司  
英文名称：Shenzhen Danbond Technology Co., Ltd.
- 2、注册资本：12,000 万元
- 3、法定代表人：刘萍
- 4、成立日期：2001 年 11 月 20 日
- 5、股份公司设立日期：2009 年 6 月 5 日
- 6、公司住所：深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼
- 7、邮政编码：518052
- 8、联系电话：0755-26511518
- 9、传真号码：0755-26511718
- 10、互联网地址：<http://www.danbang.com/>
- 11、电子信箱：[szdbond@danbang.com](mailto:szdbond@danbang.com)

### 二、发行人的历史沿革及改制重组情况

#### （一）发行人设立方式及发起人

发行人前身为深圳丹邦科技有限公司，2009年2月23日，经丹邦有限2009年第2次董事会决议同意，丹邦有限全体股东签署《关于深圳丹邦科技有限公司按原账面净资产值折股整体变更为股份公司之发起人协议书》，一致同意将丹邦有限整体变更为外商投资股份有限公司，即以丹邦有限经审计的截至2008年12月31日的账面净资产人民币188,711,657.30元出资，按1:0.6359的比例折为股本12,000万股，每股面值人民币1元。

2009年5月7日，深圳市贸易工业局出具深贸工资复[2009]0944号批复，同意丹邦有限变更为外商投资股份有限公司。2009年5月13日，公司取得深圳市人民

政府颁发的商外资粤深股资证字[2009]0002号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。2009年6月5日，深圳市工商行政管理局核准本次变更，并颁发了《企业法人营业执照》，公司更名为深圳丹邦科技股份有限公司。

发行人设立时，各发起人股东及其持股数量、持股比例如下：

单位：万股

| 序号 | 股东名称           | 持股数量      | 持股比例    |
|----|----------------|-----------|---------|
| 1  | 深圳市丹邦投资有限公司    | 7,311.60  | 60.93%  |
| 2  | 深圳市丹依科技有限公司    | 2,160.00  | 18.00%  |
| 3  | 益关寿            | 1,520.40  | 12.67%  |
| 4  | 深圳市信瑞鸿网络科技有限公司 | 480.00    | 4.00%   |
| 5  | 深圳市华浩投资有限公司    | 480.00    | 4.00%   |
| 6  | 深圳市百顺投资管理有限公司  | 48.00     | 0.40%   |
|    | 合 计            | 12,000.00 | 100.00% |

截至本招股说明书签署之日，发行人上述股权结构未发生变化。

## （二）发行人改制设立前，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务

本公司的主要发起人为深圳市丹邦投资有限公司、深圳市丹依科技有限公司、益关寿，发行人整体变更设立时，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务如下：

### 1、深圳市丹邦投资有限公司

在发行人改制设立前，丹邦投资拥有的主要资产为长期股权投资。除投资本公司外，丹邦投资还持有广东东邦、典邦科技及第比尔国际的股权，具体如下：

| 公司名称  | 成立时间           | 注册资本/实收资本（万元）          | 持股比例                          | 主营业务                     |
|-------|----------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 广东东邦  | 2009年<br>1月13日 | 8,000.00<br>/4,000.00  | 直接持有 75%股权，<br>间接持有 25%股权     | 尚未开展生产与销售，主要从事购买土地使用权等活动 |
| 典邦科技  | 2008年<br>1月9日  | 10,000.00<br>/6,000.00 | 直接持有 25.5%股权，<br>间接持有 74.5%股权 | 从事液晶显示模组（LCM）产品的代工业务     |
| 第比尔国际 | 2004年<br>9月24日 | 10.00 万港元              | 100.00%                       | 股权投资                     |



在发行人改制设立前，丹邦投资无生产性经营业务，主营业务为投资兴办实业。

## 2、深圳市丹依科技有限公司

在发行人改制设立前，丹依科技主要资产为持有丹邦有限18%的股权。丹依科技主要业务为投资本公司，除此之外，没有控股或参股其他公司。

## 3、益关寿

在发行人设立前，除投资本公司外，益关寿先生还持有邦达集团、典邦柔性及丹邦柔性的股权，具体如下：

| 公司名称     | 成立时间       | 注册资本       | 持股比例   | 主营业务          | 备注                |
|----------|------------|------------|--------|---------------|-------------------|
| 邦达集团（香港） | 2006年6月24日 | 400.00万美元  | 23.33% | 纺织品、服装进出口贸易业务 | -                 |
| 典邦柔性     | 1999年4月5日  | 1,000.00万元 | 50.00% | 柔性电路板代工业务     | 2005年停业，已开始办理注销手续 |
| 丹邦柔性     | 1996年9月17日 | 500.00万元   | 60.00% | 柔性覆合铜板产品的代工业务 | 2004年停业，已注销       |

### （三）发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务

发行人由丹邦有限整体变更设立，继承了丹邦有限的全部资产、负债和权益。根据开元信德会计师出具的深审字（2009）第148号《审计报告》，公司截至2008年12月31日所拥有的主要资产为：流动资产17,337.14万元，其中存货为998.44万元；非流动资产为31,719.08万元，其中固定资产为27,179.16万元、无形资产为4,148.44万元。

发行人成立时继承了丹邦有限的全部业务：从事FPC、COF柔性封装基板及COF产品的研发、生产和销售。

### （四）发行人成立以来，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务

2009年11月，主要发起人丹邦投资集团（原丹邦投资）持有广东东邦、典邦科技及第比尔国际的股权比例变化如下：

| 公司名称  | 注册资本/实收资本（万元）        | 持股比例                       | 主营业务                     |
|-------|----------------------|----------------------------|--------------------------|
| 广东东邦  | 8,000.00 / 4,000.00  | 直接持有 75%股权，间接持有 24.75%股权   | 尚未开展生产与销售，主要从事厂房及配套设施的建设 |
| 典邦科技  | 10,000.00 / 6,000.00 | 直接持有 25.5%股权，间接持有 73.75%股权 | 从事液晶显示模组（LCM）产品的代工业务     |
| 第比尔国际 | 10.20 万港元            | 99.00%                     | 股权投资                     |

除此之外，各主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务与发行人改制设立前相比均未发生变化。

### **（五）业务流程**

发行人系由有限责任公司整体变更设立为股份公司，改制前后发行人的业务流程没有发生变化，具体业务流程参见本招股说明书第五节之“四、（三）1、经营模式业务流程”的有关内容。

### **（六）发行人成立后在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况**

发行人成立之后，拥有独立完整的采购、生产和销售系统，具备独立生产经营的能力，在生产经营方面与主要发起人无关联关系。

### **（七）发起人出资资产的产权变更**

截至本招股说明书签署之日，丹邦有限拥有的资产均已变更过户至股份公司名下。

## **三、发行人独立经营情况**

本公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求严格规范运作，在业务、机构、人员、资产、财务等方面与现有股东完全分开，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

### **（一）业务独立**

本公司具有独立的产、供、销业务体系，公司主要股东目前均未从事与本公司相同或相似的业务。公司具有完全独立的业务运作系统，主营业务收入和营业利润也不存在依赖于股东及其他关联方的关联交易，同时也不存在受制于公司股东及其他关联方的情况。

公司在2009年8月之前，应部分客户及供应商对交易对方注册地的要求，以及为报关及结算外汇方便，公司部分出口销售及境外设备、原材料的采购在形式上经由实际控制人控制的第比尔国际进行，第比尔国际在整个销售和采购环节中只起到了桥梁作用，并不影响本公司销售体系、采购体系的完整性以及业务的独

立性。

在境外销售方面，本公司独立掌握所有实际客户资源，直接与实际客户洽谈销售合同。本公司和实际客户确认具体合同或订单内容（包括品种、规格型号、数量、价格、交货期及结算方式等），并根据终端客户的订单要求，进行研发、生产并从中国大陆境内直接发货至终端客户指定的中转仓库。终端客户根据合同的约定向第比尔国际支付款项，第比尔国际在收到货款后及时回款给本公司，本公司在整个出口销售过程中拥有控制权，第比尔国际在本公司的出口销售业务中仅承担对海外客户的货款回收、国际结算作用，并不具有市场开拓等实际销售功能。

在境外采购方面，本公司直接与实际供应商洽谈采购合同。本公司和实际供应商确认采购合同条款（包括品种、规格型号、数量、价格、交货期、交货方式及结算方式等内容）；合同签订后，本公司根据合同的约定向第比尔国际支付采购款项，第比尔国际在收到公司支付的款项后再向境外实际供应商支付采购款；境外供应商将设备或原材料发送至第比尔国际，再由第比尔国际将货物从香港发送至境内。本公司在整个境外采购过程中拥有控制权，第比尔国际在本公司的境外采购业务中仅承担对境外实际供应商的采购款支付、国际结算等作用。

自2008年5月起，公司全资子公司丹邦香港开始承接原来通过第比尔国际进行的境外销售和境外采购业务，截至2009年8月，原来通过第比尔国际签订的境外销售订单（合同）及境外采购订单（合同）均已履行完毕，境外采购与销售业务不再通过第比尔国际进行。丹邦香港在承接第比尔国际境外销售采购业务过程中，不存在客户资源流失的情况，没有对本公司出口销售业务带来不利影响，也没有对本公司境外的设备、原材料等采购业务带来不利影响。

## **（二）资产独立完整**

公司拥有完整的生产经营性资产、相关生产技术和配套设施、工艺流程、独立完整的供货和销售系统等。对与生产经营相关的厂房、土地、设备等资产均合法拥有所有权或使用权，与公司生产经营相关的商标由公司独立、合法拥有。公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所而进行生产经营的情况。目前公司没有以资产或信用为各股东的债务提供担保，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。

### **（三）人员独立**

公司拥有独立的人事管理部门，独立负责员工的劳动、人事和工资管理，与公司股东、实际控制人的相关管理体系完全分离；公司依照国家及地方的企业劳动、人事和工资管理规定，制定了一整套完整独立的劳动、人事及工资管理制度。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书均没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

### **（四）机构独立**

根据《公司章程》，公司设有股东大会、董事会、监事会以及公司各级管理部门等机构，各机构独立于股东运作，依法行使各自职权。公司建立了较为高效完善的组织结构，拥有完整的采购、生产和销售系统及配套服务部门，不存在与股东单位混合经营、合署办公的情况。

### **（五）财务独立**

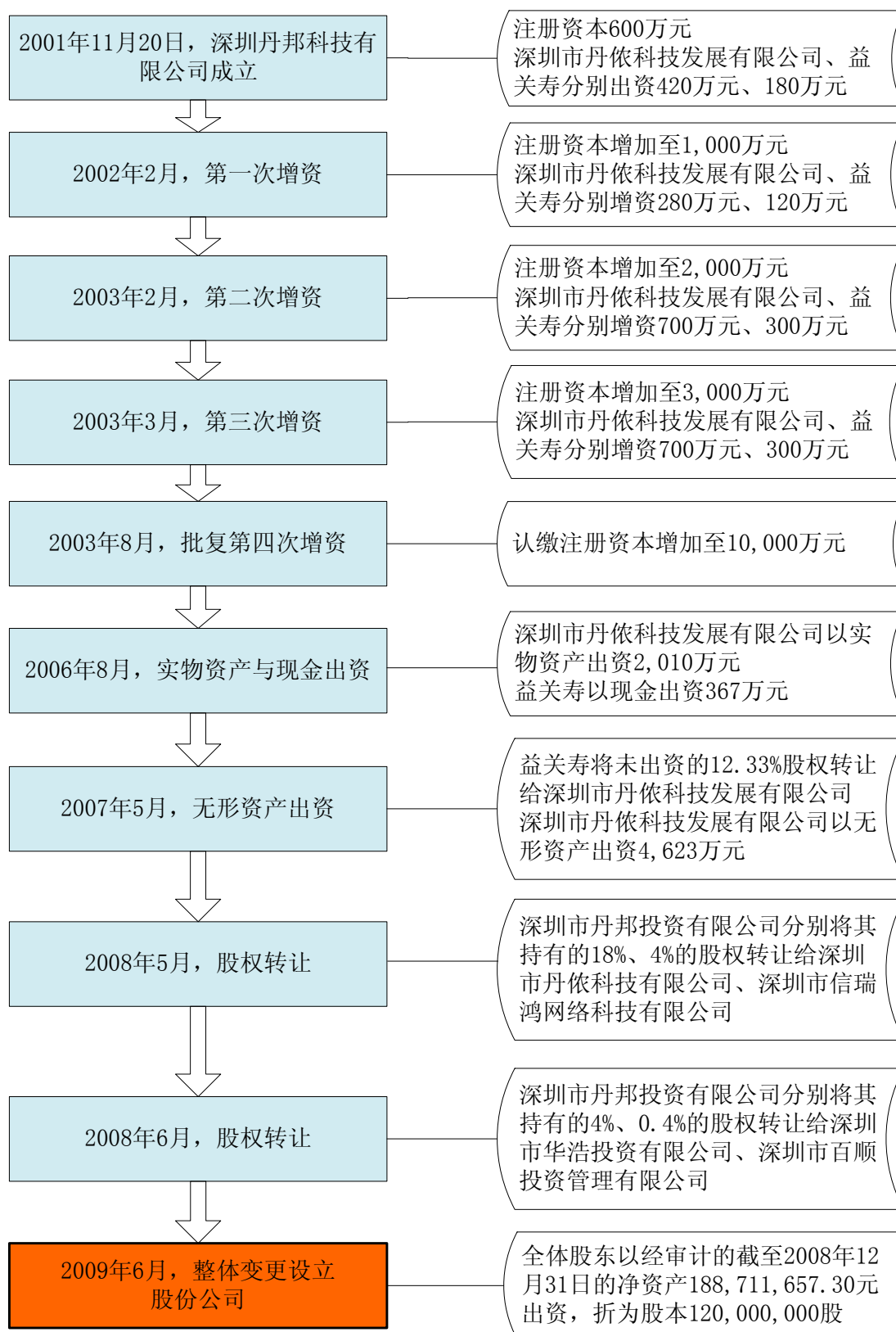
公司设立后，已按照《企业会计准则》的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并实施严格的财务监督管理。公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税；公司独立作出财务决策，独立对外签订合同，不受股东或其他单位干预或控制；公司未为股东提供担保，公司对所有的资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被股东占用或其他损害公司利益的情况。

综上所述，公司目前已建立了独立完整的供应、生产和销售系统，在业务、资产、人员、机构、财务等方面均与股东完全分开，实现了独立运作，具有独立完整的业务及面向市场自主开发经营的能力。

## 四、发行人的股本形成及重大资产重组情况

### （一）发行人的股本形成过程

本公司自设立以来的历次股本变动情况如下图所示：



## 1、2001年11月公司前身丹邦有限成立

2001年10月28日，刘萍控制的丹侬发展与益关寿签订《深圳丹邦科技有限公司合同》和《深圳丹邦科技有限公司章程》，双方约定以货币资金出资共同设立丹邦有限，合营企业期限为10年，投资总额600万元，注册资本600万元，其中丹侬发展出资420万元，益关寿出资180万元。

2001年11月12日，深圳市对外贸易经济合作局出具深外经贸资复[2001]0523号批复同意设立丹邦有限，2001年11月13日，公司取得深圳市人民政府颁发的外经贸粤深合资证字[2001]0328号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，2001年11月20日，公司领取深圳市工商行政管理局颁发的注册号为企合粤深总字第109685号企业法人营业执照。

2001年12月10日，深圳华鹏会计师事务所出具了华鹏验字[2001]163号验资报告，验证截至2001年12月4日，丹邦有限已收到股东缴纳的注册资本合计人民币600万元，均为货币资金。合资双方的出资金额及持股比例如下：

单位：万元

| 序号 | 股东名称 | 出资金额   | 持股比例    |
|----|------|--------|---------|
| 1  | 丹侬发展 | 420.00 | 70.00%  |
| 2  | 益关寿  | 180.00 | 30.00%  |
|    | 合 计  | 600.00 | 100.00% |

## 2、2002年2月增资

2002年1月22日，经丹邦有限董事会决议同意，丹侬发展与益关寿签订《深圳丹邦科技有限公司补充合同》与《深圳丹邦科技有限公司补充章程》，约定丹邦有限投资总额及注册资本增加400万元，其中丹侬发展现金增资280万元，益关寿现金增资120万元。2002年1月30日，深圳市对外贸易经济合作局以深外经贸资复[2002]0294号批复同意双方签订的《深圳丹邦科技有限公司补充合同》及本次增资。同日，公司取得深圳市人民政府换发的外经贸粤深合资证字[2001]0328号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2002年2月5日，深圳华鹏会计师事务所出具了华鹏验字[2002]013号验资报告，验证截至2002年1月29日，丹邦有限已收到各方缴纳的新增注册资本合计人民币400万元，均为货币资金。2002年2月19日，深圳市工商局核准本次增资的工

商变更登记。增资后合资双方的出资金额及持股比例如下：

单位：万元

| 序号 | 股东名称 | 出资金额     | 持股比例    |
|----|------|----------|---------|
| 1  | 丹侬发展 | 700.00   | 70.00%  |
| 2  | 益关寿  | 300.00   | 30.00%  |
|    | 合 计  | 1,000.00 | 100.00% |

### 3、2003 年 2 月增资

2002年11月1日，经丹邦有限董事会决议同意，丹侬发展与益关寿签订《深圳丹邦科技有限公司补充合同》与《深圳丹邦科技有限公司补充章程》，约定丹邦有限投资总额及注册资本增加1,000万元，其中，丹侬发展现金增资700万元，益关寿现金增资300万元。2002年11月14日，深圳市对外贸易经济合作局以深外经贸资复[2002]3952号批复同意丹邦有限合资双方签订的《深圳丹邦科技有限公司补充合同》及本次增资。2002年11月15日，公司取得深圳市人民政府换发的外经贸粤深合资证字[2001]0328号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2003年2月18日，深圳华鹏会计师事务所出具华鹏验字[2003]064号验资报告，验证截至2003年2月17日，丹邦有限已收到各方缴纳的新增注册资本合计人民币1,000万元，均为货币资金。2003年2月27日，深圳市工商局核准本次增资的工商变更登记。增资后合资双方的出资金额及持股比例如下：

单位：万元

| 序号 | 股东名称 | 出资金额     | 持股比例    |
|----|------|----------|---------|
| 1  | 丹侬发展 | 1,400.00 | 70.00%  |
| 2  | 益关寿  | 600.00   | 30.00%  |
|    | 合 计  | 2,000.00 | 100.00% |

### 4、2003 年 3 月增资

2003年3月6日，经丹邦有限董事会决议同意，丹侬发展与益关寿签订《深圳丹邦科技有限公司补充合同》与《深圳丹邦科技有限公司补充章程》，约定丹邦有限投资总额及注册资本增加1,000万元，其中，丹侬发展现金增资700万元，益关寿现金增资300万元。2003年3月21日，深圳市对外贸易经济合作局以深外经贸资复[2003]0951号批复同意合资双方签订的《深圳丹邦科技有限公司补充合同》及本次增资。2003年3月24日，公司取得深圳市人民政府换发的外经贸粤深合资

证字[2001]0328号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2003年3月31日，深圳市工商局核准本次增资的工商变更登记。2003年6月9日，深圳华鹏会计师事务所出具了华鹏验字[2003]303号验资报告，验证截至2003年5月30日，丹邦有限已收到各方缴纳的新增注册资本合计人民币1,000万元，均为货币资金。增资后合资双方的出资金额及持股比例如下：

单位：万元

| 序号 | 股东名称 | 出资金额     | 持股比例    |
|----|------|----------|---------|
| 1  | 丹侬发展 | 2,100.00 | 70.00%  |
| 2  | 益关寿  | 900.00   | 30.00%  |
|    | 合 计  | 3,000.00 | 100.00% |

截至2003年6月，丹邦有限实收资本3,000万元，其中，丹侬发展现金出资2,100万元，占注册资本的70%，出资来源为刘萍与刘文魁投入丹侬发展的资金（截至2003年6月，丹侬发展的注册资本为4,200万元，其中刘萍出资比例为85%，刘文魁的出资比例为15%）；外方股东益关寿出资900万元，占注册资本的30%，出资来源为益关寿多年经营积累的自有资金。

## 5、2006年8月及2007年5月增资

### （1）2003年8月外资主管部门批复同意增资7,000万元

2003年7月15日，经丹邦有限董事会决议同意，丹侬发展与益关寿签订《深圳丹邦科技有限公司补充合同》与《深圳丹邦科技有限公司补充章程》，一致决定丹邦有限投资总额由3,000万元增加至18,000万元，注册资本由3,000万元增加至10,000万元。其中，丹侬发展以机械设备增资5,400万元，益关寿以机械设备增资1,600万元，7,000万元增资应于变更登记后三年内缴付完毕。2003年8月5日，深圳市对外贸易经济合作局以深外经贸资复[2003]2775号批复同意丹邦有限合资双方签订的《深圳丹邦科技有限公司补充合同》及本次增资。2003年8月6日，公司取得深圳市人民政府换发的外经贸粤深合资证字[2001]0328号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2003年8月14日，公司办理完毕本资增资的工商变更登记手续，该次变更后合资双方的认缴出资、实缴出资及持股比例如下：



单位：万元

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资金额    | 实缴出资金额   | 持股比例    |
|----|------|-----------|----------|---------|
| 1  | 丹侬发展 | 7,500.00  | 2,100.00 | 75.00%  |
| 2  | 益关寿  | 2,500.00  | 900.00   | 25.00%  |
|    | 合 计  | 10,000.00 | 3,000.00 | 100.00% |

### **(2) 2006年4月延长出资期限**

考虑到股东出资未能及时到位，2006年4月15日，经丹邦有限董事会决议同意，丹侬发展与益关寿签订《深圳丹邦科技有限公司补充合同》与《深圳丹邦科技有限公司补充章程》，双方一致决定同意新增注册资本7,000万元的缴付期延长六个月，于变更登记后的三年六个月内缴付完毕，并延长公司经营期限5年。2006年4月19日，深圳市贸易工业局以深贸工资复[2006]0657号批复同意本次《深圳丹邦科技有限公司补充合同》，同日，公司取得深圳市人民政府换发的外经贸粤深合资证字[2001]0328号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

### **(3) 2006年8月变更出资方式，以实物资产及现金出资合计2,377万元**

2006年7月6日，丹侬发展与益关寿签订《深圳丹邦科技有限公司补充合同》与《深圳丹邦科技有限公司补充章程》，双方一致同意将注册资本7,000万元的出资方式变更为：丹侬发展增资5,400万元，其中实物资产2,010万元，现金人民币3,390万元；益关寿现金增资1,600万元。

2006年7月19日，深圳市南山区贸易工业局作出深外资南复[2006]0372号《关于合资企业“深圳丹邦科技有限公司”修改公司章程的批复》，批复同意丹邦有限合营双方变更增资出资方式。

丹侬发展本次用于出资的实物资产为生产FPC等产品所需的机械设备、电子设备及车辆等资产，该等实物资产在丹侬发展的账面净值为2,030万元。为了给丹侬发展向丹邦有限投资的固定资产提供价值参考，受丹侬发展的委托，深圳市国友大正资产评估有限公司对出资的实物资产进行了评估，并于2006年7月5日出具了国友大正评报字[2006]第A055号资产评估报告书，根据该资产评估报告书，截至2006年6月30日，上述资产账面净值为2,030.00万元，采用重置成本法进行评估，评估值为20,101,150.00元，评估增值率为-0.98%。

2006年7月9日，丹邦有限与合营双方丹侬发展、益关寿签署《实物价值确认

书》，一致同意国友大正评报字[2006]第A055号资产评估报告书评估结果，确认丹依发展用以出资的实物资产价值为20,101,150.00元。2006年7月10日，丹依发展与丹邦有限签署《实物资产移交清单》，将用于出资的实物资产移交至丹邦有限，其中包括机器设备222台、电子设备289台及车辆2台。

2006年8月9日，深圳星源会计师事务所出具了深星源验字[2006]第0333号验资报告对本次出资进行了验证。验证截至2006年7月24日，丹邦有限已收到各方缴纳的新增注册资本合计人民币2,377万元。丹依发展以经评估的实物资产20,101,150元出资，其中2,010万元作为资本金，1,150元列入资本公积；益关寿以货币出资367万元。

该次出资后，合资双方的认缴出资、实缴出资及持股比例如下：

单位：万元

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资金额    | 实缴出资金额   | 持股比例    |
|----|------|-----------|----------|---------|
| 1  | 丹依发展 | 7,500.00  | 4,110.00 | 75.00%  |
| 2  | 益关寿  | 2,500.00  | 1,267.00 | 25.00%  |
|    | 合 计  | 10,000.00 | 5,377.00 | 100.00% |

#### (4) 2007年4月变更出资比例及出资方式，2007年5月以无形资产出资4,623万元

鉴于注册资本尚有4,623万元未到位，经丹邦有限2007年1月28日董事会决议同意，2007年4月12日，丹依发展与益关寿签订《深圳丹邦科技有限公司补充合同》和《深圳丹邦科技有限公司补充章程》，约定由丹依发展承接外方股东益关寿自愿放弃的未缴付出资额1,233万元（12.33%股权），丹依发展以无形资产补足实收资本。尚未缴付的出资4,623万元须于变更登记后的6个月内缴付完毕。

2007年4月28日，益关寿与丹依发展签订《股权转让协议书》，约定益关寿将其未出资部分1,233万元（12.33%股权）以人民币1元的价格转让给丹依发展。该《股权转让协议书》已经深圳国际高新技术产权交易所深高交所见[2007]字第2659号股权转让见证书见证。根据上述约定，公司出资比例及出资方式变更为：丹依发展对丹邦有限出资合计8,733万元，其中现金2,100万元，实物资产2,010万元，无形资产4,623万元；益关寿现金出资1,267万元。

2007年4月29日，深圳市贸易工业局出具深贸工资复[2007]1064号批复，同

意双方签订的上述股权转让协议、《深圳丹邦科技有限公司补充合同》和《深圳丹邦科技有限公司补充章程》。2007年4月30日，公司取得深圳市人民政府换发的外经贸粤深合资证字[2001]0328号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

受刘萍、丹邦有限及丹依发展的委托，为了给委托方了解四项发明专利的价值及投资入股提供价值参考，深圳中联岳华会计师事务所对四项发明专利采用收益法进行了评估，并于2007年1月21日出具深中岳评报字[2007]第007号资产评估报告书，四项发明专利于评估基准日2006年12月31日评估值为4,843万元。考虑到本次出资之前公司股东认缴的注册资本为10,000万元，实收资本为5,377万元，尚有4,623万元出资未缴纳，经2007年1月28日丹邦有限董事会决议同意，丹依发展以上述无形资产的评估值为参考作价4,623万元补足实收资本。

2007年4月23日，中联会计师事务所有限公司深圳分所出具了中联深所验字[2007]第081号验资报告对此次无形资产出资进行了验证。验证截至2007年3月23日，丹邦有限已收到丹依发展缴纳的新增注册资本合计人民币4,623万元，全部为知识产权出资。于2007年3月15日投入专利权“用于芯片搭载及封装的电绝缘树脂浆”、于2007年3月21日投入专利权“UV固化可剥离压敏胶膜”、于2007年3月22日投入专利权“一种潜伏性固化剂的制造方法”及“一种无胍刻蚀液”，四项发明专利评估价值为4,843万元，全体股东确认的价值为4,623万元。

发明专利“UV固化可剥离压敏胶膜”、“一种无胍刻蚀液”、“一种潜伏性固化剂的制造方法”的专利权人已于2007年3月30日变更登记为丹邦有限，“用于芯片搭载及封装的电绝缘树脂浆”的专利申请人已于2007年3月23日由丹依发展变更为丹邦有限，且于2008年10月1日由丹邦有限获得专利授权。

2007年5月15日，深圳市工商局核准本次变更登记。本次出资后，公司注册资本全部出资到位，合资双方的出资金额及持股比例如下：

单位：万元

| 序号 | 股东名称 | 出资金额      | 持股比例    |
|----|------|-----------|---------|
| 1  | 丹依发展 | 8,733.00  | 87.33%  |
| 2  | 益关寿  | 1,267.00  | 12.67%  |
|    | 合 计  | 10,000.00 | 100.00% |

关于本次无形资产出资的详细说明参见本节之“四、（二）关于2007年5月

以无形资产出资的说明”。

2007年9月14日，中方股东丹依发展更名为深圳市丹邦投资有限公司。

## 6、2008年5月股权转让

### （1）股权转让情况

经2008年4月20日丹邦有限董事会决议同意，丹邦投资将其持有丹邦有限18%的股权、4%的股权分别转让给丹依科技与信瑞鸿网络，丹邦投资、益关寿、丹依科技、信瑞鸿网络签订了《合资经营深圳丹邦科技有限公司合同》和《合资经营深圳丹邦科技有限公司章程》。根据丹邦投资与丹依科技签订的《股权转让合同》，丹邦投资将其持有丹邦有限18%的股权计1,800万元出资以人民币1,800万元的价格转让给丹依科技；根据丹邦投资与信瑞鸿网络签订的《股权转让合同》及补充协议，丹邦投资将其持有丹邦有限4%的股权计400万元出资以人民币3,870万元的价格转让给信瑞鸿网络。深圳市南山区公证处分别出具了（2008）深南证字第3412、（2008）深南证字第3411号公证书对上述《股权转让合同》进行了公证。

2008年5月13日，深圳市南山区贸易工业局以深外资南复[2008]0174号批复同意各方签订的《合资经营深圳丹邦科技有限公司合同》、《合资经营深圳丹邦科技有限公司章程》及本次股权转让。2008年5月14日，公司取得深圳市人民政府换发的外经贸粤深合资证字[2001]0328号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。2008年5月29日，深圳市工商局核准本次股权转让的工商变更登记。本次股权转让后，各方出资金额及持股比例如下：

单位：万元

| 序号 | 股东名称  | 出资金额      | 持股比例    |
|----|-------|-----------|---------|
| 1  | 丹邦投资  | 6,533.00  | 65.33%  |
| 2  | 益关寿   | 1,267.00  | 12.67%  |
| 3  | 丹依科技  | 1,800.00  | 18.00%  |
| 4  | 信瑞鸿网络 | 400.00    | 4.00%   |
|    | 合 计   | 10,000.00 | 100.00% |

### （2）股权转让背景

信瑞鸿网络为丹邦有限引进的外部投资者，丹邦有限通过引进外部投资者，

有利于改善股权结构，加强外部监督，提高公司治理水平。信瑞鸿网络认为丹邦有限发展前景良好且竞争优势突出，自愿受让股权。

丹依科技成立于2008年4月11日，注册资本与实收资本均为100万元，法定代表人为刘文魁。截至本招股说明书签署之日，丹依科技股东及股权结构如下：

单位：万元

| 序号 | 股东名称 | 出资金额   | 持股比例    |
|----|------|--------|---------|
| 1  | 刘文魁  | 50.00  | 50.00%  |
| 2  | 王李懿  | 25.00  | 25.00%  |
| 3  | 邹盛和  | 25.00  | 25.00%  |
|    | 合 计  | 100.00 | 100.00% |

刘文魁是实际控制人刘萍的侄子，刘文魁的父亲在刘萍创业初期曾给予过资金支持，刘文魁自2005年起一直跟随刘萍在丹邦有限工作；王李懿与邹盛和是刘萍早年相识的同事和朋友，在刘萍早期开展有关技术的实验研究期间曾先后多次出借资金给予刘萍用于购买材料进行研究。刘萍当时曾承诺在其今后创业设立公司后，分别给予他们一定数量的股权。2008年，丹邦有限开始筹划改制上市，刘萍决定兑现对三个创业伙伴的承诺，由丹邦投资将其持有丹邦有限18%的股权以1,800万元的价格转让给刘文魁、王李懿、邹盛和投资设立的丹依科技。

### （3）股权转让价格及资金来源

信瑞鸿网络受让股权的价格为每单位出资额9.675元，以丹邦有限2007年的业绩测算，其价格为22.6倍市盈率，是丹邦投资与信瑞鸿网络在自愿平等的基础上协商一致的结果，定价是公允的。信瑞鸿网络受让股权的资金来源为其股东郝昕以自有资金投入的注册资金，以及郝昕以其自有资金向信瑞鸿网络提供的借款。郝昕的资金来源系其历年经营所得。

丹依科技受让股权的价格为注册资本面值。丹邦投资将其持有丹邦有限的股权按照注册资本面值的价格转让给丹依科技，是刘萍在改制上市前兑现当初对王李懿、邹盛和、刘文魁三个创业伙伴给予部分股权的承诺，因此于2008年4月由丹邦投资将其持有丹邦有限18%的股权以人民币1,800万元的价格转让给王李懿、邹盛和及刘文魁三个创业伙伴投资设立的丹依科技。丹依科技受让股权的资金来源为自然人股东以自有资金投入的注册资金，以及丹依科技向股东的借款。丹依

科技自然人股东出资的资金来源均为股东本人的薪酬收入及其他家庭收入。

## 7、2008 年 6 月股权转让

### （1）股权转让情况

经2008年6月3日丹邦有限董事会决议同意，丹邦投资将其持有丹邦有限4%的股权、0.4%的股权分别转让给华浩投资和百顺投资。根据丹邦投资与华浩投资、百顺投资签订的《股权转让合同》，丹邦投资将其持有丹邦有限4%的股权计400万元出资以人民币3,870万元的价格转让给华浩投资，将其持有丹邦有限0.4%的股权计40万元出资以人民币387万元的价格转让给百顺投资，深圳市南山区公证处分别出具了（2008）深南证字第4377号、（2008）深南证字第4405号公证书对上述《股权转让合同》进行了公证。同日，丹邦投资、益关寿、丹依科技、信瑞鸿、华浩投资及百顺投资签订了《深圳丹邦科技有限公司补充合同》和《深圳丹邦科技有限公司补充章程》。

2008年6月19日，深圳市南山区贸易工业局以深外资南复[2008]0222号批复同意各方签订的《深圳丹邦科技有限公司补充合同》、《深圳丹邦科技有限公司补充章程》及本次股权转让。同日，公司取得深圳市人民政府换发的外经贸粤深合资证字[2001]0328号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。2008年6月29日，深圳市工商局核准本次股权转让的工商变更登记。本次股权转让后，各方出资金额及持股比例如下：

单位：万元

| 序号 | 股东名称  | 出资金额      | 持股比例    |
|----|-------|-----------|---------|
| 1  | 丹邦投资  | 6,093.00  | 60.93%  |
| 2  | 益关寿   | 1,267.00  | 12.67%  |
| 3  | 丹依科技  | 1,800.00  | 18.00%  |
| 4  | 信瑞鸿网络 | 400.00    | 4.00%   |
| 5  | 华浩投资  | 400.00    | 4.00%   |
| 6  | 百顺投资  | 40.00     | 0.40%   |
|    | 合 计   | 10,000.00 | 100.00% |

### （2）股权转让背景

华浩投资和百顺投资为丹邦有限引进的外部投资者，丹邦有限通过引进外部投资者，有利于改善股权结构，加强外部监督，提高公司治理水平。华浩投资和

百顺投资均认为丹邦有限发展前景良好且竞争优势突出，自愿受让股权。

### **(3) 股权转让价格及资金来源**

经转让双方协商，本次股权转让价格确定为每单位出资额9.675元。上述价格以2007年的业绩测算，其价格为22.6倍市盈率，该价格是丹邦投资与外部投资者在自愿平等的基础上协商一致的结果，定价是公允的。

华浩投资受让股权的资金来源为其股东张敏以自有资金投入的注册资金，以及张敏以其自有资金向华浩投资提供的借款。上述资金系张敏的历年经营所得。

百顺投资受让股权的资金来源均为其自然人股东吴丽玲、吴慧玲以自有资金投入的注册资金，以及百顺投资向股东的借款。吴丽玲、吴慧玲出资的资金来源均为其本人的历年经营所得。

## **8、2009年6月股份公司设立**

2009年2月23日，经深圳丹邦科技有限公司2009年第2次董事会决议同意，深圳市丹邦投资有限公司、深圳市丹依科技有限公司、益关寿、深圳市信瑞鸿网络科技有限公司、深圳市华浩投资有限公司及深圳市百顺投资管理有限公司签署《关于深圳丹邦科技有限公司按原账面净资产值折股整体变更为股份公司之发起人协议书》，一致同意将丹邦有限按原账面净资产值折股整体变更为外商投资股份有限公司，各发起人以丹邦有限经审计的截至2008年12月31日的账面净资产人民币188,711,657.30元出资，按1:0.6359的比例折为股本12,000万股，每股面值人民币1元。

2009年5月7日，深圳市贸易工业局出具深贸工资复[2009]0944号批复，同意丹邦有限变更为外商投资股份有限公司；2009年5月13日，公司取得深圳市人民政府颁发的商外资粤深股资证字[2009]0002号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2009年5月14日，开元信德会计师出具了开元信德深分验字（2009）第024号验资报告，验证截至2009年5月14日，丹邦有限已将净资产188,711,657.30元折为股本120,000,000元。

2009年5月20日，股份公司创立大会同意设立股份公司。2009年6月5日，深

圳市工商行政管理局核准本次变更，并颁发了注册号为440301502019128的《企业法人营业执照》，公司更名为深圳丹邦科技股份有限公司。

发行人设立时，各发起人股东的持股数量及持股比例如下：

单位：万股

| 序号 | 股东名称  | 持股数量      | 持股比例    |
|----|-------|-----------|---------|
| 1  | 丹邦投资  | 7,311.60  | 60.93%  |
| 2  | 丹依科技  | 2,160.00  | 18.00%  |
| 3  | 益关寿   | 1,520.40  | 12.67%  |
| 4  | 信瑞鸿网络 | 480.00    | 4.00%   |
| 5  | 华浩投资  | 480.00    | 4.00%   |
| 6  | 百顺投资  | 48.00     | 0.40%   |
|    | 合 计   | 12,000.00 | 100.00% |

截至本招股说明书签署之日，发行人上述股权结构未发生变化。2009年6月26日，控股股东深圳市丹邦投资有限公司更名为深圳丹邦投资集团有限公司。

## （二）关于 2007 年 5 月以无形资产出资的说明

### 1、无形资产出资过程

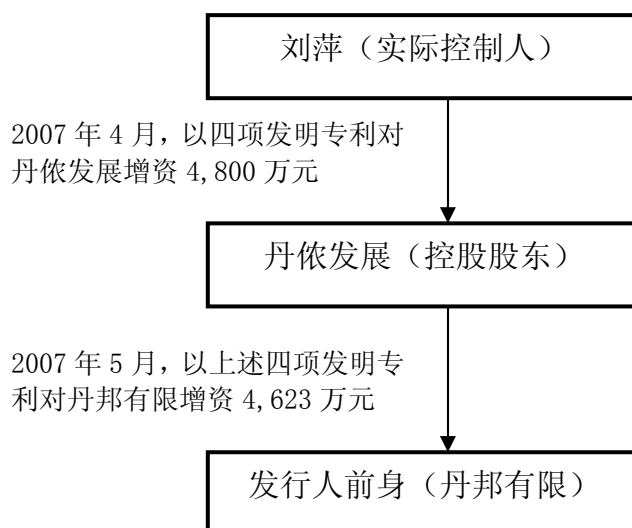
丹依发展本次用于出资的无形资产包括“UV 固化可剥离压敏胶膜”等四项发明专利。四项发明专利于 2007 年 5 月出资至丹邦有限之前具体情况如下：

| 专利名称             | 专利号              | 专利类别 | 申请日期       | 批准日期       | 发明人 | 专利权人/申请人 |
|------------------|------------------|------|------------|------------|-----|----------|
| 一种无胂刻蚀液          | ZL200310111758.4 | 发明   | 2003-10-9  | 2006-9-6   | 刘萍  | 刘萍       |
| 用于芯片搭载及封装的电绝缘树脂浆 | ZL200310111843.0 | 发明   | 2003-10-17 | 申请中        | 刘萍  | 刘萍       |
| 一种潜伏性固化剂的制造方法    | ZL200310110798.7 | 发明   | 2003-10-22 | 2005-11-23 | 刘萍  | 刘萍       |
| UV 固化可剥离压敏胶膜     | ZL200410022029.6 | 发明   | 2004-3-11  | 2006-6-21  | 刘萍  | 刘萍       |

注：2007 年 5 月出资时，四项发明专利中三项已获授权，发明专利“用于芯片搭载及封装的电绝缘树脂浆”尚在申请过程中，该项专利在 2008 年 10 月 1 日获得授权后专利权人即为丹邦有限，以下统称“四项发明专利”。

本次无形资产出资过程具体如下：





### **（1）刘萍以四项发明专利作价 4,800 万元向丹依发展增资**

2007 年 1 月 10 日，经控股股东丹依发展股东会决议同意，丹依发展注册资本从 4,200 万元增加至 9,000 万元，由刘萍以无形资产出资 4,800 万元。

受刘萍、丹邦有限及丹依发展的委托，为了给委托方了解四项发明专利的价值及投资入股提供价值参考，深圳中联岳华会计师事务所对四项发明专利采用收益法进行了评估，并于 2007 年 1 月 21 日出具深中岳评报字[2007]第 007 号资产评估报告书，上述四项发明专利于评估基准日 2006 年 12 月 31 日评估值为 4,843 万元。

鉴于 2007 年 1 月 10 日丹依发展股东会决定由刘萍以无形资产出资 4,800 万元，因此，刘萍决定以上述经评估的四项发明专利 4,843 万元作价 4,800 万元出资至丹依发展。

2007 年 4 月 20 日，中联会计师事务所有限公司深圳分所出具了中联深所验字[2007]第 0076 号验资报告对此次无形资产出资进行了验证。截至 2007 年 3 月 22 日，丹依发展已收到刘萍缴纳的新增注册资本合计人民币 4,800 万元，全部为知识产权出资。

2007 年 4 月 25 日，深圳市工商局核准丹依发展本次增资的变更登记申请。

### **（2）丹依发展以四项发明专利作价 4,623 万元向丹邦有限增资**

2007 年 4 月 12 日，丹依发展与益关寿签订《深圳丹邦科技有限公司补充合同》和《深圳丹邦科技有限公司补充章程》，约定由丹依发展承接外方股东益关寿自愿放弃的未缴付出资部分 1,233 万元（12.33%股权），丹依发展以无形资产

补足实收资本。根据上述约定，丹侬发展需要向丹邦有限增资 4,623 万元，出资方式为无形资产。2007 年 4 月 29 日，深圳市贸易工业局出具深贸工资复[2007]1064 号批复，同意双方签订的上述股权转让协议、《深圳丹邦科技有限公司补充合同》和《深圳丹邦科技有限公司补充章程》。

根据深圳中联岳华会计师事务所 2007 年 1 月 21 日出具的深中岳评报字[2007]第 007 号资产评估报告，四项发明专利于评估基准日 2006 年 12 月 31 日的评估值为 4,843 万元。经 2007 年 1 月 28 日丹邦有限董事会决议同意，丹侬发展以上述无形资产的评估值为参考作价 4,623 万元补足实收资本。

2007 年 4 月 23 日，中联会计师事务所有限公司深圳分所出具了中联深所验字[2007]第 081 号验资报告对此次无形资产出资进行了验证，截至 2007 年 3 月 23 日，丹邦有限已收到丹侬发展缴纳的新增注册资本合计人民币 4,623 万元，全部为知识产权出资。于 2007 年 3 月 15 日投入专利权“用于芯片搭载及封装的电绝缘树脂浆”、于 2007 年 3 月 21 日投入专利权“UV 固化可剥离压敏胶膜”、于 2007 年 3 月 22 日投入专利权“一种潜伏性固化剂的制造方法”及“一种无胍刻蚀液”，该四项发明专利权评估价值为 4,843 万元，全体股东确认的价值为 4,623 万元。

发明专利“UV 固化可剥离压敏胶膜”、“一种无胍刻蚀液”、“一种潜伏性固化剂的制造方法”的专利权人已于 2007 年 3 月 30 日变更登记为丹邦有限，“用于芯片搭载及封装的电绝缘树脂浆”的专利申请人已于 2007 年 3 月 23 日由丹侬发展变更为丹邦有限。

2007 年 5 月 15 日，深圳市工商局核准丹邦有限本次增资的变更登记申请。

## **2、四项发明专利的来源**

### **(1) 研发前期知识准备及经验积累**

刘萍 1994 年至 1996 年在成都科技大学师从我国著名的高分子材料专家蔡兴贤教授从事高分子材料及柔性电路材料方面的学习与研究，在此期间积累了高分子材料及柔性电路材料的专业知识。1999 年 4 月担任典邦柔性总经理，在工作期间，刘萍发现生产柔性电路产品特别是高端柔性电路产品所需基材和辅材大多

依赖进口，外购材料大大增加了产品成本，难以形成产业链优势，公司缺乏核心竞争力，这进一步激发了其对柔性电路材料领域研究的浓厚兴趣。此后，刘萍结合实践经验搜集并阅读了大量国内外行业书籍及研究资料。

**(2) 研发及形成过程**

经过全面的学习和周密的研究，刘萍利用自身专业知识，参阅了大量的技术资料，1999 年底开始，自己向朋友借钱购置材料，利用业余时间从事柔性电路材料的研发，期间经过材料选择、配方调试试验及检测等几项核心环节完成研发工作。上述研发工作最早始于 1999 年，早于公司成立的时间，其核心是化学配方，并不需要很多设备投入。2003 年 10 月、2004 年 3 月，刘萍将个人研究成果以个人名义申请四项发明专利，并分别于 2005 年、2006 年和 2008 年获得国家知识产权局批准。

四项发明专利的核心是化学配方，其主要内容如下：

| 专利名称             | 专利简要介绍                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UV 固化可剥离压敏胶膜     | 该发明专利是一种 UV 固化可剥离压敏胶膜及其制备方法，使用的共聚物由多种丙烯酸酯组成，特别是加入内聚力大的丙烯酸 2-乙基己酯，丙烯酸丁酯，亲水性的丙烯酸羟乙酯，甲基丙烯酸与丙烯酸等。共聚物分子量控制在 100 万左右。光固化单体使用容易合成的二季戊四醇五丙烯酸酯与二季戊四醇六丙烯酸酯混合物，再加入部分含氨酯基的二丙烯酸酯，增加未固化胶的粘结强度和韧性。                                                   |
| 一种无胍刻蚀液          | 该发明涉及一种无胍刻蚀液，为解决现有无胍刻蚀液的刻蚀速度较慢的问题，该发明无胍刻蚀液的成份包括苛性碱、胺类和水，其中的苛性碱为氢氧化钾，胺类中包括一乙醇胺；另外，还可采用尿素作为其增速剂；所述胺类中还可加入己二胺。                                                                                                                           |
| 一种潜伏性固化剂的制造方法    | 该发明是一种潜伏性固化剂的制造方法，其特征包括如下步骤：1）用带有长链取代基的咪唑衍生物与低分子量环氧树脂在溶剂中反应，得到加成物；2）将上述加成物溶解到环氧树脂中得到潜伏性固化剂。                                                                                                                                           |
| 用于芯片搭载及封装的电绝缘树脂浆 | 该发明用于芯片搭载及封装的电绝缘树脂浆，其组份包括环氧树脂中添加液体橡胶增韧剂，咪唑衍生物固化剂，硅粉填料和活性稀释剂；所述环氧树脂采用液体环氧树脂和固体环氧树脂的混合物；所述液体橡胶增韧剂是端羧基丁腈橡胶（CTBN）或端羧基丁腈橡胶（HTBN），为所述环氧树脂用量的 10-20%；所述咪唑衍生物固化剂为含长链取代基咪唑类潜伏性固化剂；所述硅粉填料颗粒度 0.1-1 μm，占总量的 20-30%；所述活性稀释剂为乙二醇二缩水甘油醚，占总量的 0-10%。 |

**3、四项发明专利不是丹邦有限的职务发明**

**(1) 刘萍具有独立完成四项发明专利的专业能力**

刘萍 1994 年至 1996 年在成都科技大学从事高分子材料及柔性电路材料方面

的学习与研究，在此期间积累了高分子材料及柔性电路材料的专业知识。1996年9月起，刘萍先后在丹邦柔性、典邦柔性担任总经理，从事柔性复合铜板和柔性电路板产品的代工业务，积累了生产实践经验。刘萍利用自身专业知识，结合实践经验搜集并阅读了大量国内外行业书籍及研究资料，在工作之余不断深入对柔性电路材料的研发，曾在《印制电路信息》、《照相机》等国家级刊物上发表包括与蔡兴贤教授合作的“挠性印制线路卷状基材用互穿网络胶粘剂的研究”（该文曾获得德国慕尼黑世界电路大会论文优秀奖）、“FPC 在计算机硬驱磁头的应用”、“数码相机中柔性电路的研制与应用”等多篇学术论文。刘萍是我国柔性电路材料领域的专家，具有独立完成四项发明专利的专业能力。

## **（2）四项发明专利不是刘萍执行丹邦有限工作任务的成果，没有利用丹邦有限的物质技术条件**

首先，2001年11月至2004年3月，刘萍在丹邦有限担任董事长（法定代表人），但未承担丹邦有限技术研发工作任务，也未在丹邦有限领取工资及薪酬。

其次，2001年11月至2004年3月，丹邦有限主要从事企业开办、购买土地及厂房建设等筹建活动。在此期间丹邦有限仅有2名员工，未支付其职工薪酬。2005年8月，丹邦科技工业园厂房及办公楼主体建设基本完工，公司才开始试生产，丹邦有限在此期间没有从事有关技术的研发活动。

再次，2004年3月以前，丹邦有限尚不具备用于研发活动及生产经营的机械设备及原材料。2003年3月，为了给公司试生产作相应准备，丹邦有限开始采购生产产品所需的机械设备，因所购置的机器设备尚未安装调试完毕，未达到可使用状态，均记入当年“在建工程”科目。同时，由于四项发明专利技术的核心是化学配方，因此，公司于2004年3月之前采购的机械设备无法用于四项发明专利的研发活动。

根据《专利法》第6条的规定，执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。在2004年3月之前，丹邦有限没有研发人员，未开展有关技术研发活动；未拥有开展研发活动所需要的设备、材料等物质技术条件，公司不具备从事有关技术研发的能力，四项发明专利的研

发不存在利用公司物质技术条件的可能性。因此，用于出资的四项发明专利是刘萍个人从事科研活动的研究成果，研发过程中没有利用丹邦有限的物质技术条件，不是刘萍执行上述公司职务活动的结果，刘萍对四项发明专利拥有完全的权利。

#### **4、四项发明专利不是典邦柔性和丹邦柔性的职务发明，与典邦柔性和丹邦柔性不存在权属纠纷**

四项发明专利的研发期间，刘萍在典邦柔性和丹邦柔性担任总经理职务。但典邦柔性和丹邦柔性只从事柔性覆合铜板和柔性电路板产品的代工业务，生产所需基材、辅材均由从国外进口，未开展与上述四项发明专利技术有关的研发活动。四项发明专利并非刘萍执行该两公司的工作任务的成果，亦未利用其物质技术条件，不属于在该两公司的职务发明，不存在产权纠纷及潜在的法律纠纷。

2007年1月8日，刘萍曾任职的典邦柔性出具《声明与承诺》，确认典邦柔性未开展与四项发明专利有关的技术研发活动，发行人实际控制人刘萍用于出资的四项发明专利是其个人研究成果，刘萍对四项发明专利拥有完全的权利。典邦柔性将不会就四项发明专利主张任何权利。

2007年1月8日，刘萍曾任职的丹邦柔性出具《声明与承诺》，确认丹邦柔性未开展与四项发明专利有关的技术研发活动，发行人实际控制人刘萍用于出资的四项发明专利是其个人研究成果，刘萍对四项发明专利拥有完全的权利。丹邦柔性将不会就四项发明专利主张任何权利。

2007年1月8日，典邦柔性与丹邦柔性的实际控制人益关寿出具《声明与承诺》，确认四项发明专利不是典邦柔性和丹邦柔性的职务成果，其本人不会对四项发明专利主张任何权利。

基于上述事实，用于出资的四项发明专利不属于典邦柔性和丹邦柔性的职务成果，系刘萍个人发明专利，不存在权属纠纷或潜在的法律纠纷。

#### **5、四项发明专利的评估及过户**

##### **（1）四项发明专利的评估**

受刘萍、丹邦有限及丹依发展的委托，为了给委托方了解四项发明专利（包括一项专利申请权，以下统称为“四项发明专利”）的价值及投资入股提供价值

参考，深圳中联岳华会计师事务所对四项发明专利进行了评估，并于 2007 年 1 月 21 日出具深中岳评报字[2007]第 007 号资产评估报告书，上述四项发明专利于评估基准日 2006 年 12 月 31 日评估值为 4,843 万元。

根据评估目的和发明专利的特点和现状，本次评估采用收益法进行评估。其计算公式如下：

$$P = \sum_{t=1}^n \frac{F_t}{(1+i)^t}$$

公式中P表示发明专利的评估价值；n表示发明专利的收益期限；t表示收益年份；F<sub>t</sub>表示发明专利的预期超额收益；i表示折现率。评估中主要参数确定依据如下：

①发明专利的预期超额收益是指由发明专利在未来时期内带来的超额收益。预期超额收益的测算通过分成率的方法获得。预期超额收益=销售利润×分成率×（1-所得税率）。

A、销售利润根据公司近五年的发展规划及评估人员对市场的调查和判断进行预测，评估师以公司2005年、2006年的经营数据为基础，并根据2007年发行人已签订或意向签订销售合同情况，在2007年进入规模化生产状态下对销售利润进行预测，认为未来5年后发行人目前的生产经营规模已达到饱和，2011年至专利权收益期结束，其利润总额将保持在2011年的水平。

B、根据评估人员及丹邦有限技术人员的分析，在其他条件相同的情况下，使用四项发明专利后单位产品成本下降20.5%-33.4%，采用谨慎性原则和取整的方式，以20%作为收益分成比率。在具体评估业务中，确定收益分成率通常采用国际惯例及统计数据，由评估师根据经验结合实际确定。根据联合国工业发展组织对印度等发展中国家引进技术价格的分析，认为利润分成率在16%—27%之间是合理的。本次评估以20%作为收益分成比率处于公认的合理区间。

四项发明专利预期超额收益确定如下：

单位：万元

| 项 目  | 2007 年 | 2008 年 | 2009 年 | 2010 年 | 2011 年至收益期结束 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| 销售利润 | 1,652  | 3,470  | 4,647  | 4,353  | 4,675        |

|          |     |     |     |     |     |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 所得税（15%） | 248 | 521 | 697 | 653 | 701 |
| 分成率      | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 预期超额收益   | 281 | 590 | 790 | 740 | 810 |

②无形资产收益期限的确定，一般考虑下列因素：法定的保护期限、合同或协议约定的期限及经济寿命。本次评估收益期限的确定主要考虑发明专利剩余法定保护年限，确定为18年。

③折现率采用通用的社会平均收益率法模型确定。即：折现率=无风险报酬率+风险报酬率。无风险报酬率选取2006年中国人民银行发行的五年期国债利率3.81%。综合技术、市场、经营及财务等因素的具体分析，评估人员依据折现模型及经验数据最后确定折现率为13%。

2007年1月28日，丹邦有限召开董事会，同意丹侬发展以上述无形资产以评估值为参考作价4,623万元出资至丹邦有限。

2010年8月19日，受丹邦科技的委托，开元资产评估有限公司对深圳中联岳华会计师事务所出具的深中岳评报字（2007）第007号《UV固化可剥离压敏胶膜等4项发明专利资产评估报告书》进行了复核并出具开元（深）评复字[2010]第008号《关于〈UV固化可剥离压敏胶膜等4项发明专利评估报告书〉的专项复核报告》，复核意见认为：《评估报告书》的格式符合规范；评估基准日的选择适当，且由双方约定；评估所依据的法律法规和政策合理；评估方法的应用恰当，评估过程步骤符合规范惯例的要求；《评估报告书》对UV固化可剥离压敏胶膜等4项发明专利于评估基准日2006年12月31日评估值为4,843万元，评估值公允合理；对评估结果产生重大影响的事项已明示。

保荐机构核查后认为：本次评估采用的收益法是无形资产评估中运用最广泛的方法，评估方法应用恰当；销售利润的预测客观、谨慎，2007年至2010年公司历年的销售利润均高于评估的预测数据；收益分成率确定为20%符合世界公认的国际惯例，2007年至2010年四项发明专利实际应用所产生的实际超额收益额及收益分成比率均高于预测数；结合四项发明专利的技术创新及先进性，根据发明专利剩余法定保护年限确定收益期限为18年，符合无形资产评估的惯例。

## （2）四项发明专利的过户

2007年4月23日，中联会计师事务所有限公司深圳分所出具了中联深所验字[2007]第081号验资报告对此次无形资产出资进行了验证。验证截至2007年3月23日，丹邦有限已收到丹依发展缴纳的新增注册资本合计人民币4,623万元，全部为知识产权出资。于2007年3月15日投入专利权“用于芯片搭载及封装的电绝缘树脂浆”、于2007年3月21日投入专利权“UV固化可剥离压敏胶膜”、于2007年3月22日投入专利权“一种潜伏性固化剂的制造方法”及“一种无胍刻蚀液”，四项发明专利权评估价值为4,843万元，全体股东确认的价值为4,623万元。

发明专利“UV固化可剥离压敏胶膜”、“一种无胍刻蚀液”、“一种潜伏性固化剂的制造方法”的专利权人已于2007年3月30日变更登记为丹邦有限。“用于芯片搭载及封装的电绝缘树脂浆”的发明专利在出资时尚在申请过程之中，其专利申请权人已于2007年3月23日由丹依发展变更为丹邦有限，且由丹邦有限于2008年10月1日获得专利授权。至此，四项发明专利已办理了专利权利人过户手续。

2010年8月31日，天健会计师出具天健审（2010）3-161号《关于对深圳丹邦科技股份有限公司整体变更设立股份公司前有关验资报告的鉴证报告》，对深星源验字[2006]第0333号《验资报告》及中联深所验字[2007]第081号《验资报告》的审验结论进行复核，鉴证结论认为，丹邦科技由深圳星源会计师事务所有限公司出具的深星源验字[2006]第0333号《验资报告》和中联会计师事务所有限公司深圳分所出具的中联深所验字[2007]第081号《验资报告》的审验结论在重大方面未见失实之处；上述两个《验资报告》所验证的70,000,000.00元实收资本已到位。

## **6、四项发明专利出资的合法合规性**

（1）四项发明专利系刘萍个人研发成果，不属于其在丹邦有限或其曾任职公司的职务发明；根据刘萍曾任职的公司及其实际控制人出具的《声明与承诺》，刘萍曾任职的公司不会就四项发明专利主张任何权利，与发行人、发行人股东及刘萍就四项发明专利的权属及使用不存在权属争议及法律纠纷。刘萍合法拥有上述专利权或专利申请权，有权按照相应的用途依法占有、使用、收益、转让或以其他方式处置该等专利权或专利申请权。



(2) 四项发明专利可以用于出资，符合《公司法》第二十七条“股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资”、“对作为出资的非货币财产应当评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价”以及“全体股东的货币出资金额不得低于有限责任公司注册资本的百分之三十”等有关规定。

(3) 刘萍将四项发明专利对丹依发展增资，已依法履行丹依发展股东会审议批准、资产评估、产权转移登记、注册会计师验证股东实缴出资、工商变更登记等必要的法律程序；丹依发展以四项发明专利对丹邦有限出资已依法履行董事会审议批准、外商投资主管部门批准、资产评估、注册会计师验证股东实缴出资、工商变更登记等必要的法律程序。

(4) 丹依发展本次用以出资的四项发明专利评估作价已经由具有从事证券业务资格的资产评估机构评估，并且该评估值已经由具有从事证券业务资格的评估机构复核确认。

(5) 丹依发展该次以四项发明专利出资时，发明“用于芯片搭载及封装的电绝缘树脂浆”的专利申请尚未获得专利授权，丹依发展以专利申请权出资，不违反我国相关法律、行政法规的强制性规定，不会对发行人本次发行及上市构成实质性法律障碍。

**7、四项发明专利已成为公司的重要知识产权，普遍应用于公司产品的生产并创造了良好经济效益，促使了公司核心竞争力的形成**

**(1) 四项发明专利的主要功能**

四项发明专利的技术主要应用于 FPC、COF 柔性封装基板及 COF 产品的生产，运用四项发明专利技术生产的材料是生产 FPC、COF 柔性封装基板及 COF 产品的必备材料，2007 年 3 月，四项发明专利投入丹邦有限以后，四项发明专利技术普遍运用于公司上述产品的生产过程，其具体功能及运用如下：

| 专利名称         | 主要功能及运用                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| UV 固化可剥离压敏胶膜 | 主要用于生产一种 UV 固化可剥离压敏胶膜，在芯片封装、芯片搭载和 COF 产品制造中都需要 UV 固化可剥离压敏胶膜起支撑和保护作用。 |
| 一种无胍刻蚀液      | 主要用于柔性电路制造工艺中对聚酰亚膜进行刻蚀，解决了现有无胍刻蚀液的刻蚀速度较慢的问题，刻蚀精度高。                   |

|                  |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 一种潜伏性固化剂的制造方法    | 主要用于制造一种潜伏性固化剂，该潜伏性固化剂有较长的适用期，而且得到的固化物有较高的柔性，解决了原有技术得到的加成物固化环氧树脂柔性较差的问题。            |
| 用于芯片搭载及封装的电绝缘树脂浆 | 主要用于生产一种性能良好的芯片搭载及封装用电绝缘树脂浆，解决了现有的芯片搭载及封装用电绝缘树脂浆韧性不够、内应力较大及较易出现开裂以致造成对芯片以及元器件损害等问题。 |

## （2）四项发明专利具有重要技术进步，进一步强化了公司的产业链、技术及成本优势

四项发明专利在柔性电路材料领域具有重大技术进步，填补了国内的有关技术空白。公司在拥有上述四项发明专利后形成并完善了公司技术及产业链优势，与外购有关材料的同行业企业相比，公司成本优势较为明显，强化了公司的核心竞争力，四项发明专利对公司核心竞争力形成的作用如下：

| 与四项发明专利相关的公司核心竞争力 | 四项发明专利促成公司核心竞争力的具体体现                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产业链协同优势           | 依靠四项发明专利所掌握的核心技术，公司实现了从基材、基板到芯片封装的完整产业链，而主要国际竞争对手产业链布局仅局限于基材、基板、封装产品某一个或两个领域，如日本 NOK 虽然是全球最大的 FPC 生产厂商，但其产业链不涉及封装产品领域。                                                                                                                    |
| 技术优势              | 依靠四项发明专利所掌握的核心技术，公司多项产品技术在国内外处于先进水平，此外，公司已参与国家重大战略产品、关键共性技术和重大工程研究：2011 年 2 月，公司子公司广东丹邦作为项目责任单位获批承担国家科技重大专项“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”项目下属的“三维柔性基板及工艺技术研发与产业化”项目。2009 年 1 月公司作为项目联合单位承担国家科技重大专项“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”项目下属的“芯片柔性封装基板技术与中试工艺开发”课题研究任务。 |
| 成本优势              | 四项发明专利带来的产业链优势实现了上游关键原材料的自产，减少了采购环节，原材料的成本占主营业务成本的比例不超过 30%，大幅低于同行业水平，成本优势明显。                                                                                                                                                             |

2010年6月7日，中国电子材料行业协会出具《关于深圳丹邦科技股份有限公司“UV固化可剥离压敏胶膜”等四项发明专利的情况说明》：

“深圳丹邦科技股份有限公司（下称‘丹邦公司’）拥有的‘UV固化可剥离压敏胶膜’、‘一种无胍刻蚀液’、‘一种潜伏性固化剂的制造方法’及‘用于芯片搭载及封装的电绝缘树脂浆’四项发明专利技术在柔性电路材料领域具有重大技术创新，填补了国内有关技术空白，有利于打破国外技术、原材料的垄断。用上述专利技术生产的有关材料是生产柔性电路板、COF柔性封装基板及COF产品

不可或缺的原材料。具体而言：

‘UV固化可剥离压敏胶膜’主要用于生产一种UV固化可剥离压敏胶膜，其初始粘结力强，而在UV照射后，粘结力下降，容易剥离，抗腐蚀性，清洁无残留物和污染物，在芯片封装、芯片搭载和COF产品制造中都需要UV固化可剥离压敏胶膜起支撑和保护作用。

‘一种无胍刻蚀液’主要用于柔性电路制造工艺中对聚酰亚膜进行刻蚀，解决了现有无胍刻蚀液的刻蚀速度较慢的问题，刻蚀精度高。

‘一种潜伏性固化剂的制造方法’主要是用于制造一种潜伏性固化剂，取得的潜伏性固化剂有较长的适用期，而且得到的固化物有较高的柔性，解决了原有技术得到的加成物固化环氧树脂柔性较差的问题。

‘用于芯片搭载及封装的电绝缘树脂浆’主要用于生产一种性能良好的芯片搭载及封装用电绝缘树脂浆，解决了现有的芯片搭载及封装用电绝缘树脂浆韧性不够、内应力较大、较易出现开裂以致造成对芯片以及元器件损害等问题。

‘UV固化可剥离压敏胶膜’等四项发明专利技术生产的有关材料已普遍运用于丹邦公司高端柔性电路板、COF柔性封装基板及COF产品的生产。与运用日本、美国及韩国等国外公司的专利技术相比较，丹邦公司使用上述发明专利技术自产相关材料可使单位产品成本降低20%-30%左右，生产的柔性电路板、COF柔性封装基板及COF产品的技术先进性和产品性能达到国际先进水平。”

### （3）报告期内公司业务发展状况

公司凭借先进的技术水平和可靠的品质保障已取得夏普、日立、松下、索尼、奥林巴斯、佳能、日本电产等跨国公司的认证，并成为上述全球知名的电子信息产品品牌制造商的高端柔性电路板、COF 柔性封装基板及 COF 产品的供应商。

报告期内，公司主营业务收入持续增长，运用四项发明专利技术生产的附加值高的COF柔性封装基板及COF产品占比不断提高。2010年，COF柔性封装基板、COF产品实现销售收入分别较2008年增长45.80%、132.32%。具体如下表所示：

单位：万元

| 按产品分类      | 2010 年度   |        | 2009 年度   |        | 2008 年度  |        |
|------------|-----------|--------|-----------|--------|----------|--------|
|            | 金额        | 占比     | 金额        | 占比     | 金额       | 占比     |
| COF 柔性封装基板 | 10,196.25 | 50.06% | 10,161.15 | 55.66% | 6,993.40 | 40.80% |

|        |           |        |           |        |          |        |
|--------|-----------|--------|-----------|--------|----------|--------|
| COF 产品 | 5,852.72  | 28.73% | 3,833.36  | 21.00% | 2,519.25 | 14.70% |
| 合计     | 16,048.97 | 78.79% | 13,994.51 | 76.66% | 9,512.65 | 55.50% |

运用上述技术的“COF超微线路和封装产业化”项目被深圳市政府评为2006年度“深圳市科技创新奖”，并被广东省政府评为2007年度“广东省科学技术三等奖”。2008年6月，公司被认定为深圳市第一批“自主创新行业龙头企业”；2010年5月，运用到四项发明专利技术的COF封装基板被科技部认定为“国家重点新产品”。

## 8、丹邦科技 2008 年末计提减值情况说明

### （1）2008 年末计提减值准备时的经营环境

受 2008 年全球金融危机影响，公司所属行业受到巨大冲击，FPC 下游应用产品需求疲软，2008 年与 2007 年相比，公司 FPC 产品所属的 PCB 市场全球产值仅增长 1.1%，在 FPC 下游产品中占重要比例的消费电子产品、通信产品及计算机产品表现疲软，应用于上述三个市场领域的 PCB 产值则分别大幅下降 18.6%、14.2%、17.3%<sup>1</sup>；COF 产品全球产值则下降 12.5%<sup>2</sup>。2008 年末，公司销售形势严峻，与同期相比订单大幅减少。

受宏观经济环境的影响，公司销售形势严峻，由于市场前景不明朗，许多客户决定对原 2008 年第二、三季度应交付的订单推后交货。加之 2008 年四季度销售订单与前三季度相比大幅减少，2009 年初需履行的订单很少，当时公司无法合理评估未来销售何时回暖。

此外，由于公司生产厂房位于深圳市经济特区内，深圳市对经济特区内的工业用水、排水量有严格限制，因此，公司产能扩张受到现有排水额度限制，2008 年实际产量比 2007 年增加不大，只能维持在 16 万平方米/年左右，并且未来产能增加空间受限，只能靠产品结构调整来增加销售收入。

### （2）2008 年末对四项发明专利计提减值准备的依据

四项发明专利属于“成本节约型”的专利技术，其先进性主要体现在保持产品技术性能的前提下，高效率、低成本地产生相关产品。同时以低于市场同类品质产品的价格扩大销售，实现预期超额收益。

<sup>1</sup> 《柔性印制电路板行业与市场情况调查》，中国电子材料协会，2010 年 5 月。

<sup>2</sup> 《柔性印制电路板行业与市场情况调查》，中国电子材料协会，2010 年 5 月。

鉴于 2008 年美国次贷危机引发全球宏观经济环境恶化和公司订单的减少，结合发明专利的“成本节约型”的特性及评估方法，公司认为四项发明专利存在出现经济性贬值的可能性，销售收入及销售利润可能难以达到原预测目标。此外，也考虑到由于金融危机爆发后，下游用户预算约束强化，市场对成本更为敏感，可能会刺激成本节约型技术比正常情况更快的出现。出于谨慎性原则，经董事会决议同意，于 2008 年末对四项发明专利进行减值测试。

受丹邦有限委托，为了对四项发明专利进行减值测试而涉及的四项发明专利于评估基准日的预计未来现金流量的现值提供参考，北京中盛联盟资产评估有限公司对四项发明专利进行评估，并于 2009 年 1 月 11 日出具了中盛联盟（北京）A 评报字（2009）第 010 号评估报告书，截至评估基准日 2008 年 12 月 31 日，四项发明专利的账面价值为 4,194.94 万元，评估值为 3,687.40 万元。

本次评估采用收益法，折现率为 13%，专利收益期的确定为专利保护剩余年限（15 年），评估明细如下：

单位：万元

| 项 目    | 2009 年    | 2010 年    | 2011 年    | 2012 年      | 2013 年    |
|--------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 销售收入   | 17,314.05 | 18,746.78 | 26,252.70 | 30,190.60   | 33,628.63 |
| 销售分成率  | 2.90%     | 2.80%     | 2.70%     | 2.60%       | 2.50%     |
| 折现率    | 13%       | 13%       | 13%       | 13%         | 13%       |
| 超额收益现值 | 422.13    | 365.86    | 432.30    | 421.25      | 387.86    |
| 现值合计   | 3,687.40  | -         | -         | -           | -         |
| 项 目    | 2014 年    | 2015 年    | 2016 年    | 2017-2023 年 | -         |
| 销售收入   | 33,628.63 | 33,628.63 | 33,628.63 | 235,400.41  | -         |
| 销售分成率  | 2.40%     | 2.30%     | 2.20%     | 1.50%-2.10% | -         |
| 折现率    | 13%       | 13%       | 13%       | 13%         | -         |
| 超额收益现值 | 329.51    | 279.45    | 236.55    | 812.5       | -         |
| 现值合计   | -         | -         | -         | -           | -         |
| 账面原值   | 4,194.94  | -         | -         | -           | -         |
| 评估增值   | -507.54   | -         | -         | -           | -         |

#### ①销售收入预测说明

在受 2008 年金融危机影响下，2008 年末公司销售形势非常严峻，许多客户要求推迟履行 2008 年签订的订单，新增订单同比大幅下降，在此情形下，公司对销售收入预测更为谨慎。

另外，因公司产能扩张受到现有排水额度限制，未来产能增加空间受限，只能靠产品结构调整来增加销售收入。

因此，上述销售收入预测数是在公司面临严峻的外部经营环境和产能扩张受限的情况下作出的，反映出当时公司对未来市场的谨慎判断。

## ②销售分成率

根据中盛联盟（北京）A 评报字（2009）第 010 号评估报告书，专利技术销售分成率在预测期初为 2.90%，根据企业过去两年的专利技术超额收益占销售收入比重略有下降的趋势及专利技术对生产经营产生贡献的一般规律，在专利技术的剩余寿命年限之内，这一比例将逐步下降，在初期，每年下降 0.1%，最后几年出现替代技术的概率较大，按 1.5%确定专利技术末期的销售分成率。

因减值测试评估值为 3,687.40 万元低于无形资产账面价值，根据减值测试评估结果，公司于 2008 年末计提了无形资产减值准备 507.54 万元。

四项发明专利作价出资评估时与减值测试评估在评估方法上均采用了收益法进行评估，分别选择了收益分成法和销售收入分成法，但测定专利技术超额收益额的方法则基本类似：均以成本节约额扣除以较低价格争取市场的损失之间的差额作为专利技术的超额收益额。因此，尽管方法不同，但其原理及实质是相同的。

2010年8月19日，受丹邦科技的委托，开元资产评估有限公司对北京中盛联盟资产评估有限公司出具的中盛联盟(北京)A评报字(2009)第010号“UV固化可剥离压敏胶膜等4项发明专利减值测试评估报告书”（以下简称“评估报告书”）进行了复核，并于2010年8月19日出具开元(深)评复字[2010]第007号《关于<UV固化可剥离压敏胶膜等4项发明专利减值测试评估报告书>的专项复核报告》，复核意见认为：《评估报告书》的格式符合规范；评估基准日的选择适当，且由双方约定；评估所依据的法律法规和政策合理；评估方法的应用恰当，评估过程步骤符合规范惯例的要求，《评估报告书》对UV固化可剥离压敏胶膜等4项发明专利于评估基准日2008年12月31日评估值为3,687.40万元，评估值公允合理；对评估结果产生重大影响的事项已明示。

### (3) 2009 年至今公司盈利持续增长，四项发明专利继续为公司创造良好的经济效益

2008年美国次贷危机引发国际金融危机导致公司对四项发明专利存在经济性贬值可能性的预计是出资评估时无法预见的，四项发明专利增资作价后一年计提大额减值仅系公司出于谨慎性原则的决定，事实上金融危机未对四项发明专利产生实质性的影响。

因公司产业链优势及技术优势突出，公司产品相较于日本、韩国等国的主要竞争对手具有明显的成本优势，2009年3月以来，随着全球经济企稳回暖，公司订单数量稳定并逐步回升，主营业务收入及净利润继续保持稳步增长：

单位：万元

| 项 目    | 2010 年度   | 2009 年度   | 2008 年度   |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 主营业务收入 | 20,368.09 | 18,254.82 | 17,139.84 |
| 净利润    | 5,268.05  | 4,663.14  | 3,514.35  |

因此，对四项发明专利计提减值准备是公司外部经营环境发生重大变化的结果，目前，四项发明专利内在价值并未发生变化，继续为公司创造了良好的经济效益，不存在无形资产出资不实或不足额的情形。

2010年8月25日，受丹邦科技的委托，为了给丹邦科技对其UV固化可剥离压敏胶膜等四项发明专利进行减值测试而涉及的UV固化可剥离压敏胶膜等四项发明专利于评估基准日的预计未来现金流量的现值提供参考依据，开元资产评估有限公司对UV固化可剥离压敏胶膜等四项发明专利于评估基准日2009年12月31日的预计未来现金流量的现值进行了评估。并出具了开元深评报字[2010]第096号评估报告书。本次评估方法采用收益法，上述4项发明专利评估前的账面价值为3,407.20万元，评估值为3,969.40万元。

保荐机构和发行人律师对此进行了全面尽职调查和认真核查，一致认为：

四项发明专利系刘萍个人研发成果，刘萍以其拥有的四项发明专利对丹依发展出资已履行必要的法律程序，丹依发展以四项发明专利对丹邦有限出资亦已履行必要的法律程序；四项发明专利出资作价以资产评估机构的评估值为参考，并经具有证券业务资格的评估机构复核确认，且四项发明专利出资已经注册会计师

验证，不存在虚假出资、出资不实的情形；四项发明专利出资符合《公司法》第二十七条“股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资”、“对作为出资的非货币财产应当评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价”以及“全体股东的货币出资金额不得低于有限责任公司注册资本的百分之三十”等有关规定；四项发明专利出资合法、合规、真实、有效。

### **（三）发行人重大资产重组情况**

发行人成立以来，没有进行过重大资产重组。

## **五、发行人历次股本变化的验资情况**

公司成立以来，共进行了七次验资，具体情况如下：

### **1、2001 年公司设立时验资，注册资本 600 万元**

2001年12月10日，深圳华鹏会计师事务所出具了华鹏验字[2001]163号《验资报告》，验证截至2001年12月4日，丹邦有限已收到股东缴纳的注册资本合计人民币600万元，均为货币资金。

### **2、2002 年增资时验资，注册资本增至 1,000 万元**

2002年2月5日，深圳华鹏会计师事务所出具了华鹏验字[2002]013号《验资报告》，验证截至2002年1月29日，丹邦有限已收到股东缴纳的新增注册资本合计人民币400万元，均为货币资金。公司增资后的注册资本为1,000万元。

### **3、2003 年增资时验资，注册资本增至 2,000 万元**

2003年2月18日，深圳华鹏会计师事务所出具了华鹏验字[2003]064号《验资报告》，验证截至2003年2月17日，丹邦有限已收到股东缴纳的新增注册资本合计人民币1,000万元，均为货币资金。公司增资后的注册资本为2,000万元。

### **4、2003 年增资时验资，注册资本增至 3,000 万元**

2003年6月9日，深圳华鹏会计师事务所出具了华鹏验字[2003]303号《验资报告》，验证截至2003年5月30日，丹邦有限已收到股东缴纳的新增注册资本合计人民币1,000万元，均为货币资金。公司增资后的注册资本为3,000万元。



## **5、2006 年增资时验资，实收资本增至 5,377 万元**

2006年8月9日，深圳星源会计师事务所出具了深星源验字[2006]第0333号《验资报告》。验证截至2006年7月24日，丹邦有限已收到各方缴纳的新增注册资本合计人民币2,377万元，其中丹依发展以经评估的实物资产出资2,010万元，益关寿以货币出资367万元。增资后公司实收资本为5,377万元。

## **6、2007 年增资时验资，实收资本增至 10,000 万元**

2007年4月23日，中联会计师事务所有限公司深圳分所出具了中联深所验字[2007]第081号验资报告对无形资产出资进行了验证。验证截至2007年3月23日，丹邦有限已收到丹依发展缴纳的新增注册资本合计人民币4,623万元，全部为知识产权出资。其中，于2007年3月15日投入专利权“用于芯片搭载及封装的电绝缘树脂浆”，于2007年3月21日投入专利权“UV固化可剥离压敏胶膜”，于2007年3月22日投入专利权“一种潜伏性固化剂的制造方法”及专利权“一种无胍刻蚀液”。上述专利的专利权人已变更登记为丹邦有限，增资后公司实收资本为10,000万元。

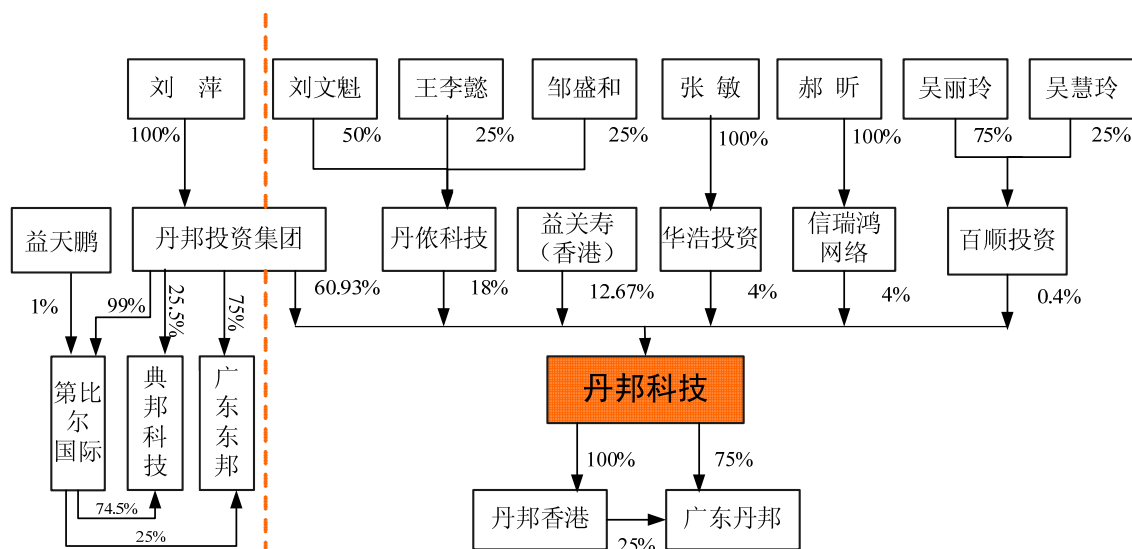
## **7、2009 年整体变更时验资，股本 12,000 万元**

2009年5月14日，开元信德会计师出具开元信德深分验字（2009）第024号验资报告，验证截至2009年5月14日，丹邦有限已将净资产188,711,657.30元折为股本120,000,000元。

# **六、发行人的内部组织结构**

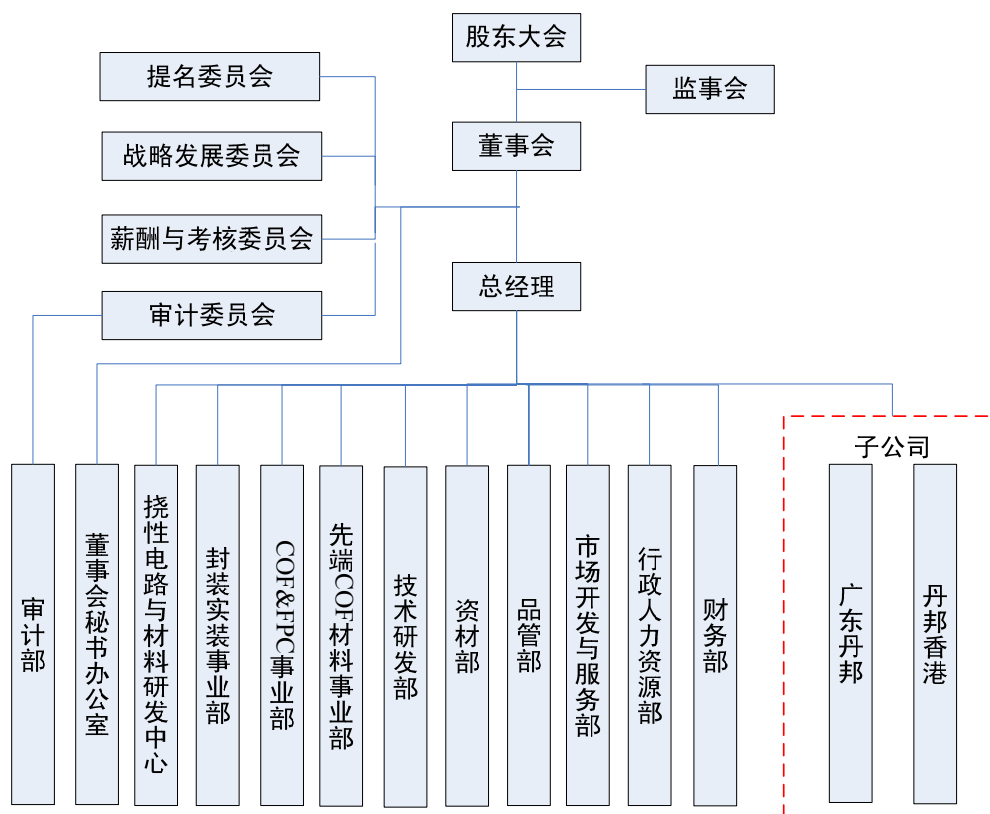
## **（一）股权结构图**

本公司与主要股东及下属子公司的股权关系情况如下：



## (二) 内部组织架构图

本公司内部组织按照生产经营的需要进行设置，具体情况如下：



公司的最高权力机构是股东大会，股东大会下设董事会，董事会向股东大会负责，履行《公司章程》赋予的职权，负责公司重大的生产经营决策和确定公司整体发展战略并监督战略的实施；公司董事会五名董事中有两名独立董事，有利

于健全公司的法人治理结构，使董事会的决策更科学、民主，从而有效地维护中小股东的利益。

公司实行董事会领导下的总经理负责制。在董事会的领导下，由总经理负责公司日常经营与管理。

## **七、发行人子公司情况**

公司目前有2家子公司，具体情况如下：

### **（一）丹邦科技（香港）有限公司**

丹邦香港成立于2007年10月26日，现为公司全资子公司，法定股本为1,400万港元，经营期限15年，注册地址为香港九龙红磡马头围道39号红磡商业中心A座508室，经营范围为柔性复合铜板、高频柔性电路、异方向导电膜、高精密集成电路、新型电子元器件的销售及其原材料的采购。

2007年10月，丹邦香港成立时的股东为本公司现任董事益天鹏。

公司没有直接在香港出资设立子公司，而是先由益天鹏出资成立丹邦香港的主要原因是：设立丹邦香港的目的是由其承接第比尔国际原来作为窗口公司的职能，但公司大多数境外客户在选择确定供应商时，需要对供应商进行比较严格的审查程序且耗时较长，同时，公司的境外设备和原材料供应商对其客户的商业信用等资信情况调查程序较长，审查比较严格。因此，丹邦香港承接原来第比尔国际境外销售职能的前提是通过境外客户和境外供应商的审查程序。如果由公司直接在香港设立子公司，需要先行取得境内商务部门、外汇管理部门的审批及核准手续，耗时较长，可能影响公司解决关联交易问题的进度。因此，为了尽早减少并消除关联交易，保证公司境外销售及境外采购业务的顺利衔接与过渡，避免对公司经营带来不利影响，2007年10月，公司决定由益天鹏（中国香港籍）在香港先行出资设立丹邦香港，并在设立后即开始与公司境外终端客户和供应商接洽，及时办理供应商资格认证、资信审查等事宜。

2008年5月8日，丹邦有限董事会作出决议，决定收购丹邦香港为其子公司。2008年5月9日，经双方协商，益天鹏与丹邦有限签署股份转让协议，将其持有丹

邦香港100%的股权以1港元的价格转让给丹邦有限，股份转让文件于2008年5月9日获香港税务局印花税组确认，并在香港公司注册处登记。2010年4月9日，商务部颁发商境外投资证第4403201000070号《企业境外投资证书》同意上述收购。

2010年7月20日，商务部颁发商境外投资证第4403201000138号《企业境外投资证书》，同意丹邦香港注册资本和投资总额增至180.05万美元。

截至2010年12月31日，丹邦香港的总资产为4,685.00万元，净资产为1,223.53万元，2010年度实现主营业务收入995.62万元，净利润-3.02万元（以上数据经天健会计师审计）。

## **（二）广东丹邦科技有限公司**

2009年8月10日，东莞市对外贸易经济合作局以东外经贸松[2009]18号批复同意丹邦科技和丹邦香港共同投资设立中外合资企业，投资总额10,000万元，注册资本5,000万元，其中丹邦科技认缴出资额3,750万元，出资比例75%；丹邦香港认缴出资额1,250万元，出资比例25%。合资双方须自营业执照签发之日起两年内缴足各自认缴的注册资本（头三个月不小于15%）。合资企业经营期限为50年。2009年8月14日，广东丹邦取得商外资粤东合资证字[2009]0007号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

广东丹邦目前持有东莞市工商行政管理局颁发的注册号为441900400115250的《企业法人营业执照》，公司注册资本5,000万元，实收资本5,000万元，公司类型为有限责任公司（台港澳与境内合资），法定代表人刘萍，注册地为东莞市松山湖科技产业园区北部工业城C区BC-18。经营范围为设立研发机构，研究、开发新型电子元器件产品、生产和销售新型电子元器件（片式元器件、敏感元器件及传感器、频率控制与选择元件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、新型机电元件、高密度互连积层板、多层挠性板、封装基板），并提供上述产品的技术咨询及相关配套服务。

目前，该公司尚无业务发生，该公司将作为本次募集资金投资项目的实施主体。

截至2010年12月31日，广东丹邦的总资产为6,909.21万元，净资产为

4,970.84万元，2010年度实现主营业务收入0.00万元，净利润-8.85万元（以上数据经天健会计师审计）。

## 八、发行人股东及实际控制人基本情况

### （一）发行人股东的基本情况

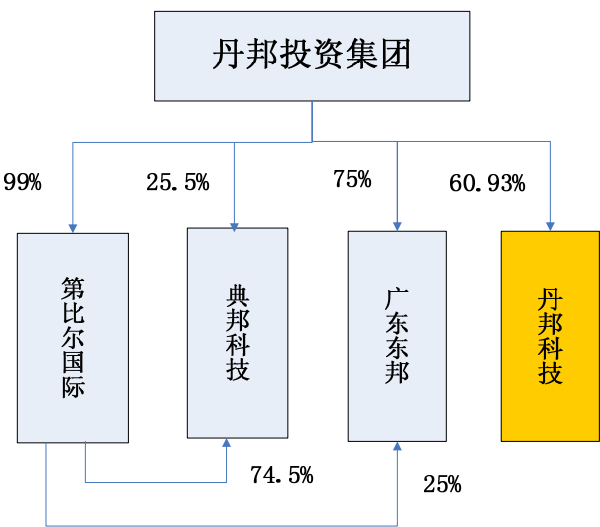
#### 1、深圳丹邦投资集团有限公司

丹邦投资集团目前持有本公司60.93%的股份，为公司控股股东。

丹邦投资集团前身为丹依发展，成立于2001年6月21日。2007年9月14日，丹依发展更名为深圳市丹邦投资有限公司。2009年6月26日，深圳市丹邦投资有限公司更名为深圳丹邦投资集团有限公司。

目前，丹邦投资集团持有注册号为440301102864651的《企业法人营业执照》，法定代表人为刘萍，注册资本和实收资本均为9,000万元，刘萍出资比例为100%，主营业务为投资兴办实业，经营范围为投资兴办实业（具体项目另行申报）；功能性高分子材料、微电子聚合物材料、OLED封装材料、有机发光材料、太阳能电池材料的技术开发与销售（不含专营、专控、专卖商品及限制项目），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。公司住所为深圳市南山区科苑路3号综合实验楼11栋二楼B。

丹邦投资集团对外投资情况如下图所示：



除投资本公司外，丹邦投资集团还持有第比尔国际99%的股权，并分别直接与间接合计持有典邦科技99.255%的股权、广东东邦99.75%的股权。截至本招股说明书签署之日，广东东邦尚未开展生产经营性业务，主要从事厂房及有关配套设施的建设；典邦科技主要从事液晶显示模组产品的代工业务；第比尔国际的主要资产是持有典邦科技及广东东邦的股权。三家公司均与本公司不存在同业竞争关系。

截至2010年12月31日，丹邦投资集团的总资产为18,056.86万元（其中长期股权投资12,251.81万元），净资产合计14,911.73万元，2010年度营业利润-8.95万元，净利润-8.95万元（以上为母公司数据，已经深圳德扬会计师事务所审计）。

## 2、深圳市丹依科技有限公司

丹依科技成立于2008年4月11日，目前持有注册号为440301103285901的《企业法人营业执照》，法定代表人为刘文魁，注册资本和实收资本均为100万元，公司住所为深圳市南山区科苑路3号综合实验楼11栋二楼A，经营范围为图像与数字显示材料技术开发（不含限制项目），主要资产为对丹邦科技的股权投资，自身未开展生产经营性业务，未从事与丹邦科技相同或相似的业务。

截至本招股说明书签署之日，丹依科技的股东及股权结构如下：

单位：万元

| 序号 | 股东名称 | 出资金额   | 持股比例    |
|----|------|--------|---------|
| 1  | 刘文魁  | 50.00  | 50.00%  |
| 2  | 王李懿  | 25.00  | 25.00%  |
| 3  | 邹盛和  | 25.00  | 25.00%  |
|    | 合 计  | 100.00 | 100.00% |

刘文魁、王李懿及邹盛和均为刘萍当年的创业伙伴。刘文魁现任公司先端COF材料事业部CCL材料技术部副部长，王李懿现任公司董事、副总经理，邹盛和现任公司监事会主席。刘文魁、王李懿及邹盛和三人之间相互不存在关联关系，刘文魁为实际控制人刘萍的侄子，王李懿及邹盛和与公司实际控制人及其关联人之间不存在关联关系。

截至2010年12月31日，丹依科技的总资产为1,806.72万元，净资产合计95.39万元，2010年度营业利润-0.29万元，净利润-0.29万元（以上数据未经审计）。

### 3、益关寿

益关寿，中国香港籍，拥有加拿大永久居留权，66岁，身份证号码为A654\*\*  
(3)，住所：香港大埔区悠然山庄。

### 4、深圳市信瑞鸿网络科技有限公司

信瑞鸿网络成立于2007年10月15日，目前持有注册号为440301102922964的《企业法人营业执照》，法定代表人为郝昕，注册资本和实收资本均为200万元，郝昕出资200万元，出资比例为100%。公司住所为深圳市福田区八卦岭鹏基商务时空大厦1510号，经营范围为网络系统技术开发、技术咨询（不含限制项目）；网络电子设备的销售及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报）。郝昕与本公司实际控制人及其关联人之间不存在关联关系。

截至2010年12月31日，信瑞鸿网络的总资产为1,175.79万元，净资产合计178.89万元，2010年度营业利润-0.03万元，净利润-0.03万元（以上数据未经审计）。

### 5、深圳市华浩投资有限公司

华浩投资成立于2003年12月31日，目前持有注册号为4403012130668的《企业法人营业执照》，法定代表人为张敏，注册资本5,350万元，实收资本5,350万元，张敏出资比例为100%。主营业务为创业投资。公司住所为深圳市南山区沙河工业区B9栋4楼厂房，经营范围为投资兴办实业（具体项目另行申报）；电视剧、综艺、专题、动画故事片的制作、复制、发行（广播电视节目制作经营许可证编号：（粤）字第431号）。张敏与本公司实际控制人及其关联人之间不存在关联关系。

截至2010年12月31日，华浩投资的总资产为5,544.91万元，净资产合计4,947.91万元，2010年度营业利润-221.26万元，净利润-221.31万元（以上数据未经审计）。

### 6、深圳市百顺投资管理有限公司

百顺投资成立于2008年3月27日，目前持有注册号为440301103250805的《企业法人营业执照》，法定代表人为吴丽玲，注册资本和实收资本均为1,000万元，

其中，吴丽玲出资750万元，出资比例为75%；吴慧玲出资250万元，出资比例为25%。主营业务为创业投资。公司住所为深圳市福田区景田路茶宫茗香苑综合楼1205（仅限办公），经营范围为投资兴办实业；投资管理、投资咨询、信息咨询；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。吴丽玲、吴慧玲与本公司实际控制人及其关联人之间不存在关联关系。

截至2010年12月31日，百顺投资的总资产为1,789.93万元，净资产合计991.22万元，2010年度营业利润-7.96万元，净利润-7.96万元（以上数据未经审计）。

## （二）发行人实际控制人

发行人的控股股东为丹邦投资集团，刘萍持有丹邦投资集团100%的股权，具有绝对控股权，是发行人的实际控制人。发行人自成立以来实际控制人未曾发生变化。

公司实际控制人刘萍的基本情况如下：

刘萍，中国国籍，未拥有永久境外居留权，身份证号码：42232719651022\*\*\*\*，住所：广东省深圳市福田区国企大厦永裕楼。

## （三）实际控制人控制的其他企业情况

除控制本公司外，实际控制人刘萍还控制第比尔国际、典邦科技及广东东邦3家公司，截至本招股说明书签署日，各公司基本情况如下：

### 1、第比尔国际（香港）有限公司

第比尔国际成立于2004年9月24日，注册资本为港币102,000元，等额分成普通股102,000股，注册地为香港九龙红磡马头围道39号红磡商业中心A座508室。实际控制人刘萍通过丹邦投资集团间接持有其99%的股份，截至本招股说明书签署之日，第比尔国际股东及股权结构如下：

单位：港元

| 序号 | 股东名称   | 出资金额       | 持股比例    |
|----|--------|------------|---------|
| 1  | 丹邦投资集团 | 100,980.00 | 99.00%  |
| 2  | 益天鹏    | 1,020.00   | 1.00%   |
|    | 合 计    | 102,000.00 | 100.00% |



在2009年8月以前，第比尔国际曾是发行人境外销售和境外采购的重要窗口公司，主要职能是满足部分客户及供应商对交易对方注册地的要求，充分利用香港商业发达的贸易环境、集中境外客户资源、供应商资源和外资银行资源、办理银行结算手续、代收客户货款、代付供应商采购款、协助报关等。因此，发行人向境外销售和从境外采购设备及原材料部分通过第比尔国际来完成，导致关联交易。为了彻底解决关联交易，发行人自2008年5月起，本公司全资子公司丹邦香港逐步承接原来通过第比尔国际进行的境外销售和境外采购业务，截至2009年8月，已完成全部境外终端客户和实际供应商的转换。此后，公司不再通过第比尔国际进行境外销售和境外采购业务。

为了满足第比尔国际正常的营运资金需求，第比尔国际对终端客户黑田电气、DML公司销售单价高于本公司对第比尔国际的售价，报告期内，第比尔国际获取的销售毛利与其自身运营费用情况如下：

单位：万港元

| 年 度               | 2010 年 | 2009 年 | 2008 年 |
|-------------------|--------|--------|--------|
| (1) 第比尔国际销售毛利     | -      | 57.99  | 372.37 |
| 来源于对黑田电气的销售       | -      | 34.28  | 372.37 |
| 来源于对 DML 公司的销售    | -      | 23.71  | -      |
| (2) 第比尔国际运营费用     | -      | 59.68  | 342.13 |
| (3) 销售毛利扣除运营费用后净额 | -      | -1.69  | 30.24  |

公司未直接收购第比尔国际以解决同业竞争，未注销第比尔国际的主要原因是：第比尔国际除了作为公司境外销售和采购的重要窗口公司之外，还分别持有典邦科技74.5%的股权、广东东邦25%的股权。

截至2010年12月31日，第比尔国际的总资产为4,371.53万港元，净资产为32.02万港元，2010年度营业收入为0.00万港元，净利润为-8.08万港元（以上数据未经审计）。

## 2、深圳典邦科技有限公司

典邦科技前身为深圳典邦微显示技术有限公司，成立于2008年1月9日，系经深圳市南山区贸易工业局深外资南复[2007]0612号批复同意设立的中外合

资企业，2007 年 12 月 27 日，典邦科技取得深圳市人民政府颁发的商外资粤深南合资证字[2007]5006 号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。目前持有注册号为 440301501125430 的《企业法人营业执照》，法定代表人为刘萍，投资总额 20,000 万元，注册资本 10,000 万元，实收资本 6,000 万元，经营期限 10 年。公司住所为深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼四楼西北、五楼西北、六楼西北，经营范围为开发、生产经营 TFT-LCD 平板显示屏、OLED 平板显示屏、显示屏材料，及提供自产产品技术咨询业务。

典邦科技目前主要从事液晶显示模组（LCM）的生产与销售业务。未从事与本公司相同或相似的业务，与本公司不存在同业竞争。关于典邦科技主营业务的具体情况参见本招股说明书第六节之“一、（一）本公司与控股股东和实际控制人不存在同业竞争”。

截至本招股说明书签署之日，典邦科技的股东及股权结构如下：

单位：万元

| 序号 | 股东名称   | 认缴出资金额    | 实缴出资金额   | 持股比例    |
|----|--------|-----------|----------|---------|
| 1  | 丹邦投资集团 | 2,550.00  | 2,550.00 | 25.50%  |
| 2  | 第比尔国际  | 7,450.00  | 3,450.00 | 74.50%  |
|    | 合 计    | 10,000.00 | 6,000.00 | 100.00% |

截至 2010 年 12 月 31 日，典邦科技的总资产为 10,089.35 万元，净资产合计 5,454.50 万元，2010 年度营业收入 1,147.93 万元，净利润-112.10 万元（以上数据经深圳德扬会计师事务所审计）。

### 3、广东东邦科技有限公司

广东东邦成立于 2009 年 1 月 13 日，系经东莞市对外贸易经济合作局以东外经贸松[2008]10 号批复同意设立的中外合资企业，2009 年 1 月 6 日，广东东邦取得商外资粤东合资证字[2009]0002 号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。目前持有注册号为 441900400102962 的《企业法人营业执照》，法定代表人为刘萍，投资总额为 20,000 万元，注册资本 8,000 万元，实收资本 4,000 万元，经营期限 50 年。公司住所为东莞松山湖科技产业园区北部工业城 C 区，经营范围为 TFT-LCD、PDP、OLED、FED（含 SED 等）平板显示屏、显示屏材料制造（生产经营 TFT-LCD 偏光片、防反射光膜、相位差光学膜等平板显示材料与光

学器件）项目（筹办期不得经营）。

广东东邦尚未开展生产与销售活动，成立后主要从事厂房及其配套设施建设，与本公司不存在同业竞争。

截至2010年12月31日，广东东邦的总资产为14,278.52万元，净资产合计4,001.35万元，2010年度营业收入为0.00万元，净利润为0.00万元（以上数据经中喜会计师事务所有限责任公司审计）。

截至本招股说明书签署之日，广东东邦的股东及股权结构如下：

单位：万元

| 序号 | 股东名称   | 认缴出资金额   | 实缴出资金额   | 持股比例    |
|----|--------|----------|----------|---------|
| 1  | 丹邦投资集团 | 6,000.00 | 3,600.00 | 75.00%  |
| 2  | 第比尔国际  | 2,000.00 | 400.00   | 25.00%  |
|    | 合 计    | 8,000.00 | 4,000.00 | 100.00% |

## 九、发行人股本情况

### （一）本次发行前后的股本情况

本公司本次发行前的总股本为 12,000 万股，本次拟发行 4,000 万股，占发行后总股本的比例为 25%。

| 类别       | 股东名称       | 发行前股本结构     |         | 发行后股本结构     |         |
|----------|------------|-------------|---------|-------------|---------|
|          |            | 持股数<br>(万股) | 持股比例    | 持股数<br>(万股) | 持股比例    |
| 有限售条件的股份 | 丹邦投资集团     | 7,311.60    | 60.93%  | 7,311.60    | 45.70%  |
|          | 丹依科技       | 2,160.00    | 18.00%  | 2,160.00    | 13.50%  |
|          | 益关寿        | 1,520.40    | 12.67%  | 1,520.40    | 9.50%   |
|          | 信瑞鸿网络      | 480.00      | 4.00%   | 480.00      | 3.00%   |
|          | 华浩投资       | 480.00      | 4.00%   | 480.00      | 3.00%   |
|          | 百顺投资       | 48.00       | 0.40%   | 48.00       | 0.30%   |
|          | 有限售条件的股份小计 | 12,000.00   | 100.00% | 12,000.00   | 75.00%  |
| 本次发行的股份  |            | -           | -       | 4,000.00    | 25.00%  |
| 合 计      |            | 12,000.00   | 100.00% | 16,000.00   | 100.00% |

### （二）自然人股东（外资）及其任职情况

根据深圳市贸易工业局 2009 年 5 月 7 日出具的深贸工资复[2009]0944 号批复及深圳市人民政府 2009 年 5 月 13 日颁发的商外资粤深股资证字[2009]0002

号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，本次发行前，本公司有中国香港籍自然人股东1名，其持股情况及在本公司任职情况如下：

| 自然人股东名称    | 持股数（万股）  | 持股比例   | 在发行人单位任职 |
|------------|----------|--------|----------|
| 益关寿（香港自然人） | 1,520.40 | 12.67% | 无        |

### （三）战略投资者持股及其简况

本公司本次发行前的股东中无战略投资者。

### （四）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

本次发行前，实际控制人刘萍通过丹邦投资集团间接持有公司60.93%的股份，刘萍的侄子刘文魁通过丹依科技间接持有公司9%的股份。

除此之外，其他股东之间不存在关联关系。

### （五）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

本次发行前公司总股本12,000万股，本次拟发行4,000万股流通股，发行后总股本为16,000万股，16,000万股均为流通股。

公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司、实际控制人刘萍及公司股东深圳市丹依科技有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

公司股东益关寿、深圳市信瑞鸿网络科技有限公司、深圳市华浩投资有限公司及深圳市百顺投资管理有限公司承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

除此之外，公司董事及高级管理人员刘萍、王李懿，监事邹盛和及核心技术人员刘文魁还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过本人直接及间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接及间接持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人直接及间接持有发行人股票总数的比例

不超过百分之五十。

## 十、发行人员工及其社会保障情况

### （一）员工人数及结构情况

#### 1、员工人数

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司及子公司在册员工共计 887 人。

#### 2、员工专业结构

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司及控股子公司的员工专业结构如下：

| 人员类型 | 人数（人） | 占员工总数的比例 |
|------|-------|----------|
| 生产人员 | 631   | 71.14%   |
| 管理人员 | 115   | 12.97%   |
| 技术人员 | 108   | 12.18%   |
| 销售人员 | 18    | 2.03%    |
| 财务人员 | 15    | 1.69%    |
| 合 计  | 887   | 100.00%  |

#### 3、员工受教育程度

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司及控股子公司的员工受教育程度如下：

| 学历    | 人数（人） | 占员工总数的比例 |
|-------|-------|----------|
| 硕士以上  | 10    | 1.13%    |
| 本科    | 132   | 14.88%   |
| 大专    | 70    | 7.89%    |
| 中专及以下 | 675   | 76.10%   |
| 合 计   | 887   | 100.00%  |

#### 4、员工年龄分布

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司及控股子公司的员工年龄分布如下：

| 年龄区间    | 人数（人） | 占员工总数的比例 |
|---------|-------|----------|
| 30 岁以下  | 602   | 67.87%   |
| 31—40 岁 | 235   | 26.49%   |
| 41—50 岁 | 32    | 3.61%    |
| 51 岁以上  | 18    | 2.03%    |
| 合 计     | 887   | 100.00%  |

## （二）员工社会保障情况

本公司实行全员劳动合同制，员工按照与公司签订的劳动合同承担义务和享受权利。公司严格按照国家及深圳市政府的有关规定参加社会保障体系，实行养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险等社会保险制度，由公司按月足额向深圳市社会保险基金管理局缴纳以上保险，并为员工缴纳住房公积金。

### 1、社会保险费用缴纳情况

按照《工伤保险条例》、《深圳经济特区企业员工社会养老保险条例》、《深圳经济特区失业保险条例》、《深圳市城镇职工社会医疗保险办法》（2008年3月1日被《深圳市社会医疗保险办法》废止）以及《深圳市社会医疗保险办法》等法律法规的规定，公司依法为员工缴纳养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险和生育保险。

报告期公司社会保险费缴纳具体情况如下：

2008 年度社会保险费缴纳情况

| 项目   |     | 职工<br>总数 | 参保<br>人数 | 缴费比例   |        |       | 缴费金额（万元） |        |       |
|------|-----|----------|----------|--------|--------|-------|----------|--------|-------|
|      |     |          |          | 合计     | 公司     | 员工    | 合计       | 公司     | 员工    |
| 养老保险 | 深户  | 40       | 40       | 19.00% | 11.00% | 8.00% | 15.54    | 9.00   | 6.54  |
|      | 非深户 | 823      | 769      | 18.00% | 10.00% | 8.00% | 205.46   | 114.14 | 91.31 |
| 医疗保险 |     | 863      | 809      | 4.70%  | 4.50%  | 0.20% | 40.82    | 33.31  | 7.51  |
| 生育保险 |     | 863      | 809      | 0.50%  | 0.50%  | —     | 0.41     | 0.41   | —     |
| 失业保险 |     | 863      | 809      | 0.40%  | 0.40%  | —     | 14.09    | 14.09  | —     |
| 工伤保险 |     | 863      | 809      | 0.80%  | 0.80%  | —     | 9.89     | 9.89   | —     |

2008年末，公司在册员工中有54名员工未缴纳社会保险费。其中，公司新入职员工从次月起缴纳社会保险费，6名为年底新入职的员工，其社保手续已在后续月份中办理完成，2名员工为退休返聘，此外，46名员工因年底离职而停交社保。

2009 年度社会保险费缴纳情况

| 项目   |     | 职工<br>总数 | 参保<br>人数 | 缴费比例   |        |       | 缴费金额（万元） |        |       |
|------|-----|----------|----------|--------|--------|-------|----------|--------|-------|
|      |     |          |          | 合计     | 公司     | 员工    | 合计       | 公司     | 员工    |
| 养老保险 | 深户  | 29       | 29       | 19.00% | 11.00% | 8.00% | 17.53    | 10.15  | 7.38  |
|      | 非深户 | 1208     | 993      | 18.00% | 10.00% | 8.00% | 215.23   | 119.57 | 95.66 |
| 医疗保险 |     | 1237     | 1022     | 4.70%  | 4.50%  | 0.20% | 31.49    | 22.53  | 8.97  |

|      |      |      |       |       |   |       |       |   |
|------|------|------|-------|-------|---|-------|-------|---|
| 生育保险 | 1237 | 1022 | 0.50% | 0.50% | - | 7.29  | 7.29  | - |
| 失业保险 | 1237 | 1022 | 0.40% | 0.40% | - | 14.77 | 14.77 | - |
| 工伤保险 | 1237 | 1022 | 0.50% | 0.50% | - | 6.57  | 6.57  | - |

2009年末，公司在册员工中有215名员工未缴纳社会保险费。其中，公司新入职员工从次月起缴纳社会保险费，119名为年底新入职的员工，其社保手续已在后续月份中办理完成，2名员工为退休返聘，此外，94名员工因年底离职而停交社保。

#### 2010年度社会保险费缴纳情况

| 项目   |     | 职工总数 | 参保人数 | 缴费比例   |        |       | 缴费金额（万元） |        |        |
|------|-----|------|------|--------|--------|-------|----------|--------|--------|
|      |     |      |      | 合计     | 公司     | 员工    | 合计       | 公司     | 员工     |
| 养老保险 | 深户  | 34   | 34   | 19.00% | 11.00% | 8.00% | 25.46    | 14.73  | 10.73  |
|      | 非深户 | 853  | 641  | 18.00% | 10.00% | 8.00% | 257.67   | 143.15 | 114.52 |
| 医疗保险 |     | 887  | 675  | 4.70%  | 4.50%  | 0.20% | 32.35    | 24.49  | 7.86   |
| 生育保险 |     | 887  | 675  | 0.50%  | 0.50%  | -     | 8.05     | 8.05   | -      |
| 失业保险 |     | 887  | 675  | 0.40%  | 0.40%  | -     | 15.36    | 15.36  | -      |
| 工伤保险 |     | 887  | 675  | 0.25%  | 0.25%  | -     | 4.41     | 4.41   | -      |

2010年末，公司在册员工中有212名员工未缴纳社会保险费。其中，公司新入职员工从次月起缴纳社会保险费，84名为年底新入职的员工，其社保手续已在后续月份中办理完成，2名员工为退休返聘，此外，126名员工因年底离职而停交社保。

根据公司员工参加社会保险清单、单位正常缴费明细以及深圳市社会保险基金管理局出具的证明，公司在报告期内按时缴纳各项社会保险费用，没有因违法违规而被处罚的情况。

控股股东丹邦投资集团承诺：若应有权部门的要求或决定，发行人及其子公司需为职工补缴社会保险费、或发行人及其子公司因未为职工缴纳社会保险费而承担任何罚款或损失，丹邦投资集团愿在毋须发行人支付对价的情况下承担所有补缴金额和相关所有费用及/或相关的经济赔偿责任。

## 2、住房公积金缴付情况

### （1）2010年12月之前公司住房公积金缴付情况

在2010年12月之前，深圳市未依据国务院《住房公积金管理条例》（国务院令350号）及《关于住房公积金管理若干具体问题的指导意见》（建金管[2005]5

号)制订有关住房公积金管理的具体办法,深圳市住房公积金制度是基于《深圳市社会保险暂行规定》(深府[1992]128号)、《深圳市社会保险暂行规定职工养老保险及住房公积金实施细则》(深府[1992]179号)两个规范性文件建立起来的。根据该等规定,职工住房公积金的规定适用于有本市常住户口的企业固定职工和合同制职工。

公司在深圳市南山区松坪山拥有松坪山高新宿舍32栋等100处房产,该等房产专门用作职工宿舍,为在深圳没有住房的员工提供集体宿舍以解决员工住宿问题。同时,鉴于在深圳市的实践操作过程中,对于未建立住房公积金制度的公司,一般采取住房补贴的形式,公司建立了符合自身的住房补贴制度:在2010年6月以前,给员工发放了住房补贴。从2010年7月起,公司为所有深圳户籍员工按国家规定缴存住房公积金,住房公积金由深圳市社会保险基金管理局代收。

## **(2) 2010年12月之后公司住房公积金缴付情况**

2010年12月,深圳市《深圳市住房公积金管理暂行办法》及《深圳市住房公积金缴存管理暂行规定(试行)》正式生效实施,公司开始按照有关规定为全体在职员工缴存住房公积金。

针对上述情况,控股股东丹邦投资集团承诺:若应有权部门的要求或决定,发行人及其子公司需为职工补缴的住房公积金、或发行人及其子公司因未为职工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失,丹邦投资集团愿在毋须发行人支付对价的情况下承担所有补缴金额和相关所有费用及/或相关的经济赔偿责任。

根据深圳市人力资源和社会保障局出具的《关于深圳丹邦科技股份有限公司守法情况的复函》,公司在报告期内无重大劳动违法违规记录。

## **十一、持有发行人 5%以上股份的股东及作为股东的董事、监事及高管人员的重要承诺**

1、持有发行人5%以上股份的股东及作为股东的董事、监事及高管人员关于股份流通限制和自愿锁定的承诺详见本招股说明书第四节“发行人基本情况”之“九、(五)本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺。”



2、控股股东丹邦投资集团及实际控制人刘萍向本公司出具了避免同业竞争的《承诺函》，详见本招股说明书第六节“同业竞争与关联交易”之“一、（四）控股股东和实际控制人作出的避免同业竞争的承诺”。

3、针对公司享受的企业所得税优惠被追缴的风险，发行人控股股东丹邦投资集团出具了《承诺函》，承诺“发行人公开发行股票并上市后，若税收主管部门要求发行人补缴因其享受有关税收优惠政策而免征及少征的企业所得税，本公司将无条件全额承担发行人在本次发行上市前应补缴的税款及因此所产生的所有相关费用”。

4、针对可能补缴职工住房公积金的情况，发行人控股股东丹邦投资集团出具了《承诺函》，承诺“若应有权部门的要求或决定，发行人及其子公司需为职工补缴的住房公积金、或发行人及其子公司因未为职工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，丹邦投资集团愿在毋须发行人支付对价的情况下承担所有补缴金额和相关所有费用及/或相关的经济赔偿责任”。

## 第五节 业务与技术

### 一、发行人主营业务及其发展情况

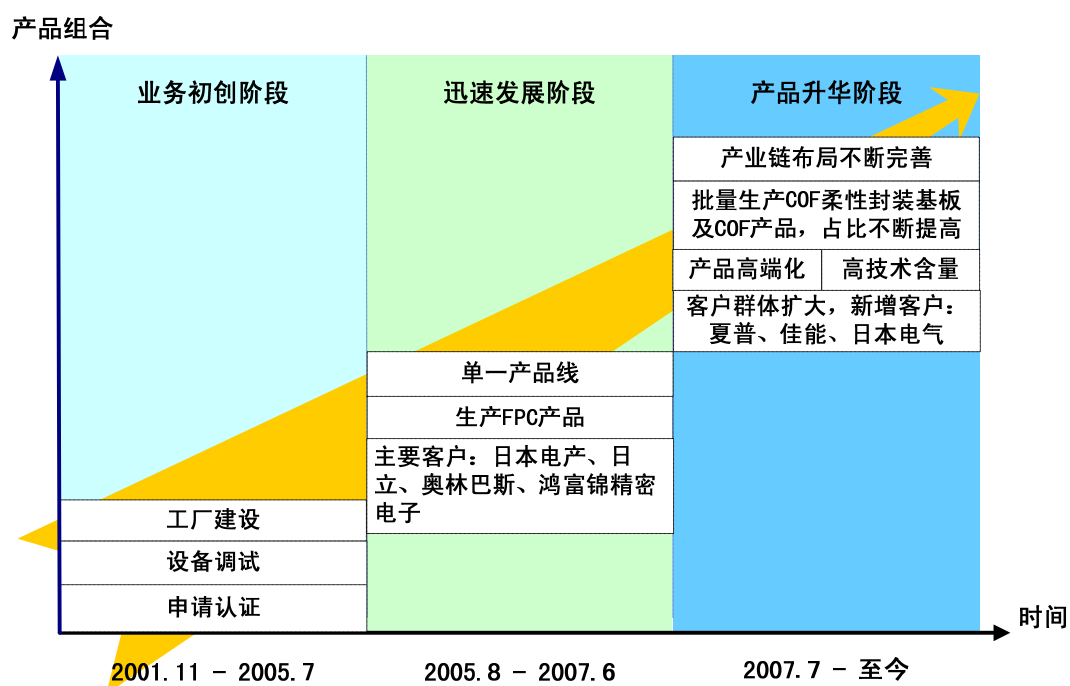
#### （一）主营业务

本公司主营业务是 FPC、COF 柔性封装基板及 COF 产品的研发、生产与销售。本公司成立以来，主营业务未发生过变化。

#### （二）主营业务发展情况

按公司提供产品的深度、广度及科技含量，以及主要客户群体的扩展，公司主营业务发展可以分为以下三个阶段：

丹邦科技业务发展阶段示意图



报告期内，公司不断完善产业链布局，打造行业领跑者，在持续提升 FPC 产品品质的同时，率先打破国际领先企业对原材料供应和技术垄断，重点发展高技术含量、高附加值的 COF 柔性封装基板及 COF 产品。2008 年-2010 年，公司 COF 柔性封装基板及 COF 产品合计占营业收入比例分别为 55.50%、76.66%和 78.79%，高技术含量产品占比逐年提升。随着产品结构不断优化，公司高端客户群体不断

扩大，公司 2008 年开始成为日本夏普、佳能在中国的 COF 产品及 COF 柔性封装基板主要供应商。公司产品以出口为主，报告期内，产品外销比例均保持在 98% 以上，产品销售市场主要集中在日本、欧美、东南亚、香港等地区。

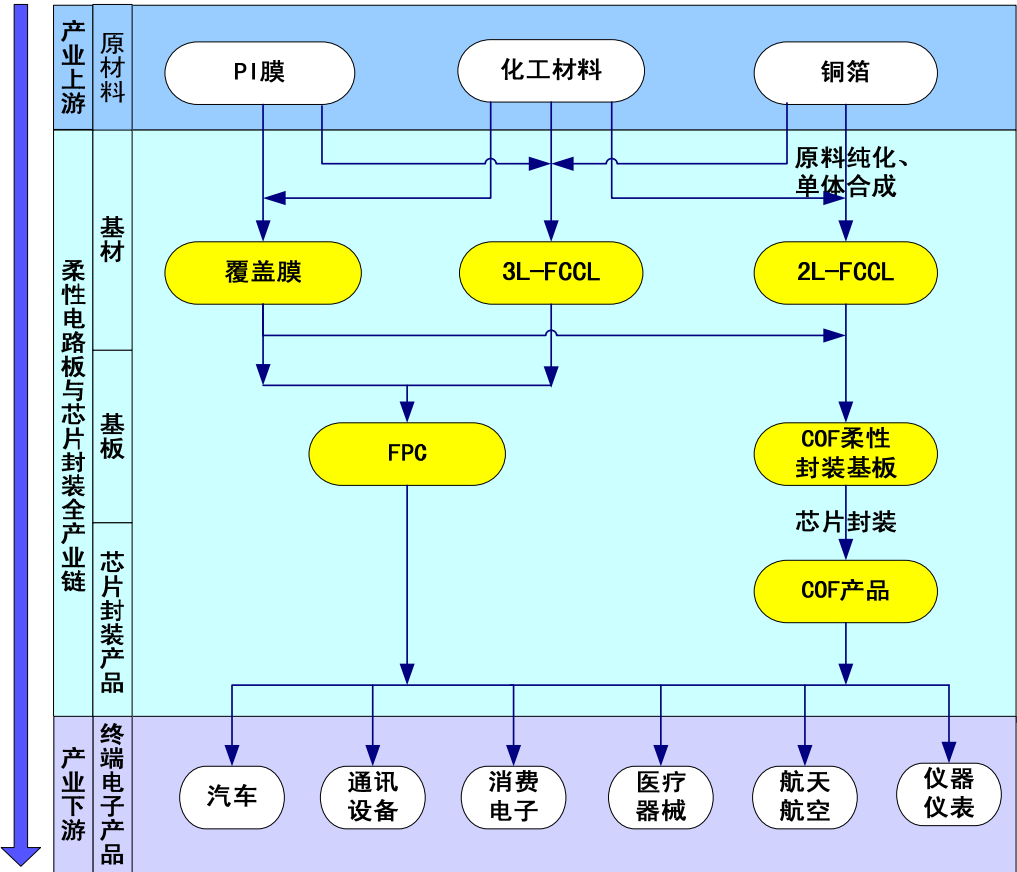
（三）公司产品产业链及其上下游关系

公司产品产业链构成及其上下游关系如下：

原材料 → 基板材料（简称“基材”）→ 电路板（简称“基板”）→ 芯片封装产品 → 终端电子产品

公司是全球极少数有完整产业链布局的厂商，主导产品 FPC、COF 柔性封装基板及 COF 产品涉及产业链各主要环节，广泛应用于各类终端电子产品，其中，FPC、COF 柔性封装基板属于电路板，COF 产品属于邦定芯片后的封装产品。

公司产品产业链及其上下游关系示意图



原材料：公司产品涉及的原材料主要包括铜箔、PI 膜、保强板、粘合剂、芯片及器件以及其他配套材料。

其中，铜箔、PI 膜、保强板、粘合剂及芯片及器件等材料通过外购取得；

而生产 COF 柔性封装基板及 COF 产品所需的热固化胶、微粘膜、覆盖膜等关键配套材料均由公司利用自有核心技术自主生产。公司自主研发生产的热固化胶、微粘膜、覆盖膜等主要配套材料均可用于生产绿色、无铅、无卤素产品。

基材：基材是生产基板的主要原材料，基材包括覆盖膜、3 层型有胶柔性覆铜板（简称“3L-FCCL”）、2 层型无胶柔性覆铜板（简称“2L-FCCL”），其中，2L-FCCL 又可根据产品档次及用途的不同，分为柔性封装基板用高端 2L-FCCL 和 FPC 用普通 2L-FCCL。公司是国内极少数掌握用于柔性封装基板的高端 2L-FCCL 制造工艺并大批量生产的厂商之一，所用基材及配套材料均通过自主研发生产。

基板：基板分为无搭载芯片的常规印制电路板（又被称为母板、主板），如 FPC，以及可邦定芯片的封装基板（印制电路板的重要高端分支产品），如 COF 柔性封装基板。公司是国内极少数不依赖进口封装基材，而通过自产封装基材批量制造 COF 柔性封装基板的厂商。

芯片封装产品：以 COF 柔性封装基板作载板，将半导体芯片与柔性封装基板邦定，形成的封装体组件即为 COF 产品。

（四）主要产品功能及应用

公司产品主要包括 FPC、COF 柔性封装基板及 COF 产品，三类产品主要区别如下图所示：

| 项目   | FPC                | COF 柔性封装基板          | COF 产品              |
|------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 特点   | 不能够邦定芯片            | 能够邦定芯片、超微细化线路       | 能够邦定芯片、超微细化线路       |
| 功能   | 电路联通、传输信号          | 邦定芯片、电路连通、传输信号、绝缘支撑 | 驱动和控制液晶屏电流电压，显示不同画面 |
| 基材   | 3L-FCCL、低端 2L-FCCL | 高端 2L-FCCL          | 高端 2L-FCCL          |
| 竞争格局 | 行业集中度低、竞争激烈        | 行业集中度非常高、少数企业垄断     | 行业集中度较高、竞争较激烈       |
| 毛利率  | 30%-50%            | 50%-60%             | 50%-60%             |

## 1、FPC 简介

FPC 是 Flexible Printed Circuit board 的英文缩写，即柔性印制电路板，是连接电子零件用的基板和电子产品信号传输的媒介，作为印制电路板的一种重要类别，2009 年全球 FPC 产值占全球印制电路板总产值的 16.1%。按照不同的分类方法可以柔性印制电路板分为不同的种类，按层数划分，FPC 可分类为单面柔性板、双面柔性板、多层柔性板；按柔软度划分，FPC 可分类为柔性板、刚柔结合板（即刚性板与柔性板相接合的印制电路板）。

与刚性印制电路板相比，柔性印制电路板具有以下优势：

①轻、薄、短、小，结构灵活，可弯曲、卷曲、折叠和立体组装，能取代很多转接部件，便于最大使用有效空间，使电子产品在外观上变得更为轻薄，广泛应用于具有小型化、轻量化和移动要求的各类电子产品；

②耐热性高，可制造更高密度和更精细节距的产品，满足元器件之间高密度互连及高稳定性的要求，使信号输出品质有较大提升；

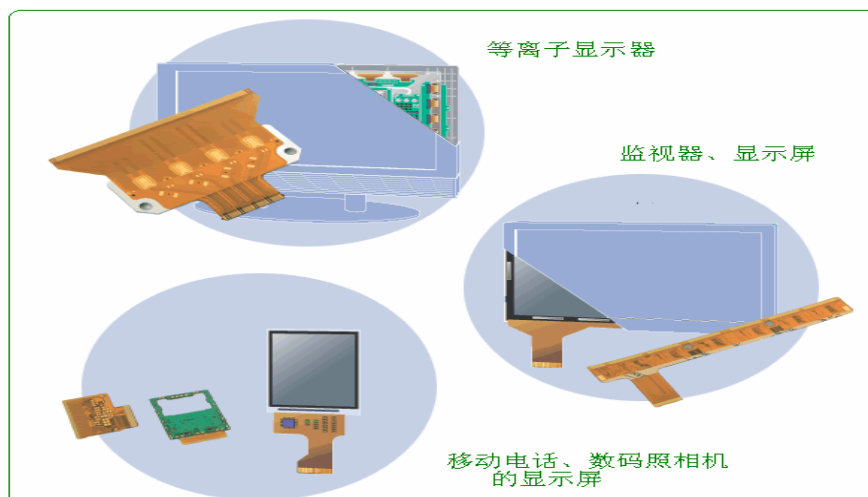
③可采用卷绕的传送滚筒加工方法（Roll-to-Roll），易于自动化、量产化，提高生产效率。

| 产品线 | 主要产品                         | 主要功能及特点                                                                        |
|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| FPC | 手机用 FPC                      | 用于显示屏连接主板、照像头连接主板、旋转式手机旋转部位连接主板、翻盖式手机翻盖部位连接主板、LED 光源、按键盘等，具有挠折性、轻薄与 3 度空间配线等特性 |
|     | 笔记本电脑用 FPC                   | 用于液晶显示屏转轴连接主板、CD-ROM 连接主板、软盘连接主板、硬盘连接主板、开关连接主板和键盘连接主板                          |
|     | 液晶显示器及等离子显示器用 FPC            | 用于液晶面板和液晶模块连接部位                                                                |
|     | 数码相机以及硬盘、光驱、移动存储等 PC 配件用 FPC | 用于激光读写头，具有高柔软度及超薄特性，以完成快速的资料读取                                                 |

## FPC 在手机中的应用示例



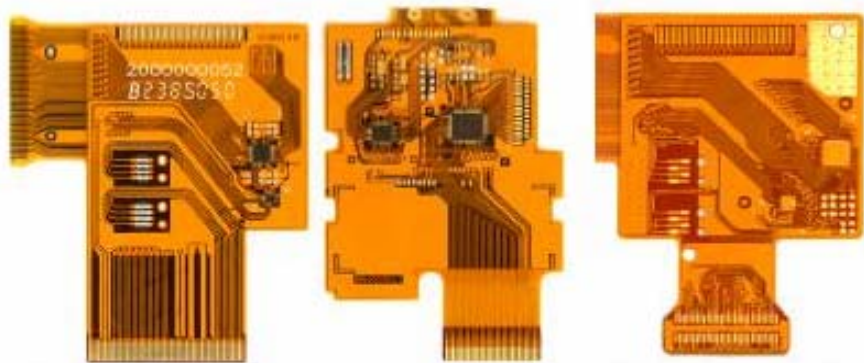
## FPC 在液晶显示器的应用示例



## 2、COF 柔性封装基板简介

COF 柔性封装基板作为印制电路板产品中的重要高端分支产品，指还未装联上芯片、元器件的封装型柔性基板。在芯片封装过程中，起到承载芯片、电路连通、绝缘支撑的作用，特别是对芯片起到物理保护、提高信号传输速率、信号保真、阻抗匹配、应力缓和、散热防潮的作用。另外，COF 柔性封装基板具有配线密度高、重量轻、厚度薄、可折叠、弯曲、扭转等优点，是一种新兴产品，有利于先进封装技术的使用和发展。

C0F 柔性封装基板图例



与 FPC 相比，C0F 柔性封装基板具有以下特点：

①C0F 柔性封装基板可以搭载芯片，而 FPC 不能够搭载芯片，只能用作电子产品信号传输的媒介；

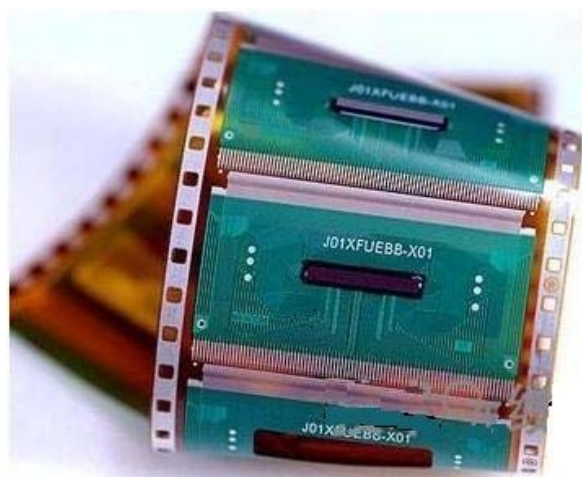
②C0F 柔性封装基板体积更小，电路制作更精密、配线密度更高；

③C0F 柔性封装基板对导电及绝缘可靠性、耐热性、耐湿性、弹性率、板的厚度均匀性等性能要求都要高于 FPC。

### 3、C0F 产品简介

C0F 产品是 Chip on flexible printed circuit 的英文缩写，是用 C0F 柔性封装基板作载体，将半导体芯片直接封装在柔性基板上形成的芯片封装产品。

C0F 产品图例



C0F 产品的作用是通过柔性基板与液晶面板连接导通芯片，由芯片驱动和控制液晶面板电流、电压，从而改变液晶状态显示不同画面。目前，C0F 产品广泛应用于液晶电视、智能 3G 手机及笔记本电脑等产品液晶屏的显示驱动。

| 产品线                | 主要产品          | 主要功能及特点                                                |
|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| COF 柔性封装基板及 COF 产品 | 手机用 COF 产品    | 用于各种型号智能手机，多层布线、软硬结合，产品功能可靠，弯折滑动寿命达到 20 万次以上           |
|                    | LCD 用 COF 产品  | 用于各类液晶屏驱动芯片，产品稳定性高，可实现 180 度弯折                         |
|                    | LED 用 COF 产品  | 由 COF 及发光二极管组成，用于液晶背光                                  |
|                    | 激光读写头用 COF 产品 | 用于笔记本电脑、蓝光 DVD、车载 DVD 等各类消费电子产品的激光读写头，弯折寿命达到 3000 万次以上 |
|                    | 高频高密阻抗 COF 产品 | 用于我国航天航空、国防军工等尖端领域的高频信号传输                              |

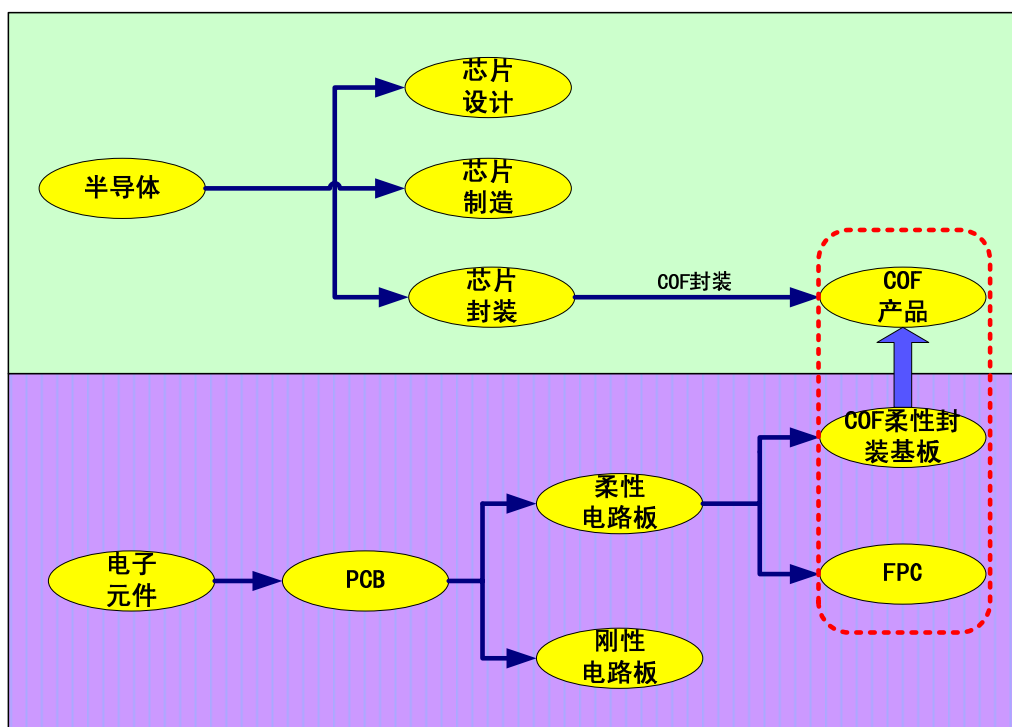
## 二、发行人所处行业的基本情况

### （一）行业管理体制和行业政策

根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司主要产品属于电子元件制造业（行业代码：C8515）。根据国家统计局最新修订的《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754—2002），FPC 和 COF 柔性封装基板属于电子元件制造业（行业代码：C406）中的 PCB 印制电路板制造业（行业代码：C4062），COF 产品属于柔性电路板与芯片封装相结合的新兴产品，国内只有极少数公司能够生产此类产品，尚无相关行业资料或数据，因此，本招股说明书仍将 COF 产品作为柔性印制电路板行业的产业链延伸来分析。



公司产品所属行业示意图



公司行业主管部门为中华人民共和国工业和信息化部，负责行业管理，产业政策制定与行业发展规划等。中国电子材料行业协会是行业的自律组织，隶属工业和信息化部。

近年来，我国相继推出了一系列支持电子元件制造业发展的政策，具体如下：

| 发布部门及时间                        | 主要政策                           | 主要规定                             | 涉及的公司主导产品      |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 发改委<br>2005年12月                | 《产业结构调整指导目录（2005年本）》           | 新型电子元器件，如高密度印制电路板和柔性电路板等制造属鼓励类产业 | 高密度印制电路板和柔性电路板 |
| 工业和信息化部<br>2006年9月             | 《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》 | 发展重点技术包括多层、柔性、柔刚结合和绿色环保印制电路板技术   | 绿色环保柔性印制电路板技术  |
| 发改委、科技部、商务部、国家知识产权局<br>2007年1月 | 《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）》  | 优先发展高密度印制电路板和柔性电路板               | 高密度柔性印制电路板     |
| 发改委、商务部<br>2007年1月             | 《外商投资产业指导目录（2007）》             | 高密度互连积层板、多层柔性板、刚柔印制电路板属鼓励外商投资类   | 多层柔性板          |
| 科技部、财政部、国家税务总局<br>2008年4月      | 《国家重点支持的高新技术领域》                | 刚柔结合板和高密度积层板为国家重点支持的高新技术领域产品     | 高密度积层板         |

|                        |                       |                                                                                                                             |                                         |
|------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 发改委、工业和信息化部<br>2009年9月 | 《电子信息产业技术进步和技术改造投资方向》 | 重点支持高端印制电路板及覆铜板材料，高端印制电路板包括高密度互联多层印制电路板、多层挠性板、刚挠印制电路板、IC封装基板、特种印制电路板；鼓励节能减排工艺发展，重点发展环保型的高性能覆铜板、特殊功能覆铜板、高性能挠性覆铜板和基板材料等研发和产业化 | 多层挠性板、IC封装基板（包括COF柔性封装基板）、高性能挠性覆铜板、基板材料 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|

## （二）行业发展概况

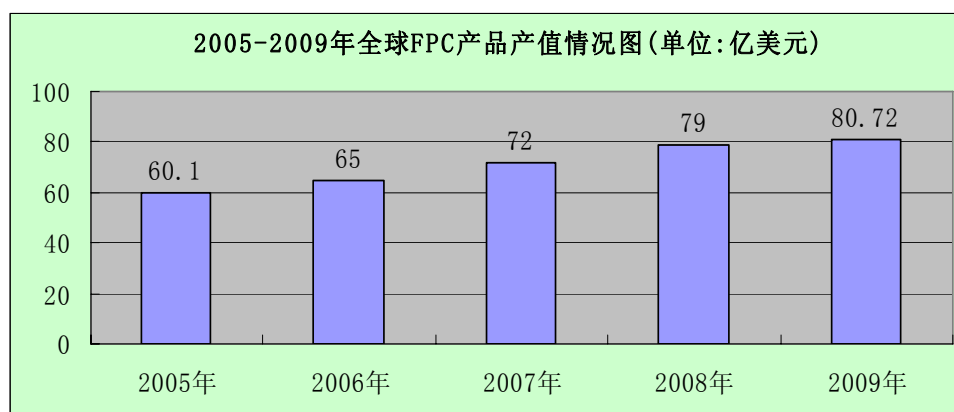
### 1、柔性印制电路板行业发展状况

#### （1）全球市场发展状况

##### ①全球产值规模不断增长

柔性印制电路板需求由下游终端电子产品需求所主导，随着下游终端电子产品不断更新换代，全球柔性印制电路板行业近年来保持较快发展。根据JMS的统计，2006年至2009年，世界FPC产值年增长率分别为8.15%、10.77%、9.72%和2.18%。受全球金融危机影响，2009年全球FPC产品产值为80.72亿美元，较2008年增长2.18%，增速较以前年度有所放缓。

2005-2009 年全球 FPC 产品产值情况如下图：



数据来源：JMS

##### ②产业转移促使亚洲成为全球重要生产基地

21世纪以来，欧美发达国家FPC产业因成本过高而未继续成长，产业逐步外移至亚洲地区，根据Prismark的统计，美洲、欧洲的FPC产值近几年处于负增长的趋势，其中，2008年欧洲FPC产值较2006年下降7.7%，而亚洲是目前全球FPC产值最大及增长最快的地区，2008年亚洲FPC产值占全球FPC产值的92%，2008年

较2006年增长17%，其中，日本是亚洲最大的FPC生产国，2008年日本的FPC产值占全球FPC产值的25.4%，其FPC 产值的增长得益于近几年全球智能手机和高端手机对FPC 的应用量增大，就FPC技术水平、产量、产值而言，日本均为世界第一；我国台湾地区是亚洲（不含日本）主要的FPC 生产地之一，2008 年台湾FPC 产值占全球市场的份额为10%左右，台湾FPC产业正随着下游厂商外移至中国大陆，目前，台湾从事FPC 生产的主要上市公司均已在大陆设立生产基地，中国大陆FPC产业处于高速发展的状态。

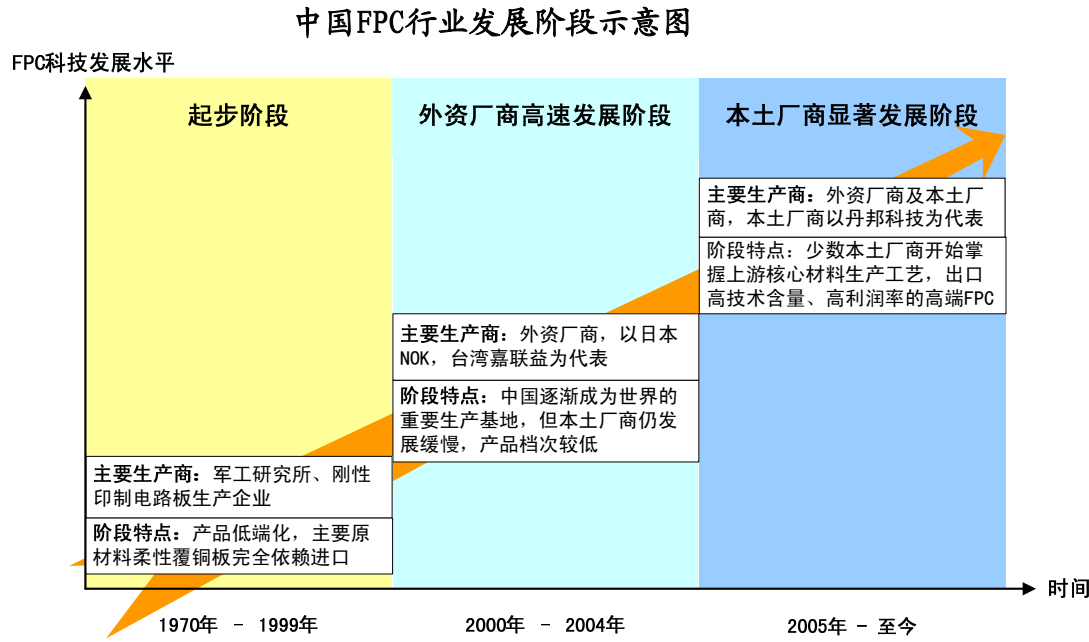
③应用范围日趋扩大

20世纪60年代，FPC最早被美国应用于军事领域，如人造卫星、雷达系统、导弹控制装置等，20世纪90年代，日本走在了世界各国前列，开始大力发展了FPC技术，使FPC迅速从军用品转到民用，FPC被广泛应用于计算机、照相机、打印机、汽车音响等消费电子产品中，21世纪以来，随着信息化时代的来临，在消费电子产品追求轻、薄、短、小设计的背景下，FPC应用范围扩大到新的领域，包括手机、PDA、笔记本电脑、数码相机、数码摄像机、汽车卫星方向定位装置、液晶显示屏等小型化终端电子产品。

(2) 中国市场发展状况

①行业发展阶段

中国柔性电路板行业基本经历了三个阶段的发展，具体如下图所示：



#### A、起步阶段（1999年以前）

中国最早进行FPC研发生产是在20世纪70年代，当时我国一些顶尖的军工研究所开始研究和少量生产FPC，并应用于军事领域，在随后的20年中，我国一些刚性印制电路板厂家开始陆续加入FPC的研发生产，但由于研发水平有限，主要原材料柔性覆铜板完全依赖进口，导致FPC未形成大批量的生产规模，所生产的FPC仅少量用于计算机、照相机，根据CPCA统计，1998年，我国FPC的年产量只有25万m<sup>2</sup>，年产值为5,000万元，产值约占全球产值的0.23%。

#### B、外资厂商高速发展阶段（2000—2004年）

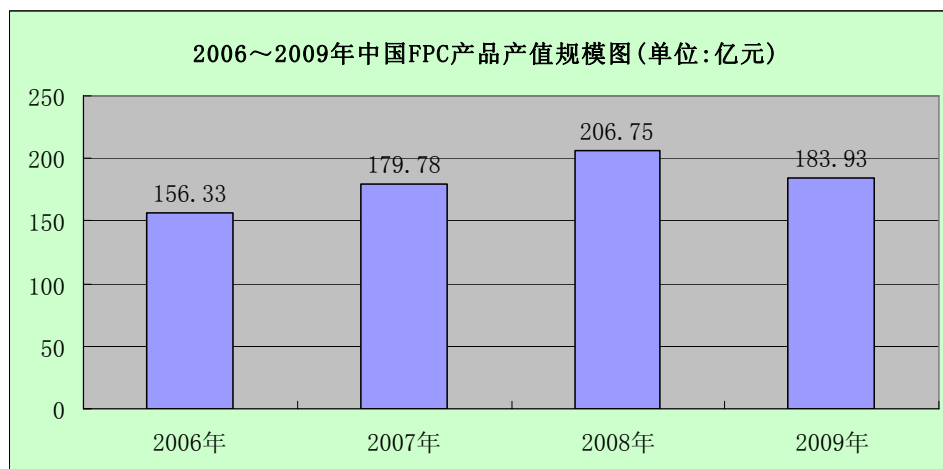
21世纪以来，FPC产业由于受成本和下游产业转移的影响，逐渐向中国等发展中国家转移，日本、中国台湾、美国企业开始在中国大陆大规模投资建设FPC生产厂，如日本的Nippon Mektron（简称“NOK”）、Fujikura、Sony Chemical，美国Parlex、M-Flex，台湾的嘉联益、佳通等均在中国设有子公司，特别是世界上最大的FPC生产厂日本NOK在珠海设立全资子公司珠海紫翔电子科技有限公司，标志着中国大陆逐渐成为世界FPC的重要生产基地，中国FPC行业进入高速发展阶段，与此同时，中国大陆多家本土著名的刚性印制电路板企业，也相继改建、新建FPC工厂，包括广州安费诺诚信软性电路有限公司、珠海元盛电子科技股份有限公司等，但本土FPC厂商受上游基材生产工艺和成本制约，未见明显发展，生产的FPC产品档次较低，利润较低。根据CPCA统计，2000—2004年，我国FPC年增长率为62%，2004年，我国FPC的年产量为950万平方米，年产值为85亿元，产值约占全球产值的17%。

#### C、本土厂商显著发展阶段（2005年至今）

2005年以来，本土厂商产能及市场规模扩张很快，开始较大规模的工业生产，但产品局限于低端市场。以丹邦科技为代表的少数国内本土FPC厂商率先掌握上游核心基材柔性覆铜板的生产工艺，致使原材料成本显著降低、产品质量较大提升，开始出口高技术含量、高利润的高端FPC产品。根据CPCA统计，2009年，我国FPC的年产量达到2,940.12万平方米，年产值达到183.93亿元，产值约占全球产值的33.5%。

## ②行业发展规模

2006-2009年中国FPC产品产值规模如下图：



数据来源：CPCA. 2010. 4

## 2、柔性印制电路板行业市场前景

FPC 需求由下游电子信息产品需求所主导，应用领域几乎涉及所有的电子信息产品，总体来说，消费电子产品、通信设备、汽车载品是 FPC 最大的三个应用领域；在具体细分电子信息产品上，手机、笔记本电脑、液晶显示器、等离子显示器、数码相机以及硬盘、光驱、移动存储等 PC 配件是 FPC 主要的应用市场；其他便携式电子产品如 MP3、便携式 DVD、汽车音响都是 FPC 下游应用领域，虽然这类产品增长率有限，但会保持长期增长。

未来，FPC 普及和应用的市场驱动力有以下几个方面：

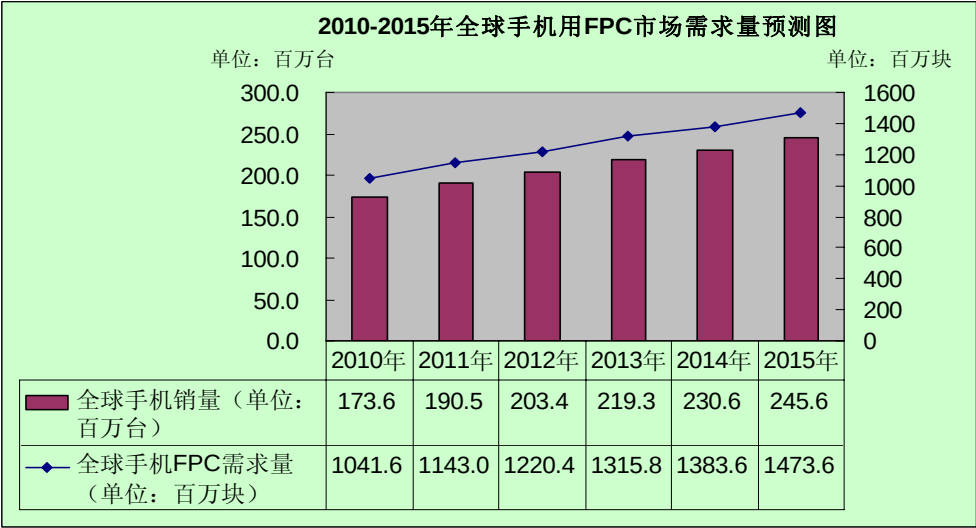
### ①手机 FPC 市场

手机是 FPC 市场的主要增长动力，近年来，受惠于轻、薄、小巧、旋转式、翻盖式、滑盖式、彩屏及具有拍照和摄像功能的新款智能手机和高端手机产品需求的迅速增长，以及移动显示和平板显示对空间利用率的要求，具有挠折性、轻薄与 3 度空间配线等特性的 FPC 符合新款手机的设计需求，使用频率不断增加，成为新款手机中取代笨重、占用空间大的刚性电路板的首选。

一般来说，每部手机大致需用到 6 块 FPC，具体用于显示屏连接主板、照像头连接主板、旋转式手机旋转部位连接主板、翻盖式手机翻盖部位连接主板、LED

光源、按键盘等，因此，随着未来全球手机需求持续稳定增长，手机用 FPC 市场空间十分广阔。

2010-2015 年，全球手机用 FPC 市场需求预测如下：



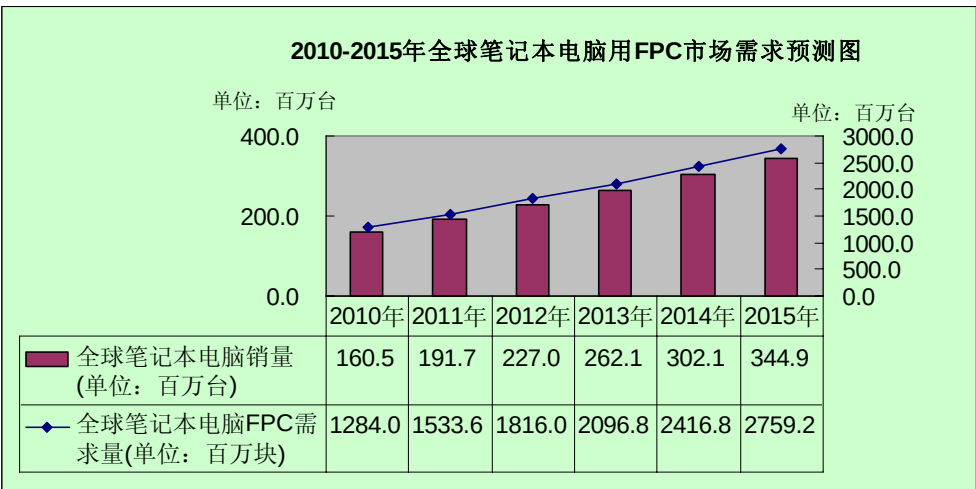
资料来源：Displaysearch，2009 年 4 月

注：全球手机用 FPC 需求量预测基于以下假设——每部手机 FPC 用量平均为 6 块。

### ②笔记本电脑 FPC 市场

笔记本电脑 FPC 市场的另一主要增长动力，目前每台笔记本电脑大致需要用到 8 块 FPC，具体用于液晶显示屏转轴连接主板、CD-ROM 连接主板、软盘连接主板、硬盘连接主板、开关连接主板和键盘连接主板等。

2010-2015 年，全球笔记本电脑用 FPC 市场需求预测如下：



资料来源：Displaysearch，2009 年 4 月

注：全球笔记本电脑用 FPC 需求量预测基于以下假设——每台笔记本电脑 FPC 用量平均为 8 块。

### ③液晶显示器及等离子显示器 FPC 市场

液晶电视及等离子电视替代传统 CRT 电视的趋势已不可逆转，是消费电子市场中的高成长性产品。从 FPC 用量看，目前一台液晶显示器的 FPC 用量约为 2~4 块，主要用于液晶面板和液晶模块。未来在笔记本电脑、液晶电视等主要下游产品需求的带动下，预计液晶显示器对 FPC 的需求仍将十分强劲。等离子显示器对 FPC 用量更大，目前每台等离子显示器需使用约 20 块 FPC。

### ④数码相机以及硬盘、光驱、移动存储等 PC 配件 FPC 市场

数码相机属于高成长性的消费电子产品，目前每台数码相机需使用约 2-4 块 FPC，且无论是采用 CMOS 或 CCD 成像技术的数码相机均需使用 FPC，故在数码相机未来可望大幅取代传统相机的趋势下，数码相机将是 FPC 产品未来重要的下游应用领域之一。硬盘、光驱、移动存储（如 U 盘）等 PC 配件都十分依赖 FPC 的高柔软度及超薄特性，以完成快速的资料读取，未来 PC 配件市场的平稳成长将带动 FPC 的需求。

## 3、柔性印制电路板行业竞争格局

### （1）全球市场竞争格局

从世界范围内来看，全世界 FPC 制造企业大部分在日本、韩国、美国、中国大陆及中国台湾，根据 Prismarkd 的统计，2008 年亚洲 FPC 产值占全球 FPC 总产值的 92%，其中，日本 FPC 产值占全球 FPC 总产值的 25.4%。

全球 FPC 市场区域格局可按产品技术水平高低划分为三个层次：

日本、美国厂商处于第一层次，在 FPC 设计、制造工艺方面，都处于世界领先地位，技术水平引领行业发展趋势，在长期的市场竞争中，逐步将主要精力转向高端市场，从提升产品档次、产品创新与研发、品牌建设方面提高自身竞争能力，但美国因成本原因并未形成大规模的民用产业，主要用于国防工业及尖端科技方面，而日本在形成民用产业方面占有绝对优势，是世界最大的 FPC 生产国，日本厂商拥有强大的研发实力和完整的上下游产业链，掌握着大量先进专利技术和标准，同时拥有环保工艺和基础材料的优势。根据日本矢野研究所统计，2008 年日本排名前十位的 FPC 制造商的 FPC 产值占日本 FPC 总产值的 90% 以上，行

业集中度非常高，其中，日本排名首位的 NOK 也是全球 FPC 产值最大的公司。

韩国和中国台湾厂商处于第二层次，技术及设备水平都略低于日本，强于我国大陆，在中档产品领域占有大部分的市场份额，21 世纪以来，中国台湾 FPC 厂商不断向中国大陆转移，在中国大陆建立的 FPC 生产厂的产值逐年增加，2007 年起在中国大陆的产值开始超过中国台湾的 FPC 产值。

中国大陆厂商处于第三层次，大多数内资企业对新技术开发投入较少，行业技术水平与国际先进技术水平相比还有差距，而且上游 FCCL 材料的供应主要依赖进口，成为中国 FPC 产业发展重大的障碍，虽然近几年本土厂商有显著发展，产能及市场规模扩张很快，但产品局限于低水平、低利润的低端市场。本公司通过多年的技术攻关，已成为少数掌握上游核心基材制造工艺，定位高端市场，规模化生产高技术含量、高利润率 FPC 产品的内资企业。

2008 年全球 FPC 市场生产商按产值排名前十位情况如下表：

单位：亿美元

| 排名 | 公司名称                   | 国家/地区 | 2008 年产值 |
|----|------------------------|-------|----------|
| 1  | NOK（旗胜）                | 日本    | 12.33    |
| 2  | Multek（超毅）             | 美国    | 8.15     |
| 3  | Compeq（华通电脑）           | 中国台湾  | 6.97     |
| 4  | LG Micron（LG 微电子）      | 韩国    | 6.46     |
| 5  | Fujikura（藤仓）           | 日本    | 6.35     |
| 6  | TTM（泰科）                | 美国    | 5.96     |
| 7  | Foxconn（富士康）           | 中国台湾  | 5.50     |
| 8  | Daeduck（大德）            | 韩国    | 5.42     |
| 9  | Young Poong（永丰）        | 韩国    | 5.35     |
| 10 | Hitachi Chemical（日立化成） | 日本    | 5.00     |

资料来源：WORLD TOP PCB MAKER IN 2008 by NTI Hayao Nakahara

注：上表中 2008 年产值包括刚性 PCB 和 FPC 产值。

## （2）中国市场竞争格局

中国大陆目前有 100 多家 FPC 生产企业，从产业规模上来说已经成为产量大国，但市场集中度较低，呈现高度分散的竞争格局，生产厂家集中分布在广东省（厂家数量约占 49%）、华东地区（厂家数量约占 31%），其中，有近 1/3 数量的企业是外商投资的企业，外资企业在生产工艺和规模上均领先于内资企业，它们的产值总和约占国内 FPC 生产总值的 80%以上。

中国大陆主要外资及内资 FPC 生产厂家情况如下表：



单位：亿元

| 公司名称           | 企业性质 | 公司地点     | 2009 年产值 | 主要产品                     |
|----------------|------|----------|----------|--------------------------|
| 珠海紫翔电子科技有限公司   | 日资   | 珠海       | 20.27    | 各类 FPC                   |
| 景旺电子（深圳）有限公司   | 港资   | 深圳       | 9.56     | 各类 PCB、FPC               |
| 湖南维胜科技有限公司     | 合资   | 长沙       | 4.38     | 各类 PCB、FPC               |
| 安捷利电子实业有限公司    | 港资   | 广州、苏州和深圳 | 3.50     | 各类 FPC                   |
| 珠海元盛电子科技股份有限公司 | 内资   | 珠海       | 2.23     | 各类 FPC                   |
| 深圳丹邦科技股份有限公司   | 内资   | 深圳       | 1.83     | 各类 FPC、COF 柔性封装基板、COF 产品 |
| 厦门弘信电子科技有限公司   | 内资   | 厦门       | 1.20     | 各类 FPC                   |
| 厦门新福莱科斯电子有限公司  | 内资   | 厦门       | 1.10     | 各类 FPC                   |

资料来源：CPCA

### （三）发行人主导产品细分市场的基本情况

报告期内，公司高技术含量的COF柔性封装基板及COF产品占比逐年上升，COF柔性封装基板、COF产品是印制电路板产品中重要的高端分支产品。

#### 1、COF 柔性封装基板

##### （1）封装基板定义及分类

##### ①封装基板定义

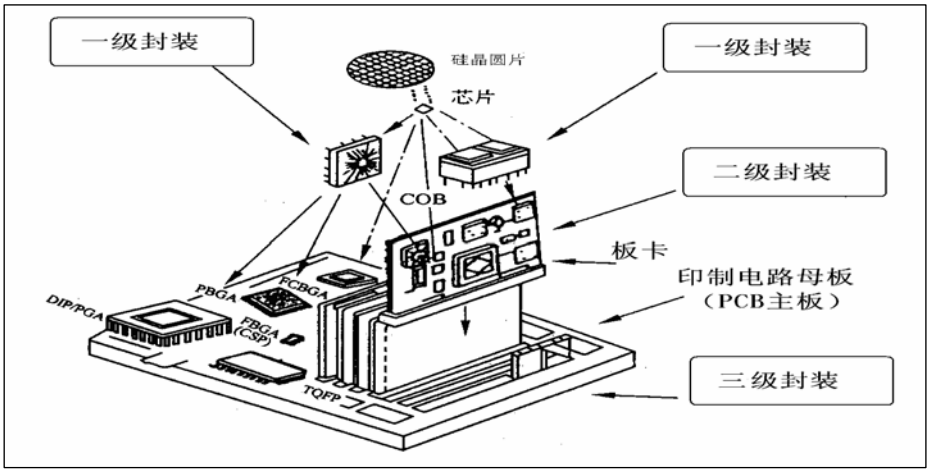
按照现代电子安装一体化的原理，印制电路板在电子安装过程的不同阶段，可划分为不同的电子安装等级，不同等级印制电路板的功能作用略有差异。封装基板作为印制电路板产品中的重要分支产品，属于一级电子安装中采用的基板。常规印制电路板如柔性印制电路板、刚性印制电路板，属于二、三级电子安装中采用的基板，又被称为母板、主板。

一级电子安装指在封装基板上直接搭载芯片，封装基板起到承载芯片、电路连通、绝缘支撑作用。二、三级电子安装指在一级电子安装的基础上，再将封装上芯片的封装基板与整机电子产品的母板、主板相连接。

封装基板较常规印制电路板有以下特点：①封装基板可以搭载芯片，而常规印制电路板无法搭载芯片；②封装基板体积更小，电路制作更精细、布线密度更高；③封装基板对导电及绝缘可靠性、耐湿性、弹性率、板的厚度均匀性、耐热

性等方面的性能要求都要高于常规印制电路板。

电子安装等级与印制电路板关系示意图



资料来源:《柔性封装基板及芯片封装产业行业调研报告》, 中国电子材料行业协会, 2010 年 4 月

②封装基板分类

封装基板按照组成基材材质的不同, 可以划分为三类: 刚性有机封装基板、柔性封装基板、陶瓷封装基板。目前在上述三类封装基板中, 刚性有机封装基板占世界封装基板总产量比重最高, 达到 80-85%。而从发展趋势上看, 近年来, 具有轻薄化、结构灵活、可挠性卷曲和折叠的特性、易实现高密度互连的柔性封装基板的需求迅速增长, 在整个封装基板市场的比重不断提升。

柔性封装基板又可按芯片封装形式的不同, 划分为 COF 柔性封装基板、TAB 柔性封装基板等。COF 柔性封装基板是目前主流的柔性封装基板, 相对于其他形式的柔性封装基板, 具有以下优势: ①尺寸缩小化、更薄、更轻; ②线距细微化, 性能更稳定; ③折弯强度更高, 形状自由度高。

本公司主导产品为 COF 柔性封装基板, 故以下仅对 COF 柔性封装基板分析。

(2) COF 柔性封装基板特点

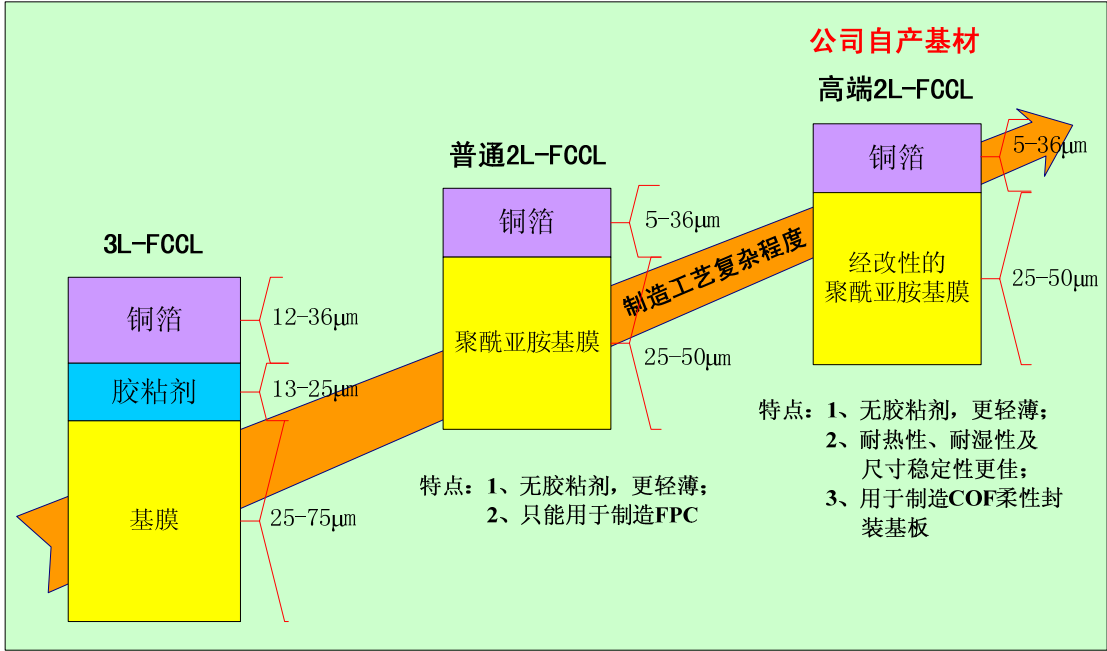
COF 柔性封装基板具有高端二层型柔性覆铜板及超微细化线路两大特点。

①高端二层型柔性覆铜板

目前, 全球仅有少数厂家有能力独立研发生产 COF 柔性封装基板, 主要原因是生产 COF 柔性封装基板的核心原材料 2L-FCCL 制造工艺复杂, 2L-FCCL 主要是

由铜箔和基膜两种材料构成。2L-FCCL 又可根据产品档次及用途的不同，分为柔性封装基板用高端 2L-FCCL 和 FPC 用普通 2L-FCCL。

柔性封装基板用高端2L-FCCL、FPC用普通2L-FCCL及3L-FCCL结构特点图



2L-FCCL 与 3L-FCCL 主要区别是：

①材料构成不同，3L-FCCL 主要是由铜箔、基膜、胶粘剂三种材料构成，胶粘剂起到粘合铜箔和基膜的作用；2L-FCCL 主要是由铜箔和基膜两种材料构成，2L-FCCL 的基膜采用高粘合性的聚酰亚胺树脂材料，这种材料制成的基膜可以直接与铜箔粘合，无需使用额外的胶粘剂，胶粘剂的缺点是含有杂质。

②性能不同，无胶粘剂的 2L-FCCL 在厚度上比有胶粘剂的 3L-FCCL 薄 25-50  $\mu$  m，更易于弯曲、折叠。

柔性封装基板用高端 2L-FCCL 和 FPC 用普通 2L-FCCL 主要区别是：

①高端 2L-FCCL 的基膜采用经改性的具有高稳定性、绿色环保的聚酰亚胺树脂材料制造，这种材料不含锑和磷、无卤素、热膨胀系数与铜箔及芯片的热膨胀系数非常接近，可以将温度、湿度变形控制在极小的范围内；普通 2L-FCCL 的基膜会因为温度、湿度的变化而产生与理论设计数值的不匹配。

②高端 2L-FCCL 在耐热性、耐湿性及尺寸稳定性等方面均优于普通 2L-FCCL，适合制造对稳定性、精密度有极高要求的 COF 柔性封装基板。

本公司是国内极少数掌握高端 2L-FCCL 制造工艺并大批量生产的厂商之一。公司通过运用高分子材料学改性聚酰亚胺材料的分子结构，提高聚酰亚胺的粘接性，同时保证了基膜与铜箔及芯片的热膨胀系数相匹配，公司研发的聚酰亚胺树脂材料热膨胀系数在 20 ppm/°C，与铜箔的热膨胀系数 18 ppm/°C 十分接近。高端 2L-FCCL 的基膜厚度在一定程度上代表产品的技术水平，目前世界上最先进且以规模化生产的高端 2L-FCCL 基膜厚度为 9-12 μm，公司生产的基膜厚度最薄可达到 12 μm，接近世界尖端水平。公司研发的聚酰亚胺挠性电路板卷材在 2005 年被广东省科技厅评为“广东省重点新产品”；在 2006 年被深圳市科技局评为“高新技术产品”。

公司研发生产的高端 2L-FCCL 填补了我国在高端柔性覆铜板材料领域技术和产品供应的空白，打破日本、韩国企业对关键材料技术垄断，有利于完善我国液晶平板显示器产业链，为我国航空航天、国防军工领域提供尖端技术支持，进一步推动我国电子信息产业发展，带动我国自有知识产权和核心技术的进步。

公司自产 2L-FCCL 主要性能参数与全球知名客户对产品性能指标要求对比如下表：

| 主要性能指标            | 知名客户要求 | 公司   | 备注                                             |
|-------------------|--------|------|------------------------------------------------|
| 热膨胀系数<br>(ppm/°C) | 30     | >20  | 热膨胀系数是衡量温度变化所导致材料面积、体积变化，热膨胀系数越低，表示材料受温度影响越小。  |
| 断裂伸长率 (%)         | 30     | <39  | 断裂伸长率是衡量材料韧性指标，伸长率越大表示材料受压力冲击时伸长幅度越大，折断可能性越小   |
| 拉伸强度 (MPa)        | 100    | <256 | 拉伸强度指材料拉伸直至断裂为止所受的最大拉伸应力，强度越大表示材料可承受拉力越大，弯折性越好 |
| 拉伸模量 (GPa)        | 3.0    | <4.2 | 拉伸模量指材料在拉伸时的弹性，模量越大表示弹性越好                      |

注：公司主要全球知名客户包括夏普、日立、日本电产、佳能等

### ②超微细化线路

超微细化线路是指 COF 柔性封装基板线宽线距小于 50 μm。当前，在电子信息产品轻、薄、短、小化趋势带动下，芯片之间的节距越来越小，线路输入输出接口越来越多，对线路精细化要求越来越高。比如，大型液晶平板显示器驱动芯片用的 COF 柔性封装基板线宽线距从 2005 年的 50 μm 减少到现今的 35 μm，行

业领军企业日本三井金属现今已能生产线宽线距仅  $20\mu\text{m}$  的 COF 柔性封装基板。

超微细化线路制造工艺复杂，涉及铜箔减薄、铜箔表面处理、图形转移、铜箔蚀刻、表面涂覆等多种技术融合应用。本公司通过多年的技术积累，已熟练掌握高微细化线路制作技术，采用减薄工艺将采购的铜箔厚度减至  $9\mu\text{m}$ ，以保证精细线路的均匀性，提高信号传输的完整性；通过调控化学药水及工艺参数，使线路达到最佳图形转移和蚀刻效果；通过表面涂覆工艺提高基板表面散热功能、耐磨性以及降低接触电阻。

公司研发的 COF 超微线路在 2007 年被深圳市政府评为“深圳市科技创新奖”；在 2008 年被广东省政府评为“广东省科学技术三等奖”。目前，公司生产的 COF 柔性封装基板线宽线距最细可达到  $25\mu\text{m}$ ，接近世界尖端水平。

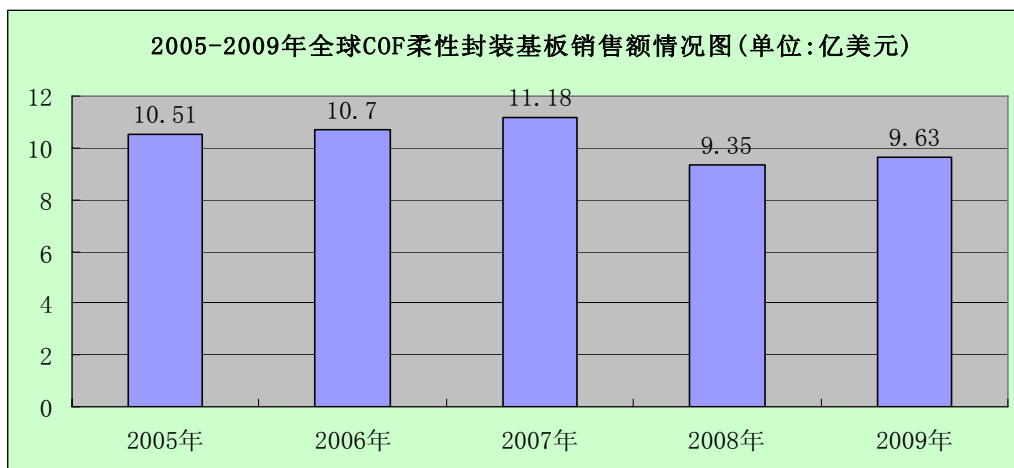
### **(3) COF 柔性封装基板市场基本情况**

#### **①市场发展平稳，与下游 TFT-LCD 应用市场息息相关**

近年来，在电子信息产品轻、薄、短、小化趋势带动下，COF 柔性封装基板被广泛应用于各种尺寸的 TFT-LCD 驱动芯片封装。驱动芯片是液晶面板模组必不可少的一部分，其作用是驱动 TFT-LCD 面板上的电压以改变液晶状态显示不同画面。驱动芯片需要先封装在基板上，再通过基板与液晶面板连接才能导通，目前，TFT-LCD 驱动芯片封装占 COF 柔性封装基板应用市场份额 85%以上，因此，COF 柔性封装基板及 COF 产品市场状况与下游 TFT-LCD 应用市场联系紧密。

除 TFT-LCD 应用市场外，随着 COF 柔性封装基板技术不断创新和突破，其兼容性越来越好，应用领域不断扩大，在电子读写磁头、扫描仪、打印机、喷墨打印头、影碟机、发动机控制器、IC 测试仪器、武器制导系统、空中导航设备、激光系统控制器、医学诊断设备、助听器、磁盘驱动器、Modem、ISDN，网卡，集线器，交换机，ADSL、VDSL、电源设备、汽车及航天仪表、手机配件、对讲机、微型马达、玩具等电子产品中应用越来越广泛。

2005-2009 年全球 COF 柔性封装基板市场规模如下图：



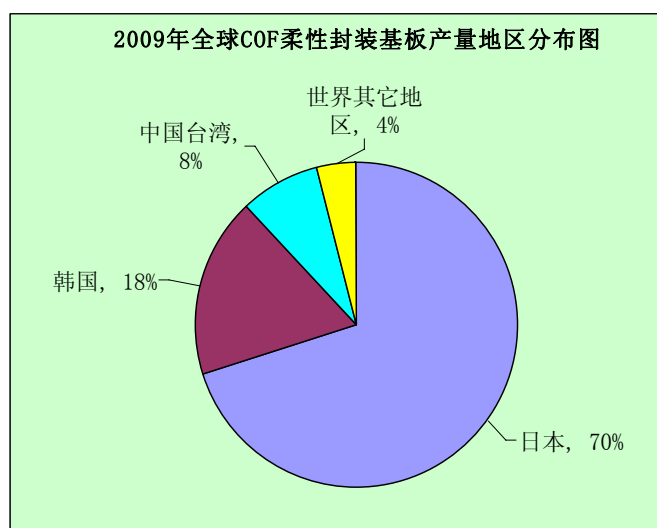
资料来源:《柔性封装基板及芯片封装产业行业调研报告》,中国电子材料行业协会,2010年4月

2008年,受世界金融危机的影响,TFT-LCD的下游应用液晶电视、手机、笔记本电脑、数码相机等产品需求量大幅下降,导致全球COF柔性封装基板销售额近年来首次出现负增长,同比下降16.37%;2009年,受益于上述产品需求在金融危机后迅速恢复,COF柔性封装基板销售额重新实现正增长。

## ②亚洲为最大生产及消费地区

TFT-LCD是COF柔性封装基板最主要应用市场。全球TFT-LCD主要生产厂商集中在日本、韩国、中国台湾及中国大陆等亚洲地区,上述地区占2009年TFT-LCD全球产量的99%以上,因此,为配合产业链整体布局,TFT-LCD上游产品COF柔性封装基板主要生产厂商也分布在上述地区。根据中国电子材料行业协会统计,亚洲是全球COF柔性封装基板最大的生产区域,2009年,全球96%以上的COF柔性封装基板均由亚洲国家生产,其中,日本为最大的COF柔性封装基板生产国,产量占全球总产量的70%,韩国、中国台湾产量分别占全球总产量的18%、8%,世界其他生产地区占4%左右。

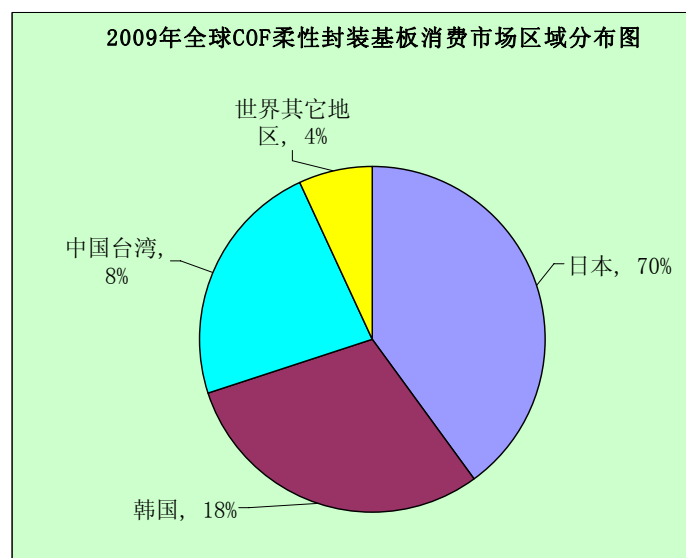
2009 年全球 COF 柔性封装基板产量区域分布图



资料来源:《柔性封装基板及芯片封装产业行业调研报告》, 中国电子材料行业协会, 2010 年 4 月

亚洲同时也是全球 COF 柔性封装基板最大的消费市场, 根据中国电子材料行业协会统计, 2009 年, 全球 93% 以上的 COF 柔性封装基板销往亚洲市场, 其中, 韩国为全球最大 COF 柔性封装基板消费市场, 需求量占全球需求总量的 40%, 主要归因于韩国是全球最大的 TFT-LCD 生产国, 对 COF 柔性封装基板需求量大。

2009 年全球 COF 柔性封装基板消费市场区域分布图

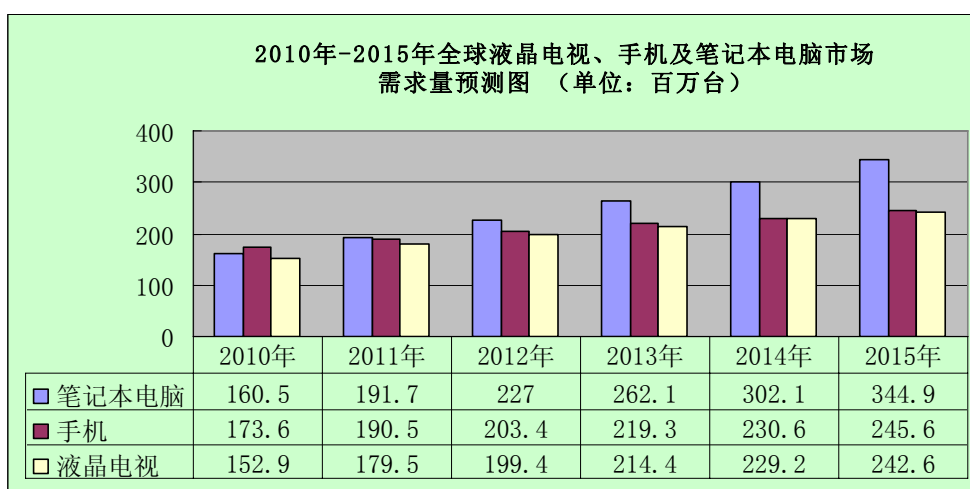


资料来源:《柔性封装基板及芯片封装产业行业调研报告》, 中国电子材料行业协会, 2010 年 4 月

#### （4）COF 柔性封装基板市场前景

COF 柔性封装基板市场前景与下游 TFT-LCD 应用市场前景息息相关。TFT-LCD 能够实现从 2 英寸以下小尺寸到 60 英寸以上大尺寸的各种尺寸的显示，下游应用范围广阔，主要应用领域包括液晶电视、手机、笔记本电脑、MP3、车载电视、PDA、高端手持游戏机等，其中，液晶电视、手机、笔记本电脑对 TFT-LCD 需求量最大，这三类产品在技术升级和消费升级带来的产品结构调整推动下将继续保持增长，市场前景广阔。

2010 年-2015 年全球液晶电视、手机及笔记本电脑市场需求量预测如下图：



资料来源：Displaysearch，2009 年 4 月

根据下游产品需求量预测，中国电子材料行业协会对 2010 年-2015 年 COF 柔性封装基板全球市场规模进行了预测，具体如下图：



资料来源：中国电子材料行业协会，2010 年 7 月



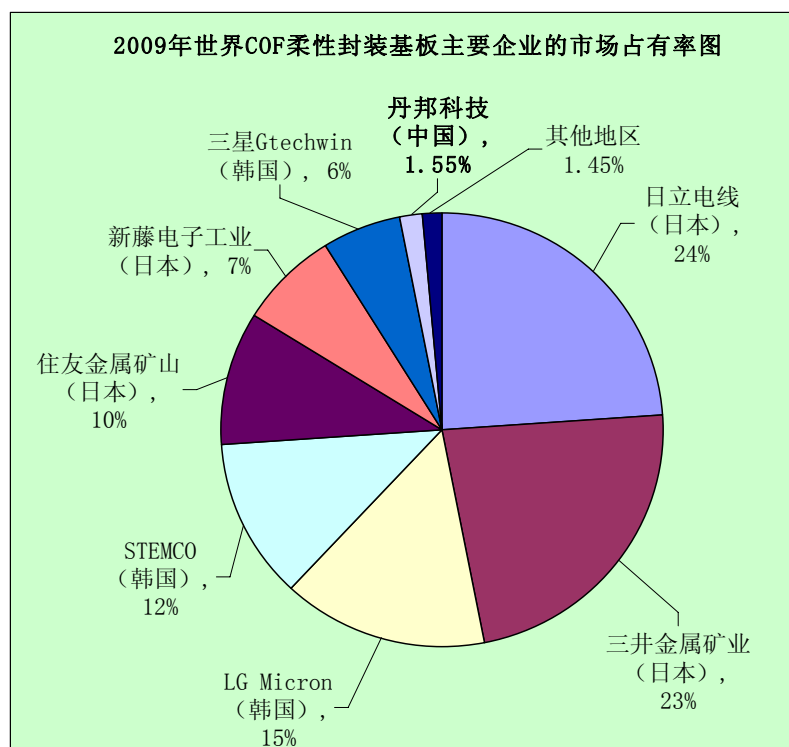
## （5）COF 柔性封装基板市场竞争格局

### ①全球市场竞争格局

长期以来，世界 COF 柔性封装基板市场份额被日本、韩国领先企业完全占领。2009 年，全球有几十家 COF 柔性封装基板生产企业，销售额排名前七位的企业占全世界销售额的 97%，呈现高度集中的竞争格局，七家企业按销售额排名依次是日本日立电线、日本三井金属矿业、韩国 LG Micron、韩国 STEMCO、日本住友金属矿山、日本新藤电子工业、韩国三星 Gtechwin。这七家企业在 COF 柔性封装基板关键制造工艺、生产能力上形成了市场垄断，且与关键原材料高端 2L-FCCL 的生产商保持紧密合作关系，同时，为维持研发技术的机密性，七家企业一直未有直接在海外建厂或与当地企业合资建厂。

2009 年，本公司的 COF 柔性封装基板销售额达到 1.016 亿元，约占全球市场总销售额的 1.55%，是全球第八大和中国最大的 COF 柔性封装基板生产商，打破日本、韩国企业在柔性电路板产业链高端封装基板领域的产品垄断，同时填补了我国在该产品领域的空白。

2009 年，世界 COF 柔性封装基板主要企业的市场占有率如下图：



资料来源：《柔性封装基板及芯片封装产业行业调研报告》，中国电子材料行业协会，2010 年 4 月

## ②中国市场竞争格局

近十年来，日本、韩国企业一直对国内 COF 柔性封装基板产业设置层层技术及知识壁垒，受制于 COF 柔性封装基板复杂的制造工艺，国内 COF 柔性封装基板产业还处于初期的起步阶段，目前国内仅有少数企业有能力自主生产 COF 柔性封装基板，这些企业大致可以分成两类，外资企业和内资企业。

外资企业主要包括日本索尼在苏州设立的全资子公司索尼凯美高电子（苏州）有限公司，日本株式会社 MISUZU 工业在无锡设立的全资子公司明思作机电（无锡）有限公司，外资企业依托母公司强大的研发实力和完整的上下游产业链，同时掌握着大量先进专利技术和标准，具有明显的先发优势。

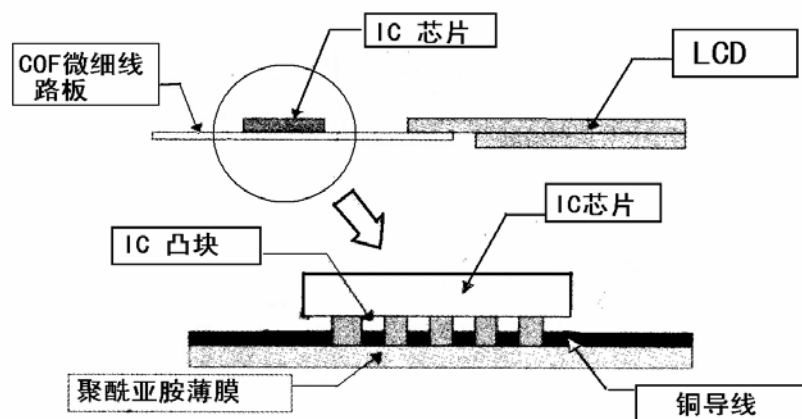
国内企业以本公司为代表，本公司通过多年的技术积累，是国内极少数掌握高端 2L-FCCL 制造工艺并大批量生产的厂商之一，填补了我国在高端柔性印制电路板领域的空白，在一定程度上影响着中国 COF 柔性封装基板产业的发展方向，公司生产的 COF 封装基板在 2010 年 5 月被国家科技部认定为“国家重点新产品”。近年来，受到国内外液晶显示器市场迅速扩大的驱动，国内多家 FPC 厂商开始涉足 COF 柔性封装基板的生产，如珠海元盛电子科技有限公司、厦门宏信电子科技有限公司等，但后进入企业的 COF 柔性封装基板目前还处于基础研发阶段，相关的认证也在申请中，比本公司落后至少 2~3 年。

## 2、COF 产品

### （1）COF 产品结构

COF 产品是用 COF 柔性封装基板作为载体，将半导体芯片直接封装在柔性基板上形成的封装产品。目前，TFT-LCD 驱动芯片封装是 COF 产品最主要的应用市场，占 COF 产品应用市场份额 85%以上。在 TFT-LCD 装配过程中，COF 产品是液晶面板模组的一部分，其作用是通过柔性基板与液晶面板连接导通芯片，由芯片驱动和控制液晶面板电流、电压，从而改变液晶状态显示不同画面。

COF产品结构示意图



资料来源：《柔性封装基板及芯片封装产业行业调研报告》，中国电子材料行业协会

COF 产品最关键制造工艺是芯片与柔性基板的连接技术，即 NCP 连接工艺，公司是国内少数掌握此项技术的企业之一。

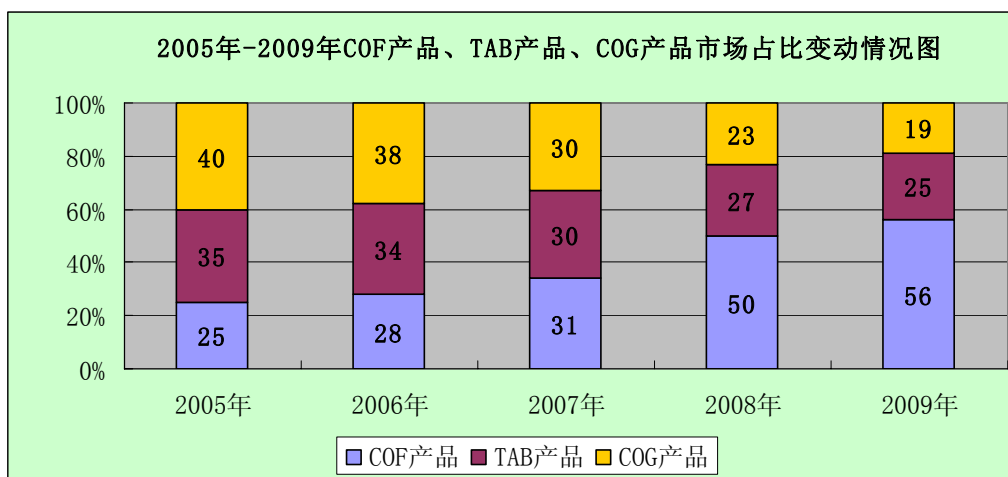
## (2) COF 产品市场现状

TFT-LCD 装配过程中常用的芯片封装产品主要有三种类别：COF 产品、TAB 产品、COG 产品。三种产品特点及应用见下表：

| 产品类别   | 定义                                                                  | 特点                                                           | 当前主要应用                      | 趋势                                      |
|--------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| COG 产品 | 将驱动芯片直接封装在 LCD 玻璃面板上,再通过刚性 PCB 和 LCD 玻璃面板连接导通芯片电路                   | 有芯片占据 LCD 玻璃面板一部分区域,减少 LCD 空间,降低分辨率                          | 中小尺寸 LCD, 分辨率低于 1280×960ppi | 受限于 COG 产品特点, LCD 分辨率低, 逐渐被淘汰           |
| TAB 产品 | 将芯片直接封装在柔性基板上,形成的封装产品再连接在 LCD 玻璃面板上,柔性基板起到导通芯片电路的作用,省去了连接刚性 PCB 的步骤 | 封装基板线宽线距在 40 μm 以上;可封装的芯片数少于 7 颗                             | 中小尺寸 LCD, 分辨率低于 1280×960ppi | 受限于 TAB 产品特点, LCD 分辨率无法提升,将逐渐被 COF 产品替代 |
| COF 产品 |                                                                     | 封装基板线宽线距在 40 μm 以下;可封装的芯片数在 10 颗以上;可达到高封装密度、节省空间、减轻总量、自由弯曲安装 | 大尺寸 LCD, 分辨率高于 1280×960ppi  | 随着大尺寸及中小尺寸 LCD 对分辨率要求不断提高, COF 产品市场前景广阔 |

注：中小尺寸 LCD 指 20 寸以下液晶显示器，大尺寸 LCD 指 20 寸以上液晶显示器。

2005 年-2009 年，COF 产品、TAB 产品、COG 产品在 TFT-LCD 用芯片封装产品市场占比变动情况如下：



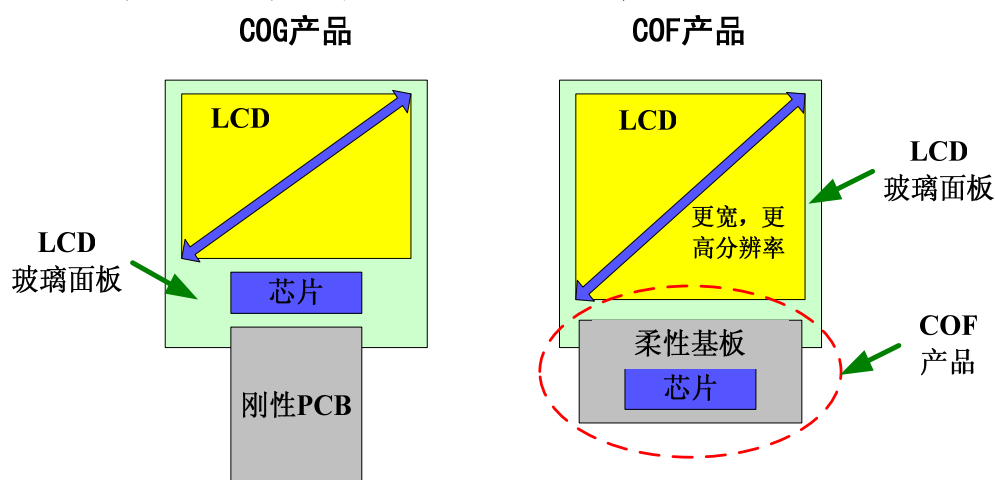
资料来源：台湾电路板协会

如上图所示，COF 产品占 TFT-LCD 用芯片封装产品市场比重逐年上升，TAB 产品保持稳定，COG 产品占比逐年下降。

### (3) COF 产品市场前景

#### ①COF 产品将逐渐替代 COG 产品

**COF产品及COG产品在TFT-LCD装配过程中安装形式对比图**



使用 COF 产品的 TFT-LCD 比使用 COG 产品的 TFT-LCD 更轻薄、分辨率更高。

COF 产品市场空间广阔，将逐渐替代 COG 产品，其主要优势如下表：

| 产品                  | 重量    | 厚度    | 分辨率         |
|---------------------|-------|-------|-------------|
| 使用 COF 产品的 TFT-LCD  | 16.9g | 3.5mm | 1280×960ppi |
| 使用传统芯片封装产品的 TFT-LCD | 22.4g | 4.8mm | 1024×768ppi |

资料来源：《柔性封装基板及芯片封装产业行业调研报告》，中国电子材料行业协会，2010年4月

## ②COF 产品将逐渐替代 TAB 产品

基于TAB产品基板线宽线距大于40 μ m的特点，中小尺寸LCD分辨率被局限在1280×960dpi以下，不能够进一步提升，随着中小尺寸LCD对分辨率等级要求不断提高，COF产品将逐渐替代TAB产品，被广泛应用于高分辨率的中小尺寸LCD。

LCD分辨率等级及适用的芯片封装产品如下表：

| LCD 分辨率等级 | LCD 分辨率      | 基板线宽线距要求  | 适用的芯片封装产品     |
|-----------|--------------|-----------|---------------|
| VGA       | 640×480ppi   | 70 μ m    | COG 产品、TAB 产品 |
| SVGA      | 800×600ppi   | 60 μ m    | COG 产品、TAB 产品 |
| XGA       | 1024×768ppi  | 50 μ m    | COG 产品、TAB 产品 |
| SXGA      | 1280×960ppi  | 40-45 μ m | COF 产品、TAB 产品 |
| UXGA      | 1600×1200ppi | 40 μ m 以下 | COF 产品        |

本公司生产的 COF 产品线宽线距最细可达到 25 μ m，接近世界尖端水平，适用于各种尺寸的高分辨率 LCD，市场前景广阔。

### （4）COF 产品市场竞争格局

与COF柔性封装基本板市场相比，全球COF产品市场竞争主体相对较多，主要生产商分为三种类型：

第一种类型是全球大型的COF柔性封装基板生产商，如日本日立电线、住友金属矿山等。本公司属于此类，是国内极少数能够生产高端COF产品的企业之一，本公司生产的COF产品线宽线距最细可达到25μm，接近世界尖端水平，适用于各种尺寸的高分辨率TFT-LCD，主要客户为日本日立等驱动芯片生产商。

第二种类型是全球主要的TFT-LCD驱动芯片生产商，如韩国三星、现代，日本日立、日本电气，台湾奇美、联咏、华邦等，上述驱动芯片厂家生产少量COF产品，均用于自身TFT-LCD装配过程，但为了加快产业结构的调整和优化升级，这些厂商逐渐向发展中国家或地区转移COF产品制造环节，并努力强化自身对COF产品核心技术的研发与控制。

第三种类型是FPC生产商，如我国广东、华东地区有多家FPC企业开始进行少量COF产品的生产，但生产的COF产品档次较低，适用于较低端的终端产品。

### （四）影响行业发展的有利和不利因素

#### 1、有利因素

### **（1）产业政策环境持续向好**

在过去的30年时间内，中国GDP的年复合增长率维持在10%左右，虽然2008年开始全球经济形势出现恶化，但面对形势的发展变化，中国政府陆续出台了一系列的调控政策，主要包括10项措施促进经济增长；投资4万亿扩大内需，特别是2009年2月1日起“家电下乡”正式在全国全面推广；8项措施落实适度宽松的货币政策；2008年以来连续4次提高出口退税率，调整了3,770项产品的出口退税率，表明国家鼓励出口稳定发展的政策导向。这些调控政策将保证未来国民经济的稳步增长，国内良好的产业发展环境为中国柔性印制电路板产业的持续稳步发展提供有利保障。

根据2006年国家信息产业部发布的《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》，多层、柔性、柔刚结合和绿色环保印制线路板技术是我国电子信息产业未来重点发展的项目；根据2007年国家发展委、科技部、商务部联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）》，高密度印刷电路板和柔性电路板是新型电子元器件领域优先发展的产品；根据2008年国家科技部、财政部、国家税务总局联合发布的《国家重点支持的高新技术领域》，刚挠结合板和HDI高密度积层板为国家重点支持的高新技术领域产品；根据2009年国家发展委、信息产业部联合发布的《电子信息产业技术进步和技术改造投资方向》，高端印制电路板（包括多层挠性板、IC封装载板）及覆铜板材料是国家重点支持的产品；在《外商投资产业指导目录》和《产业结构调整指导目录》中，高密度互连积层板、多层挠性板、刚挠印制电路板及封装载板被列为鼓励类产业。

### **（2）科技进步对行业的促进作用**

近年来，新技术的推广和普及对整个社会的发展产生了深远的影响，特别是新技术在电子产品的应用推动了电子产品向轻、薄、短、小、多功能、集成化方向发展，这必将带动FPC、COF柔性封装基板及COF产品的需求快速增长，推动产品全面向高密度化、集成组件的方向发展。

### **（3）下游产业持续推动**

目前，FPC、COF柔性封装基板、COF产品广泛应用于消费电子、通讯设备、

医疗器械、仪表仪器、航天航空等各个领域。随着电子信息产业在国民经济中的地位越来越重要，国家将进一步加大在各领域电子信息化建设的投资，下游领域电子信息化建设步伐的加快，必然带动柔性印制电路板行业发展。同时，我国3G工程已经启动，作为“十一五”期间我国产业投资领域上最突出的新产业领域之一，中国3G工程启动后6年内的总体投入将会达到6,000亿元人民币，将为柔性印制电路板行业带来发展机遇。

#### **（4）国际产业转移的发展机遇**

近年来，发达国家和地区加速向中国进行制造业转移，国际知名的柔性印制电路板厂商如日本 NOK、日东电工和索尼等均在中国投资设厂。制造业向中国转移有助于本土柔性印制电路板厂商利用国际产业转移的机遇，加强与国外厂商的合资合作、提升自身管理能力、引进先进生产设备、扩大生产规模、提升产品质量、降低成本、积累研发经验和提高国际市场份额。

### **2、不利因素**

#### **（1）国内产品与技术标准制订宽松且不及时，影响产品的出口竞争力**

我国在柔性印制电路板领域没有被国际承认和使用的行业标准，目前在国际和国内实际运用的标准是美国 IPC 行业标准或日本 JPCA 行业标准，技术标准缺失与制订落后制约着产品的出口。标准缺失与制订落后主要表现在技术标准总体水平偏低、制订周期长、标准老化，跟不上市场的变化和企业的需求，满足不了经济结构调整、规范企业行为、提高产品质量的发展要求，这直接影响到中国出口产品的国际竞争力，也成为其他发达国家和组织设置障碍的主要原因。

#### **（2）人民币汇率变化将对产品出口产生重要影响**

在过去的三年多时间里，人民币对美元汇率呈现上行的总体趋势。由于促使人民币升值的基本因素，如贸易顺差等并未出现明显变化，因此预计未来人民币升值的趋势不会改变。当人民币升值时，国内出口产品在国际市场的价格优势将被削弱，影响出口产品的价格竞争力。

### **（五）进入本行业的主要障碍**

#### **1、综合技术障碍**

FPC及COF产品的制造工艺综合运用了高分子材料学、光电子材料学、固体物理学、微电子学、光学及自动化控制学等诸多学科，且产品几何尺寸小、精度要求高，制作工艺精细，研发和生产中需要一个技术结构完备的人才团队，生产中需要各种专用设备、精密工模具及与其相适应的一整套先进的工艺流程，尤其是COF柔性封装基板的研发和生产对技术水平要求更高，是进入该行业的重要障碍。

## **2、规模和资金障碍**

由于高端 FPC、COF 柔性封装基板及 COF 产品主要以出口为主，对国外市场的依赖程度很高，而国外客户大多为国际知名企业，要获得他们的订单必须经过多方面的认证，而认证的先决条件又必须要求具有一定的生产规模，规模化的生产能力需要企业投入大量资金用于设备购置、研究开发与营运周转，这构成了新企业进入本行业的规模和资金障碍。

## **3、产品品质认证障碍**

出于环保、安全、质量等方面的考虑，世界各国都对电子元器件制定了严格的产品品质认证标准，特别是环保标准更成为柔性印制电路板企业的重点关注点，如欧盟相继发布实施环保法令ROHS。企业的产品必需取得进口国的产品环保、安全、质量认证才能够出口到该国。为此，企业需投入大量的资金并配备专门人员，向各进口国申请认证并维持认证。由于发达国家产品质量标准更新频繁，新的认证项目不断推出，给发展中国家的电子元器件产品出口到日韩、欧美增加了技术障碍和绿色障碍，给企业带来维持认证的额外成本。因此，取得目标市场的产品认证成为新企业进入本行业的主要障碍。

# **（六）行业技术水平、经营模式及行业生命周期**

## **1、行业技术水平**

近年来，全球电子信息产业飞速发展，在电子产品小型化、轻量化、多功能化、集成化发展趋势带动下，使得柔性印制电路板制造技术不断向高密度超薄型、微细线路、环保材料、高耐热和高散热等技术方向发展。随着COF柔性封装基板制造技术向高性能化和轻薄化方向不断创新和突破，COF产品结构、性能、功能不断提高，新形态产品不断推出，其兼容性越来越好，应用领域不断扩大。



随着全球大型柔性印制电路板厂商陆续在中国投资建厂，先进的技术工艺不断被引进，国内技术水平日益提高，但总体上仍与日本、韩国、欧美存在较大差距，主要是由于国内企业大多对研发投入较少，人才储备普遍不足，国内技术附加值较低的产品仍占较大比例。

在COF柔性封装基板产业核心原材料高端2L-FCCL生产方面，我国的技术力量也远远落后于日本、韩国，本公司是国内极少数掌握高端2L-FCCL制造工艺并大批量生产的厂商之一，突破了国内企业依赖进口高端2L-FCCL的局面，公司生产的2L-FCCL可以替代国外同类高端产品。

## **2、行业经营模式**

柔性印制电路板行业垂直分工的特征非常明显，即发达国家领先企业在控制关键材料技术、原材料供给、产品研发、设计、营销及品牌运作等核心业务的同时，将部分生产、组装等环节委托给发展中国家专业工厂，形成原材料生产、基板生产、芯片封装、模板组装的相互独立、各为专业的分工体系。

本公司经营模式独特于行业典型经营模式，凭借多年的技术积累和强大的研发实力，公司业务全面覆盖原材料生产、基板生产、芯片封装各专业体系，形成了较完整的产业链。

## **3、行业的周期性、季节性特征**

柔性印制电路板行业的下游应用领域较为广泛，受单一行业的影响较小，行业的周期性主要表现为随宏观经济周期的波动而波动。

柔性印制电路板行业的下游应用领域如手机、笔记本电脑、液晶电视、通讯设备等电子信息产品的消费季节性特征较为明显，通常每年第一季度为淡季、第四季度为旺季。

### **（七）利润水平的变动趋势及变动原因**

铜、石油、化工材料等上游原料的价格水平决定了印制电路板的生产成本，而下游消费电子、通讯设备、汽车载品、仪表仪器、医疗器械、航天航空等行业的周期性波动则决定了印制电路板产品需求和价格水平，因此印制电路板产业的利润水平主要取决于上下游行业的变动情况。

从行业利润变动趋势来看，近年行业利润水平保持了稳定。

## （八）上下游行业发展对柔性印制电路板行业的影响

柔性印制电路板行业的上游是各类石油加工产品、基本金属、化工原料。因此，柔性印制电路板行业与大宗商品市场紧密联系，而大宗商品市场则受全球宏观经济景气度及全球通货膨胀水平的影响。

柔性印制电路板行业的下游是各类电子信息产品。全球宏观经济景气度、消费者可支配收入状况、消费者的消费偏好等因素影响消费者的消费需求，进而影响柔性印制电路板行业产品销售。

## （九）主要产品进口国的政策

本公司产品以出口为主，报告期内，产品外销比例均保持在99%以上，产品销售市场主要集中于日本、欧美、东南亚、香港等地区。由于环保意识不断加强，日本和欧美有关环保法规均要求电子零部件无铅。

各主要进口国对公司主导产品的进口政策及公司的应对措施如下表：

| 国家/地区 | 主要进口政策                                                                                                                | 公司应对措施                                                                                                                                                                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧洲    | 欧盟于2003 年1 月27 日公布ROHS, 限制在电子产品中使用包括铅在内的六种有害成份，2008 年开始全面禁止使用含铅焊料产品进口，所有出口到欧盟的电子电气产品不得含有铅、镉、汞、六价铬、聚溴联苯和聚溴二苯醚等六种有害有毒物质 | <ul style="list-style-type: none"><li>● 公司主要产品顺利通过美国UL认证，日本索尼公司“绿色合作伙伴”和日本佳能公司“绿色供应商标准”等认可</li><li>● 公司积极响应欧盟ROHS指令，加大绿色、无铅、无卤素产品开发力度，现已全面掌握了成熟的无铅、无卤素技术和量产工艺</li></ul> |
| 北美    | 主要参照执行欧盟ROHS                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |
| 日本    | 主要参照执行欧盟ROHS                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |
| 香港    | 主要参照执行欧盟 ROHS                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |
| 东南亚   | 主要参照执行欧盟ROHS                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |

除上表要求外，日本、欧美、东南亚、香港地区对原产自中国的柔性印制电路板产品均没有设置进口关税、进口配额等限制性贸易政策。

### 1、公司执行比欧盟 ROHS 指令更严格的索尼标准

公司产品以出口为主，产品销售市场主要集中于日本、欧美、东南亚、香港等地区，主要出口国的产品准入标准均参照欧盟颁布的ROHS认证执行，ROHS认证是产品准入的环保要求底线。

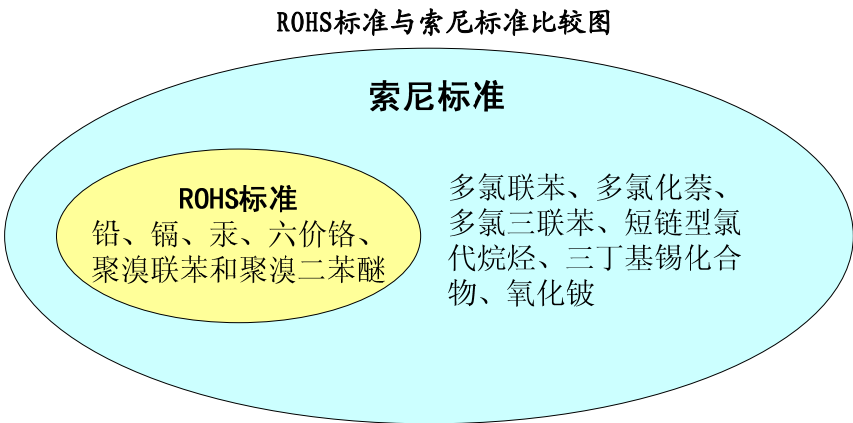
在ROHS认证基础上，索尼、松下、佳能、三星等国际领先电子信息产品企业根据自身发展需要制定了更高的产品环保准入认证标准。目前，行业内最严格的产品环保准入认证标准为日本索尼制定的《零部件和原材料中的环境管理物质管

理规定(SS00259)》，明确规定化学物质管理方面的各项标准，并根据该标准实施供应商审核，要求索尼的业务伙伴提供环境意识型部件、产品和服务，并实施环境意识型运作，该标准已被行业内其他主要企业所采纳，符合该标准的供应商将获得索尼颁布的“绿色合作伙伴”认证。2008年-2010年，公司均顺利取得索尼“绿色合作伙伴”认证

## 2、ROHS 标准与索尼标准比较

### (1) 索尼标准涉及范围更广

ROHS标准要求所有电子电气产品不得含有铅、镉、汞、六价铬、聚溴联苯和聚溴二苯醚等六种有害有毒物质，除上述六种有害有毒物质外，索尼标准还要求所有电子电气产品不得含有多氯联苯、多氯化萘、多氯三联苯、短链型氯代烷烃、三丁基锡化合物、石棉、甲醛、氧化铍、特定邻苯二甲酸盐等有害有毒物质。



如上图所示，索尼标准包含ROHS标准涉及的全部有害有毒物质，范围更广。

### (2) 索尼标准管控指标更严格

| 序号 | 有害有毒<br>化学物质 | ROHS 标准下<br>最大允许含量 | 索尼标准下<br>最大允许含量 | 备注                           |
|----|--------------|--------------------|-----------------|------------------------------|
| 1  | 镉            | <100 ppm           | <5 ppm          | 最大允许含量值越<br>小，说明管控的要求<br>越严格 |
| 2  | 铅            | <1000 ppm          | <100 ppm        |                              |
| 3  | 汞            | <1000 ppm          | <5 ppm          |                              |
| 4  | 六价铬          | <1000 ppm          | <5 ppm          |                              |
| 5  | 聚溴联苯         | <1000 ppm          | <100 ppm        |                              |
| 6  | 聚溴二苯醚        | <1000 ppm          | <100 ppm        |                              |

如上表所示，索尼标准对有害有毒化学物质的含量管控较ROHS标准更严格。

综上所述，公司取得行业内最严格的日本索尼“绿色合作伙伴”认证说明公司产品在主要出口国不存在被采取限制性贸易政策的风险。

### 三、发行人在行业中的竞争地位

#### （一）发行人的行业地位

本公司坚持实施高端产品竞争战略，通过多年的技术创新和市场开拓，市场竞争能力不断增强，已经形成较为完整的产业链和合理的产品结构，是全球极少数掌握高端2L-FCCL、COF柔性封装基板到COF芯片封装全产业链中各环节主要材料制造工艺并大批量生产的厂商之一。公司与多家世界500强企业及全球知名的电子信息产品品牌制造商建立了持久稳定的客户关系，产品远销亚洲、欧洲、美洲等20多个国家和地区。

在具体的细分市场，公司2008-2010年COF柔性封装基板销售额分别为6,993.40万元、10,161.15万元、10,196.25万元，2008年、2009年连续两年成为中国最大的COF柔性封装基板生产商，全球市场占有率分别为1.1%、1.55%，全球市场占有率稳步提高，2009年成为全球第八大COF柔性封装基板生产商，主要客户为全球知名的电子信息产品品牌制造商，如日本电产、夏普、佳能、日立、奥林巴斯、三洋电机等。

公司综合性技术运用能力突出，是国家级高新技术企业和深圳市自主创新行业龙头企业，也是国家科技部认定的“国家高技术研究发展计划成果产业化基地”和“国家挠性电路与材料研发中心”。2009年1月、2011年2月，公司及子公司广东丹邦先后获批承担国家科技重大专项（02专项）的课题研究任务及项目，国家科技重大专项是国家支持行业发展的具体举措，承担国家科技重大专项是国家对本公司技术研发水平、行业领先地位的肯定，对于公司产品档次升级和提升公司核心竞争力具有非常重要的意义。

经过多年的技术攻关和生产实践，公司成为国内极少数掌握高端2L-FCCL和COF柔性封装基板制造工艺及芯片封装技术并大批量生产的厂商之一，填补了我国在高端柔性覆铜板材料及柔性封装基板领域的技术和产品空白，打破日本、韩国企业对关键材料的供应和技术垄断，有利于完善我国液晶平板显示器产业链，为我国航空航天、国防军工领域提供尖端技术支持。

## **（二）发行人的竞争优势**

丹邦科技作为国内高端柔性印制电路板行业的领先者，具有显著的业务竞争优势，具体概括如下：

### **1、自主创新技术研发优势**

#### **（1）具备承担国家科技重大专项的技术攻关能力**

2009年1月，公司作为项目联合单位开始承担国家科技重大专项（02专项）“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”项目下属的“芯片柔性封装基板技术与中试工艺开发”课题研究任务。2011年2月，公司子公司广东丹邦作为项目责任单位获批承担国家科技重大专项“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”项目下属的“三维柔性基板及工艺技术研发与产业化”项目。国家科技重大专项是国家支持行业发展的具体举措，承担国家科技重大专项是国家对本公司技术研发水平、行业领先地位的肯定，对于公司产品档次升级和提升公司核心竞争力具有非常重要的意义。

公司自设立以来，一直坚持走自主创新道路，培养了一批从技术开发到生产管理的技术管理骨干队伍，截至2010年末，公司有各类专业技术人员108人，其中核心技术人员刘萍、刘文魁分别为深圳市地方级高层次人才、深圳市后备级高层次人才。公司产品研发水平和质量检测能力在行业内居领先地位，为公司的发展奠定了良好人才基础。

#### **（2）具备突出的多学科技术运用能力**

公司所处产业链涉及的基材、基板、封装产品的制造工艺综合运用了高分子材料学、光电子材料学、固体物理学、微电子学、光学及自动化控制学等诸多学科，公司在多学科综合技术掌握的全面性方面具有优势，是国内极少数掌握产业链各环节主要产品制造工艺的企业之一。

经过多年的技术攻关和生产实践，公司成功掌握了COF产品领域的三项核心技术：高端2L-FCCL制造、超微细化线路制作和NCP连接绑定工艺，填补了我国在高端柔性覆铜板材料及柔性封装基板领域的技术空白，打破了日本、韩国企业对关键材料技术垄断，有利于完善我国液晶平板显示器产业链，为我国航空航天、

国防军工领域提供尖端技术支持。公司是国内极少数掌握高端 2L-FCCL 制造工艺并大批量生产的厂商之一，公司生产的高端 2L-FCCL 的基膜采用经改性的高稳定性、绿色环保聚酰亚胺树脂材料，这种材料不含锑和磷、无卤素、热膨胀系数约为 20ppm/°C，与铜箔及芯片的热膨胀系数 18ppm/°C 十分接近，可以将温度、湿度变形控制在极小的范围内，增强基板与芯片粘合性，避免芯片信号传输失真。同时公司还积极响应欧盟 RoHS 指令，加大绿色、无铅、无卤素产品开发力度，现已全面掌握了成熟的无铅、无卤素技术和量产工艺。

公司目前已获得发明专利 9 项，并且有多项产品和科技成果荣获国家级或省级新产品奖以及科技成果奖，其中：COF 封装基板在 2010 年被国家科技部认定为“国家重点新产品”；聚酰亚胺挠性电路基板卷材在 2005 年被广东省科技厅评为“广东省重点新产品”，并在 2006 年被深圳市科技局评为“高新技术产品”；先进 COF 超微线路及封装产业化项目被深圳市政府评为 2006 年度“深圳市科技创新奖”，并被广东省政府评为 2007 年度“广东省科学技术三等奖”；多叠层柔性基板 2010 年被广东省科技厅、广东省发改委评为“广东省自主创新产品”；柔性多叠层多芯片封装产品 2010 年被广东省科技厅、广东省发改委评为“广东省自主创新产品”。

### **（3）技术水平在国内居领先水平，接近国际尖端水平**

公司的技术水平在国内同行中处于领先地位，部分技术接近国际尖端水平。公司承担的“高性能特种挠性电路连接与封装技术”项目是为了满足国家航天、航空、舰艇、兵器等军事电子装备的应用需求，为我军武器装备的发展和进步提供技术支撑。2009 年 1 月、2011 年 2 月，公司及子公司广东丹邦先后获批承担国家科技重大专项的课题研究任务及项目，国家科技重大专项是为了实现国家目标，通过核心技术突破和资源集成，在一定时限内完成的重大战略产品、关键共性技术和重大工程。《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》确定了大型飞机、极大规模集成电路制造装备与成套工艺等 16 个重大专项，这些重大专项是我国到 2020 年科技发展的重中之重。

公司非常注重工艺改进与技术创新，取得了多项国内外先进或领先水平的技

术，使得公司产品与同类产品相比具有技术领先、成本低、品质高等特点。公司现有主要技术与国际尖端及内资企业领先水平对比情况如下表：

| 项目                | 技术指标                                   | 国际尖端                  | 国内领先      | 丹邦科技                 | 备注                |
|-------------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------|----------------------|-------------------|
| 高端 2L-FCCL        | 制造方式                                   | 涂布法、层压法、真空溅镀加电镀法      | -         | 涂布法                  | 涂布法制造成本最低、生产效率较高  |
|                   | 基膜厚度（ $\mu\text{m}$ ）                  | 9-12                  | -         | 12                   | 厚度越小，技术要求越高       |
|                   | 热膨胀系数（ $\text{ppm}/^{\circ}\text{C}$ ） | 12                    | -         | 20                   | 值越小，材料受温度影响越小     |
|                   | 断裂伸长率（%）                               | 45                    | -         | 39                   | 值越大，弯折性越好         |
|                   | 拉伸强度（ $\text{MPa}$ ）                   | 300                   | -         | 256                  | 值越大，抗压力越强         |
|                   | 拉伸模量（ $\text{GPa}$ ）                   | 4.3                   | -         | 4.2                  | 值越大，稳定性越高         |
|                   | 剥离强度（ $\text{Kg}/\text{cm}$ ）          | 1.4                   | -         | 1.4                  | 值越大，难度越高          |
|                   | 表面电阻（ $\Omega$ ）                       | $1.0 \times 10^{14}$  | -         | $1.3 \times 10^{16}$ | 值越大，难度越高          |
| 超微细化线路 COF 柔性封装基板 | 耐弯曲疲劳次数（万次）                            | 2,000                 | -         | 2,500                | 值越大，寿命越长          |
|                   | 线宽线距（ $\mu\text{m}$ ）                  | 20                    | 35        | 25                   | 值越小，难度越高          |
|                   | 深度孔公差（ $\text{mil}$ ）                  | $\pm 5$               | $\pm 10$  | $\pm 5$              | 公差越小，传输线路的精细化程度越高 |
|                   | 压插件孔径公差（ $\text{mil}$ ）                | $\pm 1.5$             | $\pm 2.0$ | $\pm 1.5$            | 公差越小，传输线路的精细化程度越高 |
|                   | 阻抗控制（%）                                | $\pm 7$               | $\pm 10$  | $\pm 8$              | 公差越小，难度越高         |
| COF 封装            | 电镀方式                                   | 脉冲/直流                 | 多数为直流     | 脉冲/直流                | 多样性，满足不同设计        |
|                   | 封装方式                                   | COF、COG、TAB           | COG、TAB   | COF                  | COF 封装最轻薄         |
|                   | 芯片连接技术                                 | 金-锡共晶连接、ACF 连接、NCP 连接 | 金-锡共晶连接   | NCP 连接               | NCP 连接绿色环保，生产效率高  |

资料来源：根据公司整理所得

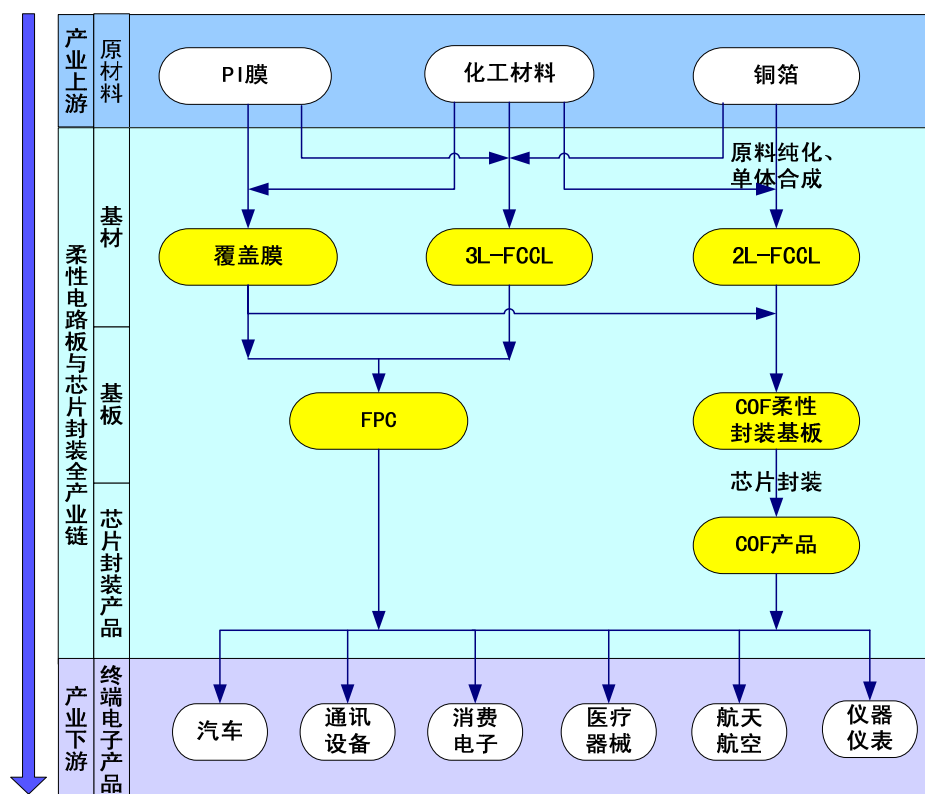
目前，公司的技术研发项目如线宽线距  $20\mu\text{m}$  的超微细化线 COF 柔性封装基板和厚度小于  $10\mu\text{m}$  的高端 2L-FCCL 基膜都是根据国际上最新技术、标准的发展方向所做的前瞻性研究，符合电子信息产品轻薄短小的发展趋势，是公司在未来几年内持续保持技术领先的保证。

## 2、产业链优势

### （1）完整的产业链布局，能够提供一站式采购

公司专注于微电子柔性互连与封装业务，形成了从 FCCL→FPC、FCCL→COF 柔性封装基板→COF 产品的完整产业链，是全球极少数产业链涵盖从基材、基板到芯片封装的企业之一。

公司在柔性电路板与芯片封装全产业链中的产品布局图如下：



2L-FCCL、3L-FCCL 属于基材，FPC、COF 柔性封装基板属于基板，COF 产品属于搭载芯片后的封装产品，公司丰富的产品结构一方面可以满足国际大客户“一站式”采购的需求，使公司接纳大订单的能力大大增强。报告期内，公司知名客户数量持续增加，客户质量不断提升，如公司分别于 2009 年和 2010 年成为日本夏普和日本佳能在中国的主要 COF 产品或 COF 柔性封装基板供应商；另一方面使公司具备较强的抵御单个产品市场波动风险的能力，保证公司的整体盈利水平持续、稳定地提高。

## （2）关键原材料自产，具备成本优势和质量一致性

FCCL 是生产 FPC 及柔性封装基板的主要原材料，其成本占整个产品成本的 40%-50%。由于公司实现了上游关键原材料柔性封装基板用高端 2L-FCCL、FPC 用 3L-FCCL 和低端 2L-FCCL 的自产，使公司产品具有成本优势，增强了产品的市场竞争力，提升了企业在行业中的地位。

同时，由于公司实现了上游关键原材料的自产，并严格控制产业链各个中间产品的质量，确保工艺流程的顺畅，使公司产品能够长期保持恒定的质量水平。公司产品质量一致性使公司能够形成稳定的客户关系，成为公司的竞争优势。



### 3、客户资源优势

#### (1) 优质的客户群体和较高的知名度

公司产品远销亚洲、欧洲、美洲等20多个国家和地区，公司与众多国际跨国公司和专业厂商建立了全面战略合作伙伴关系，形成了自己稳定的客户群，在国际高端柔性印制电路板行业形成了较高的知名度和良好的信誉度。公司的客户按地区可划分为日本、欧美、东南亚及香港，主要包括国际顶尖电子信息产品生产厂商或代理商，其中具有国际影响力的客户如下：

| 客户所在国家/地区 | 客户名称及所属行业                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日本        | <ul style="list-style-type: none"><li>● 夏普 (Sharp)，电子、电器设备，世界500强</li><li>● 日立 (Hitachi)，电子、电器设备，世界500强</li><li>● 佳能 (Canon)，影像器材、办公设备，世界500强</li><li>● 日本电产 (NIDEC)，电机制造，2008年营业收入达到63亿美元</li><li>● 奥林巴斯 (Olympus)，数码相机</li><li>● 松下 (Panasonic)，电子、电气设备，世界500强</li><li>● 三洋电机 (SanyoElectric)，电子、电气设备，世界500强</li><li>● 胜利公司 (JVC)，视频、音频设备，世界500强</li><li>● 欧姆龙 (OMRON)，自动化控制及电子设备，亚洲500强</li><li>● 阿尔卑斯电气 (ALPS)，磁性模具、通信及汽车电子产品</li><li>● 三美电子 (Mitsumi Electric)，PC配件和元器件生厂商</li><li>● 立志凯 (NISCA)，ID卡打印机</li><li>● 黑田电气 (Z. KURODA)，知名的电子元件、半导体及光学配件经销商</li></ul> |
| 亚洲其他地区    | <ul style="list-style-type: none"><li>● 鸿富锦精密电子 (Foxcoon)，消费类电子信息产品，世界500强</li><li>● 元太科技 (Prime View International)，TFT-LCD、LED显示和电子书</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

本公司的COF柔性封装基板及COF产品主要用于上述国际顶尖电子信息产品制造商的高端产品（比如本公司销售给佳能（Canon）影像器材用的COF柔性封装基板及COF产品均是用于1,000万像素以上的照相机）。在与国际顶尖电子信息产品生产厂商的合作过程中，公司能够汲取最新的国际生产经营理念，把握行业动态和技术走向，为进一步开拓市场创造有利条件。

#### (2) 通过世界知名客户严格认证

目前公司生产的产品与日韩及台湾地区的行业龙头企业的同类产品品质相当，部分指标甚至优于日韩及台湾地区的厂商。电子信息终端产品的制造商一般为国际知名公司，他们除了重视电子元器件本身的性能与品质外，也十分注重供应商的生产能力和过程质量控制与保证能力，一般国际知名公司的认证均至少需

要1—2年左右的时间，认证过程主要包括工厂认证、产品认证、生产过程认证和环保认证。本公司以技术和品质为保障已取得夏普、日立、松下、索尼、奥林巴斯、佳能、日本电产等一大批大型世界知名公司的认证。

下表以公司主要客户日本松下为例，说明公司获取大型国际客户认证的复杂性和严格性：

| 客户名称 | 认证类型   | 认证模式                                                                                                                              | 认证标准                                                                                                                                                                         | 认证周期                                                                                 |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 松下   | 工厂认证   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 松下指定代理人首先在全球调查具实力的潜在供应商并报告松下</li> <li>● 对入围供应商进行工厂实地考察：考察人员包括松下代理商、工厂代表以及总部代表</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 行业地位</li> <li>● 年销售额及产能</li> <li>● 主要客户</li> <li>● 研发能力及检测试验能力</li> <li>● 成本控制</li> <li>● 良好的经营及财务业绩</li> <li>● 质保体系的完整性</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 6个月以内</li> </ul>                            |
|      | 产品认证   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 样品确认：既定规格样品确认</li> <li>● 文件确认：新品测量及试验资料的完整性认证。</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 既定目标规格书</li> <li>● 松下电器内部附加标准</li> </ul>                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 4-8 个月</li> </ul>                           |
|      | 生产过程认证 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 松下总部及工厂QA代表实地审核</li> </ul>                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>● ISO9001 的完整性及有效性</li> </ul>                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 首次：3 天</li> <li>● 以后每年至少2次：2 天/次</li> </ul> |
|      | 环保认证   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 松下总部及工厂QA代表实地审核</li> </ul>                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>● ISO14001 的完整性及有效性</li> <li>● RoHS 管理体系及流程的有效性</li> </ul>                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 首次：1 天</li> <li>● 以后每年至少1次：1 天/次</li> </ul> |

#### 4、高端产品优势

##### (1) 发展战略明确，定位高端产品市场

公司坚持实施高端产品竞争战略，即依靠技术、管理和服务的比较竞争优势，重点生产技术含量高、应用领域相对高端的差异化产品。如报告期内，公司高技术含量的 COF 柔性封装基板、COF 产品占比不断提高，避免生产准入门槛低、市场竞争激烈的标准化产品。另外，本公司的产品普遍用于国际顶尖电子信息产品制造商的高端产品，比如佳能（Canon）影像器材事业部采购的 COF 柔性封装基板及 COF 产品均是用于 1,000 万像素以上的高档照相机。

##### (2) 符合国际标准的产品品质

公司建立了符合国际标准的生产体系，公司的生产设备、实验设施、产品检测设施等均符合国际大客户的质量管理体系审核标准，确保公司产品性能优良、质量稳定，公司三大产品系列均顺利通过美国 UL 认证，公司还获得了日本索尼公司“绿色合作伙伴”和日本佳能公司“绿色供应商标准”等认可。

## 5、管理优势

公司具有丰富的高端柔性印制电路板产品生产管理经验，2005年，公司被评为全国企业管理创新优秀示范单位，长期以来与多家国际知名公司保持长期稳定的产销合作和技术合作关系，逐步建立了与国际接轨的产品生产质量监督体系，2007年9月通过 ISO14001:2004 国际环境管理体系认证，2008年4月通过 ISO9001:2000 国际质量管理体系认证，2008年4月通过符合全球汽车行业中现用的汽车质量体系要求的 ISO/TS16949: 2002 质量体系认证。通过借鉴国外先进的生产管理方式，公司逐步形成了一整套规范化、标准化、流程化、可复制的生产管理制度，有利于满足公司不断扩大生产规模的管理要求。

### （三）竞争劣势

公司的竞争劣势主要表现为：

首先，与国际一流高端柔性印制电路板生产企业相比，公司在生产规模、技术水平、研发能力、资金实力等方面还存在一定的差距，特别是随着公司业务规模的不断扩大，公司将面临资本实力不足、高端人才紧缺、产品快速替代的挑战。

其次，公司的生产制造系统在国内柔性印制电路板行业处于前列，但由于受生产规模、深圳经济特区内用水指标的制约，公司产能的增长速度远不能满足市场需求，产能不足已经成为限制公司发展的主要制约因素。

### （四）主要竞争对手的简要情况

本公司主导产品在全球和中国的主要竞争对手情况如下：

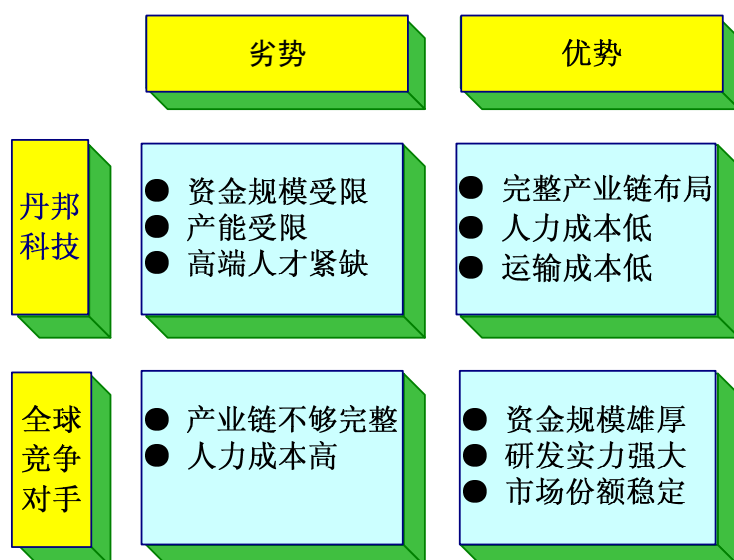
| 序号 | 产品类别             | 主要竞争对手                       |                     |
|----|------------------|------------------------------|---------------------|
|    |                  | 全球竞争对手                       | 中国竞争对手              |
| 1  | FPC              | NOK、Multek、Hitachi Chemical  | 珠海紫翔电子、安捷利电子、珠海元盛电子 |
| 2  | COF 柔性封装基板及COF产品 | 日立电线、三井金属矿业、LG Micron、STEMCO | 索尼凯美高               |

## 1、全球主要竞争对手概况

| 企业名称                           | 主打产品                     | 细分行业地位                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日本 NOK 株式会社                    | 各类 PCB、FPC               | 成立于 1969 年，世界及日本最大的 FPC 生产厂，在台湾、中国大陆、泰国、德国有 FPC 生产厂，2008 年全球 PCB 及 FPC 产值排名第一，达到 12.33 亿美元                                                                 |
| 美国 Multek Flexible Circuits 公司 | 各类 PCB、FPC               | 成立于 1978 年，隶属于伟创力（FLEXTRONICS）国际集团，总部位于美国加利福尼亚州，主要客户为 IBM、Dell、HP 等全球知名厂商。日前在北美洲、欧洲及亚洲有多家产品开发中心和制造工厂，全球员工超过 10,000 名，2008 年全球 PCB 及 FPC 产值排名第二，达到 8.15 亿美元 |
| 日本 Hitachi Chemical 株式会社       | 各类 PCB、FPC、感光性干膜产品       | 成立于 1962 年，在中国设有日立化成工业（苏州）、日立化成工业（烟台）、日立化成工业（东莞）三家公司，2008 年全球 PCB 及 FPC 产值排名第十，达到 5 亿美元                                                                    |
| 日本日立电线株式会社                     | 电线电缆、信息通讯网络、高性能材料、封装基板   | 成立于 1956 年，2008 年收购了当时封装基板产量在世界排名第二的日本卡西欧微电子公司全部封装基板生产线，使其综合实力及产能大增，2009 年全球 COF 柔性封装基板销售额排名第一                                                             |
| 日本三井金属矿业株式会社                   | 铜箔、封装基板                  | 主要生产基地在日本的山口县、福岡县、埼玉县；2007 年初，三井金属率先在世界上开发出 25 $\mu$ m 线宽线距的 COF 柔性封装基板，2007 年下半年又开发出 20 $\mu$ m 线宽线距的 COF 柔性封装基板；2009 年全球 COF 柔性封装基板销售额排名第二               |
| 韩国 LG Micron Ltd               | 电视机及计算机显像管用荫罩板、引线框架、封装基板 | 是 LG 集团三大事业领域中电子和通信事业领域的直属企业，是全球专业生产超精密电子零部件的领导企业，2009 年全球 COF 柔性封装基板销售额排名第三                                                                               |
| 韩国 STEMCO Ltd                  | 带式电路、封装基板                | 成立于 1995 年，是由日本东丽公司与韩国三星电机公司共同合资创建的，2004 年开始生产 COF 柔性封装基板，2009 年全球 COF 柔性封装基板销售额排名第四                                                                       |

资料来源：根据各公司网站整理获得

与全球主要竞争对手相比，本公司具有以下优势：



### （1）完整产业链布局

尽管全球主要竞争对手在资金规模、研发实力、市场份额上均优于本公司，但其产业链布局仅局限于基材、基板、封装产品某一个或两个领域，如日本 NOK 虽然是全球最大的 FPC 生产厂商，但其产业链不涉及封装产品领域。公司是行业内极少数产业链涵盖从基材、基板到芯片封装的企业之一。通过完整的产业链布局，公司实现了关键原材料自产和及时供应、提高了产品毛利率、保证了产品质量一致性。同时丰富的产品结构可满足客户一站式采购需求。

| 公司与国外主要竞争对手产业链布局对比图      |                                             |  | 评价       |
|--------------------------|---------------------------------------------|--|----------|
| 丹邦科技                     | <div>基材</div> <div>基板</div> <div>封装产品</div> |  | 产业链布局完整  |
| 日本NOK、<br>日本三井金属         | <div>基材</div> <div>基板</div>                 |  | 产业链布局较完整 |
| 韩国LG Micron、<br>韩国STEMCO | <div>基板</div>                               |  | 产业链布局单一  |

### （2）成本优势

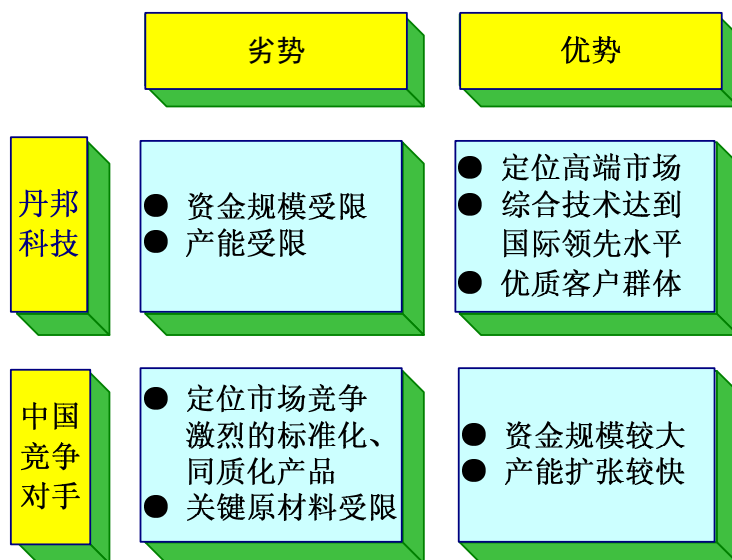
与日韩、欧美等发达国家和地区相比，中国具有明显的人力成本优势，2008年，我国生产工人平均工资仅为美国工人的4%。同时，从原辅材料采购成本来看，公司生产基地所在的珠江三角洲是中国印制电路板及配套原辅材料最主要的生产区域，与发达国家企业相比，公司原辅材料采购更便捷，运输成本更低。

## 2、中国主要竞争对手概况

| 企业名称            | 主打产品                 | 细分行业地位                                                                                 |
|-----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 珠海紫翔电子科技有限公司    | 各类 FPC               | 紫翔电子成立于 1997 年，是目前世界及日本最大的 FPC 生产厂 NOK 在中国设立的全资子公司，现注册资本为 2,000 万美元，2009 年产值为 20.27 亿元 |
| 安捷利电子实业有限公司     | 各类 FPC               | 安捷利电子成立于1994 年，是香港创业板上市公司，已在中国广州、苏州和深圳设立工厂，拥有员工近1,500人，年产能超过480,000 平方米，2009 年产值为3.5亿元 |
| 珠海元盛电子科技股份有限公司  | 各类 FPC               | 元盛电子成立于 2000 年，拥有员工 1,475 人，年产能超过 280,000 平方米，2009 年产值为 2.23 亿元                        |
| 索尼凯美高电子（苏州）有限公司 | 各类 FPC、COF 产品、铜箔、粘胶剂 | 日本索尼化学于 1994 年在中国设立的全资子公司，2008 年销售额 1.2 亿美元                                            |

资料来源：根据各公司网站整理获得

与中国主要竞争对手相比，本公司具有以下优势：



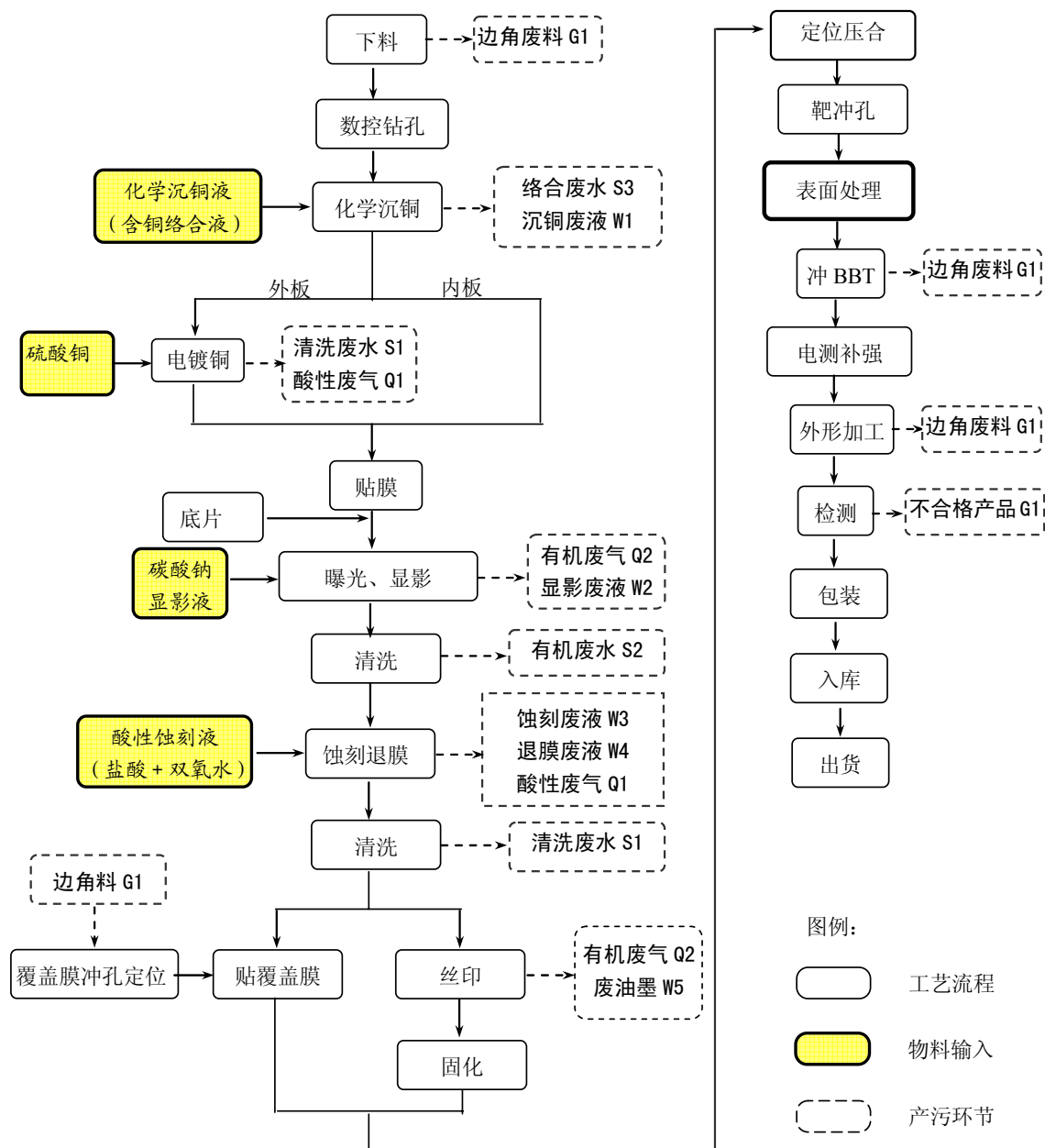
## 四、发行人的主营业务

### （一）主要产品的用途

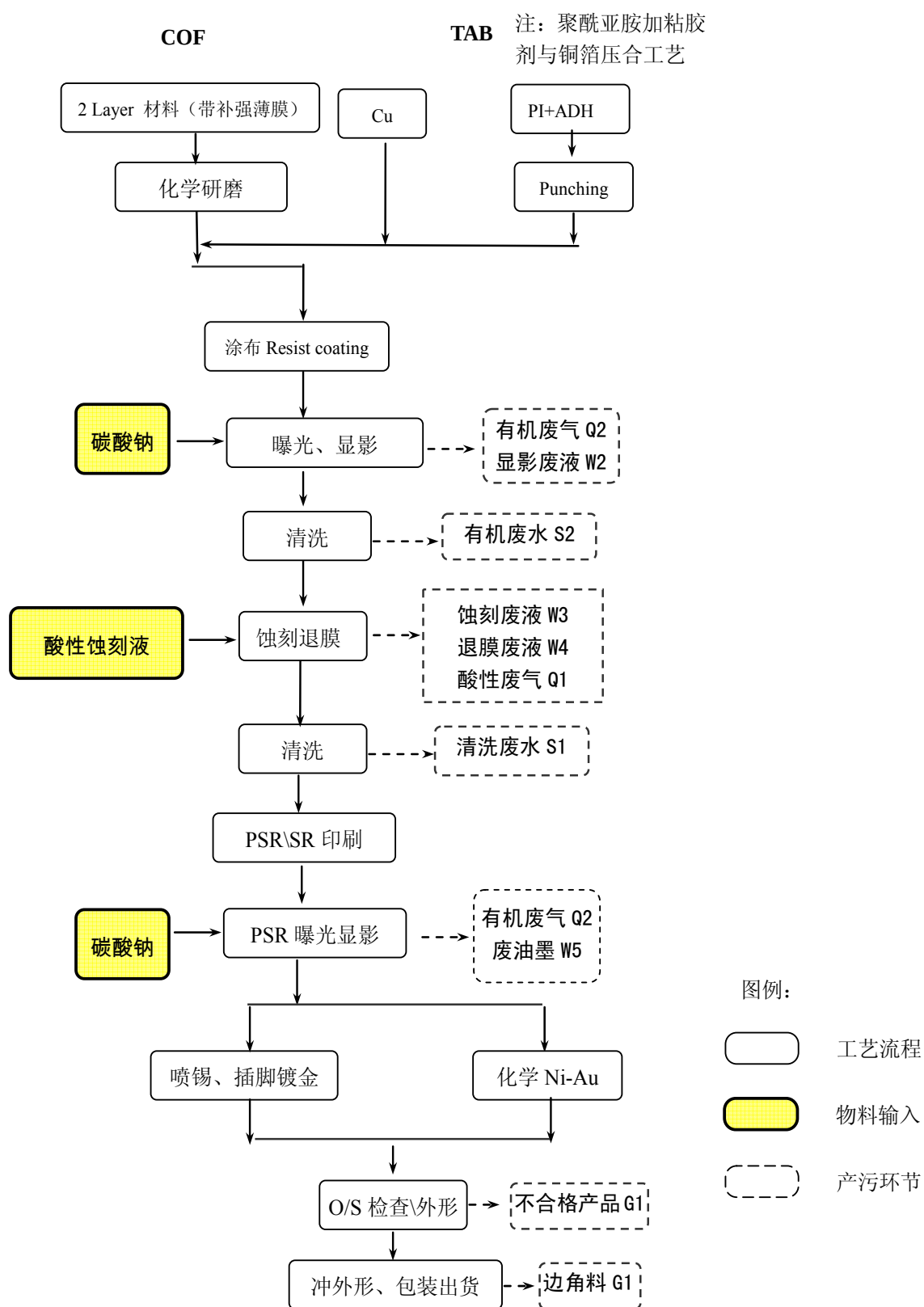
详见本招股说明书本节“一、发行人主营业务及其发展情况”之“（三）主要产品功能及应用”。

## (二) 生产工艺流程

### 1、FPC



## 2、COF 柔性封装基板

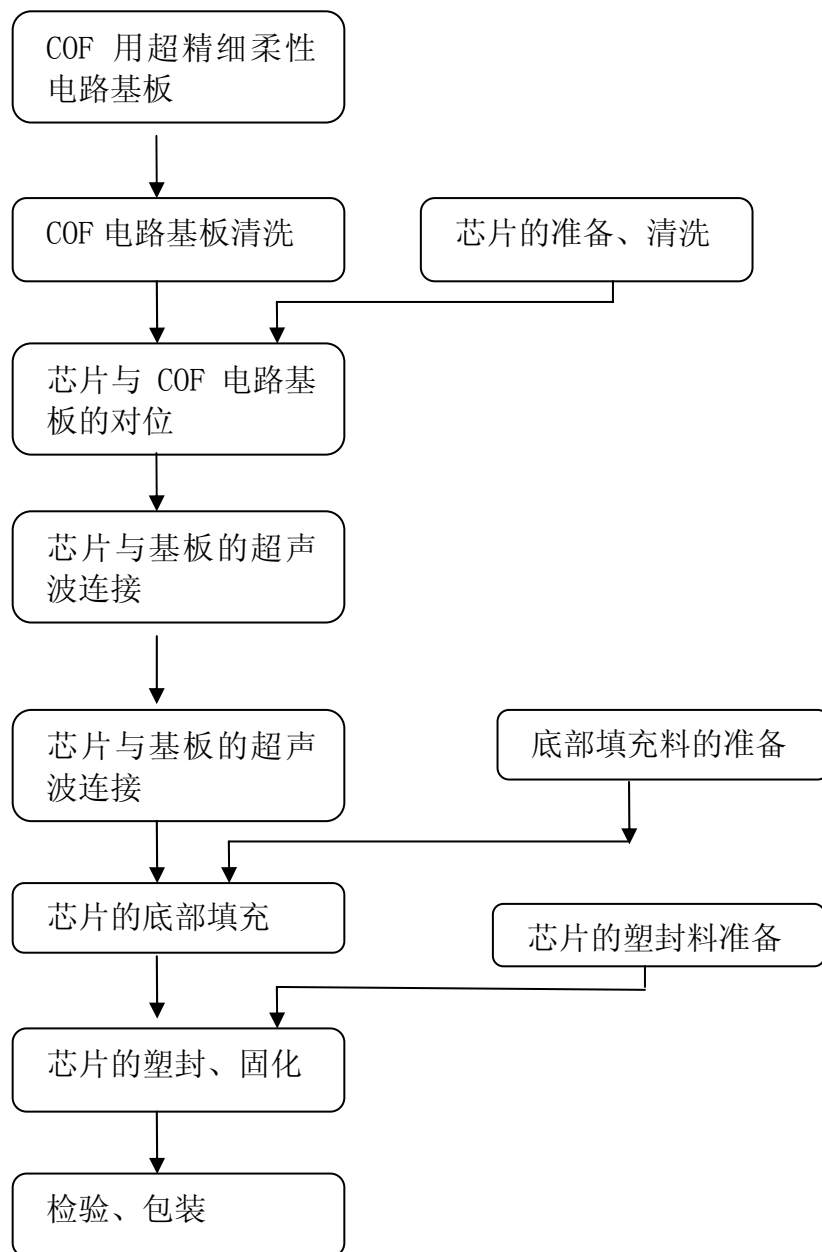




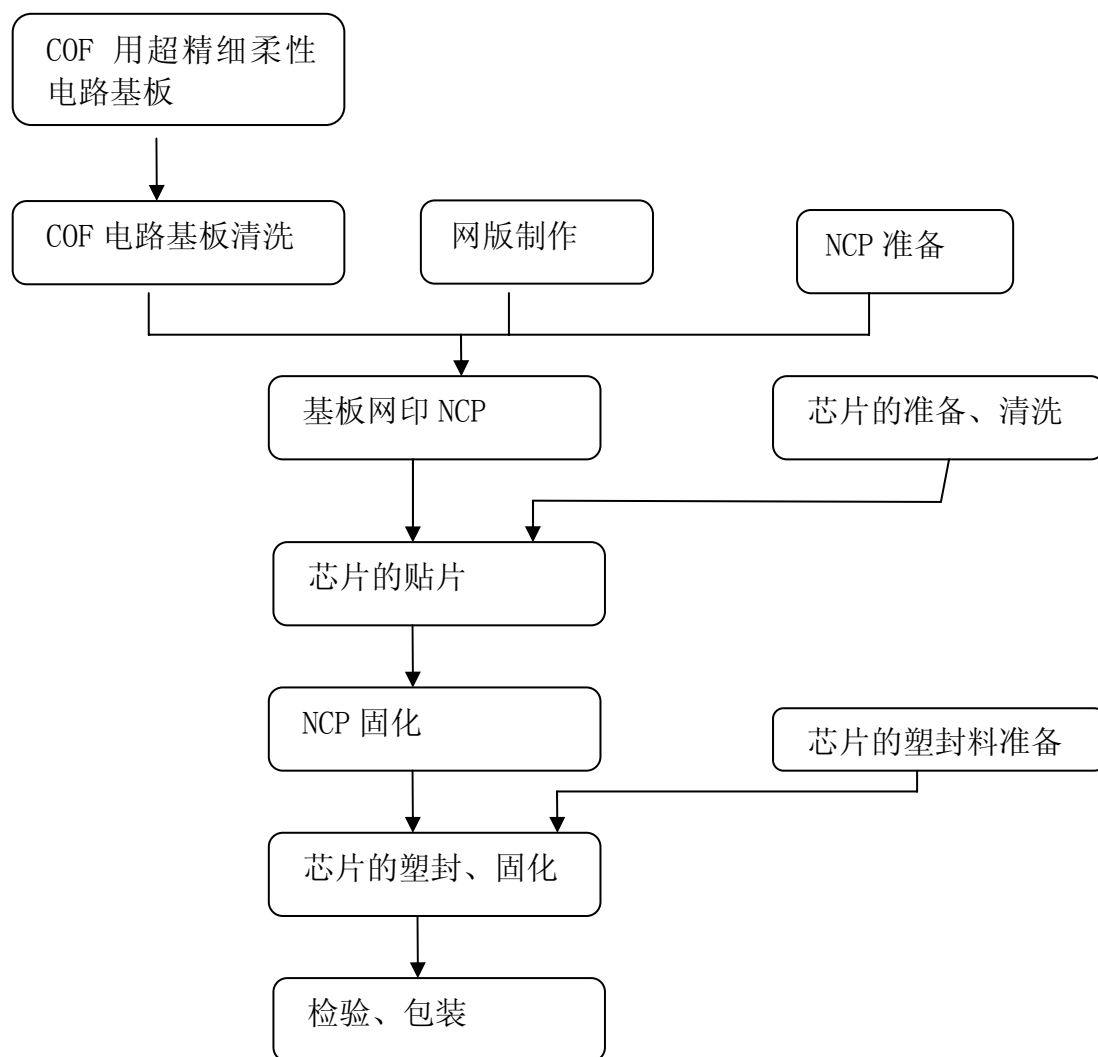
### 3、COF 产品

芯片与柔性封装基板的连接有 2 种方式：Au-Au 共晶超声波连接工艺与非导电胶（NCP）连接工艺，其工艺流程分别如下：

#### （1）Au-Au 共晶超声波连接工艺

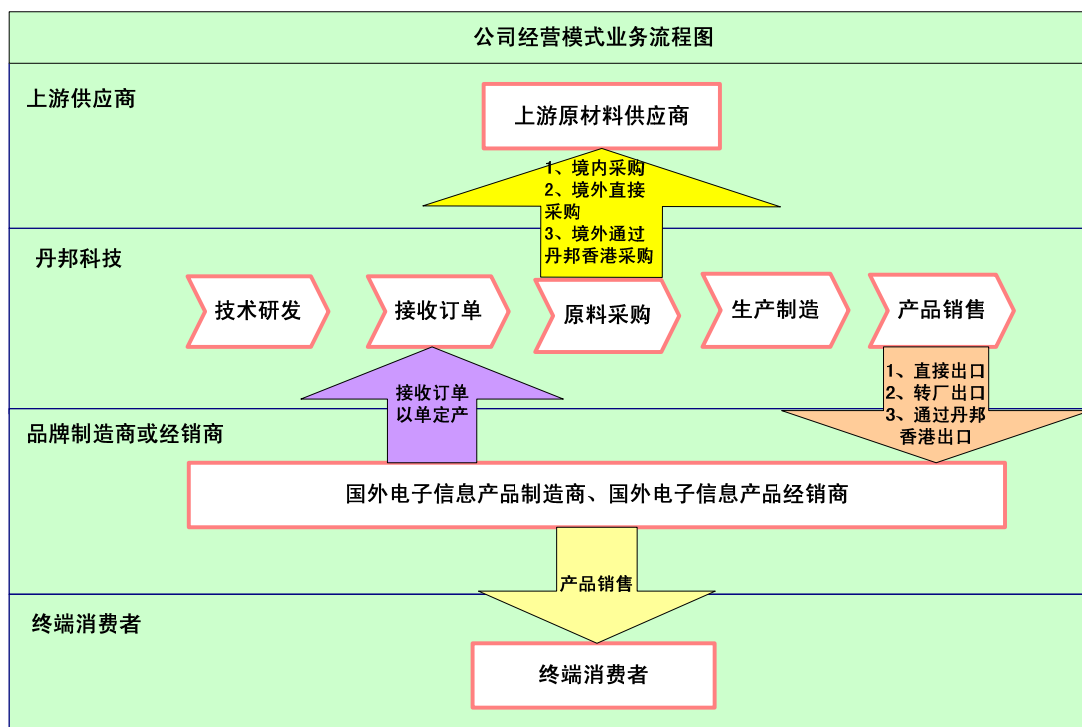


## (2) 非导电胶（NCP）的连接工艺



### （三）主要经营模式

#### 1、经营模式业务流程



#### 2、生产模式

由于不同客户、不同电子产品对电子元器件有不同的质量、电器性能以及结构配套要求，因此不同客户的不同产品均会有所差异，公司主导产品是一种定制化产品而非标准件产品。基于这种特点，公司的生产模式是“以单定产”，即根据客户的订单情况来确定生产计划。订单生产避免了公司自行制定生产计划可能带来的盲目性，以销定产，原材料采购和生产更有计划性，可以大大降低库存积压导致的存货跌价风险，还可以最大限度控制原材料库存，提高资源利用效率。

#### 3、采购模式

公司原材料采购分为境内采购和境外采购：

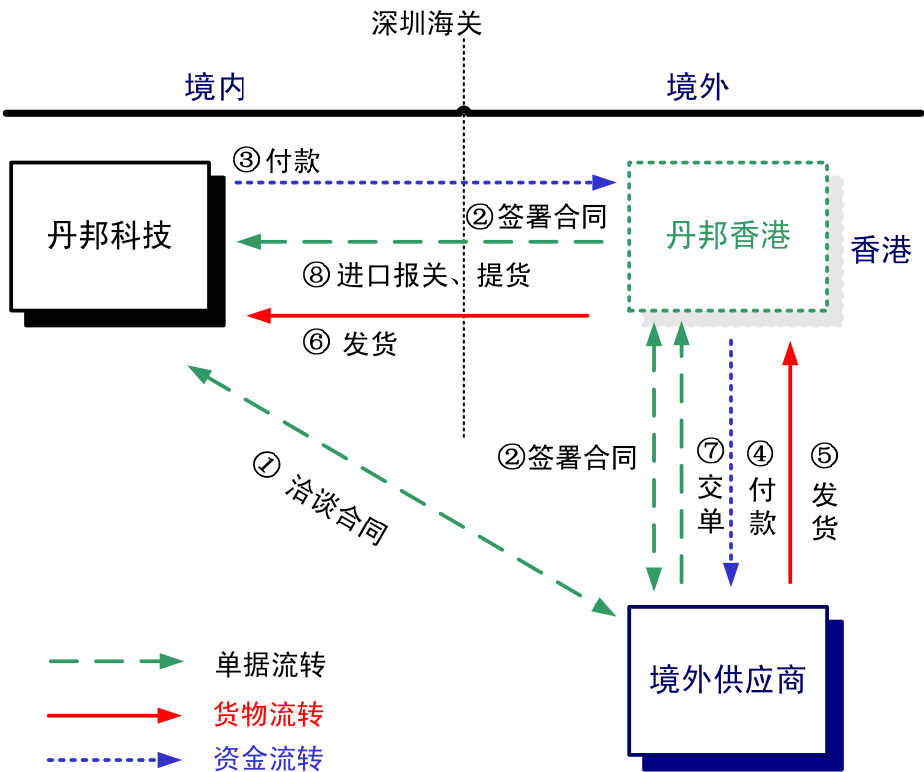
##### （1）境内采购

由公司根据生产需要，直接与供应商洽谈采购条件并向其发出采购订单，公司直接收货并直接向供货商付款，主要的付款方式为电汇等，主要以人民币结算。

##### （2）境外采购

公司境外采购分为两种情况：第一种是公司直接与境外供应商签订采购协议，直接办理进口报关并直接向境外供应商付款；第二种是委托丹邦香港（2009年8月以前为第比尔国际）代理采购及付款。主要的付款方式为电汇（T/T），主要以美元、日元结算。

公司委托丹邦香港代理采购业务流程图如下：



①洽谈合同：公司直接与境外供应商接触与洽谈，约定设备或原材料的种类、技术要求、规格型号、数量、价格、交货期、结算方式等具体合同内容。

②签订合同：丹邦香港和境外供应商根据公司商定的条款签订采购合同或订单，同时公司与丹邦香港签订具有同样条款的采购合同或订单。

③付款：公司根据合同约定的支付条件向丹邦香港支付款项，境外材料采购一般采用 T/T 方式付款，供应商一般给予公司 60-90 天左右的信用账期，也有部分铜箔等原材料的采购采用预付的方式。

④付款：丹邦香港在收到公司支付的货款后转付给境外供应商。

⑤发货：境外供应商根据合同约定将货物发送至丹邦香港。

⑥发货：丹邦香港收到境外供应商发送的货物后从香港发送至境内。

⑦交单：境外供应商发货后，根据合同约定将提单、装箱单、质量证明书及保险单等单据开具给丹邦香港，丹邦香港再将上述单据开具给本公司。

⑧进口报关、提货：公司办理电子报关进口，形成电子报关单并提货，于次月向海关办理集中报关。

报告期内，公司各种原材料采购模式分类如下：

单位：万元

| 项 目  |                | 2010 年度  |         | 2009 年度  |         | 2008 年度  |         |
|------|----------------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|
|      |                | 金额       | 占比      | 金额       | 占比      | 金额       | 占比      |
| 境外采购 | 由丹邦科技直接付款给供应商  | 412.08   | 7.29%   | 1,942.01 | 31.53%  | 259.53   | 5.46%   |
|      | 通过第比尔国际代理采购及付款 | -        | -       | 965.82   | 15.68%  | 2,560.90 | 53.92%  |
|      | 通过丹邦香港代理采购及付款  | 1,596.01 | 28.25%  | 615.70   | 9.99%   | -        | -       |
|      | 小 计            | 2,008.09 | 35.54%  | 3,523.52 | 57.20%  | 2,820.43 | 59.39%  |
| 境内采购 |                | 3,642.05 | 64.46%  | 2,636.64 | 42.80%  | 1,928.95 | 40.61%  |
| 合 计  |                | 5,650.14 | 100.00% | 6,160.17 | 100.00% | 4,749.38 | 100.00% |

#### 4、销售模式

公司产品以出口为主，报告期内产品外销比例均保持在98%以上，公司境外销售分为三种情况：直接出口、转厂出口、通过丹邦香港（2009年8月以前为第比尔国际）代理出口。公司国内销售主要采取向客户直接销售的内销模式。

报告期内，公司各种销售模式分类如下：

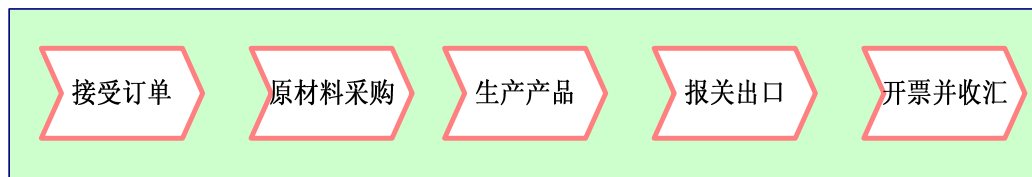
单位：万元

| 项 目  |                | 2010 年度   |         | 2009 年度   |         | 2008 年度   |         |
|------|----------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
|      |                | 金额        | 占比      | 金额        | 占比      | 金额        | 占比      |
| 境外销售 | 由丹邦科技直接出口及收款   | 14,755.30 | 72.44%  | 10,758.22 | 58.93%  | 9,261.17  | 54.03%  |
|      | 由丹邦科技转厂出口及收款   | 4,261.00  | 20.92%  | 5,775.60  | 31.64%  | 1,939.00  | 11.31%  |
|      | 通过第比尔国际代理出口及收款 | -         | -       | 404.65    | 2.22%   | 5,842.88  | 34.09%  |
|      | 通过丹邦香港代理出口及收款  | 995.62    | 4.89%   | 1,138.76  | 6.24%   | -         | -       |
|      | 小 计            | 20,011.92 | 98.25%  | 18,077.23 | 99.03%  | 17,043.05 | 99.44%  |
| 境内直销 |                | 356.17    | 1.75%   | 177.59    | 0.97%   | 96.79     | 0.56%   |
| 合 计  |                | 20,368.09 | 100.00% | 18,254.82 | 100.00% | 17,139.84 | 100.00% |

### (1) 直接出口

公司直接与国外电子信息产品品牌制造商、经销商洽谈，与各客户协商确定销售量、产品型号和销售价格，签订销售合同；产品生产完成后直接发货至客户指定的国外交货地点，直接办理出口报关并直接向境外客户收款，主要的收款方式为电汇（T/T），主要以美元结算。

公司直接出口业务流程图如下：

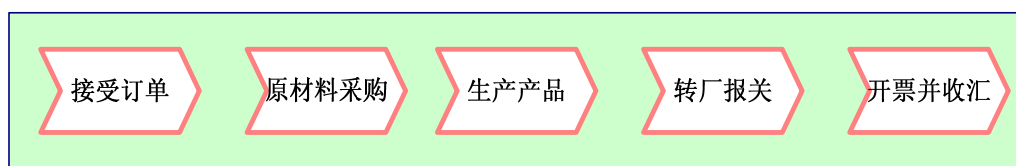


### (2) 转厂出口

转厂出口，简称转厂，是指由一个企业将海关监管的货物，转移到另一海关监管企业，并向海关办理监管货物的转移手续。转厂涉及两个不同的主管海关，买卖双方需同时向两个主管海关提出申报，其中转入方申报和办理进口手续，转出方申报和办理出口手续，货物不需要真正出口，而是直接由国内的一个厂商发送到另一个厂商的货物转移方式。转入方与转出方通过外汇进行结算。

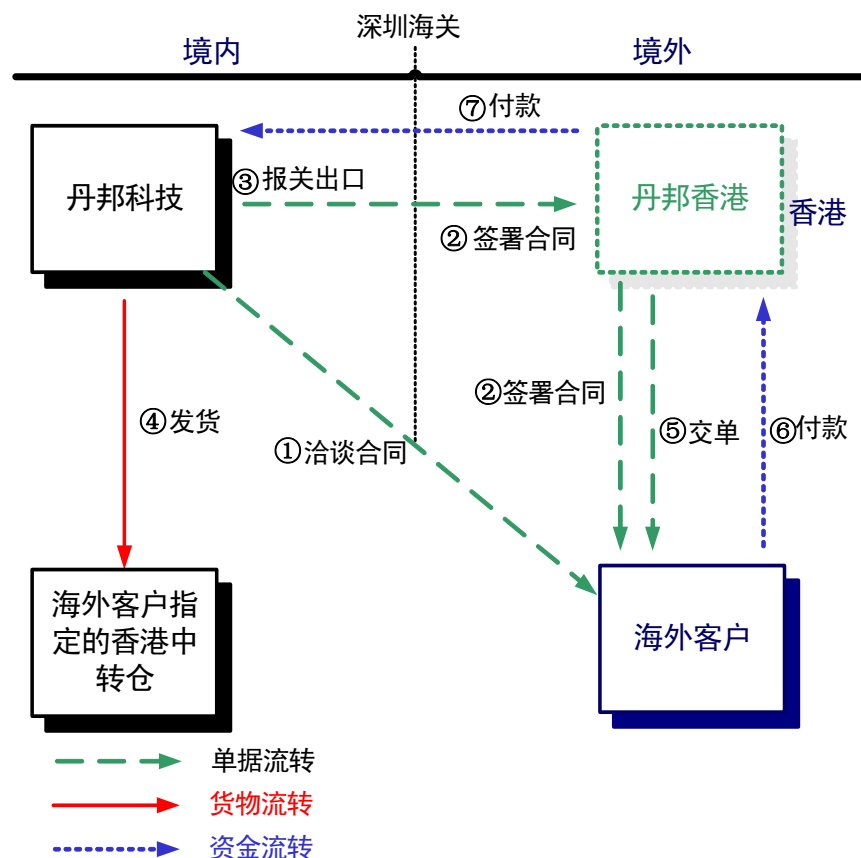
公司转厂出口客户是国外知名品牌制造商在中国的生产基地，如日本夏普在中国的子公司无锡夏普电子元器件有限公司，其通过将本公司提供的COF柔性封装基板及COF产品进行加工后报关出口。2009年公司转厂出口贸易额较2008年大幅增加198%，主要是由于2009年以前，公司销往日本夏普的产品是通过第比尔国际代理出口至经销商日本黑田电气，再由黑田电气销售至日本夏普，2009以后，公司开始直接对日本夏普在国内的子公司无锡夏普销售产品，该销售以美元结算，为转厂出口贸易，由此导致公司2009年以来转厂出口贸易大幅增加。

公司转厂出口业务流程图如下：



### （3）通过丹邦香港代理出口

公司通过丹邦香港代理出口及收款业务流程图如下：



①洽谈合同：公司直接与境外客户接触与洽谈，约定产品种类、规格型号、技术要求、数量、价格、交货期、结算方式等具体合同内容。

②签订合同：客户和丹邦香港按照公司商定的条款签订销售合同或下单，同时丹邦香港与公司签订具有同样条款的合同或下单。

③报关出口：公司办理电子报关出口，形成电子报关单，并于次月向海关办理集中报关。

④发货：由丹邦香港委托的运输公司从本公司提货，直接将货物发至海外客户指定的香港中转仓，完成货物的交付运输。

⑤交单：丹邦科技根据合同中规定的条款，将货运单据、发票、装箱单等单据以丹邦香港的名义开具给境外客户。

⑥付款：境外客户根据合同中约定的支付条件向丹邦香港支付款项或付款赎

单，公司主要采用 T/T 结算方式，一般授予客户 90 天的信用账期。

⑦付款：丹邦香港将收到的境外客户货款后转付给公司。

#### （四）主要产品产销情况

##### 1、主要产品产能及产销情况

| 产品类别                       | 时间     | 产能     | 产量        | 产能利用率  | 销量        | 产销率     |
|----------------------------|--------|--------|-----------|--------|-----------|---------|
| FPC<br>(单位：平方米)            | 2010 年 | 70,000 | 49,904.58 | 71.29% | 51,136.63 | 102.47% |
|                            | 2009 年 | 70,000 | 50,095.35 | 71.56% | 49,844.87 | 99.50%  |
|                            | 2008 年 | 90,000 | 89,428.88 | 99.37% | 87,676.07 | 98.04%  |
| COF 柔性<br>封装基板<br>(单位：平方米) | 2010 年 | 80,000 | 74,726.69 | 93.41% | 77,160.64 | 103.26% |
|                            | 2009 年 | 80,000 | 77,475.44 | 96.84% | 76,708.43 | 99.01%  |
|                            | 2008 年 | 70,000 | 54,471.20 | 77.82% | 53,675.92 | 98.54%  |
| COF 产品<br>(单位：万块)          | 2010 年 | 250    | 243.78    | 97.51% | 247.38    | 101.48% |
|                            | 2009 年 | 250    | 213.91    | 85.56% | 210.89    | 98.59%  |
|                            | 2008 年 | 200    | 182.96    | 91.48% | 178.13    | 97.36%  |

在日常经营中，公司一般会根据现有的产品需求状况，预计未来的产品需求形势，并以此决策是否扩充产能。报告期内，随着公司不断加大高端产品开发与推广力度，COF 柔性封装基板、COF 产品销量持续稳定增长；公司 FPC 产能逐年下降，主要是由于公司不断调整产品结构，提升高端产品比例，将部分现有 FPC 生产设备改造后用于 COF 柔性封装基板生产，以扩大 COF 柔性封装基板和 COF 产品产能。

##### 2、产品主营业务收入构成

单位：万元

| 按产品分类      | 2010 年度   |         | 2009 年度   |         | 2008 年度   |         |
|------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
|            | 金额        | 占比      | 金额        | 占比      | 金额        | 占比      |
| FPC        | 4,319.12  | 21.21%  | 4,260.31  | 23.34%  | 7,627.19  | 44.50%  |
| COF 柔性封装基板 | 10,196.25 | 50.06%  | 10,161.15 | 55.66%  | 6,993.40  | 40.80%  |
| COF 产品     | 5,852.72  | 28.73%  | 3,833.36  | 21.00%  | 2,519.25  | 14.70%  |
| 合 计        | 20,368.09 | 100.00% | 18,254.82 | 100.00% | 17,139.84 | 100.00% |

公司不断优化产品结构，加大高技术含量、高附加值 COF 柔性封装基板及 COF 产品的研发、生产和销售。上表显示，报告期内，COF 柔性封装基板及 COF 产品销售收入占比逐年上升，二者合计占比由 2008 年的 55.5% 上升到 2010 年的 78.79%；FPC 销售收入占比逐年下降，由 2008 年的 44.5% 下降到 2010 年的 21.21%。



### 3、产品销售区域分布

单位：万元

| 按销售区域 |      | 2010 年度   |         | 2009 年度   |         | 2008 年度   |         |
|-------|------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| 分类    |      | 金额        | 占比      | 金额        | 占比      | 金额        | 占比      |
| 境内    | 中国大陆 | 356.17    | 1.75%   | 177.59    | 0.97%   | 96.79     | 0.56%   |
|       | 小 计  | 356.17    | 1.75%   | 177.59    | 0.97%   | 96.79     | 0.56%   |
| 境外    | 日本   | 14,513.06 | 71.25%  | 13,479.32 | 73.84%  | 8,510.41  | 49.65%  |
|       | 香港   | 967.49    | 4.75%   | 962.05    | 5.27%   | 6,377.73  | 37.21%  |
|       | 东南亚  | 1,750.72  | 8.60%   | 1,399.64  | 7.67%   | 1,210.49  | 7.06%   |
|       | 欧美   | 2,780.65  | 13.65%  | 2,236.21  | 12.25%  | 944.41    | 5.51%   |
|       | 小 计  | 20,011.92 | 98.25%  | 18,077.23 | 99.03%  | 17,043.04 | 99.44%  |
| 合 计   |      | 20,368.09 | 100.00% | 18,254.82 | 100.00% | 17,139.84 | 100.00% |

公司产品以出口为主，报告期内产品外销比例均保持在 98%以上。公司产品销售市场主要集中于日本、欧美、东南亚（包括韩国）、香港等国家和地区。从区域来看，受益于良好的客户关系和不断的市场拓展，报告期内公司产品对日本的出口销售额相对稳定，对欧美、东南亚的出口销售逐年增加，对香港的出口销售逐年下降，主要系 2009 年 8 月开始公司将原本通过香港关联方第比尔国际进行的境外销售业务由公司全资子公司丹邦香港承接的同时，部分原来通过第比尔国际进行的境外销售业务改由本公司向境外最终客户直接销售。

### 4、产品价格的变动情况

报告期内，公司主要产品平均销售价格变动情况如下表所示：

| 按产品分类                    | 2010 年度  |        | 2009 年度  |        | 2008 年度  |        |
|--------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
|                          | 均价       | 增长幅度   | 均价       | 增长幅度   | 均价       | 增长幅度   |
| FPC<br>(单位：元/平方米)        | 844.62   | -1.18% | 854.71   | -1.75% | 869.93   | -8.06% |
| COF 柔性封装基板<br>(单位：元/平方米) | 1,321.43 | -0.24% | 1,324.65 | 1.67%  | 1,302.89 | -0.05% |
| COF 产品<br>(单位：元/块)       | 23.66    | 30.14% | 18.18    | 28.53% | 14.14    | 11.47% |

公司主要产品平均价格变化特点及原因如下：

FPC 均价呈逐年下降趋势，主要是由于 FPC 市场集中度较低，进入门槛相对较低，随着更多企业加入，市场竞争越来越激烈，使得 FPC 价格逐年下降。

COF 柔性封装基板均价稳中有升，主要是由于 COF 柔性封装基板制造工艺复

杂，市场集中度非常高，少数企业处于垄断地位，公司较强的议价能力使得产品价格保持相对稳定。

COF产品均价呈逐年上升趋势，主要是由于多芯片封装COF产品占比逐年增加，公司在2007年打样试产时，产品主要为单芯片封装，随着公司对COF芯片封装技术的不断提高以及满足客户的下游产品升级需求，公司多芯片封装COF产品占比逐年增多，增加了COF产品的单位成本，公司相应的提高了产品价格。

## 5、主要客户情况

报告期内，公司产品外销比例均保持在98%以上，外销主要客户均是国际知名企业，信誉良好。

公司客户主要可分为两个类别：品牌制造商、经销商。报告期内，公司对各类客户的销售额及其销售额占营业收入的比例情况如下：

单位：万元

| 按产品分类 | 2010 年度   |         | 2009 年度   |         | 2008 年度   |         |
|-------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
|       | 金额        | 占比      | 金额        | 占比      | 金额        | 占比      |
| 品牌制造商 | 15,926.45 | 78.19%  | 14,726.31 | 80.67%  | 12,432.68 | 72.54%  |
| 经销商   | 4,441.64  | 21.81%  | 3,528.51  | 19.33%  | 4,707.16  | 27.46%  |
| 合 计   | 20,368.09 | 100.00% | 18,254.82 | 100.00% | 17,139.84 | 100.00% |

公司的销售模式是直接销售为主，经销销售为辅，直销对象为全球顶尖电子信息产品品牌制造商。2008-2010 年，公司通过经销商销售的金额占营业收入比例分别为 27.46%、19.33%、21.81%，占比保持稳定。

公司采用经销商为辅的销售模式原因是公司产品以出口为主，报告期内，产品外销比例均保持在 98%以上，产品销售市场主要集中在日本、欧美、东南亚、香港等地区，由于一些境外终端客户地处偏远或规模较小，公司较难直接对其进行服务和管理，经销模式有助于公司借助经销商精细化布局的销售网络进行扩张，拓展市场区域，更好的贴近客户提供服务，特别是对远离公司区域进行有效渗透，有利于公司节省资金投入，提高运营效率，让公司更专注于产品的技术与应用创新，保持持续领先的行业技术优势。

印制电路板行业生产企业主要采取直销、经销、代销或三者之间相互结合的销售模式，公司与国内印制电路板行业主要上市公司销售模式对比情况如下表：

| 企业名称 | 直销   | 经销 | 代销  | 主要销售模式 | 主要销售区域 |
|------|------|----|-----|--------|--------|
| 丹邦科技 | ★★★  | ★  |     | 直销     | 国际     |
| 沪电股份 | ★    |    | ★★★ | 代销     | 国际     |
| 超华科技 | ★★★★ |    |     | 直销     | 国内     |
| 兴森快捷 | ★★★  | ★  |     | 直销     | 国际     |

注：其他公司销售模式的信息根据其公告的招股说明书整理所得，★数量越多，表示该模式销售额占企业营业收入的比例越高。

通过以上比较可知，企业采用不同销售模式主要受其销售区域影响，以出口为主的企业均采用直销与经销或直销与代销结合的销售模式，如丹邦科技、兴森快捷销售模式以直销为主，经销为辅，而沪电股份销售模式以代销为主，直销为辅；而以内销为主的企业主要采用直销模式，如超华科技完全采用直销模式。

### （1）主要国外品牌制造商

#### ①无锡夏普电子元器件有限公司

无锡夏普是日本夏普的在无锡设立的控股子公司，主要开发生产液晶显示装置及其配套零部件、新型电子元器件、数字照相机关键件、卫星导航定位接收设备及关键部件等。日本夏普成立于 1912 年，是世界知名的电器品牌，2010 年世界 500 强企业排名第 264 位，2009 年营业收入达到 296 亿美元。

#### ②NIDEC CORPORATION. SHIGA TECHNICAL CENTER

NIDEC CORPORATION 中文简称日本电产，成立于 1973 年，目前已发展成为国际著名跨国企业，注册资本 6.25 亿美元，在全球拥有 140 多家公司，遍及美国、德国、中国、中国台湾、新加坡、香港、泰国等国家和地区，员工达 13 万多名，主要生产电子和光学元件、机械产品、中型电机、小型精密马达等，其中硬盘驱动装置用主轴马达占世界市场的 70%以上，成为世界一流的电机制造企业，并先后在东京、大阪、纽约的证交所上市，2008 年营业收入达到 63 亿美元。

#### ③NIDEC SANKYO (H.K.) CO., LTD.

NIDEC SANKYO 中文简称日本电产三协，日本电产三协前身是日本三协公司。日本三协公司成立于 1946 年，主要生产家电、住宅设备、汽车、电脑、DVD、数码相机、工业机械的电动器具及零部件，2003 年三协公司被日本电产收购，成为日本电产控股子公司，三协公司更名为日本电产三协。

④HITACHI MEDIA ELECTRONICS CO.,LTD.

HITACHI MEDIA ELECTRONICS 中文简称日立多媒体电子，是日本日立集团全资子公司，日立集团成立于 1910 年，是全球最大的综合跨国集团之一，总部位于日本东京，在世界各地拥有控股子公司 956 家，员工约 33 万人，2010 年世界 500 强企业排名第 47 位，2009 年营业收入达到 965 亿美元。

(2) 主要国外经销商

①Z. KURODA (HONG KONG) CO. LTD.

Z. KURODA 中文简称黑田电气，成立于 1945 年，是日本知名的电器材料、电子元件、半导体、机械装备及光学配件经销商，目前在日本有 31 处经销网点，在海外 11 个国家有 24 处经销网点。

②DML 有限公司

DML 有限公司简称 DML，成立于 1994 年，是英国较知名的电子元器件经销商，DML 与世界 500 强企业美国 Honeywell 和世界领先的电子制造服务提供商 Felixtronics 等企业保持长期稳定的业务关系。

公司主要经销商黑田电气、DML 的终端客户情况如下表：

| 经销商名称 | 主要的终端客户名称 | 终端客户简介                                   | 该终端客户是否同时是公司直销客户                                       |
|-------|-----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 黑田电气  | 夏普        | 夏普手机液晶显示事业部通过黑田电气向公司采购产品，用于手机的照相镜头和手机显示屏 | 是<br>夏普电子元件和设备事业部直接向公司采购产品，用于笔记本电脑硬盘光头                 |
|       | 松下        | 松下照相机事业部通过黑田电气向公司采购产品，用于照相机              | 否                                                      |
|       | 日立        | 日立显示事业部通过黑田电气向公司采购产品，用于显示屏背光源            | 是<br>日立子公司日立多媒体电子直接向公司采购产品，用于笔记本电脑硬盘光头                 |
|       | 佳能        | 佳能照相机事业部通过黑田电气向公司采购产品，用于照相机              | 是<br>日本佳能的子公司 Canon Finetech Nisca 直接向公司采购产品，用于照相机伸缩镜头 |
| DML   | 霍尼韦尔      | 美国霍尼韦尔在全球 95 个国家拥有 10.8 万员工，连续 50 年成     | 否                                                      |

|  |      |                                                            |   |
|--|------|------------------------------------------------------------|---|
|  |      | 为《财富》世界 500 强企业，核心业务为航空航天、汽车和工程材料、住宅及楼宇控制技术和工业控制以及自动化产品    |   |
|  | 西部数据 | 美国西部数据是全球知名的硬盘生产商，在全球拥有 2.3 万员工，其生产机构设在马来西亚、中国、泰国，设计机构设在加州 | 否 |

## 6、报告期内向前五大客户销售情况

单位：万元

| 年度    | 序号  | 客户名称                                       | 客户类型      | 销售金额      | 占主营业务收入比例 |
|-------|-----|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2010年 | 1   | 无锡夏普电子元器件有限公司                              | 品牌制造商     | 2,102.51  | 10.32%    |
|       | 2   | Z. KURODA (HONG KONG) CO. LTD.             | 经销商       | 1,928.64  | 9.47%     |
|       | 3   | NIDEC. CORPORATION. SHIGA TECHNICAL CENTER | 品牌制造商     | 1,686.37  | 8.28%     |
|       | 4   | NIDEC SANKYO (H. K.) CO., LTD.             | 品牌制造商     | 1,237.97  | 6.08%     |
|       | 5   | DML SOURCING LTD                           | 经销商       | 1,194.13  | 5.86%     |
|       | 合 计 |                                            | -         | 8,149.62  | 40.01%    |
| 2009年 | 1   | 无锡夏普电子元器件有限公司                              | 品牌制造商     | 2,012.85  | 11.03%    |
|       | 2   | NIDEC. CORPORATION. SHIGA TECHNICAL CENTER | 品牌制造商     | 1,844.14  | 10.10%    |
|       | 3   | HITACHI MEDIA ELECTRONICS CO., LTD.        | 品牌制造商     | 1,015.75  | 5.56%     |
|       | 4   | Z. KURODA (HONG KONG) CO. LTD.             | 经销商       | 1,007.42  | 5.52%     |
|       | 5   | NIDEC SANKYO (H. K.) CO., LTD.             | 品牌制造商     | 894.05    | 4.90%     |
|       | 合 计 |                                            | -         | 6,774.22  | 37.11%    |
| 2008年 | 1   | 第比尔国际(香港)有限公司                              | 经销商、品牌制造商 | 5,842.88  | 34.09%    |
|       | 2   | HITACHI MEDIA ELECTRONICS CO., LTD.        | 品牌制造商     | 1,444.87  | 8.43%     |
|       | 3   | NIDEC SANKYO (H. K.) CO., LTD.             | 品牌制造商     | 1,177.98  | 6.87%     |
|       | 4   | NIDEC. CORPORATION. SHIGA TECHNICAL CENTER | 品牌制造商     | 1,021.99  | 5.96%     |
|       | 5   | ALPS ELECTRONICS HONG KONG Limited         | 品牌制造商     | 688.00    | 4.01%     |
|       | 合 计 |                                            | -         | 10,175.72 | 59.37%    |

注：2009年以前，公司通过第比尔国际代理销售，第比尔国际客户包括经销商和品牌制造商，经销商主要为日本黑田电气，2009年后，公司不再通过第比尔国际代理销售，日本黑田电气成为公司直接客户。

2009 年以前，公司前 5 大客户中除通过第比尔国际代理销售对应的部分客户为经销商外，其他客户均为电子信息产品品牌制造商。

2009 年以后，公司前 5 大客户中除日本黑田电气和 DML 有限公司为经销商外，其他客户均为国际知名电子信息产品品牌制造商。

报告期内，公司客户群体公司不存在向单个客户销售比例超过销售总额 50% 的情况。公司不依赖于单一客户，具有较强的抗风险能力。

上述客户中，第比尔国际为本公司实际控制人控制的关联企业，2009 年 8 月以前，公司部分境外销售通过其代理进行。除此以外，本公司与其他客户之间不存在关联关系，本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及主要关联方或持有本公司 5%以上股份的股东均未在上述客户中拥有权益。

2008-2009 年，公司通过第比尔国际向境外出口的前五名客户情况如下表：

单位：万元

| 年度    | 序号  | 客户名称                           | 销售金额     | 占外销收入比例 |
|-------|-----|--------------------------------|----------|---------|
| 2009年 | 1   | DML有限公司                        | 138.34   | 0.77%   |
|       | 2   | 友新有限公司                         | 89.02    | 0.49%   |
|       | 3   | 东和集团有限公司                       | 81.58    | 0.45%   |
|       | 4   | Z. KURODA (HONG KONG) CO. LTD. | 73.80    | 0.41%   |
|       | 5   | 精电科技（香港）有限公司                   | 8.63     | 0.05%   |
|       | 合 计 |                                | 391.38   | 2.16%   |
| 2008年 | 1   | Z. KURODA (HONG KONG) CO. LTD. | 2,312.86 | 13.57%  |
|       | 2   | DML有限公司                        | 1,241.03 | 7.28%   |
|       | 3   | 东和集团有限公司                       | 1,175.34 | 6.90%   |
|       | 4   | 易拓科技有限公司                       | 680.20   | 3.99%   |
|       | 5   | 精电科技（香港）有限公司                   | 139.07   | 0.82%   |
|       | 合 计 |                                | 5,548.49 | 32.56%  |

## （五）主要原材料和能源供应情况

### 1、主要原材料供应情况

公司生产所需原材料品种较多，主要包括铜箔、PI 膜、保强板、粘合剂、芯片及器件等，其中 PI 膜大部分由境外进口，保强板、粘合剂、芯片及器件大部分由境内采购，铜箔境内、境外采购数量相当。公司在境外及境内均具有良好的采购和配套渠道，在多年的经营中，公司已与多家原材料生产厂商建立了长期稳固的合作关系，且每种主要原材料供应商数量保持两家以上，原材料来源和质量有保证。与此同时，珠三角地区电子元器件生产供应厂商众多，元器件供应充足。

公司生产所需能源主要为水和电力，由深圳供水、供电系统供应，报告期内

供应稳定。

## 2、主要原材料占成本的比重及其价格波动情况

### (1) 产品成本构成

单位：万元

| 成本项目   | 2010 年   |         | 2009 年   |         | 2008 年   |         |
|--------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|
|        | 金额       | 占比      | 金额       | 占比      | 金额       | 占比      |
| 直接材料成本 | 2,438.04 | 25.69%  | 2,248.00 | 26.61%  | 2,247.38 | 28.06%  |
| 直接人工成本 | 2,126.76 | 22.41%  | 1,806.18 | 21.38%  | 1,602.20 | 20.01%  |
| 辅助材料   | 1,350.46 | 14.23%  | 1,331.40 | 15.76%  | 1,443.03 | 18.02%  |
| 直接动力   | 1,148.32 | 12.10%  | 1,015.45 | 12.02%  | 941.8    | 11.76%  |
| 制造费用   | 2,426.65 | 25.57%  | 2,046.94 | 24.23%  | 1,774.09 | 22.15%  |
| 合 计    | 9,490.23 | 100.00% | 8,447.97 | 100.00% | 8,008.48 | 100.00% |

公司主营业务成本构成在报告期内保持稳定，以直接材料成本、制造费用为主，二者合计占比在 50%左右，直接人工成本占比保持在 20%左右。

### (2) 主要原材料占直接材料成本的比例

单位：万元

| 材料名称  | 2010 年   |         | 2009 年   |         | 2008 年   |         |
|-------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|
|       | 金额       | 占比      | 金额       | 占比      | 金额       | 占比      |
| 铜箔    | 473.22   | 19.41%  | 471.28   | 20.96%  | 507.97   | 22.60%  |
| PI 膜  | 853.80   | 35.02%  | 859.04   | 38.21%  | 914.36   | 40.69%  |
| 保强板   | 254.78   | 10.45%  | 232.94   | 10.36%  | 247.72   | 11.02%  |
| 粘合剂   | 250.14   | 10.26%  | 255.83   | 11.38%  | 266.16   | 11.84%  |
| 芯片及器件 | 606.10   | 24.86%  | 428.91   | 19.08%  | 311.16   | 13.85%  |
| 合 计   | 2,438.04 | 100.00% | 2,248.00 | 100.00% | 2,247.38 | 100.00% |

上表显示，公司主要原材料包括铜箔、PI 膜、保强板、粘合剂、芯片及器件等，其中铜箔和 PI 膜合计占材料总成本的 50%以上，其他材料主要包括保强板、粘合剂、芯片及器件等。报告期内，铜箔、PI 膜占比逐年下降，主要原因为：一方面，铜箔、PI 膜的价格逐年下降；另一方面，公司 COF 产品的占比越来越高，使得生产 COF 产品所用的芯片及器件占比逐年上升。

### (3) 原材料价格波动情况

报告期内，公司主要原材料铜箔、PI膜价格变动情况如下：

单位：元/千克

| 产品类别 |              | 2010 年 |        | 2009 年 |        | 2008 年 |         | 2007 年 |
|------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
|      |              | 单价     | 变动比例   | 单价     | 变动比例   | 单价     | 变动比例    | 单价     |
| 铜箔   | 35 $\mu$ m   | 123    | -0.81% | 124    | -0.80% | 125    | -       | 125    |
|      | 18 $\mu$ m   | 242    | -1.22% | 245    | -3.16% | 253    | -7.66%  | 274    |
| PI 膜 | 25 $\mu$ m   | 612    | -0.33% | 614    | -6.40% | 656    | -12.42% | 749    |
|      | 12.5 $\mu$ m | 1,611  | -5.62% | 1,707  | -7.73% | 1,850  | -22.98% | 2,402  |

注：铜箔、PI 膜价格取自公司报告期内采购的平均价格。

### 3、报告期内向前五大供应商的采购情况

单位：万元

| 年度     | 序号  | 供应商名称            | 主要采购材料 | 采购金额     | 占采购总额比例 |
|--------|-----|------------------|--------|----------|---------|
| 2010 年 | 1   | 三井电子薄膜（香港）有限公司   | PI 膜   | 858.05   | 15.19%  |
|        | 2   | 深圳市天诚化工有限公司      | 化工原料   | 710.85   | 12.58%  |
|        | 3   | (JADA) 积德电子有限公司  | 铜箔     | 212.29   | 3.76%   |
|        | 4   | 东莞华港国际贸易有限公司     | 离型膜    | 170.94   | 3.03%   |
|        | 5   | 深圳市兴精益模具有限公司     | 器件     | 151.05   | 2.67%   |
|        | 合 计 |                  | -      | 2,103.18 | 37.22%  |
| 2009 年 | 1   | 第比尔国际（香港）有限公司    | PI 膜   | 965.82   | 15.68%  |
|        | 2   | 三井电子薄膜（香港）有限公司   | PI 膜   | 773.83   | 12.56%  |
|        | 3   | 深圳市天诚化工有限公司      | 化工原料   | 574.12   | 9.32%   |
|        | 4   | 深圳市宝安区公明下村岩佐荣华厂  | 器件     | 235.23   | 3.82%   |
|        | 5   | 上海盟星国际贸易有限公司     | 保强板    | 227.46   | 3.69%   |
|        | 合 计 |                  | -      | 2,776.46 | 45.07%  |
| 2008 年 | 1   | 第比尔国际（香港）有限公司    | PI 膜   | 2,560.90 | 53.92%  |
|        | 2   | 深圳市宝安区公明下村岩佐荣华厂  | 器件     | 227.07   | 4.78%   |
|        | 3   | 苏州福田金属有限公司       | 铜箔     | 159.68   | 3.36%   |
|        | 4   | 圣戈班高性能塑料（上海）有限公司 | 离型膜    | 107.83   | 2.27%   |
|        | 5   | 利昌工业（无锡）化成有限公司   | 保强板    | 102.84   | 2.17%   |
|        | 合 计 |                  | -      | 3,158.31 | 66.50%  |

上述供应商中，第比尔国际为本公司实际控制人控制的关联企业，2009 年 8 月以前，公司部分境外采购通过其代理进行。除此以外，本公司与其他供应商之间不存在关联关系，本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及主要关联方或持有本公司 5%以上股份的股东均未在上述供应商中拥有权益。

2008-2009 年，本公司通过第比尔国际向境外采购的前五名供应商情况详见下表：



单位：万元

| 年度    | 序号  | 供应商名称           | 采购金额     | 占境外<br>采购比例 |
|-------|-----|-----------------|----------|-------------|
| 2009年 | 1   | (Olin) 奥林亚太有限公司 | 444.00   | 12.60%      |
|       | 2   | 伊藤忠             | 231.84   | 6.58%       |
|       | 3   | 香港三井物产          | 155.49   | 4.41%       |
|       | 4   | 三井电子薄膜(香港)有限公司  | 100.52   | 2.85%       |
|       | 5   | 香港瑞泰公司          | 15.39    | 0.44%       |
|       | 合 计 |                 | 947.24   | 14.15%      |
| 2008年 | 1   | 三井电子薄膜(香港)有限公司  | 1,260.43 | 44.69%      |
|       | 2   | 三井金属(香港)有限公司    | 464.91   | 16.48%      |
|       | 3   | (Olin) 奥林亚太有限公司 | 242.56   | 8.60%       |
|       | 4   | 殷田化工有限公司        | 104.93   | 3.72%       |
|       | 5   | 香港瑞泰公司          | 102.82   | 3.65%       |
|       | 合 计 |                 | 2,175.65 | 77.14%      |

## （六）安全及环保情况

### 1、安全生产情况

公司制定并实施了系统的安全生产管理制度，建立了生产、储存、经营、使用危险化学品的系列规章制度，对特种作业人员（电工、焊工等）要求通过专业培训与考核，公司定期进行安全生产检查，保证安全生产。

根据深圳市南山区安全生产监督管理局出具的证明，公司自 2008 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日未发生重特大安全生产事故，未因发生安全生产事故受到行政处罚，无重大违法违规记录。

根据东莞市安全生产监督管理局松山湖分局出具的证明，公司子公司广东丹邦自 2009 年 8 月 25 日成立至 2010 年 12 月 31 日未出现因违反国家安全生产法律，法规和规章而受处罚的情况。

### 2、环保情况

柔性印制电路板生产过程中产生废水、大气污染物、固体废物及噪声等。公司十分重视清洁生产和“三废”的污染防治工作，公司按照 ISO14001:2004 国际环境管理体系对生产经营中产生的噪音、废气、废水采取合理的处理措施，公司已经具备比较完善的环保设施，具有成熟的污染物控制技术，在生产过程和“三废”处理上严格按照环保要求的流程进行操作，对于生产工艺过程中污染源的控

制落实到部门，进行责任跟踪，公司废气、废水排放标准和排放总量均符合当地环保部门相关标准。

**(1) 环保设施的运行情况**

公司对环保设施进行了持续、系统的投入和建设。截至目前，公司共有 1 套处理能力为 1,000 吨/日的工业废水处理设施和 3 套污泥脱水装置，3 台废气净化处理设备，并建设了隔音防噪专门机房。以上环保设施均稳定运行，功能良好，有效保证了公司环境保护的各项指标达到国家及地方的相关标准。

**(2) 三废处理情况**

公司产品生产过程中会产生一定的废水、废气、固体废物及噪声等。公司在三废处理的具体措施包括：

**① 废水的处理**

公司对生产中产生的废水分门别类地进行处理，尤其是对废水中的有机物、重金属离子等污染物有针对性地进行处理，公司废水的处理效果及污染排放情况如下表：

| 序号 | 污染物指标      | 排污排放标准 | 实际排放量       |
|----|------------|--------|-------------|
| 1  | 废水量（吨/日）   | ≤1000  | 800~900     |
| 2  | PH值        | 6~9    | 6.80~8.11   |
| 3  | 总铜（毫克/升）   | ≤1.0   | 0.065~0.385 |
| 4  | 总镍（毫克/升）   | ≤1.0   | 0.058~0.325 |
| 5  | 耗氧量（毫克/升）  | ≤80    | 16~61       |
| 6  | 总氰化物（毫克/升） | ≤0.3   | 0.000~0.003 |
| 7  | 悬浮物（毫克/升）  | ≤100   | 4~7         |

数据来源：深圳市环境监测中心站监测报告

**② 废气的处理**

公司在生产车间内安装通风集气设备，加大废气的收集力度，将气体经活性炭吸附处理后由高排气筒引向高空排放；同时，加强厂区的绿化建设，厂区种植的大量植物对生产中产生的废气也起到一定的吸附作用。经上述措施处理后，生产过程中排放的工艺废气可达到《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中工艺废气大气污染物排放限值第二时段无组织排放监控浓度限值要求。

**③ 固体废物的处理**

公司产品生产中会产生一定的固体废弃物，固体废弃物主要包括废水处理中产生的污泥、裁板产生的边角废料、废包装材料、钻孔粉尘、生活垃圾等。公司对这些固体废弃物均采取定点堆放，同时全部可以回收利用，不会对周边环境产生不良影响。

### （3）报告期内公司的环保投入情况

公司非常重视环保投入，报告期内不断加大环保设施建设，具体如下：

单位：万元

| 项目  | 2010 年度  | 2009 年度 | 2008 年度 |
|-----|----------|---------|---------|
| 设备费 | 1,979.91 | —       | —       |
| 工程费 | 2,219.74 | —       | —       |
| 排污费 | 53.34    | 52.92   | 45.71   |
| 绿化费 | 4.57     | 3.56    | 4.50    |
| 环评费 | 6.42     | 5.86    | 4.78    |
| 人工费 | 59.45    | 47.91   | 48.27   |
| 合 计 | 4,323.43 | 110.25  | 103.26  |

### （4）报告期内公司环保达标情况

根据深圳市人居环境委员会出具的深人环法证字[2010]第 187 号、深人环法证字[2011]第 027 号证明，公司自 2008 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日未发生重大环境污染事故和重大环境违法行为。

根据东莞市松山湖科技产业园区环境保护局出具的证明，公司子公司广东丹邦自 2009 年 8 月成立至 2010 年 12 月 31 日未受到与环境保护有关的处罚。

## 五、与主要业务相关的固定资产和无形资产

### （一）主要固定资产

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司固定资产情况如下：

单位：万元

| 项目     | 原值        | 累计折旧     | 净值        | 成新率    |
|--------|-----------|----------|-----------|--------|
| 房屋及建筑物 | 14,050.01 | 1,444.64 | 12,605.37 | 89.72% |
| 机械设备   | 28,243.81 | 7,087.69 | 21,156.12 | 74.91% |
| 检测设备   | 618.95    | 352.59   | 266.36    | 43.03% |
| 运输工具   | 51.36     | 35.68    | 15.68     | 30.53% |
| 办公电子设备 | 252.12    | 203.26   | 48.86     | 19.38% |
| 其他设备   | 104.76    | 86.86    | 17.89     | 17.08% |
| 合 计    | 43,321.01 | 9,210.72 | 34,110.28 | 78.74% |

注：成新率 = 扣除折旧后账面净值 / 固定资产账面原值 \* 100%

## 1、发行人拥有的房屋及建筑物

| 序号 | 房地产证号            | 房地产名称             | 坐落地               | 建筑面积<br>(平方米) | 用途 | 终止日期       |
|----|------------------|-------------------|-------------------|---------------|----|------------|
| 1  | 深房地字第4000332352号 | 丹邦科技大楼1栋、2栋、3栋、4栋 | 深圳市南山区朗山一路东、朗山二路北 | 22,697.00     | 工业 | 2042-11-27 |
| 2  | 深房地字第4000421138号 | 松坪山高新宿舍32栋整栋      | 深圳市南山区朗山路北侧       | 5,271.14      | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 3  | 深房地字第4000421141号 | 松坪山高新宿舍33栋整栋      | 深圳市南山区朗山路北侧       | 5,271.14      | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 4  | 深房地字第4000445692号 | 松坪山高新住宅18栋101     | 深圳市南山区松坪山         | 95.30         | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 5  | 深房地字第4000445585号 | 松坪山高新住宅18栋102     | 深圳市南山区松坪山         | 74.48         | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 6  | 深房地字第4000445444号 | 松坪山高新住宅18栋103     | 深圳市南山区松坪山         | 96.11         | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 7  | 深房地字第4000445348号 | 松坪山高新住宅18栋104     | 深圳市南山区松坪山         | 96.11         | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 8  | 深房地字第4000445529号 | 松坪山高新住宅18栋105     | 深圳市南山区松坪山         | 96.52         | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 9  | 深房地字第4000445408号 | 松坪山高新住宅18栋106     | 深圳市南山区松坪山         | 96.52         | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 10 | 深房地字第4000445048号 | 松坪山高新住宅18栋201     | 深圳市南山区松坪山         | 95.30         | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 11 | 深房地字第4000445586号 | 松坪山高新住宅18栋202     | 深圳市南山区松坪山         | 74.48         | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 12 | 深房地字第4000445515号 | 松坪山高新住宅18栋203     | 深圳市南山区松坪山         | 96.11         | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 13 | 深房地字第4000445730号 | 松坪山高新住宅18栋204     | 深圳市南山区松坪山         | 96.11         | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 14 | 深房地字第4000445433号 | 松坪山高新住宅18栋205     | 深圳市南山区松坪山         | 96.52         | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 15 | 深房地字第4000445328号 | 松坪山高新住宅18栋206     | 深圳市南山区松坪山         | 96.52         | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 16 | 深房地字第4000445736号 | 松坪山高新住宅18栋301     | 深圳市南山区松坪山         | 95.3          | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 17 | 深房地字第4000445725号 | 松坪山高新住宅18栋302     | 深圳市南山区松坪山         | 74.48         | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 18 | 深房地字第4000445482号 | 松坪山高新住宅18栋303     | 深圳市南山区松坪山         | 96.11         | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 19 | 深房地字第4000445462号 | 松坪山高新住宅18栋304     | 深圳市南山区松坪山         | 96.11         | 宿舍 | 2071-12-27 |

|    |                      |                   |           |       |    |            |
|----|----------------------|-------------------|-----------|-------|----|------------|
| 20 | 深房地字第<br>4000445460号 | 松坪山高新住宅18<br>栋305 | 深圳市南山区松坪山 | 96.52 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 21 | 深房地字第<br>4000445511号 | 松坪山高新住宅18<br>栋306 | 深圳市南山区松坪山 | 96.52 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 22 | 深房地字第<br>4000445341号 | 松坪山高新住宅18<br>栋401 | 深圳市南山区松坪山 | 95.30 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 23 | 深房地字第<br>4000445336号 | 松坪山高新住宅18<br>栋402 | 深圳市南山区松坪山 | 74.48 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 24 | 深房地字第<br>4000445407号 | 松坪山高新住宅18<br>栋403 | 深圳市南山区松坪山 | 96.11 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 25 | 深房地字第<br>4000445406号 | 松坪山高新住宅18<br>栋404 | 深圳市南山区松坪山 | 96.11 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 26 | 深房地字第<br>4000445329号 | 松坪山高新住宅18<br>栋405 | 深圳市南山区松坪山 | 96.52 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 27 | 深房地字第<br>4000445077号 | 松坪山高新住宅18<br>栋406 | 深圳市南山区松坪山 | 96.52 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 28 | 深房地字第<br>4000445593号 | 松坪山高新住宅18<br>栋501 | 深圳市南山区松坪山 | 95.30 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 29 | 深房地字第<br>4000445691号 | 松坪山高新住宅18<br>栋502 | 深圳市南山区松坪山 | 74.48 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 30 | 深房地字第<br>4000445584号 | 松坪山高新住宅18<br>栋503 | 深圳市南山区松坪山 | 96.11 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 31 | 深房地字第<br>4000445689号 | 松坪山高新住宅18<br>栋504 | 深圳市南山区松坪山 | 96.11 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 32 | 深房地字第<br>4000445350号 | 松坪山高新住宅18<br>栋505 | 深圳市南山区松坪山 | 96.52 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 33 | 深房地字第<br>4000445038号 | 松坪山高新住宅18<br>栋506 | 深圳市南山区松坪山 | 96.52 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 34 | 深房地字第<br>4000445249号 | 松坪山高新住宅18<br>栋601 | 深圳市南山区松坪山 | 95.30 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 35 | 深房地字第<br>4000445072号 | 松坪山高新住宅18<br>栋602 | 深圳市南山区松坪山 | 74.48 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 36 | 深房地字第<br>4000445052号 | 松坪山高新住宅18<br>栋603 | 深圳市南山区松坪山 | 96.11 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 37 | 深房地字第<br>4000445087号 | 松坪山高新住宅18<br>栋604 | 深圳市南山区松坪山 | 96.11 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 38 | 深房地字第<br>4000445326号 | 松坪山高新住宅18<br>栋605 | 深圳市南山区松坪山 | 96.52 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 39 | 深房地字第<br>4000445312号 | 松坪山高新住宅18<br>栋606 | 深圳市南山区松坪山 | 96.52 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 40 | 深房地字第<br>4000445734号 | 松坪山高新住宅18<br>栋701 | 深圳市南山区松坪山 | 95.30 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 41 | 深房地字第<br>4000445687号 | 松坪山高新住宅18<br>栋702 | 深圳市南山区松坪山 | 74.48 | 宿舍 | 2071-12-27 |

|    |                      |                   |           |       |    |            |
|----|----------------------|-------------------|-----------|-------|----|------------|
| 42 | 深房地字第<br>4000445405号 | 松坪山高新住宅18<br>栋703 | 深圳市南山区松坪山 | 96.11 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 43 | 深房地字第<br>4000445409号 | 松坪山高新住宅18<br>栋704 | 深圳市南山区松坪山 | 96.11 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 44 | 深房地字第<br>4000445404号 | 松坪山高新住宅18<br>栋705 | 深圳市南山区松坪山 | 96.52 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 45 | 深房地字第<br>4000445346号 | 松坪山高新住宅18<br>栋706 | 深圳市南山区松坪山 | 96.52 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 46 | 深房地字第<br>4000445484号 | 松坪山高新住宅21<br>栋101 | 深圳市南山区松坪山 | 81.11 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 47 | 深房地字第<br>4000445449号 | 松坪山高新住宅21<br>栋102 | 深圳市南山区松坪山 | 95.53 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 48 | 深房地字第<br>4000445749号 | 松坪山高新住宅21<br>栋103 | 深圳市南山区松坪山 | 95.53 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 49 | 深房地字第<br>4000445438号 | 松坪山高新住宅21<br>栋104 | 深圳市南山区松坪山 | 81.11 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 50 | 深房地字第<br>4000445332号 | 松坪山高新住宅21<br>栋201 | 深圳市南山区松坪山 | 81.11 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 51 | 深房地字第<br>4000445347号 | 松坪山高新住宅21<br>栋202 | 深圳市南山区松坪山 | 95.53 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 52 | 深房地字第<br>4000445089号 | 松坪山高新住宅21<br>栋203 | 深圳市南山区松坪山 | 95.53 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 53 | 深房地字第<br>4000445485号 | 松坪山高新住宅21<br>栋204 | 深圳市南山区松坪山 | 81.11 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 54 | 深房地字第<br>4000445583号 | 松坪山高新住宅21<br>栋301 | 深圳市南山区松坪山 | 81.11 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 55 | 深房地字第<br>4000445458号 | 松坪山高新住宅21<br>栋302 | 深圳市南山区松坪山 | 95.53 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 56 | 深房地字第<br>4000445431号 | 松坪山高新住宅21<br>栋303 | 深圳市南山区松坪山 | 95.53 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 57 | 深房地字第<br>4000445034号 | 松坪山高新住宅21<br>栋304 | 深圳市南山区松坪山 | 81.11 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 58 | 深房地字第<br>4000445074号 | 松坪山高新住宅21<br>栋401 | 深圳市南山区松坪山 | 81.11 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 59 | 深房地字第<br>4000445480号 | 松坪山高新住宅21<br>栋402 | 深圳市南山区松坪山 | 95.53 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 60 | 深房地字第<br>4000446583号 | 松坪山高新住宅21<br>栋403 | 深圳市南山区松坪山 | 95.53 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 61 | 深房地字第<br>4000445478号 | 松坪山高新住宅21<br>栋404 | 深圳市南山区松坪山 | 81.11 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 62 | 深房地字第<br>4000445247号 | 松坪山高新住宅21<br>栋501 | 深圳市南山区松坪山 | 81.11 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 63 | 深房地字第<br>4000445246号 | 松坪山高新住宅21<br>栋502 | 深圳市南山区松坪山 | 95.53 | 宿舍 | 2071-12-27 |

|    |                      |                     |           |       |    |            |
|----|----------------------|---------------------|-----------|-------|----|------------|
| 54 | 深房地字第<br>4000445293号 | 松坪山高新住宅 21<br>栋 503 | 深圳市南山区松坪山 | 95.53 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 65 | 深房地字第<br>4000445630号 | 松坪山高新住宅 21<br>栋 504 | 深圳市南山区松坪山 | 81.11 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 66 | 深房地字第<br>4000445035号 | 松坪山高新住宅 21<br>栋 601 | 深圳市南山区松坪山 | 81.11 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 67 | 深房地字第<br>4000445248号 | 松坪山高新住宅 21<br>栋 602 | 深圳市南山区松坪山 | 95.53 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 68 | 深房地字第<br>4000445306号 | 松坪山高新住宅 21<br>栋 603 | 深圳市南山区松坪山 | 95.53 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 69 | 深房地字第<br>4000445442号 | 松坪山高新住宅 21<br>栋 604 | 深圳市南山区松坪山 | 81.11 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 70 | 深房地字第<br>4000445477号 | 松坪山高新住宅 21<br>栋 701 | 深圳市南山区松坪山 | 81.11 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 71 | 深房地字第<br>4000445330号 | 松坪山高新住宅 21<br>栋 702 | 深圳市南山区松坪山 | 95.53 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 72 | 深房地字第<br>4000445440号 | 松坪山高新住宅 21<br>栋 703 | 深圳市南山区松坪山 | 95.53 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 73 | 深房地字第<br>4000445313号 | 松坪山高新住宅 21<br>栋 704 | 深圳市南山区松坪山 | 81.11 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 74 | 深房地字第<br>4000445331号 | 松坪山高新住宅 22<br>栋 101 | 深圳市南山区松坪山 | 81.11 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 75 | 深房地字第<br>4000445447号 | 松坪山高新住宅 22<br>栋 102 | 深圳市南山区松坪山 | 95.53 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 76 | 深房地字第<br>4000445349号 | 松坪山高新住宅 22<br>栋 103 | 深圳市南山区松坪山 | 95.53 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 77 | 深房地字第<br>4000445327号 | 松坪山高新住宅 22<br>栋 104 | 深圳市南山区松坪山 | 81.11 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 78 | 深房地字第<br>4000445307号 | 松坪山高新住宅 22<br>栋 201 | 深圳市南山区松坪山 | 81.11 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 79 | 深房地字第<br>4000445417号 | 松坪山高新住宅 22<br>栋 202 | 深圳市南山区松坪山 | 95.53 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 80 | 深房地字第<br>4000445429号 | 松坪山高新住宅 22<br>栋 203 | 深圳市南山区松坪山 | 95.53 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 81 | 深房地字第<br>4000445629号 | 松坪山高新住宅 22<br>栋 204 | 深圳市南山区松坪山 | 81.11 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 82 | 深房地字第<br>4000445686号 | 松坪山高新住宅 22<br>栋 301 | 深圳市南山区松坪山 | 81.11 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 83 | 深房地字第<br>4000445091号 | 松坪山高新住宅 22<br>栋 302 | 深圳市南山区松坪山 | 95.53 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 84 | 深房地字第<br>4000445418号 | 松坪山高新住宅 22<br>栋 303 | 深圳市南山区松坪山 | 95.53 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 85 | 深房地字第<br>4000445732号 | 松坪山高新住宅 22<br>栋 304 | 深圳市南山区松坪山 | 81.11 | 宿舍 | 2071-12-27 |

|     |                  |               |           |       |    |            |
|-----|------------------|---------------|-----------|-------|----|------------|
| 86  | 深房地字第4000445685号 | 松坪山高新住宅22栋401 | 深圳市南山区松坪山 | 81.11 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 87  | 深房地字第4000445631号 | 松坪山高新住宅22栋402 | 深圳市南山区松坪山 | 95.53 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 88  | 深房地字第4000445308号 | 松坪山高新住宅22栋403 | 深圳市南山区松坪山 | 95.53 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 89  | 深房地字第4000445420号 | 松坪山高新住宅22栋404 | 深圳市南山区松坪山 | 81.11 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 90  | 深房地字第4000445421号 | 松坪山高新住宅22栋501 | 深圳市南山区松坪山 | 81.11 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 91  | 深房地字第4000445051号 | 松坪山高新住宅22栋502 | 深圳市南山区松坪山 | 95.53 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 92  | 深房地字第4000445319号 | 松坪山高新住宅22栋503 | 深圳市南山区松坪山 | 95.53 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 93  | 深房地字第4000445033号 | 松坪山高新住宅22栋504 | 深圳市南山区松坪山 | 81.11 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 94  | 深房地字第4000445080号 | 松坪山高新住宅22栋601 | 深圳市南山区松坪山 | 81.11 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 95  | 深房地字第4000445317号 | 松坪山高新住宅22栋602 | 深圳市南山区松坪山 | 95.53 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 96  | 深房地字第4000445468号 | 松坪山高新住宅22栋603 | 深圳市南山区松坪山 | 95.53 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 97  | 深房地字第4000445053号 | 松坪山高新住宅22栋604 | 深圳市南山区松坪山 | 81.11 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 98  | 深房地字第4000445079号 | 松坪山高新住宅22栋701 | 深圳市南山区松坪山 | 81.11 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 99  | 深房地字第4000445727号 | 松坪山高新住宅22栋702 | 深圳市南山区松坪山 | 95.53 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 100 | 深房地字第4000445530号 | 松坪山高新住宅22栋703 | 深圳市南山区松坪山 | 95.53 | 宿舍 | 2071-12-27 |
| 101 | 深房地字第4000445467号 | 松坪山高新住宅22栋704 | 深圳市南山区松坪山 | 81.11 | 宿舍 | 2071-12-27 |

注：公司上述房屋及建筑物均已用于为公司的银行借款提供抵押担保。

## 2、发行人拥有的主要设备

| 序号 | 主要设备             | 类别   | 数量<br>(台、套) | 账面价值<br>(万元) | 成新率    |
|----|------------------|------|-------------|--------------|--------|
| 1  | LCP 净化涂布机装置      | 机器设备 | 1           | 3,380.59     | 88.03% |
| 2  | 微电子涂布机           | 机器设备 | 1           | 2,320.00     | 80.50% |
| 3  | 特殊雾围 R-R 热处理工程装置 | 机器设备 | 1           | 1,797.35     | 82.02% |
| 4  | 电磁加热覆合机          | 机器设备 | 1           | 1,424.89     | 81.25% |
| 5  | 卷到片蚀刻线           | 机器设备 | 1           | 772.51       | 91.00% |
| 6  | 印刷基板镀金装置         | 机器设备 | 1           | 770.64       | 78.99% |
| 7  | 卷到片去膜线           | 机器设备 | 1           | 724.13       | 91.00% |



|    |              |      |    |           |        |
|----|--------------|------|----|-----------|--------|
| 8  | 影像线          | 机器设备 | 1  | 723.59    | 78.99% |
| 9  | 基板镀金线        | 机器设备 | 1  | 591.43    | 91.00% |
| 10 | 蚀刻去膜线        | 机器设备 | 1  | 578.04    | 78.99% |
| 11 | 化学净面线        | 机器设备 | 2  | 403.53    | 78.99% |
| 12 | 露光机          | 机器设备 | 2  | 401.35    | 78.99% |
| 13 | GD 分切机       | 机器设备 | 1  | 294.72    | 81.24% |
| 14 | 卷到卷化学净面线     | 机器设备 | 1  | 272.73    | 78.99% |
| 15 | 标本测试仪        | 机器设备 | 1  | 264.80    | 79.00% |
| 16 | 卷到片、片到片干膜现像线 | 机器设备 | 1  | 259.85    | 78.99% |
| 17 | 油墨 PSR 显影线   | 机器设备 | 1  | 259.38    | 78.99% |
| 18 | 曝光机 6        | 机器设备 | 1  | 236.52    | 79.00% |
| 19 | 电镀（沉）镍金线     | 机器设备 | 1  | 235.89    | 79.30% |
| 20 | 显影线          | 机器设备 | 1  | 235.81    | 91.00% |
| 21 | 自动光学检测机      | 检测设备 | 1  | 207.86    | 85.76% |
| 22 | 高精度钻孔机       | 机器设备 | 1  | 197.17    | 81.25% |
| 23 | 全自动超声波清洗机    | 机器设备 | 1  | 178.20    | 50.72% |
| 24 | 卷出卷取搬送装置     | 机器设备 | 1  | 173.36    | 79.19% |
| 25 | 钻孔机          | 机器设备 | 1  | 162.71    | 51.25% |
| 26 | R-R 贴膜机      | 机器设备 | 1  | 158.30    | 78.99% |
| 27 | S-R 贴膜机      | 机器设备 | 1  | 145.75    | 78.99% |
| 28 | 日立六轴高精密钻孔机   | 机器设备 | 1  | 140.90    | 51.25% |
| 29 | 涂布机          | 机器设备 | 1  | 132.35    | 51.33% |
| 30 | 基板压合机        | 机器设备 | 1  | 118.48    | 91.00% |
| 31 | RO+EDI 纯水系统  | 机器设备 | 1  | 112.97    | 51.25% |
| 32 | 镀金后化学清洗线     | 机器设备 | 1  | 105.82    | 78.99% |
|    | 合计           |      | 34 | 17,781.62 | -      |

## （二）主要无形资产

截至本招股说明书签署日，公司拥有的无形资产情况如下：

### 1、土地使用权

| 序号 | 坐落地               | 宗地号               | 宗地面积<br>(平方米) | 土地<br>用途 | 终止日期       | 权利人/<br>抵押情况 |
|----|-------------------|-------------------|---------------|----------|------------|--------------|
| 1  | 深圳市南山区朗山一路东、朗山二路北 | T401-0019         | 9,999.40      | 工业       | 2042-11-27 | 丹邦科技/<br>被抵押 |
| 2  | 深圳市南山区朗山路北侧       | T404-0012         | 23,977.20     | 宿舍       | 2071-12-27 | 丹邦科技/<br>被抵押 |
| 3  | 深圳市南山区松坪山         | T404-0014         | 35,836.15     | 宿舍       | 2071-12-27 | 丹邦科技/<br>被抵押 |
| 4  | 东莞市松山湖北部工业城       | 1935030100<br>045 | 56,964.00     | 工业       | 2059-3-27  | 广东丹邦/<br>未抵押 |

上述地块已经建设工业厂房及配套房产，或用作公司员工宿舍。房产证取得情况参见本节“五、（一）1、发行人拥有的房屋及建筑物”。

## 2、商标

| 序号 | 商标名称或图案                                                                             | 证书编号      | 类别    | 有效期限                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------|
| 1  |    | 第 1177472 | 第 9 类 | 自2008-05-21 至<br>2018-05-20 |
| 2  |    | 第 5397307 | 第 9 类 | 自2009-05-28 至<br>2019-05-27 |
| 3  |    | 第 5397308 | 第 9 类 | 自2009-05-28 至<br>2019-05-27 |
| 4  |    | 第 5397309 | 第 9 类 | 自2009-05-28 至<br>2019-05-27 |
| 5  |   | 第 5397310 | 第 9 类 | 自2009-05-28 至<br>2019-05-27 |
| 6  |  | 第 5397311 | 第 9 类 | 自2009-05-28 至<br>2019-05-27 |
| 7  |  | 第 5397312 | 第 9 类 | 自2009-05-28 至<br>2019-05-27 |
| 8  |  | 第 5397313 | 第 9 类 | 自2009-05-28 至<br>2019-05-27 |
| 9  |  | 第 5397314 | 第 9 类 | 自2009-05-28 至<br>2019-05-27 |
| 10 |  | 第 5397315 | 第 9 类 | 自2009-05-28 至<br>2019-05-27 |
| 11 |  | 第 5397316 | 第 9 类 | 自2009-05-28 至<br>2019-05-27 |
| 12 |  | 第 5397357 | 第 9 类 | 自2009-07-07至<br>2019-07-06  |

## 3、专利技术

| 序号 | 专利名称          | 专利类别 | 专利号              | 授权公告日      | 专利申请日      | 抵押情况 |
|----|---------------|------|------------------|------------|------------|------|
| 1  | 一种潜伏性固化剂的制造方法 | 发明专利 | ZL200310110798.7 | 2005-11-23 | 2003-10-22 | 被质押  |
| 2  | 一种无硅阻燃型快      | 发明   | ZL2003101107     | 2006-01-18 | 2003-10-22 | 被质押  |

|   |                          |      |                      |            |            |     |
|---|--------------------------|------|----------------------|------------|------------|-----|
|   | 速固化柔性电路覆盖膜及其制备方法         | 专利   | 97.2                 |            |            |     |
| 3 | 用于挠性电路装配的热固化胶膜及其制备方法     | 发明专利 | ZL2003101118<br>42.6 | 2006-03-08 | 2003-10-17 | 被质押 |
| 4 | 直接涂布粘附的超薄型聚酰亚胺卷状基材及其制备方法 | 发明专利 | ZL2003101118<br>49.8 | 2006-06-07 | 2003-10-17 | 被质押 |
| 5 | UV 固化可剥离压敏胶膜             | 发明专利 | ZL2004100220<br>29.6 | 2006-06-21 | 2004-03-11 | 被质押 |
| 6 | 一种无胍刻蚀液                  | 发明专利 | ZL2003101117<br>58.4 | 2006-09-06 | 2003-10-09 | 被质押 |
| 7 | 用于芯片搭载及封装的电绝缘树脂浆         | 发明专利 | ZL2003101118<br>43.0 | 2008-10-01 | 2003-10-17 | -   |
| 8 | 柔性电路基材胶粘剂、制备方法及制得的基材     | 发明专利 | ZL2006100345<br>93.9 | 2008-10-22 | 2006-03-20 | -   |
| 9 | 一种柔性印制电路覆盖膜及其制备方法        | 发明专利 | ZL2006100345<br>94.3 | 2009-08-26 | 2006-03-20 | -   |

#### 4、非专利技术

除上述专利和非专利技术外，公司不持有水面养殖权、探矿权、采矿权等其他无形资产。

#### （三）特许经营权情况

本公司无特许经营权。

### 六、发行人的技术水平与研发情况

#### （一）主要产品生产技术所处的阶段

本公司主要产品为FPC、COF柔性封装基板及COF产品，这些产品的生产技术成熟，均处于大批量生产阶段。

#### （二）主要的核心技术

##### 1、公司现有的核心技术情况

| 序号 | 主要核心技术         | 技术阶段  | 技术水平 |
|----|----------------|-------|------|
| 1  | 二层无胶基材原料纯化处理技术 | 大批量生产 | 国际先进 |

|    |                         |       |      |
|----|-------------------------|-------|------|
| 2  | 聚酰亚胺材料结构改良技术            | 大批量生产 | 国际先进 |
| 3  | 多层精密涂布技术                | 大批量生产 | 国际先进 |
| 4  | UV 固化可剥离压敏胶膜技术          | 大批量生产 | 国际先进 |
| 5  | 微孔电镀及导通技术               | 大批量生产 | 国际先进 |
| 6  | 超微细化线路铜箔减薄加工技术          | 大批量生产 | 国际先进 |
| 7  | 超微细化线路铜箔表面处理技术          | 大批量生产 | 国际先进 |
| 8  | 超微细化线路图形转移技术            | 大批量生产 | 国际先进 |
| 9  | 焊盘金手指制作技术               | 大批量生产 | 国际先进 |
| 10 | 超薄高密度封装基板表面涂覆工艺         | 大批量生产 | 国际先进 |
| 11 | 超薄高密度封装基板可靠性检测与分析       | 大批量生产 | 国际先进 |
| 12 | COF 封装技术                | 大批量生产 | 国际先进 |
| 13 | 微粘膜制造技术                 | 大批量生产 | 国际先进 |
| 14 | 封装基板卷状曝光和显影蚀刻技术         | 大批量生产 | 国际先进 |
| 15 | COF 柔性封装基板卷状/片状生产工艺     | 大批量生产 | 国际先进 |
| 16 | 封装基板高密度布线技术             | 大批量生产 | 国际先进 |
| 17 | 合成含有醚键、羰基及酰胺结构的聚酰亚胺制造技术 | 大批量生产 | 国际先进 |
| 18 | 超薄型铜箔制造技术               | 小批量生产 | 国内领先 |
| 19 | 低应力化学镀镍技术               | 小批量生产 | 国内领先 |
| 20 | 三维多层内连高频高密度柔性线路         | 小批量生产 | 国内领先 |

## 2、主要的研发项目及所处的阶段

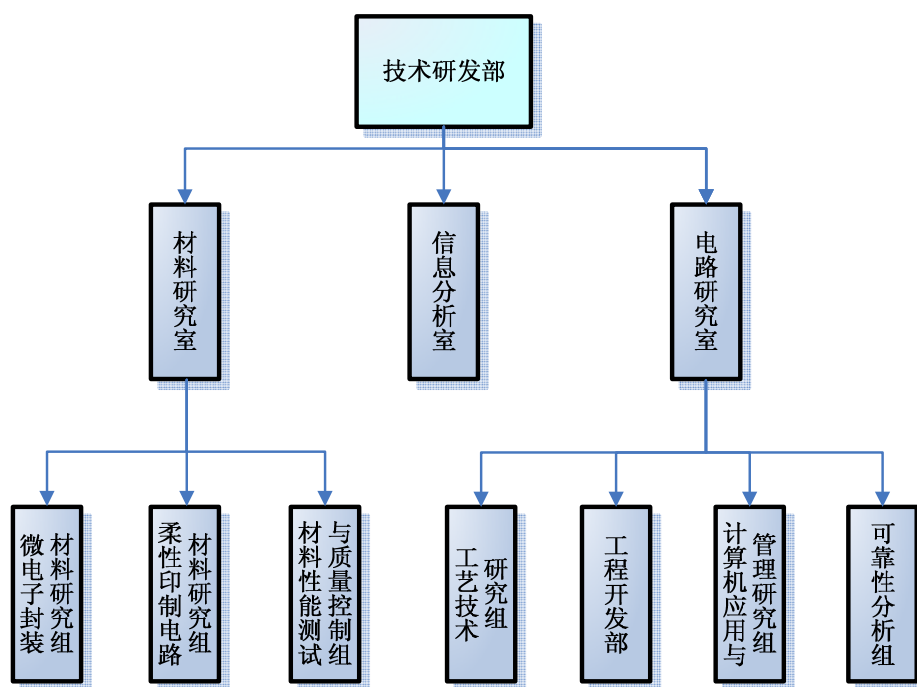
目前，公司正在从事的技术开发项目是根据行业技术的发展方向进行的前瞻性技术研究工作，为公司的长远发展提供技术储备，具体如下：

| 序号 | 项目名称                    | 研发阶段 | 拟达到的目标                                                                |
|----|-------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1  | 二层无胶基材基膜厚度减薄与表面电阻增强技术研究 | 基础研究 | 基膜厚度 $\leq 9\mu\text{m}$ ；<br>基膜表面电阻 $\geq 1.3 \times 10^{14} \Omega$ |
| 2  | 超微细化线路高密度布线提升技术         | 基础研究 | 线宽线距 $10\mu\text{m}$                                                  |
| 3  | 柔性材料上埋入器件研究             | 基础研究 | 在柔性基板上内置有源及无源器件                                                       |
| 4  | 多层柔性封装基板研发技术            | 基础研究 | 基板层数：4-6 层；<br>叠层数：2-3 层；<br>封装体厚度： $\leq 1.2\text{mm}$               |

## （三）研发机构及研发人员

### 1、研发机构

公司研发部门下设 3 个研究室，七个研究组，具体情况如下图：



## 2、研发人员

截至2010年末，公司有技术人员108人，组成了专业功底深厚、经验丰富、专业互补、新老组合的研发团队。大部分研发人员毕业于国内专业院校材料学专业、计算机专业、电子工程专业以及物理专业等。公司研发部门的骨干工程师从业时间多在5年以上，具有较丰富的技术开发经验和研究能力。

## 3、研发费用

报告期内，公司研发费用及研发费用占主营业务收入的比例情况见下表：

单位：万元

| 项目             | 2010 年度   | 2009 年度   | 2008 年度   |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 研发费用           | 2,005.46  | 1,633.32  | 1,241.47  |
| 主营业务收入         | 20,368.09 | 18,254.82 | 17,139.84 |
| 研发费用占主营业务收入的比例 | 9.85%     | 8.95%     | 7.24%     |

## （四）技术创新

公司非常注重产品开发和科技创新机制的建设，实施多种措施推动与激励员工锐意进取、不断突破精神，建立了一个完善的技术创新体系与创新环境。首先，公司建立了明确的研究方向并制定研发计划，重视研发活动的课题来源、人员组织、过程进展、成果评价、产研结合等，使公司的技术人员在研发过程中目标明

确、决策清晰，保障了公司技术创新的连续性、完整性、系统性。其次，公司实施了明确的激励制度，给予作出重大品质突破及重大产品开发贡献的人员以奖励，同时保证激励制度的持续性，以充分发挥科研人员的潜力，激发其技术创新的热情。第三，公司注重将科研成果与生产迅速结合，注重从客户需求出发进行技术储备和创新安排，技术创新已成为公司市场开发系统的有机组成部分，并发挥着越来越重要的作用。

## 七、发行人进行境外生产经营情况

截至本招股说明书签署日，发行人在中国香港拥有一家全资子公司丹邦香港，丹邦香港成立于 2007 年 10 月 26 日，法定股本为 1,400 万港元，注册地址为香港九龙红磡马头围道 39 号红磡商业中心 A 座 508 室，经营范围为柔性相覆合铜板、高频柔性电路、异方向导电膜、高精密集成电路、新型电子元器件的销售及其原材料的采购。

丹邦香港主要配合本公司办理境外银行结算手续、代收部分境外客户货款、代付部分境外供应商采购款、协助进出口报关等。

## 八、发行人的质量管理

### （一）质量控制标准

在质量控制方面，本公司依次采取以下标准：客户提出的标准、IPC标准和 IEC 标准。（IPC 标准是美国电子电路和电子互连行业协会制定的质量标准，IEC 标准是国际电工委员会制定的质量标准）

由于本公司的主要生产经营模式为按照客户订单生产，因此若客户对产品的质量提出了明确的标准，公司将优先满足客户提出的质量要求。在客户没有提出明确质量标准的情况下，公司将采用 IPC 和 IEC 标准。

截至本招股书签署日，公司拥有的全部与生产经营有关的认证或许可如下：

| 序号 | 认证或许可               | 有效期限                    | 备注                                               |
|----|---------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| 1  | “废水、废气、噪声”<br>排污许可证 | 2010.7.18<br>-2015.7.18 | 废水治理设施处理能力1000 吨/日<br>废气治理设施处理能力7000 标立方米/<br>小时 |

|   |                          |                           |                        |
|---|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| 2 | “国家级高新技术企业”认证            | 2008.12.16<br>-2011.12.16 | 享受相关税收优惠政策             |
| 3 | ISO14001:2004 国际环境管理体系认证 | 2007.9.12<br>-2013.9.11   | 用于组织内部环境管理体系的建立、实施与审核  |
| 4 | ISO9001:2008国际质量管理体系认证   | 2009.4.15<br>-2011.4.15   | 用于组织内部质量管理体系的建立、实施与审核  |
| 5 | ISO/TS16949：2009质量体系认证   | 2010.3.11<br>-2011.4.12   | 全球汽车行业中现用的汽车质量体系要求     |
| 6 | 日本索尼公司“绿色合作伙伴”认证         | 2008.1.1<br>-2011.12.31   | 明确规定电子产品中化学物质管理方面的各项标准 |
| 7 | 日本佳能公司“绿色供应商标准”认证        | 2010.4<br>-2012.4         | 明确规定电子产品中化学物质管理方面的各项标准 |
| 8 | 美国UL认证                   | 每年自动续期                    | 世界权威的产品安全测试和认证         |

## （二）质量控制措施

公司制定了严格的内部控制制度和内部产品稽核制度，并在各项产品的生产中严格执行ISO9001:2000及ISO/TS16949:2002质量体系标准，在环保及职业健康安全方面严格执行ISO14001:2004环境体系标准，公司三大系列产品均顺利通过具有产品安全标志象征的美国UL认证，公司还获得了日本索尼公司“绿色合作伙伴”、日本佳能公司“绿色供应商标准”等认可。

## （三）质量纠纷及处理

由于公司建立了完善的质量控制体系，公司产品与服务均符合各项国际行业技术质量标准，未出现因违反有关产品及服务质量和技术监督方面的法律、法规被处罚的情况，也未出现过重大质量纠纷。根据深圳市市场监督管理局出具的深市监信证[2010]53号、深市监信证[2011]49号证明，公司在2008年1月1日至2010年12月31日的经营活动中，没有违反市场监督管理有关法律法规的记录。

## 九、公司冠名“科技”依据

公司名称为“深圳丹邦科技股份有限公司”的依据如下：

1、2006年10月27日，公司被深圳市科学和信息局认定为深圳市高新技术企业，并获颁《高新技术企业认定证书》，证书编号为：S2006263。

2、2008 年 12 月 16 日，公司被深圳市科学和信息局、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合认定为国家级高新技术企业，并获颁《高新技术企业证书》，证书编号为：GR200844200041，有效期三年。



## **第六节 同业竞争与关联交易**

### **一、同业竞争**

#### **(一) 本公司与控股股东和实际控制人不存在同业竞争**

本公司控股股东丹邦投资集团的经营范围是“投资兴办实业（具体项目另行申报）；功能性高分子材料、微电子聚合物材料、OLED 封装材料、有机发光材料、太阳能电池材料的技术开发与销售（不含专营、专控、专卖商品及限制项目），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）”。丹邦投资集团无实际的生产经营业务，目前主营业务为投资兴办实业，除投资本公司外，还持有第比尔国际、典邦科技及广东东邦的股权，因此丹邦投资集团与本公司不存在同业竞争关系。

本公司的实际控制人为刘萍，除投资丹邦投资集团及其下属企业外，无其他实际控制企业，没有自营或者为他人经营与本公司同类的业务，故刘萍先生与本公司不存在同业竞争。

#### **(二) 本公司与控股股东和实际控制人控制的企业不存在同业竞争**

丹邦投资集团目前除投资本公司外，还持有第比尔国际 99%的股份，并分别直接与间接合计持有典邦科技 99.255%的股权、广东东邦 99.75%的股权。

##### **1、典邦科技与本公司不构成同业竞争**

典邦科技主要从事液晶显示模组的代工业务，即根据客户的委托，由客户提供加工液晶显示模组所需的样品有关技术资料，从客户及客户指定的供应商采购主要原材料，代为加工液晶显示模组产品，并收取一定代工费。

截至 2010 年 12 月 31 日，典邦科技的总资产为 10,089.35 万元，净资产合计 5,454.50 万元，2010 年度营业收入 1,147.93 万元，净利润-112.10 万元（以上数据经深圳德扬会计师事务所审计）。

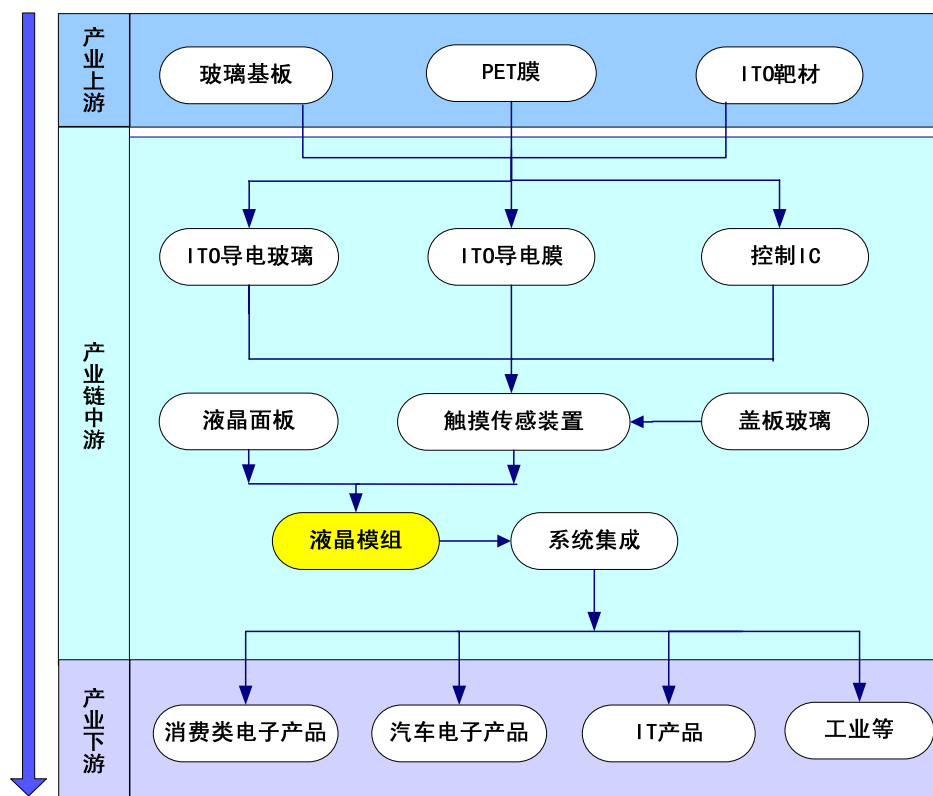
本公司与典邦科技主要产品及主营业务等具体情况比较说明如下：

| 比较项目        | 丹邦科技                                                                                  | 典邦科技                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 主要产品与服务     | FPC、COF 柔性封装基板、COF 产品                                                                 | 从事小尺寸液晶显示模组（LCM）产品的代工业务                                  |
| 所属行业        | 印制电路板                                                                                 | 液晶显示                                                     |
| 产品、服务的功能及用途 | FPC 主要用于电子元器件之间连接及信号传输；COF 柔性封装基板主要用于承载芯片、电路连通、绝缘支撑；COF 产品主要用于电子产品中电子元器件的连接和液晶屏的显示驱动。 | 液晶显示，用于显示图像及信息。                                          |
| 主要下游产品、客户   | 国际尖端电子产品品牌制造商所属的电子元器件制造企业，如夏普、日本电产、日立、松下、佳能及元太科技等集团企业下属的电子元器件制造企业。                    | 涉及小尺寸显示屏的普通电子产品生产厂商                                      |
| 生产方式        | 自主研发生产，关键原材料自给，采取大规模、批量化的生产。                                                          | 代工方式，核心部件及材料由客户提供，根据用户订单、工艺要求及组装建议生产，具有典型的客户定制和代工的个性化特点。 |
| 主要技术、工艺     | 材料合成、表面处理、线路加工及涂布等技术。                                                                 | COG 等封装技术、LVDS 线路设计、TCON 设计、FPGA 测试方法。                   |
| 主要原材料       | 铜箔、PI 膜、保强板、离型膜和粘合剂等。                                                                 | TFT 面板、IC、背光源、ACF 等。                                     |

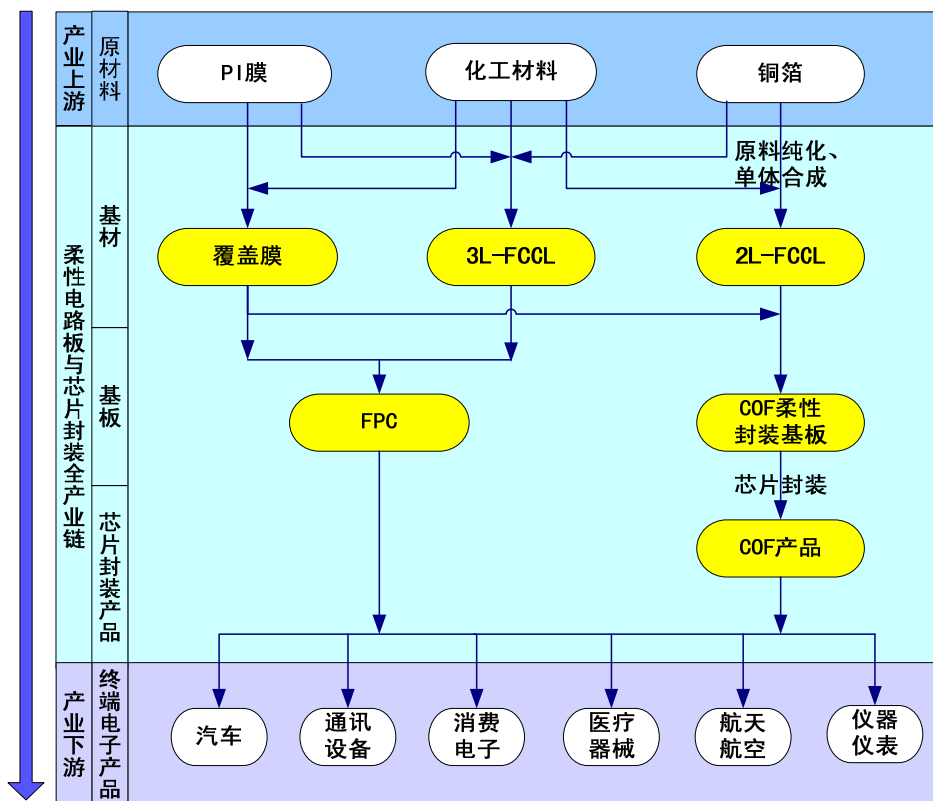
从上表可以看出，典邦科技和本公司的主营业务与产品分属不同领域：

#### （1）产品类别不同，属于不同行业

典邦科技代工的主要产品为小尺寸液晶显示模组（LCM）产品，液晶模组主要是将 TFT 面板和驱动 IC、背光源、连接件等组件组装在一起的模块。在电子产品中主要用于显示图像及信息，从细分行业来看，属于液晶显示行业。典邦科技从事行业的主要产业链关系图如下所示：

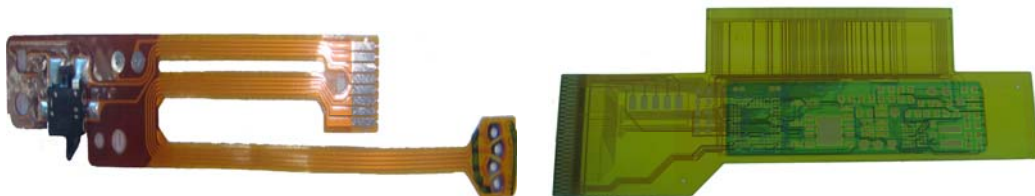


本公司的主要产品为 FPC、COF 柔性封装基板、COF 产品，主要用于电子元器件之间连接、信号传输、承载芯片、电路连通、绝缘支撑等用途，属于电子元器件制造业中的印制电路板。其主要产业链关系图如下所示：



## （2）产品物理构成及特征明显不同

本公司生产的 FPC、COF 柔性封装基板及 COF 产品主要由铜箔、PI 膜、保强板、离型膜、粘合剂及芯片生产加工而成，生产过程中主要涉及材料合成、表面处理、线路加工及涂布等技术，产品为柔性的块状物。产品图示如下：



典邦科技生产的液晶显示模组（LCM）主要由 TFT 面板、IC、背光源等器件组装而成，加工过程中主要涉及 COG 封装、LVDS 线路设计、TCON 设计及 FPGA 测试方法等，产品是由若干器件组合而成的液晶显示部件。产品图示如下：



## （3）功能用途存在本质差异，不具有类似性及相互替代的可能性

本公司生产的 FPC、COF 柔性封装基板及 COF 产品广泛应用于空间狭小、可移动、可折叠的电子信息产品，起电路连通、信号传输、承载芯片、绝缘支撑及显示驱动等作用；典邦科技生产的液晶显示模组则主要用于显示图像及信息。

## （4）在下游应用及客户方面不存在相互竞争关系

因产品功能用途不同，典邦科技与本公司面向的客户完全不同，典邦科技与本公司上下游及客户情况比较如下：

| 公司名称 | 主要上游材料                   | 产品                    | 下游客户                                                                |
|------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 典邦科技 | TFT 面板、偏光片、IC、背光源等液晶显示器件 | 液晶显示模组（LCM）产品         | 涉及小尺寸显示屏的普通电子产品生产厂商：如中低端车载显示器、山寨电子产品生产厂商。                           |
| 丹邦科技 | PI 膜、铜箔、保强板、离型膜、粘合剂及芯片器件 | FPC、COF 柔性封装基板、COF 产品 | 电子产品品牌制造商：世界知名企业所属的电子元器件厂商，如夏普、日本电产、日立、松下、佳能及元太科技等集团企业下属的电子元器件制造企业。 |

综上所述，典邦科技未从事与本公司相同或相似的业务，与本公司不存在同业竞争。

## **2、广东东邦与本公司不构成同业竞争**

广东东邦成立于 2009 年 1 月 13 日，经营范围为 TFT-LCD、PDP、OLED、FED（含 SED 等）平板显示屏、显示屏材料制造（生产经营 TFT-LCD 偏光片、防反射光膜、相位差光学膜等平板显示材料与光学器件）。

广东东邦尚未开展生产与销售活动，成立后主要从事建设实施本次募投项目所需的生产厂房、研发大楼及生活配套设施等活动，广东东邦经营范围主要从事液晶显示器件的生产与销售业务，不会从事与本公司相同或相似的业务，与本公司不存在同业竞争。

## **3、第比尔国际与本公司不构成同业竞争**

第比尔国际曾是本公司境外销售和采购的重要窗口公司，主要职能就是满足部分客户及供应商的要求、充分利用香港商业发达的贸易环境、集中境外客户资源和外资银行资源、办理银行结算手续、代收客户货款、代付供应商采购款、协助报关等。

截至 2009 年 8 月，公司通过第比尔国际的境外销售及采购合同（订单）全部履行完毕，境外采购或销售不再通过第比尔国际进行。此后，第比尔国际仅作为一家境外投资主体而存在，不再从事 FPC、COF 柔性封装基板及 COF 产品的销售活动，因此，第比尔国际目前未从事与本公司相同或相近的业务，与本公司不存在同业竞争。

本公司未直接收购或注销第比尔国际以解决关联交易主要原因是：第比尔国际除了履行公司原来境外销售和采购的职能之外，还分别持有典邦科技 74.5%的股权、广东东邦 25%的股权。

因此，典邦科技、广东东邦及第比尔国际与发行人的经营范围和实际从事的业务均不同，与发行人不存在同业竞争关系。

## **（三）拟投资项目的同业竞争情况**

本次募集资金投资的项目均围绕本公司现有主营业务开展，而本公司控股股

东、实际控制人及其控制的其他企业均不从事与本公司拟投资项目相同或相近的业务。因此，本公司拟投资项目与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在潜在的同业竞争关系。

#### **（四）控股股东和实际控制人作出的避免同业竞争的承诺**

本公司控股股东丹邦投资集团与实际控制人刘萍先生分别签署了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

1、本公司/本人（包括本公司控制的全资、控股企业或其他关联企业，下同）保证在发行人依法存续期间，严格遵守《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规和发行人《公司章程》的相关规定，不以任何形式（包括但不限于直接经营或与他人合资、合作、参股经营）从事与发行人构成竞争的业务；保证将采取合法、有效的措施，促使本公司/本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织及本人的其他关联企业不直接或间接从事与发行人相同或相似的业务；不会直接或间接投资、收购与发行人存在竞争的企业，也不以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助；或在竞争企业或经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2、若因任何原因导致出现本公司/本人与发行人从事相同或类似业务的情形，本公司/本人同意由发行人在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，和/或通过合法途径促使本公司/本人所控制的全资、控股企业或其他关联企业向发行人转让该等资产或控股权，和/或通过其他公平、合理的途径对本公司的业务进行调整以避免与发行人的业务构成同业竞争。

3、如违反本承诺函，本公司/本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给发行人造成的所有直接或间接损失。

4、本公司/本人不利用在发行人的控股股东/主要股东或实际控制人地位，损害发行人及其他中小股东的利益。

5、本承诺函一经签署立即生效，且上述承诺在本公司/本人对发行人拥有由资本或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对发行人存在重大影响的期间内持续有效，且不可变更或撤销。

## 二、关联方与关联关系

### 1、控股股东、实际控制人及其控制的企业

本公司控股股东、实际控制人简要情况如下：

| 序号 | 关联方名称  | 关联关系                                               |
|----|--------|----------------------------------------------------|
| 1  | 丹邦投资集团 | 公司控股股东，持有本公司 60.93%的股份                             |
| 2  | 刘 萍    | 公司实际控制人、董事长、总经理，持有丹邦投资集团 100%的股权，间接持有本公司 60.93%的股份 |

控股股东丹邦投资集团除投资本公司外，还持有典邦科技 25.5%股权，持有广东东邦 75%股权，持有第比尔国际 99%股权。实际控制人刘萍除控制本公司外，还通过丹邦投资集团控制典邦科技、广东东邦及第比尔国际。情况如下：

| 序号 | 关联方名称 | 注册资本/<br>实收资本（万元） | 关联关系                         |
|----|-------|-------------------|------------------------------|
| 1  | 典邦科技  | 10,000/6,000      | 实际控制人控制的企业，刘萍间接持有 99.255%的股份 |
| 2  | 广东东邦  | 8,000/4,000       | 实际控制人控制的企业，刘萍间接持有 99.75%的股份  |
| 3  | 第比尔国际 | 10.20 万港元         | 实际控制人控制的企业，刘萍间接持有 99%的股份     |

### 2、其他持有发行人 5%以上股份的股东

| 序号 | 关联方名称 | 关联关系             |
|----|-------|------------------|
| 1  | 丹依科技  | 公司股东，持股比例 18%    |
| 2  | 益关寿   | 公司股东，持股比例 12.67% |

### 3、发行人的子公司

| 序号 | 关联方名称 | 注册资本      | 关联关系                                |
|----|-------|-----------|-------------------------------------|
| 1  | 广东丹邦  | 5,000 万元  | 发行人全资子公司，直接持股 75%，通过丹邦香港间接持有 25%的股权 |
| 2  | 丹邦香港  | 1,400 万港元 | 发行人全资子公司，持股比例 100%                  |

### 4、公司董事、监事、高级管理人员及其控制的企业

公司董事、监事、高级管理人员及其控制的企业情况参见本招股说明书“第七节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”。

## 5、发行人的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员

根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》，关键管理人员，是指有权力并负责计划、指挥和控制企业活动的人员，包括本公司董事、高级管理人员及核心技术人员；与其关系密切的家庭人员，是指在处理与企业的交易时可能影响该个人或受该个人影响的家庭成员。报告期内，发行人的该类关联方如下：

| 关联方名称 | 在本公司任职                    | 关联关系     |                  |
|-------|---------------------------|----------|------------------|
| 刘 萍   | 董事长、总经理、研发中心主任            | 公司关键管理人员 |                  |
| 王李懿   | 董事、副总经理                   | 公司关键管理人员 |                  |
| 益天鹏   | 董事                        | 公司关键管理人员 |                  |
| 谭 芸   | 无                         | 董事长刘萍的配偶 | 与关键管理人员关系密切的家庭成员 |
| 刘道鳌   | 无                         | 董事长刘萍的兄弟 |                  |
| 刘春爱   | 无                         | 董事长刘萍的姐姐 |                  |
| 刘文魁   | 先端 COF 材料事业部 CCL 材料技术部副部长 | 董事长刘萍的侄子 |                  |
| 益关寿   | 无                         | 董事益天鹏的父亲 |                  |
| 益天翔   | 无                         | 董事益天鹏的兄弟 |                  |

## 6、其他关联方

| 关联方名称 | 注册资本       | 关联关系             |
|-------|------------|------------------|
| 邦达集团  | 400.00 万美元 | 益关寿持股 23.33%并任董事 |

## 三、关联交易

### （一）经常性关联交易

2009 年 8 月之前，公司部分境外销售及境外原材料、设备采购在形式上经由实际控制人刘萍在香港设立的第比尔国际进行，具体情况如下：

#### 1、销售商品

##### （1）报告期内通过第比尔国际进行的境外销售情况

单位：万元

| 项 目            | 2010 年度 | 2009 年度   | 2008 年度   |
|----------------|---------|-----------|-----------|
| 向第比尔国际销售商品的金额  | -       | 404.64    | 5,842.88  |
| 主营业务收入         | -       | 18,254.82 | 17,139.84 |
| 关联交易占主营业务收入的比重 | -       | 2.22%     | 34.09%    |



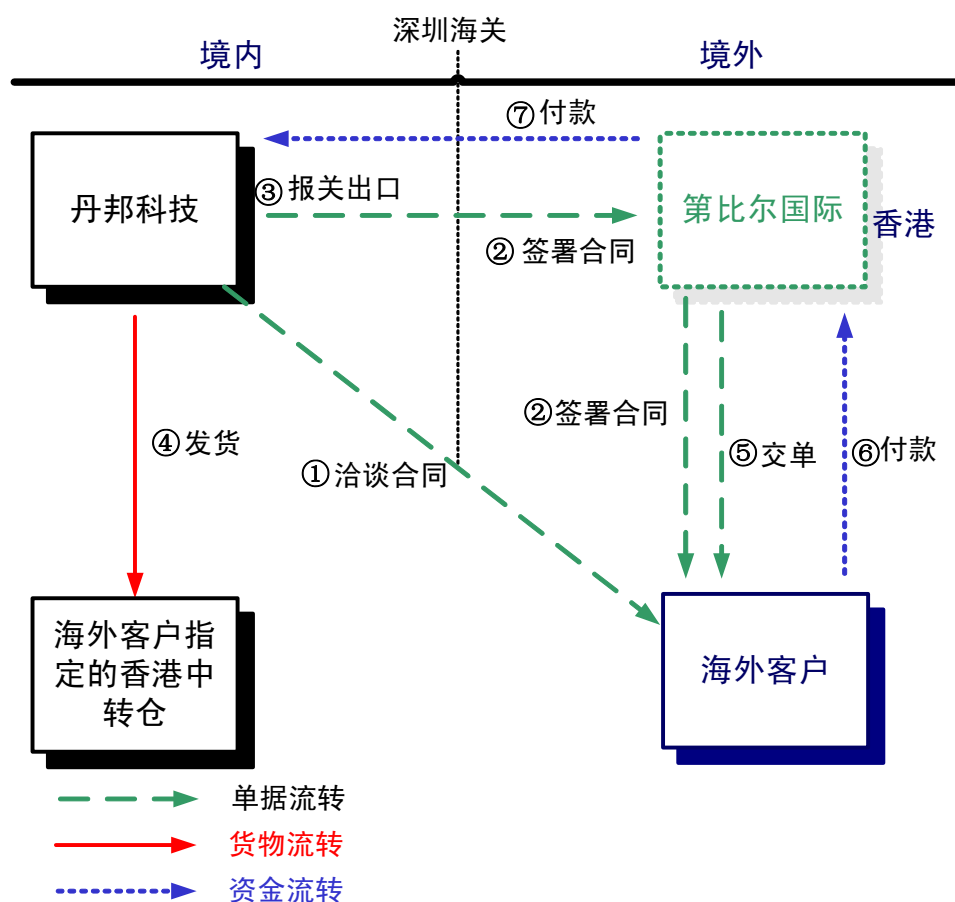
产生上述关联销售的原因是本公司在 2008-2009 年部分境外销售通过第比尔国际进行。自 2008 年 5 月起, 本公司及全资子公司丹邦香港开始承接原来通过第比尔国际进行的境外销售的职能。2009 年, 本公司通过第比尔国际的关联销售金额和占比均大幅度降低, 2010 年已不再发生该类关联交易。

2008 年通过第比尔国际进行的境外销售金额占主营业务收入的比重为 34.09%, 其主要原因是: ①公司境外最终客户主要包括日本、韩国等国家和地区的电子信息产品制造商, 此类企业对供应商要求十分严格, 在选择或更换供应商之前, 需要对供应商进行严格的审查等程序, 耗时较长。丹邦香港承接第比尔国际境外销售职能的前提是需要完成境外客户对其进行的供应商资格审查, 因此, 在完成该等工作之前, 境外销售仍然主要通过第比尔国际进行。②公司产品一般按客户要求订制, 产品从开模、打样、客户认证到下单耗时较长, 因此, 境外客户通过丹邦香港向本公司采购产品, 丹邦香港承接境外销售的职能需要一定的过渡期。

自 2009 年 3 月起, 第比尔国际不再接受境外客户的采购订单, 截至 2009 年 8 月, 通过第比尔国际签订的境外销售订单已全部履行完毕, 境外销售不再通过第比尔国际进行。2009 年度本公司通过第比尔国际的关联销售金额为 404.64 万元, 主要是执行 2009 年 3 月之前签订的订单所致, 同比大幅度下降。

## **(2) 通过第比尔国际进行境外销售的流程**

订单确认或合同签订后, 本公司以第比尔国际名义向境外客户发货并交单→海外客户根据销售合同(或形式发票 Proforma Invoice)规定向第比尔国际在银行开设的专用账户支付款项或付款赎单→第比尔国际将客户回款汇回丹邦科技。具体流程图如下:



公司通过第比尔国际进行海外销售的具体工作流程为：

①洽谈合同：公司直接与境外客户接触与洽谈，约定产品种类、规格型号、技术要求、数量、价格、交货期、结算方式等具体合同内容。

②签订合同：客户和第比尔国际按照公司商定的条款签订销售合同或订单，同时第比尔国际与公司签订具有同样条款的合同或订单。

③报关出口：公司办理电子报关出口，形成电子报关单，并于次月向海关办理集中报关。

④发货：由第比尔国际委托的运输公司从本公司提货，直接将货物发至海外客户指定的香港中转仓，完成货物的交付运输。

⑤交单：丹邦科技根据合同中规定的条款，将货运单据、发票、装箱单等单据以第比尔国际的名义开具给境外客户。

⑥付款：境外客户根据合同约定的支付条件向第比尔国际支付款项，公司主

要采用 T/T 结算方式，一般授予客户 60-90 天的信用账期。

⑦付款：第比尔国际在收到境外客户货款后转付给公司。

每月末，公司向第比尔国际开具出口专用发票，并在收到海关结关单或中国电子口岸结关信息后确认出口销售收入。

从上可以看出，公司独立掌握海外客户资源，直接与海外终端客户洽谈销售条款，具有出口产品的决定权和定价权，不受制于第比尔国际。公司出口销售的货物流转过程为“公司→海外客户在香港的中转仓→终端客户”，公司出口销售的货物不经停第比尔国际。

### （3）关联销售的定价

报告期内，本公司通过第比尔国际出口的产品，除最终销售给黑田电气、DML 公司的产品外，公司销售给第比尔国际的价格与第比尔国际销售给境外客户的价格一致，均系本公司与最终客户约定的价格。

第比尔国际对黑田电气、DML 公司销售单价高于本公司对第比尔国际的售价，主要是为了满足第比尔国际正常的营运资金需求。报告期内，第比尔国际获取的销售毛利与其自身运营费用情况如下：

单位：万港元

| 年度                | 2010 年度 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|-------------------|---------|---------|---------|
| (1) 第比尔国际销售毛利     |         | 57.99   | 372.37  |
| 来源于对黑田电气的销售       | —       | 34.28   | 372.37  |
| 来源于对 DML 公司的销售    | —       | 23.71   | —       |
| (2) 第比尔国际运营费用     |         | 59.68   | 342.13  |
| (3) 销售毛利扣除运营费用后净额 | —       | -1.69   | 30.24   |

由上表可见，报告期内第比尔国际获取的差价是为了保证其正常运营的需要，不存在通过转移定价而操纵利润及输送利益的情形。

## 2、采购原材料、设备

### （1）报告期内通过第比尔国际进行的境外采购情况

单位：万元

| 关联采购         | 2010 年度 | 2009 年度   | 2008 年度  |
|--------------|---------|-----------|----------|
| 向第比尔采购原材料的金额 | -       | 965.82    | 2,560.90 |
| 向第比尔采购设备的金额  | -       | 3,170.05  | 3,674.95 |
| 向第比尔采购商品的总金额 | -       | 4,135.87  | 6,235.85 |
| 公司采购总额       | -       | 12,705.48 | 8,737.53 |
| 关联采购占公司采购的比重 | -       | 32.55%    | 71.37%   |

产生上述关联采购的原因是本公司在 2008-2009 年部分境外设备与原材料采购通过第比尔国际进行，本公司向第比尔国际采购商品的价格与第比尔国际向境外供应商采购商品的价格相一致。

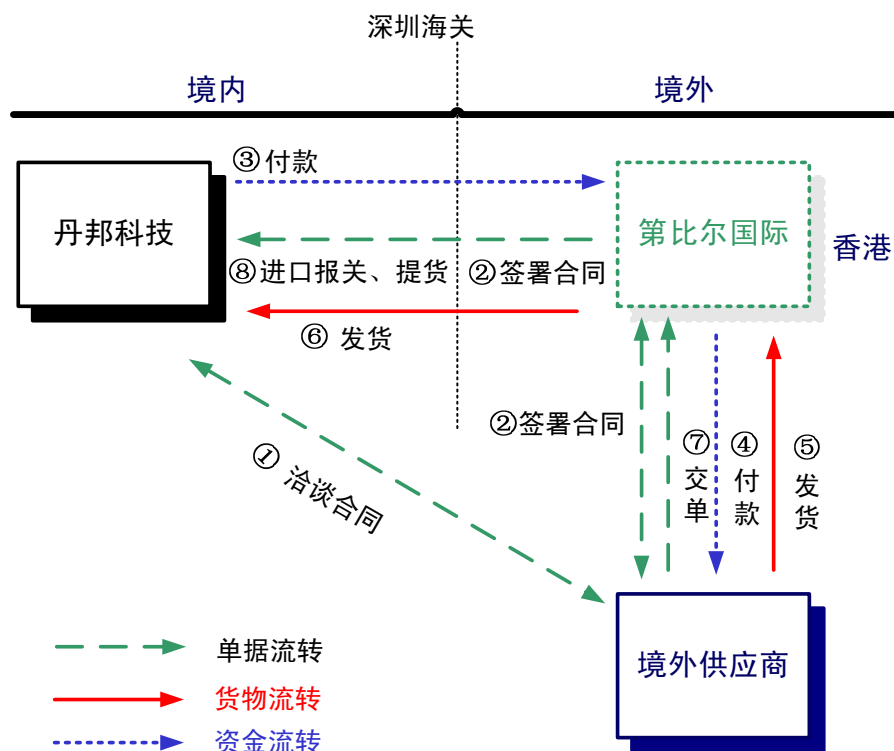
自 2008 年 5 月起，本公司全资子公司丹邦香港开始承接原来通过第比尔国际进行的境外采购职能。因此，2009 年，本公司通过第比尔国际的关联采购金额和占比均大幅度降低，2010 年已不再发生该类关联交易。

2008 年，本公司通过第比尔国际进行的境外采购金额占公司原材料及设备采购总金额的 71.37%，其主要原因是：公司的境外设备和原材料供应商对客户的商业信用等资信情况调查程序较长，审查比较严格，通过丹邦香港进行境外采购的前提是丹邦香港完成境外供应商对其商业信用等资信情况的调查并获得认可，因此，在完成上述工作之前，本公司部分境外采购仍然通过第比尔国际进行。

2009 年，本公司通过第比尔国际的关联采购金额和占比开始下降。其中，通过第比尔国际采购原材料的金额大幅下降，但设备采购金额降幅不大，其主要原因是：在 2008 年 5 月之前，公司通过第比尔国际与境外设备供应商签订了部分金额较大的设备采购合同，因设备采购周期较长，从合同签订、付款、供应商制造到交货一般耗时 7 个月以上，因此，上述设备采购合同于 2009 年才履行完毕。

## （2）通过第比尔国际进行境外采购的流程

本公司以第比尔国际的名义与境外供应商签订采购合同（或以形式发票 Proforma Invoice 代替采购合同）→本公司以第比尔国际名义向境外供应商付款→境外供应商发货并向第比尔国际交单→第比尔国际向本公司开具发票并交单→公司凭单提货。具体流程图如下：



公司通过第比尔国际进行境外采购的具体工作流程为：

①洽谈合同：公司直接与境外供应商接触与洽谈，约定设备或原材料的种类、技术要求、规格型号、数量、价格、交货期、结算方式等具体合同内容。

②签订合同：第比尔国际和境外供应商根据公司商定的条款签订采购合同或订单，同时公司与第比尔国际签订具有同样条款的采购合同或订单。

③付款：公司根据合同约定的支付条件向第比尔国际支付款项，在境外设备采购中，公司一般在合同签订一个月内，以 T/T、信用证方式全额支付设备款或支付部分订金。而境外材料采购一般采用 T/T 方式付款，供应商一般给予公司 30-90 天左右的信用账期，也有部分原材料的采购采用预付的方式。

④付款：第比尔国际在收到公司支付的货款后转付给境外供应商。

⑤发货：境外供应商根据合同约定将货物发送至第比尔国际，部分贵重机器设备的交付由境外供应商根据合同约定将货物直接发送至境内公司指定的地点，完成货物的交付运输。

⑥发货：第比尔国际收到境外供应商发送的货物后协助从香港发送至境内。

⑦交单：境外供应商发货后，根据合同约定将提单、装箱单、质量证明书及保险单等单据开具给第比尔国际，第比尔国际再将上述单据开具给本公司。

⑧进口报关、提货：公司办理电子报关进口，形成电子报关单并提货，于次月向海关办理集中报关。

从上可以看出，公司独立掌握境外供应商资源，直接与境外供应商洽谈采购条款，自主选择设备及原材料供应商，不受制于第比尔国际。

### **（3）关联采购的定价**

根据发行人与第比尔国际关联采购的凭证、单据等资料显示，发行人向第比尔国际采购商品的价格与第比尔国际向境外实际供应商采购商品的价格相一致，即发行人与第比尔国际关联采购的定价原则为境外实际供应商的销售价格，不存在转移定价及利益输送的情形。

### **3、通过第比尔国际进行境外销售及采购的必要性说明**

（1）本公司产品以外销为主，主要生产用设备及部分原材料也从境外进口，部分境外客户及供应商对交易方有注册地要求，倾向于选择注册地在香港的公司作为交易对象。为了不流失这类客户，并便捷地进口公司所需原材料及设备，公司将第比尔国际作为境外交易的窗口，在本公司与最终客户或境外供应商就交易事宜协商一致后，由第比尔国际与最终交易方就已商定事宜签定交易合同，在进出口业务流程中第比尔国际仅承担中转站之职能。

（2）通过第比尔国际与客户及供应商签订合同，以其在香港开立的银行账户可以充分利用香港自由、发达的贸易商业环境和外资银行资源，可以更加高效地办理议付、结汇、押汇、信用证通知等各种银行业务，本公司通过第比尔国际办理银行结算、代收客户货款，有利于本公司集中办理销售货款催收及采购货款的支付，进行客户账期管理和授信管理以提高货款回收速度；有利于本公司更加高效快捷地办理采购货款的支付，保持本公司在境外供应商中的良好商业信用及资信水平。

基于上述原因，本公司在 2009 年 8 月以前部分境外销售及采购通过第比尔国际来完成。本公司与第比尔国际的交易价格为本公司与最终客户或供应商协商的交易价格，第比尔国际只是替本公司代为收款、付款及代为结算，不赚取出口产品和进口货物的差价，不存在将利润转移给第比尔国际的情况。截至 2009 年

8 月，本公司境外销售与采购业务不再通过第比尔国际进行，第比尔国际的业务人员也全部转移至丹邦香港，较为彻底地解决了上述关联交易。截至 2009 年末，第比尔国际与本公司的所有款项均已结清。

保荐机构经核查后认为：发行人独立掌握境外终端客户及供应商资源，直接与终端客户及供应商洽谈合同条款，仅以第比尔国际的名义与境外客户或供应商签订销售合同（或订单）、采购合同（或订单）以及由第比尔国际负责货款回收、采购款支付及国际结算等，因此，发行人具有价格决定权及自主选择权。根据对发行人与第比尔国际关联交易凭证、单据等资料的核查，第比尔国际对黑田电气、DML 公司销售单价略高于发行人对第比尔公司的售价，主要是为了满足第比尔国际正常的营运资金需求，除此之外，发行人向第比尔国际销售的产品价格与第比尔国际收到海外最终客户的订单价格相一致，即发行人与第比尔国际关联销售的定价原则为海外最终客户的订单价格；发行人向第比尔国际采购的货物价格与第比尔国际向境外实际供应商的采购价格相一致，即发行人向第比尔国际关联采购的定价原则为境外实际供应商的销售价格。

## **（二）偶发性关联交易**

### **1、关联租赁**

（1）2009 年 3 月 30 日，公司与控股股东丹邦投资集团签署《房屋租赁合同》，将深圳市南山区朗山一路丹邦科技大楼五楼南、六楼南合计 1,000 平方米出租给丹邦投资用于办公，月租金 20,000 元人民币，租赁期限为 2009 年 4 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日。该合同已于 2009 年 3 月 31 日在深圳市南山区人民政府备案。2010 年 8 月 18 日，深圳市南山区西丽街道办事处房屋租赁管理所出具《停止出租证明书》，证明上述《房屋租赁合同》已经双方协议于 2010 年 7 月 13 日终止。

2009 年 4 月至 2010 年 7 月，公司因出租上述房屋向丹邦投资集团收取的租金合计 16 万元。

（2）2009 年 6 月 1 日，公司与关联方典邦科技签署《房屋租赁合同》，将深圳市南山区朗山一路丹邦科技大楼四楼西北、五楼西北、五楼西北合计 3,000

平方米出租给典邦科技用作厂房，月租金 60,000 元人民币，租赁期限为 2009 年 6 月 1 日至 2019 年 5 月 31 日。该合同已于 2009 年 7 月 3 日在深圳市南山区人民政府备案。

2009 年 6 月至 2010 年 12 月，公司因出租上述房屋向典邦科技收取租金合计 122 万元，此外，典邦科技租赁使用上述房屋期间所产生的电费合计 81.10 万元由公司代付，典邦科技已随房屋租金一并向公司偿付完毕。

## 2、接受关联方担保

(1) 2007 年 3 月 30 日，实际控制人刘萍与国家开发银行深圳市分行签订保证合同，为本公司与国家开发银行深圳市分行签订的 4403401652007020305 号借款合同项下本金 28,000.00 万元、借款期限 6 年的长期借款提供无限连带责任保证。担保到期日为 2015 年 3 月 29 日。

(2) 2007 年 3 月 30 日，丹邦投资集团与国家开发银行深圳市分行签订股权质押合同，并于 2007 年 9 月 11 日、2008 年 2 月 27 日、2009 年 11 月 20 日分别三次签订该股权质押合同的补充协议；2007 年 3 月 30 日，益关寿与国家开发银行深圳市分行签订股权质押合同，并于 2007 年 9 月 11 日签订该股权质押合同的补充协议；2009 年 11 月 20 日，丹依科技与国家开发银行签订股权质押合同。根据上述股权质押合同及补充协议，丹邦投资集团、丹依科技和益关寿分别以其持有本公司 60.93%、18%、12.67%的股权为本公司与国家开发银行深圳市分行签订的本金 28,000.00 万元、借款期限 6 年的长期借款提供质押担保。

2010 年 9 月 17 日，丹邦投资集团、丹依科技和益关寿与国家开发银行签署《国家开发银行股份有限公司人民币资金借款合同变更协议》，解除上述股权质押担保。深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市市场监督管理局分别于 2010 年 9 月 25 日、2010 年 9 月 28 日以深科工贸信资字[2010]2825 号文、编号为 563 的《企业股权解押备案函》同意解除上述股权质押。

(3) 2010 年 5 月 13 日，控股股东丹邦投资集团、实际控制人刘萍及其配偶谭芸分别与招商银行股份有限公司深圳高新园支行签订编号为 2010 年高字第 1010198115-1 号、2010 年高字第 1010198115-2 号、2010 年高字第 1010198115-3



号《不可撤销担保书》，为本公司与招商银行股份有限公司深圳高新园支行签订的 2010 年高字第 1010198115 号借款合同项下本金 5,000.00 万元、借款期限 2 年的借款提供连带责任保证。保证责任期间为 2010 年 5 月 13 日起至借款、垫款或其他债务履行期届满之日起另加两年。

### **3、关联方资产转让**

#### **(1) 收购股权**

为了减少关联交易，由丹邦香港承接原来由第比尔国际履行的境外销售及境外采购职能。2008 年 5 月 8 日，丹邦有限召开董事会并作出决议，决定收购丹邦香港为子公司。

2008 年 5 月 9 日，丹邦香港股东益天鹏先生与丹邦有限签署股份转让协议，将其持有的丹邦香港 100%股权以港币 1 元的价格转让给丹邦有限，该股权转让协议文件于 2008 年 5 月 9 日获香港税务局印花税组确认，并在香港公司注册处登记。2010 年 4 月 9 日，中华人民共和国商务部颁发商境外投资证第 4403201000070 号《企业境外投资证书》同意上述收购。

#### **(2) 出售设备**

2008 年 7 月 18 日，经丹邦有限董事会决议同意，丹邦有限与典邦科技签订《转让协议》，丹邦有限向典邦科技出售一批设备，受丹邦有限委托，广东中广信资产评估有限公司对该批生产设备采用重置成本法进行了评估并出具了中广信评报字[2008]第 043 号《资产评估报告书》，截至 2008 年 6 月 30 日，该批生产设备账面净值 7,940,472.11 元，评估后净值为 8,043,426.00 元。经双方协商，转让价格以评估值参考确定为 7,940,472.11 元。典邦科技已于设备移交前支付完毕上述设备转让价款。

该批设备系一批用于异方导电膜的研发设备，根据公司业务发展规划，公司专注于 FPC、COF 柔性封装基板等产品的研发与生产，于是将该批设备出售给典邦科技。

#### **(3) 无偿受让专利**

2009 年 10 月，丹邦投资集团将其拥有的专利号为 ZL200310111842.6、

ZL200610034593.9、ZL200610034594.3 的三项发明专利无偿转让给丹邦有限，并分别于 2009 年 10 月 2 日、2009 年 10 月 16 日、2009 年 10 月 16 日办理了专利权转移备案登记手续。

#### **4、广东丹邦收购广东东邦土地使用权、地上建筑物及附着物**

##### **(1) 本次收购的目标资产**

2010 年 9 月 13 日，本公司子公司广东丹邦与实际控制人控制的广东东邦签署了《资产收购协议书》。根据该《资产收购协议书》，广东丹邦拟收购广东东邦位于东莞市松山湖科技产业园区北部工业城 C 区，土地面积为伍万陆仟玖佰陆拾肆平方米（56,964 m<sup>2</sup>）的土地使用权（宗地号为 1935030100045）及其地上建筑物、附着物（包括厂房、研发大楼及相关生产、办公、生活配套设施等）。

本次收购的目标资产由同一实际控制人控制下的广东东邦于 2009 年 2 月 27 日与东莞市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》（东国土出让（市场）合[2009]第 16 号），通过招拍挂程序受让取得。2009 年 8 月，公司在东莞注册成立了全资子公司广东丹邦，拟由广东丹邦实施建设“基于柔性封装基板技术的芯片封装产业化项目”。因此，发行人决定由广东丹邦购买上述用地用于实施募集资金投资项目。

##### **(2) 本次收购决策程序合法合规**

2010 年 9 月 13 日，公司子公司广东丹邦与实际控制人控制的广东东邦签署了《资产收购协议书》。该次关联交易已经 2010 年 8 月 31 日召开的公司第一届董事会第十次会议、2010 年 9 月 15 日召开的 2010 年第二次临时股东大会决议通过，会议表决时，关联董事、关联股东回避表决。独立董事于 2010 年 9 月 15 日就该关联交易出具了核查意见，认为本次关联交易“本次关联交易已依法履行相关决策程序，遵循平等、自愿、等价、有偿原则，不存在严重影响公司独立性或者显失公允的情形，不存在损害发行人和非关联股东利益的情形。”

2011 年 4 月 15 日，广东丹邦与广东东邦签署《补充协议》，补充约定事项已经 2011 年 4 月 18 日召开的公司第一届董事会第十六次会议决议通过，会议表决时，关联董事回避表决。针对《补充协议》约定事项，独立董事于 2011 年 4

月 18 日就该关联交易出具了核查意见，认为“广东丹邦以经审计账面值为参考作价购买广东东邦的土地使用权和在建工程，即以广东东邦购买土地及在建工程的建设成本作价收购目标资产，不存在向关联方输送利益及损害公司及其全体股东利益的情形。”

保荐机构及发行人律师核查后认为：本次关联交易遵循平等、自愿原则，已依据相关法律法规、《公司章程》及公司制度经董事会、股东大会决议通过，关联股东、关联董事回避表决，独立董事发表了独立意见，本次关联交易的决策程序合法合规。

### **(3) 本次关联交易的具体实施符合相关法律法规及协议约定**

根据广东丹邦与广东东邦 2010 年 9 月 13 日签署的《资产收购协议书》及 2011 年 4 月 15 日签署的《补充协议》，自双方共同确定的会计师事务所出具目标资产专项审计报告之日起 30 个工作日内，双方应备齐有关资料共同向相关产权登记部门申请办理目标资产不动产产权转移登记手续，广东丹邦应将目标资产收购价款以银行转账方式支付给广东东邦。

东莞市国土资源局于 2011 年 5 月 6 日出具东国土转让字[2011]3070 号《关于广东东邦科技有限公司国有土地使用权交易成交的通知》，确认广东丹邦依法受让《国有土地使用证》号为东府国用[2009]第特 66 号、宗地号为 1935030100045 号的土地使用权；广东丹邦已根据《资产收购协议书》、《补充协议》约定的期限、方式将目标资产收购价款向广东东邦支付完毕；广东丹邦于 2011 年 5 月 9 日取得东莞市人民政府颁发的 1935030100045 号宗地的《国有土地使用证》（东府国用[2009]第特 66 号），完成该土地使用权的过户变更登记。

保荐机构及发行人律师核查后认为：广东丹邦已向广东东邦支付收购价款，并已完成该土地使用权的过户变更登记手续，本次关联交易的履行符合《资产收购协议书》、《补充协议》的约定，符合土地及房地产转让相关法律法规的规定。

### **(4) 本次收购价格不存在向关联方输送利益及损害发行人利益的情形**

根据 2011 年 4 月 15 日广东丹邦与广东东邦签署《补充协议》，协议约定双方共同确定一家具有证券从业资格的会计师事务所，由该会计师事务所以 2011

年 3 月 31 日为审计基准日，对目标资产进行专项审计，并以目标资产经审计的账面值为目标资产的收购价格。此外，因收购目标资产而产生的应缴税款（包括但不限于契税、印花税、营业税、土地增值税等法定税款）及应付费用（包括但不限于对目标资产的评估费用、审计费用、产权转移登记费用等其他必要费用）由广东丹邦承担。

天职国际会计师事务所于 2011 年 4 月 12 日出具天职深 QJ[2011]501 号《审计报告》对本次收购的土地使用权和在建工程（地上建筑物）进行了审计，经审计，截至 2011 年 3 月 31 日，广东东邦的土地使用权和在建工程账面价值合计 63,482,104.02 元，其中土地使用权 34,401,943.10 元，在建工程 29,080,160.92 元。

因此，广东丹邦以审计账面值为参考作价 63,482,104.02 元购买广东东邦拥有的土地使用权和在建工程，已向广东东邦支付全部转让价款。此外，根据协议约定，广东丹邦支付本次关联交易涉及的税款及费用合计 3,807,655.81 元。

保荐机构及发行人律师核查后认为：本次关联交易定价经交易双方自愿、平等协商，以具有证券从业资格的会计师事务所审计的账面值为参考，即以广东东邦购买土地及建设地上建筑物及附着物的成本作价收购目标资产，不存在发行人向关联方输送利益及损害发行人利益的情形。

### （三）关联方应收应付账款余额

单位：万元

| 科目名称  | 关联方   | 2010 年<br>12 月 31 日 | 2009 年<br>12 月 31 日 | 2008 年<br>12 月 31 日 |
|-------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 应收账款  | 第比尔国际 | -                   | -                   | 782.66              |
| 预付款项  | 第比尔国际 | -                   | -                   | 5,274.69            |
| 其他应收款 | 典邦科技  | -                   | 8.77                | -                   |
| 应付账款  | 邦达集团  | -                   | -                   | 261.48              |

2008 年末，公司对第比尔国际的应收账款主要为通过其销售产品的货款，且均在信用期内，已于 2009 年全部收回。

2008 年末，公司对第比尔国际的预付款项主要是通过其采购设备的预付款，

已于 2009 年结转完毕。

2009 年末，公司对典邦科技的其他应收账款系其应支付给本公司的房屋租金，典邦科技已于 2010 年支付完毕。

2008 年末，公司对邦达集团的应付账款系 2006 年以前通过其从境外采购材料的货款，已于 2009 年支付完毕。

#### **（四）关联交易对经营状况和财务状况的影响**

本公司具有独立的采购、生产、销售系统，在销售及采购环节发生的关联交易均为公司经营所必需，依照《公司章程》以及有关协议规定进行，且按市场价格公允定价，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果未产生重大影响。

### **四、公司减少关联交易的措施**

本公司具有独立的产、供、销业务体系，将严格按关联交易决策制度规范关联交易行为。为减少关联交易，自 2008 年 5 月起，本公司全资子公司丹邦香港开始承接第比尔国际的窗口公司职能，截至 2009 年 8 月，原通过第比尔国际进行的境外销售与采购业务已履行完毕，较为彻底地解决了经常性关联交易。今后，本公司将进一步完善购销体系，严格控制关联交易行为的发生。

控股股东丹邦投资集团已以书面形式出具《关于减少和规范与公司关联交易的承诺》：

1、本公司及本公司控制的其他企业将尽量避免与发行人之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，将按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护上市公司及中小股东利益。

2、如因本公司未履行本承诺函所作的承诺而给发行人造成损失的，本公司对因此给发行人造成的损失予以赔偿。

3、本公司不利用在发行人的控股股东地位，损害发行人及其他中小股东的利益。

4、本承诺函一经签署立即生效，且上述承诺在本公司对发行人拥有由资本或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对发行人存在重大影响的期间内持续有效，且不可变更或撤销。

## **五、发行人近三年关联交易的执行情况及公司独立董事意见**

经核查，报告期内公司与关联方之间的重大关联交易事项，均按照公司《章程》规定履行必要的审批程序，其重大交易事项已经董事会审议通过。

本公司独立董事已对本公司报告期的关联交易协议及其履行情况进行审核，并发表意见如下：“公司最近三年内所发生的关联交易已依法履行相关决策程序，遵循平等、自愿原则，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在严重影响公司独立性或者显失公允的关联交易，不存在损害发行人和非关联股东利益的情形。”

## **六、规范关联交易的制度安排**

为严格执行中国证监会有关规范关联交易行为的规定，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《公司法》、《证券法》、《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》等有关法律、法规，本公司已在《公司章程》、《公司章程（草案）》、《深圳丹邦科技股份有限公司股东大会议事规则》、《深圳丹邦科技股份有限公司董事会议事规则》及《深圳丹邦科技股份有限公司关联交易决策制度》中明确规定关联交易的决策程序、关联交易的信息披露等事项。

### **（一）发行人在《公司章程》中规定了关联交易的回避制度**

《公司章程》第七十八条规定：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

《公司章程》第一百一十八条规定：董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。

该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。

## **（二）发行人在《关联交易决策制度》中规定了对关联交易的决策权限**

《关联交易决策制度》第十八条规定：公司与关联法人发生的金额低于一百万元人民币的交易，由总经理审议批准。

公司与关联自然人发生的金额低于三十万元人民币的交易，或公司与关联法人发生的金额一百万元人民币以上，三百万元人民币以下的交易，或虽超过三百万元人民币，但累计不足公司最近一期经审计净资产绝对值百分之零点五的交易由董事长审议批准。

公司与关联法人发生的金额在三百万元人民币以上，低于三千万元人民币，且占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之零点五以上的交易；或公司与关联自然人发生的金额在三十万元人民币以上，低于三千万元人民币的交易；公司与关联人发生的金额在三千万元人民币以上，但占公司最近一期经审计净资产百分之零点五以上，低于百分之五的交易，由董事会审议批准。

《关联交易决策制度》第十九条规定：公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在三千万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之五以上的关联交易，公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计，并将该交易提交股东大会审议。

《关联交易决策制度》第二十条规定：公司拟与关联人达成的金额在三百万元人民币以上，或高于公司最近经审计净资产值的百分之五以上的关联交易，应由独立董事认可后提交董事会讨论决定。独立董事做出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员

### 一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员情况

#### （一）董事会成员（5人）

截至本招股说明书签署日，公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，独立董事人数不少于董事会人数的1/3；董事由创立大会或股东大会选举产生，任期3年，任期届满可连选连任，本届董事会至2012年5月19日期满。公司董事的基本情况如下：

1、刘萍，男，46岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学冶金科学与工程学院，工学博士。曾任深圳市新追求公司部门经理，典邦柔性、丹邦柔性总经理。2001年11月至今任本公司董事长，2001年11月至2009年5月任本公司总经理，现任本公司董事长、总经理及研发中心主任，兼任丹邦投资集团、典邦科技、广东东邦、广东丹邦董事长，丹邦香港、第比尔国际董事。2009年，刘萍被深圳市政府认定为深圳市地方级高层次人才。

2、王李懿，男，44岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学信息管理专业，本科学历。曾任湖北省政府发展研究中心科员、深圳市新追求公司副总经理、总经理等。2003年加入丹邦有限任副总经理，2008年4月至今任公司董事，现任本公司董事、副总经理，兼任广东丹邦董事、总经理，丹依科技、广东东邦副董事长，典邦科技监事。

3、益天鹏，男，36岁，中国香港籍，拥有加拿大永久居留权，毕业于加拿大滑铁卢大学，本科学历。曾任第比尔国际营业经理，2007年10月至今，任丹邦香港总经理。现任本公司董事、丹邦香港总经理。

4、龚艳，女，43岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南财经学院会计系，本科学历。曾任中南大学计财处教学经费主管会计、机械学院主管会计、计财处科研财务科科长、计财处会计二科科长，现任湖南中大业翔科技有限公司财务总监、本公司独立董事。



5、赖延清，男，37岁，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任中南大学冶金科学与工程学院讲师、副教授，现任中南大学冶金科学与工程学院教授、中南大学轻金属及工业电化学研究所副所长、本公司独立董事。

## **（二）监事会成员（3人）**

截至本招股说明书签署日，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，设监事会主席1名。职工代表监事由职工代表以民主方式选举产生，其他监事由全体发起人提名并经2009年5月20日召开的创立大会选举产生，任期三年，任期届满可以连选连任，本届监事会至2012年5月19日期满。公司监事的基本情况如下：

1、邹盛和，男，45岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北广播电视大学，专科学历。曾任典邦柔性财务部长。2001年加入丹邦有限公司财务部部长。现任本公司监事会主席，兼任广东丹邦副董事长，丹邦投资集团、典邦科技、丹依科技、广东东邦董事。

2、殷鹰，男，34岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉工业大学，大专学历。曾任深圳中络电子有限公司部门主管。2005年加入丹邦有限公司技术研发部副部长，现任本公司监事、技术研发部部长。

3、刘绪芳，女，35岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于深圳大学光电工程学院物理电子专业，硕士学历。曾任德昌电机（深圳）有限公司生产材料控制科主管、晶浩达电子有限公司生产材料控制科主管、东莞新科影音制品厂生产材料控制科主管。2008年加入丹邦有限公司资材部课长，现任本公司监事、资材部课长。

## **（三）高级管理人员（4人）**

公司高级管理人员由公司董事会聘任，任期3年，任期届满可连聘连任。截至本招股说明书签署日，本公司高级管理人员为刘萍、王李懿、唐苗丽、吴荔。刘萍、王李懿的简历请见本节之“一、（一）董事会成员”，其他人员简历如下：

1、唐苗丽，女，29岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学会

计专业，本科学历。曾任深圳合悦嘉贸易有限公司会计、深圳深信会计师事务所审计员、深圳天健信德会计师事务所项目经理、典邦科技财务主管。2009年6月起任本公司财务负责人。

2、吴荔，女，33岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南师范大学，本科学历。曾任东莞宏远工业区股份有限公司证券事务代表。2010年4月加入本公司任公司董事会秘书。

#### **（四）核心技术人员（3人）**

本公司核心技术人员刘萍、殷鹰、刘文魁，简历如下：

1、刘萍，简历请见本节之“一、（一）董事会成员”。

2、殷鹰，简历请见本节之“一、（二）监事会成员”。

3、刘文魁，男，37岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于深圳大学，本科学历。2005年加入丹邦有限，曾任工程师、CCL材料技术部课长，现任公司先端COF材料事业部CCL材料技术部副部长，兼任丹依科技董事长、总经理，广东东邦监事。2009年，刘文魁被深圳市政府认定为深圳市后备级高层次专业人才。

#### **（五）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间的亲属关系**

除刘萍与刘文魁为叔侄关系外，本公司其他董事、监事、高级管理人员与核心技术人员相互之间不存在亲属关系。

## **二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况**

### **（一）直接持股情况**

截至本招股说明书签署日，公司现任董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属近三年直接持有本公司股份情况如下表：

单位：万股

| 姓名  | 2010年12月31日 |        | 2009年12月31日 |        | 2008年12月31日 |        |
|-----|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
|     | 持股数         | 比例     | 持股数         | 比例     | 持股数         | 比例     |
| 益关寿 | 1,520.40    | 12.67% | 1,520.40    | 12.67% | 1,267.00    | 12.67% |

益关寿是本公司董事益天鹏之父，持有本公司12.67%的股份。2009年6月，丹邦有限整体变更设立为外商投资股份有限公司，股本12,000万股，益关寿持股数由1,267.00万股变为1,520.40万股，持股比例未发生变化。

## （二）间接持股情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属间接持有本公司股份情况如下表：

单位：万股

| 姓名  | 本公司职务                     | 间接持股单位 | 间接持股数量   | 持股比例   |
|-----|---------------------------|--------|----------|--------|
| 刘 萍 | 董事长、总经理、研发中心主任            | 丹邦投资集团 | 7,311.60 | 60.93% |
| 刘文魁 | 先端 COF 材料事业部 CCL 材料技术部副部长 | 丹依科技   | 1,080.00 | 9.00%  |
| 王李懿 | 董事、副总经理                   | 丹依科技   | 540.00   | 4.50%  |
| 邹盛和 | 监事会主席                     | 丹依科技   | 540.00   | 4.50%  |

除上述情形外，本公司其他董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属，不存在直接或间接持有本公司股份的情况。

截至本招股说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员持有本公司的股份不存在质押情况。

## 三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的其他对外投资情况

单位：万元

| 姓名  | 投资企业名称 | 注册资本      | 持股比例    | 持股方式 | 投资企业与本公司关系 | 利益冲突 |
|-----|--------|-----------|---------|------|------------|------|
| 刘 萍 | 丹邦投资集团 | 9,000.00  | 100.00% | 直接   | 本公司控股股东    | 无    |
|     | 第比尔国际  | 10.20 万港元 | 99.00%  | 间接   | 关联公司       | 无    |
|     | 典邦科技   | 10,000.00 | 99.255% | 间接   | 关联公司       | 无    |
|     | 广东东邦   | 8,000.00  | 99.75%  | 间接   | 关联公司       | 无    |
| 益天鹏 | 第比尔国际  | 10.20 万港元 | 1.00%   | 直接   | 关联公司       | 无    |
| 王李懿 | 丹依科技   | 100.00    | 25.00%  | 直接   | 本公司股东      | 无    |
| 邹盛和 | 丹依科技   | 100.00    | 25.00%  | 直接   | 本公司股东      | 无    |
| 刘文魁 | 丹依科技   | 100.00    | 50.00%  | 直接   | 本公司股东      | 无    |

本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的上述其他对外投资情况

与本公司不存在利益冲突。除上述列明的投资情况外，本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员无其他对外投资。

#### 四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬

##### 1、本公司董事（不含独立董事）、监事、高管人员 2010 年度含税收入

单位：万元

| 姓 名 | 在本公司职务                    | 领薪处 | 薪酬    |
|-----|---------------------------|-----|-------|
| 刘 萍 | 董事长、总经理、研发中心主任            | 本公司 | 19.80 |
| 王李懿 | 董事、副总经理                   | 本公司 | 17.52 |
| 邹盛和 | 监事会主席                     | 本公司 | 18.12 |
| 殷 鹰 | 监事、技术研发部部长                | 本公司 | 9.04  |
| 刘绪芳 | 监事、资材部课长                  | 本公司 | 6.30  |
| 唐苗丽 | 财务负责人                     | 本公司 | 16.20 |
| 吴 荔 | 董事会秘书                     | 本公司 | 13.60 |
| 刘文魁 | 先端 COF 材料事业部 CCL 材料技术部副部长 | 本公司 | 6.90  |

本公司董事益天鹏未在公司领薪，董事会秘书吴荔于 2010 年 4 月加入本公司后开始领薪。

##### 2、独立董事津贴

公司 2009 年 5 月开始聘请独立董事并于当月开始计薪，津贴按月支付，公司每年向每位独立董事支付津贴 5 万元（含税）。

本公司未对董事、监事、高级管理人员及核心技术人员实行退休金计划。

#### 五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况

| 姓名  | 本公司职务          | 兼职单位   | 在兼职单位的职务 | 兼职单位与公司关系 |
|-----|----------------|--------|----------|-----------|
| 刘 萍 | 董事长、总经理、研发中心主任 | 丹邦投资集团 | 董事长      | 控股股东      |
|     |                | 丹邦香港   | 董事       | 公司子公司     |
|     |                | 广东丹邦   | 董事长      | 公司子公司     |
|     |                | 典邦科技   | 董事长      | 关联公司      |
|     |                | 广东东邦   | 董事长      | 关联公司      |
|     |                | 第比尔国际  | 董事       | 关联公司      |
| 王李懿 | 董事、副总经理        | 丹依科技   | 副董事长     | 公司股东      |
|     |                | 广东丹邦   | 董事、总经理   | 公司子公司     |
|     |                | 广东东邦   | 副董事长     | 关联公司      |

|     |                           |                  |         |       |
|-----|---------------------------|------------------|---------|-------|
|     |                           | 典邦科技             | 监事      | 关联公司  |
| 益天鹏 | 董事                        | 丹邦香港             | 总经理     | 公司子公司 |
| 龚 艳 | 独立董事                      | 湖南中大业翔科技有限公司     | 财务总监    | 无关联关系 |
| 赖延清 | 独立董事                      | 中南大学冶金科学与工程学院    | 教授      | 无关联关系 |
|     |                           | 中南大学轻金属及工业电化学研究所 | 副所长     | 无关联关系 |
| 邹盛和 | 监事会主席                     | 丹邦投资集团           | 董事      | 控股股东  |
|     |                           | 丹依科技             | 董事      | 公司股东  |
|     |                           | 广东丹邦             | 副董事长    | 公司子公司 |
|     |                           | 典邦科技             | 董事      | 关联公司  |
|     |                           | 广东东邦             | 董事      | 关联公司  |
| 刘文魁 | 先端 COF 材料事业部 CCL 材料技术部副部长 | 丹依科技             | 董事长、总经理 | 公司股东  |
|     |                           | 广东东邦             | 监事      | 关联公司  |

除上述人员外，其他董事、监事、高管及核心技术人员均未在控股股东、实际控制人控制的其他企业以及同行业其他法人单位兼任执行职务。

## 六、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员作出的重要承诺及与本公司签订的协议及其履行情况

持有公司股份的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均对所持本公司股份的限售作出相关承诺。

除两名独立董事外，其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均与本公司签订了《劳动合同》，并签订了《保密协议》。

截至本招股说明书签署日，上述合同、协议均履行正常，不存在违约情况。

## 七、董事、监事、高级管理人员的任职资格

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## **八、公司董事、监事、高级管理人员的变动情况**

### **（一）董事变动情况**

2007年1月1日至2008年4月21日，公司董事会成员为刘萍、益关寿、陈洪野三人；2008年4月22日，陈洪野因个人原因不再担任董事职务，根据丹依科技的《董事委派书》，委派王李懿为丹邦科技董事。

2009年5月20日，公司为改制为股份有限公司，根据有关规定增选两名独立董事。

2010年8月26日，2010年第一次临时股东大会同意益关寿因身体原因辞去公司董事职务的申请，同时选举益关寿儿子益天鹏为公司董事。

公司上述董事的变动均履行了必要的法律程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，且对公司的持续经营未造成不利影响。

### **（二）监事变动情况**

股份公司成立前，公司作为外商投资企业未设立监事会、监事，2009年5月20日，公司改制为股份有限公司，根据有关规定成立了股份公司第一届监事会。监事会成员为邹盛和、刘绪芳、殷鹰，其中邹盛和任监事会主席。

### **（三）高级管理人员变动情况**

股份公司成立之前，刘萍一直担任公司总经理，王李懿自2003年担任公司副总经理。2009年6月1日，公司第一届董事会第一次会议聘任魏志祥为总经理，聘任张震远为副总经理，聘任唐苗丽为公司财务负责人。在试用期内，魏志祥、张震远因个人原因辞去公司职务，2010年3月26日，公司第一届董事会第四次会议免去魏志祥、张震远的总经理、副总经理职务，同时，聘任刘萍为公司总经理，聘任王李懿为公司副总经理。

2010年4月21日，公司第一届董事会第五次会议聘任吴荔为董事会秘书。

公司上述高级管理人员的变动履行了必要的法律程序，符合相关法律、法规和本公司章程的规定。

魏志祥、张震远辞去公司总经理、副总经理职务后，公司实际控制人、原公

司总经理刘萍继续担任总经理，原公司副总经理王李懿继续担任副总经理。实际控制人刘萍是公司的主要创立者和决策者，自公司成立以来一直担任公司董事长，并长期担任公司总经理职务，对公司的发展战略及经营方针的制定与实施具有决定性的影响；王李懿自2003年担任公司副总经理起，一直分管公司的日常经营管理工作。报告期内，公司增聘财务负责人和董事会秘书系为了完善公司治理；2009年6月至2010年3月，部分高级管理人员因个人原因发生变动，该变动没有对公司核心经营层和公司生产经营管理的连续性造成实质性影响，没有改变公司的发展战略、经营目标及经营方针，公司经营管理的最终决策人未发生变化。因此，报告期内发行人董事、高级管理人员没有发生重大变化，未对公司的生产经营构成重大不利影响。

## 第八节 公司治理

### 一、公司法人治理制度建立健全情况

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，本公司已建立了由股东大会、董事会、监事会组成的治理结构，公司股东大会、董事会、监事会分别为公司的最高权力机构、主要决策机构和监督机构，三者与公司高级管理层共同构建了分工明确、相互配合、相互制衡的运行机制。

公司的股东大会由全体股东组成。公司董事会由五名董事组成，其中独立董事两名；董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，监事会设监事会主席一名。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘。

公司股东大会、董事会、监事会按照《公司法》及《公司章程》的要求履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及重要财务决策严格按照《公司章程》规定的程序与规则进行，未出现违法违规现象，功能不断得到完善。

为更好地维护股东权益，确保股东、董事、监事职权的有效履行，规范股东大会、董事会及监事会的组织和行为，提高决策效率，根据《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，公司召开董事会、股东大会，审议通过了有关内部制度，具体如下：

| 日期         | 会议名称           | 通过的议案                                                                                  |
|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2009年5月20日 | 创立大会           | 《公司章程》                                                                                 |
| 2009年6月20日 | 2009年第一次临时股东大会 | 《关于修改<公司章程>的议案》                                                                        |
| 2010年4月21日 | 第一届董事会第五次会议    | 《董事会秘书工作规范》、《总经理工作细则》                                                                  |
| 2010年5月20日 | 第一届董事会第七次会议    | 《董事会提名委员会工作规则》、《董事会审计委员会工作规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》、《董事会战略发展委员会工作规则》、《内部审计制度》              |
| 2010年6月11日 | 2009年度股东大会     | 《关于设立董事会专门委员会的议案》、《股东大会累积投票制实施细则》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 |



|            |                |                                                                             |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2010年9月15日 | 2010年第二次临时股东大会 | 《公司章程（草案）》、《募集资金管理办法》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》 |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|

## 二、公司三会、独立董事和董事会秘书制度的建立健全及规范运作情况

### （一）股东大会

#### 1、股东的权利与义务

股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（5）法律、行政法规、规章和其他规范性文件及本章程规定应当承担的其他义务。

## 2、股东大会的职责及议事规则

根据《公司章程》规定，股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

- (1) 决定公司经营方针和投资计划；
- (2) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- (3) 审议批准董事会的报告；
- (4) 审议批准监事会的报告；
- (5) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (6) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (7) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- (8) 对发行公司债券作出决议；
- (9) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
- (10) 修改公司章程；
- (11) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
- (12) 审议批准下列担保事项：
  - ①本公司及本公司控股子公司的对外担保总额, 达到或超过最近一期经审计净资产的百分之五十（50%）以后提供的任何担保；
  - ②公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的百分之三十（30%）以后提供的任何担保；
  - ③为资产负债率超过百分之七十（70%）的担保对象提供的担保；
  - ④单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十（10%）的担保；
  - ⑤对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
- (13) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十（30%）的事项；
- (14) 审议批准变更募集资金用途事项；
- (15) 审议股权激励计划；
- (16) 审议公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）

金额在三千（3000）万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之五（5%）以上的关联交易；

（17）审议公司发生的交易包括但不限于：购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）、对外投资（含委托理财，委托贷款，对子公司投资等）、提供财务资助、提供担保、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议，但是公司获赠现金资产除外达到下列标准之一的事项：

①交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的百分之五十（50%）以上；

②交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的百分之五十（50%）以上，且绝对金额超过五千（5000）万元；

③交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之五十（50%）以上，且绝对金额超过五百（500）万元；

④交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的百分之五十（50%）以上，且绝对金额超过五千（5000）万元；

⑤交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之五十（50%）以上，且绝对金额超过五百（500）万元；

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算；

（18）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

### **3、股东大会规范运行情况**

自设立以来，公司股东大会一直严格依照有关法律、法规和公司章程的规定

规范有效地运作。股东认真履行股东义务，依法行使股东权利。

## **（二）董事会**

### **1、董事会的构成**

根据《公司章程》规定，董事会由五名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事人数不少于董事会人数的三分之一（1/3）。董事会设立战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会等专门委员会。

### **2、董事会的职权及议事规则**

根据《公司章程》规定，董事会行使下列职权：（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（7）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（8）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（9）决定公司内部管理机构的设置；（10）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（11）制订公司的基本管理制度；（12）制订本章程的修改方案；（13）管理公司信息披露事项；（14）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（15）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（16）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

根据《公司章程》规定，董事会的议事规则包括：（1）董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议；（2）董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持；（3）董事会会议应当由董事本人出席；董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章；（4）董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表

决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。董事会根据《公司章程》的规定，在其权限范围内对担保事项作出决议，除公司全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的三分之二以上董事的同意；（5）董事会决议采取书面记名投票方式表决。

### **3、董事会规范运行情况**

自设立以来，公司董事会一直严格依照有关法律、法规和公司章程的规定规范有效地运作。

### **4、董事会专门委员会的设置情况**

2010年6月11日，公司召开的2009年年度股东大会审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》。2010年5月20日，公司召开了第一届董事会议第七次会议，通过了《董事会战略发展委员会工作规则》、《董事会审计委员会工作规则》、《董事会提名委员会工作规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》、《内部审计制度》，并选举了各专门委员会委员。

#### **（1）董事会战略发展委员会**

战略发展委员会成员由五名董事组成，设召集人（主任委员）一名，由公司董事长担任。

战略发展委员会的主要职责：①对公司中长期发展战略进行研究、规划并提出建议；②对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；③对《公司章程》规定须经董事会批准的重大战略投资、重大资本运作或兼并收购进行研究并提出建议；④对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；⑤组织对以上事项的专家评审会；⑥对以上事项的实施进行检查；⑦董事会授权的其他事宜。

#### **（2）董事会审计委员会**

审计委员会成员由三名董事组成，其中两名成员由独立董事担任。审计委员会设召集人（主任委员）一名，由会计专业的独立董事委员担任，负责主持委员

会工作；召集人在委员内选举产生。

审计委员会的主要职责：①提议聘请或更换外部审计机构；②检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序；③对内部审计人员及其工作进行考核，监督公司的内部审计制度及其实施；④负责内部审计与外部审计之间的沟通；⑤审查公司内部控制，组织对责任体系进行日常监督检查。负责公司责任体系的事前指导、事中监督和事后检查，健全内部监察机制，对重大关联交易进行审计；⑥检查、监督公司存在或潜在的各种风险；⑦审核公司的财务信息与其披露；⑧检查公司遵守法律、法规的情况；⑨公司董事会授予的其他事宜。

### **（3）董事会提名委员会**

提名委员会成员由三名董事组成，其中两名成员由独立董事担任。提名委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。召集人在委员内选举产生。

提名委员会的主要职责：①根据公司经营情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；②研究制订董事、高级管理人员的选择标准和聘任程序，报董事会批准实施；③广泛搜寻并提交合格的董事、高级管理人员、控股企业中委派的董事长和高级管理人员的候选人；④对董事、高级管理人员进行审查并提出任免建议；⑤对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出任免建议；⑥董事会授权的其他事宜。

### **（4）董事会薪酬与考核委员会**

薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名成员由独立董事担任。薪酬与考核委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举产生。

薪酬与考核委员会的主要职责：①根据公司董事、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，研究、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策、标准与方案并提出建议；薪酬标准或方案包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；②审核公司整体薪酬政策和年度薪酬总额，并对薪酬政策以及年度薪酬执行

情况进行检查；③研究公司董事、高级管理人员考核的标准；④审查公司董事、高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评并提出建议；⑤负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；⑥董事会授权的其他事宜。

### **（三）监事会**

#### **1、监事会的构成**

公司设监事会。监事会由三名监事组成。监事会设监事会主席一名，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。

#### **2、监事会的职权及议事规则**

根据《公司章程》，监事会行使以下职权：（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）向股东大会提出提案；（7）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。召开定期会议和临时会议，会议通知应当分别在会议召开十日和五日以前书面送达全体监事。监事会会议应当由过半数的监事出席方可举行。监事会的决议，应当经半数以上监事通过。

#### **3、监事会运行情况**

公司监事会自成立以来，共召开了五次会议，监事会规范运行，各监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事》的规定行使自己的职权。

#### **（四）独立董事**

##### **1、独立董事设立情况**

公司2009年5月20日召开的创立大会审议通过龚艳、赖延清为独立董事，超过董事会人数的三分之一，其中龚艳为会计专业人士。

##### **2、独立董事的制度安排**

为了充分发挥独立董事的作用，独立董事除应当具有公司法和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，还拥有以下特别职权：（1）重大关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；（2）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；（3）向董事会提请召开临时股东大会；（4）提议召开董事会；（5）独立聘请外部审计机构和咨询机构；（6）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。独立董事行使上述职权时应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

独立董事除履行上述职责外，独立董事应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：（1）提名、任免董事；（2）聘任或解聘高级管理人员；（3）公司董事、高级管理人员的薪酬；（4）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于三百万元或高于公司最近经审计净资产值的百分之五的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；（5）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；（6）证券监管部门、证券交易所要求独立董事发表意见的事项；（7）法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》规定的其他事项。

独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。

##### **3、独立董事实际发挥作用的情况**

公司独立董事自聘任以来，对公司近三年的关联交易及公司与第比国际的



关联交易发表了意见。公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，勤勉尽责地履行职权，积极参与公司决策，努力维护中小股东的利益，为公司治理结构的完善和规范运作起到了积极作用。

### **（五）董事会秘书**

公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。

董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：（1）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；（2）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；（3）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；（4）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向证券交易所报告并办理公告；（5）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复证券交易所所有问询；（6）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、《上市规则》及相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；（7）督促董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、《上市规则》、证券交易所其他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或可能作出违反有关规定的决议时，应予以提醒并立即如实地向证券交易所报告；（8）《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所要求履行的其他职责。

公司董事会秘书自聘任以来，严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会秘书工作规范》。

## **三、发行人近三年违法违规行为情况**

2009年7月3日，文锦渡海关作出文关缉违进字[2009]216号《行政处罚决定书》，认定发行人于2009年6月2日向海关申报进口货物一批，其中申报进口纯铜

箔101,610克,实际进口纯铜箔401,600克,该案涉案货物漏缴税款人民币1.7756万元,决定对发行人罚款人民币18,000元。

上述处罚系由本公司供应商委托的货运公司将提单号码贴错所致,供应商出具了《证明》并承担了该笔罚款。2009年7月6日,上述涉案纯铜箔出口方GBC METALS SAIA PACIFIC PTE LTD出具《证明》,证明本次违规系因其委托之货运公司将提单号码贴错所致,并“愿意承担因单据与实际重量不符的问题而造成的海关处罚丹邦科技的罚金以及相关的清关费用共计3,479.76美元。本次违规与丹邦科技无关。”

保荐机构经核查《行政处罚决定书》、出口方GBC METALS SAIA PACIFIC PTE LTD出具的《证明》,并对发行人相关人员进行访谈后认为:

上述发行人受海关处罚系因货物出口方委托之货运公司将提单号码贴错导致,发行人不存在漏税的主观故意,且罚款金额较小、情节轻微,已及时、足额缴纳了罚款,发行人上述受海关行政处罚的事项,不属于重大违法行为,对发行人本次发行上市不构成法律障碍。

发行人律师核查后认为:发行人上述受海关行政处罚的事项,不属于重大违法行为,对发行人本次发行上市不构成法律障碍。

报告期内,发行人及发行人下属子公司不存在重大违法违规行为或情节严重的行政处罚。

#### **四、发行人近三年资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用及担保的情况**

本公司有严格的资金管理制度,近三年不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况,不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

## **五、公司内部控制制度的情况**

### **（一）公司管理层的自我评价**

公司现有的内部会计控制制度符合我国有关法规和相关监管部门的要求、符合《企业内部控制基本规范》的规定，符合当前公司实际经营情况；现有内部会计控制制度在企业管理各个过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。因此我们认为，本公司内部控制于2010年12月31日在所有重大方面是有效的。

### **（二）注册会计师对内控制度的评价**

天健会计师于 2011 年 1 月 22 日就本公司内部控制制度出具天健审（2011）3-41《内部控制鉴证报告》，其鉴证意见为：“我们认为，丹邦科技按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2010 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。”

## 第九节 财务会计信息

本公司2008-2010年财务报告已经天健会计师事务所审计，并出具了天健审（2011）3-38号标准无保留意见的《审计报告》。

本节的财务会计数据及有关分析引用的财务数据，非经特别说明，均引自经审计的财务报告。投资者欲对本公司进行更详细的了解，应当认真阅读审计报告及财务报告全文。

### 一、财务报表

#### （一）合并资产负债表

单位：万元

| 资产      | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
|---------|-------------|-------------|-------------|
| 流动资产：   |             |             |             |
| 货币资金    | 2,050.44    | 4,974.78    | 3,949.32    |
| 应收账款    | 4,592.96    | 5,589.65    | 6,521.74    |
| 预付款项    | 4,507.55    | 139.06      | 5,426.55    |
| 其他应收款   | 439.34      | 283.89      | 129.15      |
| 存货      | 1,603.33    | 2,276.99    | 998.44      |
| 流动资产合计  | 13,193.63   | 13,264.37   | 17,025.20   |
| 非流动资产：  |             |             |             |
| 固定资产    | 34,110.28   | 31,034.46   | 26,992.52   |
| 在建工程    | -           | 1,822.38    | 402.79      |
| 工程物资    | 3,803.32    | 17.17       | 1.18        |
| 无形资产    | 4,452.01    | 3,837.09    | 4,138.22    |
| 开发支出    | 800.29      | 752.19      | -           |
| 递延所得税资产 | 109.78      | 90.15       | 85.52       |
| 非流动资产合计 | 43,275.69   | 37,553.44   | 31,620.23   |
| 资产总计    | 56,469.32   | 50,817.81   | 48,645.42   |

#### （二）合并资产负债表（续）

单位：万元

| 负债及股东权益 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
|---------|-------------|-------------|-------------|
| 流动负债：   |             |             |             |
| 短期借款    | -           | -           | -           |
| 应付账款    | 1,407.64    | 1,233.73    | 1,553.80    |
| 预收款项    | 48.18       | 23.27       | 27.51       |

|               |           |           |           |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 应付职工薪酬        | 226.21    | 268.70    | 307.35    |
| 应交税费          | 74.48     | 97.45     | 140.90    |
| 应付利息          | 47.77     | 47.01     | 49.90     |
| 其他应付款         | 141.49    | 171.02    | 152.45    |
| 其他流动负债        | 21.84     | -         | -         |
| 流动负债合计        | 1,967.61  | 1,841.18  | 2,231.91  |
| 非流动负债：        |           |           |           |
| 长期借款          | 26,000.00 | 25,900.00 | 28,000.00 |
| 其他非流动负债       | 215.08    | 72.00     | 72.00     |
| 非流动负债合计       | 26,215.08 | 25,972.00 | 28,072.00 |
| 负债合计          | 28,182.69 | 27,813.18 | 30,303.91 |
| 所有者权益：        |           |           |           |
| 股本            | 12,000.00 | 12,000.00 | 10,000.00 |
| 资本公积          | 6,341.51  | 6,341.51  | 331.98    |
| 盈余公积          | 997.95    | 470.07    | 766.62    |
| 未分配利润         | 8,933.25  | 4,193.07  | 7,242.91  |
| 外币报表折算差额      | 13.92     | -0.03     | -         |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 28,286.63 | 23,004.63 | 18,341.51 |
| 少数股东权益        | -         | -         | -         |
| 所有者权益合计       | 28,286.63 | 23,004.63 | 18,341.51 |
| 负债及所有者权益总计    | 56,469.32 | 50,817.81 | 48,645.42 |

### （三）母公司资产负债表

单位：万元

| 资产      | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
|---------|-------------|-------------|-------------|
| 流动资产：   |             |             |             |
| 货币资金    | 1,988.25    | 975.51      | 3,949.32    |
| 应收账款    | 4,600.34    | 9,550.91    | 6,521.74    |
| 预付款项    | 1,803.53    | 139.06      | 5,426.55    |
| 其他应收款   | 1,992.12    | 283.89      | 129.15      |
| 存货      | 1,603.33    | 2,276.99    | 998.44      |
| 流动资产合计  | 11,987.57   | 13,226.35   | 17,025.20   |
| 非流动资产：  |             |             |             |
| 长期股权投资  | 4,969.69    | -           | -           |
| 固定资产    | 34,110.28   | 31,034.46   | 26,992.52   |
| 在建工程    | -           | 1,822.38    | 402.79      |
| 工程物资    | 8.77        | 17.17       | 1.18        |
| 无形资产    | 4,452.01    | 3,837.09    | 4,138.22    |
| 开发支出    | 800.29      | 752.19      | -           |
| 递延所得税资产 | 100.06      | 83.38       | 85.52       |
| 非流动资产合计 | 44,441.11   | 37,546.67   | 31,620.23   |
| 资产总计    | 56,428.69   | 50,773.02   | 48,645.42   |

#### （四）母公司资产负债表（续）

单位：万元

| 负债及股东权益    | 2010 年 12 月 31 日 | 2009 年 12 月 31 日 | 2008 年 12 月 31 日 |
|------------|------------------|------------------|------------------|
| 流动负债：      |                  |                  |                  |
| 短期借款       | -                | -                | -                |
| 应付账款       | 1,332.94         | 1,178.41         | 1,553.80         |
| 预收款项       | 47.90            | 23.27            | 27.51            |
| 应付职工薪酬     | 226.21           | 268.70           | 307.35           |
| 应交税费       | 74.48            | 97.45            | 140.90           |
| 应付利息       | 47.77            | 47.01            | 49.90            |
| 其他应付款      | 141.49           | 143.94           | 152.45           |
| 其他流动负债     | 21.85            | -                | -                |
| 流动负债合计     | 1,892.64         | 1,758.78         | 2,231.91         |
| 非流动负债：     |                  |                  |                  |
| 长期借款       | 26,000.00        | 25,900.00        | 28,000.00        |
| 其他非流动负债    | 215.08           | 72.00            | 72.00            |
| 非流动负债合计    | 26,215.08        | 25,972.00        | 28,072.00        |
| 负债合计       | 28,107.71        | 27,730.78        | 30,303.91        |
| 所有者权益：     |                  |                  |                  |
| 股本         | 12,000.00        | 12,000.00        | 10,000.00        |
| 资本公积       | 6,341.51         | 6,341.51         | 331.98           |
| 盈余公积       | 997.95           | 470.07           | 766.62           |
| 未分配利润      | 8,981.52         | 4,230.65         | 7,242.91         |
| 所有者权益合计    | 28,320.98        | 23,042.24        | 18,341.51        |
| 负债及所有者权益总计 | 56,428.69        | 50,773.02        | 48,645.42        |

#### （五）合并利润表

单位：万元

| 项目           | 2010 年度   | 2009 年度   | 2008 年度   |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 一、营业收入       | 20,567.36 | 18,347.60 | 17,151.52 |
| 减：营业成本       | 9,563.84  | 8,455.46  | 8,008.48  |
| 营业税金及附加      | 3.77      | 3.42      | -         |
| 销售费用         | 406.85    | 238.06    | 172.20    |
| 管理费用         | 3,924.25  | 3,447.18  | 2,861.60  |
| 财务费用         | 1,739.13  | 1,919.95  | 1,820.88  |
| 资产减值损失       | -57.95    | -46.56    | 679.15    |
| 加：公允价值变动收益   | -         | -         | -         |
| 投资收益         | -         | -         | -         |
| 二、营业利润       | 4,987.47  | 4,330.09  | 3,609.21  |
| 加：营业外收入      | 754.21    | 705.75    | 190.61    |
| 减：营业外支出      | 2.79      | 0.67      | 42.53     |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2.79      | 0.62      | 32.38     |

|                    |          |          |          |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 三、利润总额             | 5,738.89 | 5,035.17 | 3,757.28 |
| 减：所得税费用            | 470.84   | 372.02   | 242.93   |
| 四、净利润              | 5,268.05 | 4,663.14 | 3,514.35 |
| 其中：归属于母公司股东的净利润    | 5,268.05 | 4,663.14 | 3,514.35 |
| 少数股东损益             | -        | -        | -        |
| 五、每股收益             |          |          |          |
| （一）基本每股收益（元）       | 0.44     | 0.39     |          |
| （二）稀释每股收益（元）       | 0.44     | 0.39     |          |
| 六、其他综合收益           | 13.95    | -0.03    | -        |
| 其中：归属于母公司股东的其他综合收益 | 13.95    | -0.03    | -        |
| 归属于少数股东的其他综合收益     | -        | -        | -        |
| 七、综合收益总额           | 5,282.00 | 4,663.11 | 3,514.35 |
| 其中：归属于母公司股东的综合收益总额 | 5,282.00 | 4,663.11 | 3,514.35 |
| 归属于少数股东的综合收益总额     | -        | -        | -        |

## （六）母公司利润表

单位：万元

| 项目         | 2010 年度   | 2009 年度   | 2008 年度   |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 一、营业收入     | 20,348.91 | 18,060.22 | 17,151.52 |
| 减：营业成本     | 9,563.84  | 8,292.97  | 8,008.48  |
| 营业税金及附加    | 3.77      | 3.42      | -         |
| 销售费用       | 224.67    | 171.08    | 172.20    |
| 管理费用       | 3,877.63  | 3,359.66  | 2,861.60  |
| 财务费用       | 1,734.68  | 1,921.63  | 1,820.88  |
| 资产减值损失     | -56.78    | -62.98    | 679.15    |
| 加：公允价值变动收益 | -         | -         | -         |
| 投资收益       | -         | -         | -         |
| 二、营业利润     | 5,001.11  | 4,374.45  | 3,609.21  |
| 加：营业外收入    | 754.21    | 705.75    | 190.61    |
| 减：营业外支出    | 2.79      | 0.67      | 42.53     |
| 三、利润总额     | 5,752.53  | 5,079.52  | 3,757.28  |
| 减：所得税费用    | 473.79    | 378.79    | 242.93    |
| 四、净利润      | 5,278.73  | 4,700.73  | 3,514.35  |
| 五、其他综合收益   | -         | -         | -         |
| 六、综合收益总额   | 5,278.73  | 4,700.73  | 3,514.35  |

## （七）合并现金流量表

单位：万元

| 项目                        | 2010 年度    | 2009 年度   | 2008 年度   |
|---------------------------|------------|-----------|-----------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |            |           |           |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 19,762.51  | 19,140.45 | 13,392.81 |
| 收到的税费返还                   | 531.17     | 289.43    | 361.11    |
| 收到的其他与经营活动有关的现金           | 768.05     | 712.13    | 723.67    |
| 现金流入小计                    | 21,061.73  | 20,142.01 | 14,477.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 5,413.18   | 6,270.49  | 6,155.66  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 3,338.47   | 3,235.94  | 2,845.56  |
| 支付的各项税费                   | 584.67     | 429.68    | 162.45    |
| 支付的其他与经营活动有关的现金           | 950.64     | 954.47    | 615.86    |
| 现金流出小计                    | 10,286.96  | 10,890.58 | 9,779.53  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 10,774.78  | 9,251.43  | 4,698.07  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |            |           |           |
| 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.77       | 4.56      | 809.25    |
| 收到的其他与投资活动有关的现金           | 197.00     | -         | -         |
| 现金流入小计                    | 198.77     | 4.56      | 809.25    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金  | 12,390.87  | 4,418.26  | 7,471.38  |
| 现金流出小计                    | 12,390.87  | 4,418.26  | 7,471.38  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -12,192.10 | -4,413.70 | -6,662.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |            |           |           |
| 取得借款所收到的现金                | 5,000.00   | 16,000.00 | 5,000.00  |
| 现金流入小计                    | 5,000.00   | 16,000.00 | 5,000.00  |
| 偿还债务所支付的现金                | 4,900.00   | 18,100.00 | 100.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金        | 1,565.10   | 1,686.89  | 2,106.87  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 540.00     | 10.00     | 55.00     |
| 现金流出小计                    | 7,005.10   | 19,796.89 | 2,261.87  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -2,005.10  | -3,796.89 | 2,738.13  |
| 四、汇率变动对现金的影响额             | -16.92     | -15.37    | -130.65   |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -3,439.34  | 1,025.46  | 643.41    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 4,974.78   | 3,949.32  | 3,305.90  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 1,535.44   | 4,974.78  | 3,949.32  |

## （八）母公司现金流量表

单位：万元

| 项目              | 2010 年度   | 2009 年度   | 2008 年度   |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |           |           |           |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 23,496.46 | 14,908.23 | 13,392.81 |
| 收到的税费返还         | 531.17    | 289.43    | 361.11    |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 727.93    | 712.12    | 723.67    |



|                          |            |           |           |
|--------------------------|------------|-----------|-----------|
| 现金流入小计                   | 24,755.56  | 15,909.78 | 14,477.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金           | 5,415.28   | 6,163.32  | 6,155.66  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金          | 3,262.98   | 3,184.95  | 2,845.56  |
| 支付的各项税费                  | 580.87     | 429.68    | 162.45    |
| 支付的其他与经营活动有关的现金          | 2,285.77   | 877.13    | 615.86    |
| 现金流出小计                   | 11,544.90  | 10,655.07 | 9,779.53  |
| 经营活动产生的现金流量净额            | 13,210.66  | 5,254.70  | 4,698.07  |
| 二、投资活动产生的现金流量：           |            |           |           |
| 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.77       | 4.56      | 809.25    |
| 收到的其他与投资活动有关的现金          | 197.00     | -         | -         |
| 现金流入小计                   | 198.77     | 4.56      | 809.25    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,915.81   | 4,418.26  | 7,471.38  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额      | 4,969.69   | -         | -         |
| 现金流出小计                   | 10,885.50  | 4,418.26  | 7,471.38  |
| 投资活动产生的现金流量净额            | -10,687.73 | -4,413.70 | -6,662.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：           |            |           |           |
| 取得借款所收到的现金               | 5,000.00   | 16,000.00 | 5,000.00  |
| 现金流入小计                   | 5,000.00   | 16,000.00 | 5,000.00  |
| 偿还债务所支付的现金               | 4,900.00   | 18,100.00 | 100.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金       | 1,565.10   | 1,686.89  | 2,106.87  |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金          | 540.00     | 10.00     | 55.00     |
| 现金流出小计                   | 7,005.10   | 19,796.89 | 2,261.87  |
| 筹资活动产生的现金流量净额            | -2,005.10  | -3,796.89 | 2,738.13  |
| 四、汇率变动对现金的影响额            | -21.10     | -17.92    | -130.65   |
| 五、现金及现金等价物净增加额           | 497.73     | -2,973.80 | 643.41    |
| 加：期初现金及现金等价物余额           | 975.51     | 3,949.32  | 3,305.90  |
| 六、期末现金及现金等价物余额           | 1,473.25   | 975.51    | 3,949.32  |

## 二、财务报表编制的基础、合并报表范围及变化情况

### （一）财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。财务报表涉及的会计主体的确定方式为：母公司财务报表以法人主体为会计主体，母公司财务报表为汇总了公司本部及下属独立核算分公司财务报表的汇总财务报表；合并财务报表以包括母公司及控股子公司的合并主体为会计主体。

## （二）合并财务报表范围及变化情况

报告期期末，纳入公司合并财务报表范围内的公司所控制的国内外所有子公司情况如下：

| 公司名称 | 注册地 | 注册资本         | 持股比例 |     | 实际出资额        |
|------|-----|--------------|------|-----|--------------|
|      |     |              | 直接   | 间接  |              |
| 丹邦香港 | 香港  | 1,400.00 万港元 | 100% | -   | 1,400.00 万港元 |
| 广东丹邦 | 东莞  | 5,000.00 万元  | 75%  | 25% | 5,000.00 万元  |

报告期内，公司合并报表范围变化情况如下：

丹邦香港、广东丹邦为本公司的子公司。丹邦香港自成为公司子公司之日起纳入合并报告范围；广东丹邦自成立之日起纳入合并报表范围。

## 三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计

### （一）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并：公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并：公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### （二）收入确认和计量的具体方法

公司收入主要为销售商品收入，当收入同时满足下列条件的，予以确认：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额

能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

公司境内销售与境外销售的收入确认时点有所不同：境内销售以产品发出并经客户确认后根据销售发票确认收入；境外销售是在每月末，公司开具出口专用发票，并在收到海关结关单或中国电子口岸结关信息后确认出口销售收入。

### **（三）外币业务和外币报表折算**

#### **1、外币业务折算**

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

#### **2、外币财务报表折算**

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示；现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

### **（四）应收账款核算方法**

#### **1、应收账款确认方法**

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

## 2、坏账准备计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项

#### ①确认标准

应收账款金额在500万元以上(含)且占应收账款账面余额10%以上(含)的款项；其他应收款金额在10万元以上(含)且占其他应收款账面余额10%以上(含)的款项。

#### ②计提方法

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

(2) 单项金额不重大但单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

#### ①确认标准

应收账款和其他应收款账龄在3年以上的款项

#### ②计提方法

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

### (3) 单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备

#### ①确认标准

以账龄为信用风险特征。

#### ②计提方法

A、账龄分析法下计提比例如下：

| 账龄           | 比例  |
|--------------|-----|
| 一年以内（含一年，下同） | 5%  |
| 一至二年         | 10% |
| 二至三年         | 20% |
| 三至四年         | 50% |

|      |      |
|------|------|
| 四至五年 | 80%  |
| 五年以上 | 100% |

#### B、其他计提方法：

对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款和其他应收款，采用个别认定法计提坏账准备。

对应收出口退税款采用个别认定法，不计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### （五）存货的核算方法

#### 1、存货的核算方法

原材料采用先进先出法，产成品、自制半成品采用月末一次加权平均法。

#### 2、存货可变现净值的确定依据

存货可变现净值系本公司存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

#### 3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### （六）长期股权投资的核算

#### 1、初始计量

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

## 2、后续计量及收益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

## (七) 固定资产的核算

### 1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### 2、固定资产的分类

固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、检测设备、办公电子设备、运输工具、其他设备等。

### 3、固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率（预计净残值为原值的10%）确定折旧率。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

| 资产类别   | 折旧年限    | 残值率（%） | 年折旧率（%）   |
|--------|---------|--------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 20-38 年 | 10.00  | 2.37-4.50 |

|        |      |       |       |
|--------|------|-------|-------|
| 机器设备   | 10 年 | 10.00 | 9.00  |
| 检测设备   | 5 年  | 10.00 | 18.00 |
| 办公电子设备 | 5 年  | 10.00 | 18.00 |
| 运输工具   | 5 年  | 10.00 | 18.00 |
| 其他设备   | 5 年  | 10.00 | 18.00 |

## （八）在建工程的核算

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## （九）无形资产的核算

### 1、无形资产的确认条件

无形资产，是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

### 2、无形资产的计价方法

无形资产按照成本进行初始计量。

### 3、无形资产使用寿命及摊销

对使用寿命确定的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直接法摊销。

各种无形资产在其有效期限内按直线法摊销。具体如下：

土地使用权：按50年平均摊销；

专利权：按15-17年平均摊销；

软件：按5年平均摊销；

其他：按20年平均摊销。

## （十）借款费用资本化的依据及方法

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额。借款费用同时具备下列条件时，借款费用予以资本化：

资产支出已经发生，借款费用已经发生，为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 2、借款费用资本化的确认方法

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## (十一) 主要税种及税收政策

### 1、主要税种及税率

#### (1) 流转税及其他

| 税种      | 计税依据                                              | 税率        |
|---------|---------------------------------------------------|-----------|
| 增值税     | 内销                                                | 17%       |
|         | 外销——一般贸易                                          | 免抵退       |
|         | ——转厂贸易                                            | 免税        |
| 营业税     | 应纳税营业额                                            | 5%        |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴 | 1.2%或 12% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额                                           | 1%、7%     |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额                                           | 3%        |

#### (2) 企业所得税(利得税)

公司及其子公司报告期内企业所得税(或利得税)税率的变化情况列示如下：

| 公司名称/基本税率/期间 | 2010 年度 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|--------------|---------|---------|---------|
| 丹邦科技         | 11.00%  | 10.00%  | 9.00%   |
| 丹邦香港         | 16.50%  | 16.50%  | 16.50%  |
| 广东丹邦         | 25.00%  | 25.00%  | —       |



## 2、税收优惠及批文

### (1) 企业所得税

根据国务院《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(国发〔2007〕39号)和《深圳市人民政府关于深圳特区企业税收政策若干问题的规定》(深府〔1988〕232号),经深圳市南山区地方税务局批准,本公司2006年为获利年度,享受两免三减半的税收优惠。本公司2006年度、2007年度执行免税优惠,2008年度、2009年度、2010年分别按18%、20%、22%的过渡税率减半征收。虽然公司于2009年6月外资比例降低至25%以下,但根据深府[1988]232号文,公司作为在深圳市特区内设立的生产型企业,可享受“两免三减半”的税收优惠。2011年1月24日,本公司取得深圳市南山区地方税务局出具的确认函,确认本公司可继续在剩余税收优惠期间享受上述税收优惠。

### (2) 房产税

根据《深圳经济特区房产税实施办法》,深圳市南山区地方税务局对本公司备案登记的新建丹邦科技大厦,自建成之日起免征房产税3年。本公司2007年2月1日至2010年2月28日免征房产税。

根据财政部、国家税务总局《关于调整住房租赁市场税收政策的通知》(财税[2000]125号),深圳市南山区地方税务局对本公司备案登记的按不高于政府规定价格出租给职工的单位自有住房暂免征收房产税。

## (十二) 会计政策、会计估计的变更

报告期内,本公司无会计政策、会计估计变更。

## 四、非经常性损益

依据经天健会计师核验的非经常性损益明细表,近三年本公司非经常性损益的具体内容、金额及扣除非经常性损益后的净利润金额如下表:

单位: 万元

| 项 目                          | 2010 年度 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|------------------------------|---------|---------|---------|
| 1、非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -2.79   | 1.39    | -32.38  |
| 2、越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的        | 178.35  | 188.33  | 208.40  |

|                                                              |          |          |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 税收返还、减免                                                      |          |          |          |
| 3、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 752.42   | 703.60   | 189.70   |
| 4、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                | -        | -        | -        |
| 5、根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响                       | -        | -        | -        |
| 6、除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         | 1.79     | 0.08     | -9.24    |
| 7 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                          | -        | -        | -        |
| 非经常性损益合计                                                     | 929.78   | 893.40   | 356.48   |
| 减：所得税                                                        | 112.71   | 105.76   | 22.21    |
| 少数股东损益                                                       | -        | -        | -        |
| 扣除所得税、少数股东损益后的非经常性损益净额                                       | 817.06   | 787.64   | 334.27   |
| 归属于母公司所有者的净利润                                                | 5,268.05 | 4,663.14 | 3,514.35 |
| 扣除非经常性损益后的净利润                                                | 4,450.99 | 3,875.50 | 3,180.08 |

近三年，本公司非经常性损益对当期经营成果的影响均较小，2008-2010年非经常性损益净额占归属于母公司所有者的净利润的比重分别为9.51%、16.89%和15.51%，对公司经营业绩无重大影响。

## 五、主要资产情况

### （一）固定资产

本公司各类固定资产的分类折旧率如下：

| 资产类别   | 残值率    | 折旧年限    | 年折旧率       |
|--------|--------|---------|------------|
| 房屋及建筑物 | 10.00% | 20-38 年 | 2.37-4.50% |
| 机器设备   | 10.00% | 10 年    | 9.00%      |
| 检测设备   | 10.00% | 5 年     | 18.00%     |
| 办公电子设备 | 10.00% | 5 年     | 18.00%     |
| 运输工具   | 10.00% | 5 年     | 18.00%     |
| 其他设备   | 10.00% | 5 年     | 18.00%     |

截至2010年12月31日，本公司固定资产情况如下：

单位：万元

| 资产类别   | 原值        | 累计折旧     | 净值        | 减值准备 | 净额        |
|--------|-----------|----------|-----------|------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 14,050.01 | 1,444.64 | 12,605.36 | -    | 12,605.36 |
| 机器设备   | 28,243.81 | 7,087.69 | 21,156.12 | -    | 21,156.12 |
| 检测设备   | 618.95    | 352.59   | 266.36    | -    | 266.36    |

|        |           |          |           |   |           |
|--------|-----------|----------|-----------|---|-----------|
| 运输工具   | 51.36     | 35.68    | 15.68     | - | 15.68     |
| 办公电子设备 | 252.12    | 203.26   | 48.86     | - | 48.86     |
| 其他设备   | 104.76    | 86.87    | 17.89     | - | 17.89     |
| 合计     | 43,321.01 | 9,210.72 | 34,110.28 | - | 34,110.28 |

截至2010年12月31日，本公司用于抵押的固定资产账面净值为16,522.54万元。

## （二）对外投资

截至2010年12月31日，本公司无对外投资项目。

## （三）无形资产

单位：万元

| 类别    | 取得方式 | 原值       | 摊销年限   | 累计摊销额    | 减值准备   | 2010年12月31日 |
|-------|------|----------|--------|----------|--------|-------------|
|       |      |          |        |          |        | 账面价值        |
| 土地使用权 | 购买   | 488.55   | 50年    | 70.60    | -      | 417.96      |
| 专利权   | 股东投入 | 4,623.00 | 15-17年 | 957.81   | 507.54 | 3,157.64    |
| 软件    | 购买   | 19.88    | 5年     | 19.82    | -      | 0.06        |
| 其他    | 自主研发 | 914.45   | 20年    | 38.10    | -      | 876.35      |
| 合计    | -    | 6,045.89 | -      | 1,086.33 | 507.54 | 4,452.01    |

截至2010年12月31日，公司将其拥有的上述原值为488.55万元的土地使用权及原值为4,623万元的专利权用于抵押向银行申请贷款。

上述无形资产中的专利权，于股东投入时经深圳中联岳华会计师事务所进行了评估，并出具了深中岳评报字[2007]第007号资产评估报告书，本次评估方法采用收益法。

## 六、主要债项及股东权益

### （一）应付账款

报告期各期末，公司应付账款情况如下：

单位：万元

| 项目     | 2010年<br>12月31日 | 2009年<br>12月31日 | 2008年<br>12月31日 |
|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 应付账款金额 | 1,407.64        | 1,233.73        | 1,553.80        |
| 总负债    | 28,182.69       | 27,813.18       | 30,303.91       |
| 占总负债比例 | 4.99%           | 4.44%           | 5.13%           |

## （二）长期借款

单位：万元

| 借款类别       | 2010 年<br>12 月 31 日 | 2009 年<br>12 月 31 日 | 2008 年<br>12 月 31 日 |
|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 抵押、保证、质押借款 | 26,000.00           | 25,900.00           | 28,000.00           |
| 合计         | 26,000.00           | 25,900.00           | 28,000.00           |

## （三）股东权益情况

报告期各期末，公司股东权益情况如下：

单位：万元

| 股东权益          | 2010 年<br>12 月 31 日 | 2009 年<br>12 月 31 日 | 2008 年<br>12 月 31 日 |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 股本            | 12,000.00           | 12,000.00           | 10,000.00           |
| 资本公积          | 6,341.51            | 6,341.51            | 331.98              |
| 盈余公积          | 997.95              | 470.07              | 766.62              |
| 未分配利润         | 8,933.25            | 4,193.07            | 7,242.91            |
| 外币报表折算差额      | 13.92               | -0.03               | -                   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 28,286.63           | 23,004.63           | 18,341.51           |
| 少数股东权益        | -                   | -                   | -                   |
| 股东权益合计        | 28,286.63           | 23,004.63           | 18,341.51           |

### 1、股本

报告期各期末，公司股本情况如下：

单位：万元

| 股东     | 2010 年 12 月 31 日 |         | 2009 年 12 月 31 日 |         | 2008 年 12 月 31 日 |        |
|--------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|--------|
|        | 股本               | 比例      | 股本               | 比例      | 股本               | 比例     |
| 丹邦投资集团 | 7,311.60         | 60.93%  | 7,311.60         | 60.93%  | 6,093            | 60.93% |
| 益关寿    | 1,520.40         | 12.67%  | 1,520.40         | 12.67%  | 1,267            | 12.67% |
| 丹依科技   | 2,160            | 18%     | 2,160            | 18%     | 1,800            | 18%    |
| 信瑞鸿网络  | 480              | 4%      | 480              | 4%      | 400              | 4%     |
| 华浩投资   | 480              | 4%      | 480              | 4%      | 400              | 4%     |
| 百顺投资   | 48               | 0.4%    | 48               | 0.4%    | 40               | 0.4%   |
| 合计     | 12,000           | 100.00% | 12,000           | 100.00% | 10,000           | 100%   |

### 2、资本公积

报告期各期末，公司资本公积情况如下：

单位：万元

| 项目   | 2010 年 12 月 31 日 | 2009 年 12 月 31 日 | 2008 年 12 月 31 日 |
|------|------------------|------------------|------------------|
| 股本溢价 | 6,341.51         | 6,341.51         | 4.84             |

|        |          |          |        |
|--------|----------|----------|--------|
| 其他资本公积 | -        | -        | 327.14 |
| 合计     | 6,341.51 | 6,341.51 | 331.98 |

### 3、盈余公积

报告期各期末，公司盈余公积情况如下：

单位：万元

| 项目      | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
|---------|-------------|-------------|-------------|
| 法定盈余公积金 | 997.95      | 470.07      | 766.62      |
| 合计      | 997.95      | 470.07      | 766.62      |

### 4、未分配利润

报告期各期末，公司未分配利润情况如下：

单位：万元

| 项目             | 2010年<br>12月31日 | 2009年<br>12月31日 | 2008年<br>12月31日 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 未分配利润期初余额      | 4,193.07        | 7,242.91        | 4,079.99        |
| 加：归属于母公司股东的净利润 | 5,268.05        | 4,663.14        | 3,514.35        |
| 减：转作股本、资本公积的利润 |                 | 7,242.91        | -               |
| 提取法定盈余公积金      | 527.87          | 470.07          | 351.44          |
| 对股东的分配         | -               | -               | -               |
| 同一控制合并转回       | -               | -               | -               |
| 未分配利润期末余额      | 8,933.25        | 4,193.07        | 7,242.91        |

## 七、现金流量情况

单位：万元

| 项目            | 2010年度     | 2009年度    | 2008年度    |
|---------------|------------|-----------|-----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,774.78  | 9,251.43  | 4,698.07  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,192.10 | -4,413.70 | -6,662.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,005.10  | -3,796.89 | 2,738.13  |
| 汇率变动对现金的影响数   | -16.92     | -15.37    | -130.65   |
| 现金及现金等价物净增加额  | -3,439.34  | 1,025.46  | 643.41    |

## 八、财务报表附注中的重要事项

### （一）或有事项

截至资产负债表日，公司不存在需披露的重大或有事项。

## （二）其他重要事项

### 1、外币金融资产

单位：万元

| 项目              | 2009 年末  | 本期公允价值变动损益 | 本期计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 2010 年末  |
|-----------------|----------|------------|-----------------|---------|----------|
| 金融资产—<br>贷款及应收款 | 5,875.21 | -          | -               | -       | 9,571.54 |
| 金融负债            | 107.37   | -          | -               | -       | 632.24   |

### 2、其他

截至2008年12月31日止的净资产为18,341.51万元与公司整体变更为股份有限公司时所依据的经开元信德审计的净资产18,871.17万元相差529.65万元(差异原因主要系补提坏账准备、固定资产折旧、无形资产摊销)，公司将差额调整资本公积-股本溢价。

截至审计报告日，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 九、近三年主要财务指标

### （一）主要财务指标

| 项目                                       | 2010 年末<br>/2010 年 | 2009 年末/<br>2009 年 | 2008 年末/<br>2008 年 |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 流动比率                                     | 6.71               | 7.20               | 7.63               |
| 速动比率                                     | 5.89               | 5.97               | 7.18               |
| 资产负债率（母公司）                               | 49.81%             | 54.62%             | 62.30%             |
| 应收账款周转率<br>（次/年）                         | 4.04               | 2.88               | 3.36               |
| 存货周转率（次/年）                               | 4.93               | 5.16               | 8.42               |
| 息税折旧摊销前利润（万元）                            | 10,506.98          | 9,459.67           | 7,310.66           |
| 利息保障倍数                                   | 4.67               | 3.99               | 3.10               |
| 每股经营活动的现金流量（元/股）                         | 0.90               | 0.77               | 0.46               |
| 每股净现金流量（元/股）                             | -0.29              | 0.09               | 0.06               |
| 无形资产（扣除土地使用权、<br>水面养殖权和采矿权等后）占<br>净资产的比例 | 14.26%             | 14.81%             | 20.14%             |

计算公式如下：

流动比率=流动资产÷流动负债

速动比率 = (流动资产 - 存货) ÷ 流动负债

资产负债率 = (负债总额 ÷ 资产总额) × 100%

应收账款周转率 = 营业收入 ÷ 平均应收账款

存货周转率 = 营业成本 ÷ 平均存货

息税折旧摊销前利润 = 利润总额 + 利息支出 + 折旧费 + 无形资产摊销 + 长期待摊费用摊销

利息保障倍数 = (利润总额 + 利息支出) ÷ 利息支出

每股经营活动的现金流量 = 经营活动的现金流量净额 ÷ 年度末普通股份总数

每股净现金流量 = 现金及现金等价物净增加额 ÷ 年度末普通股份总数

## (二) 净资产收益率及每股收益

按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》要求计算如下：

| 期间     | 项目                      | 加权平均净资产收益率 | 每股收益      |           |
|--------|-------------------------|------------|-----------|-----------|
|        |                         |            | 基本每股收益(元) | 稀释每股收益(元) |
| 2010年度 | 归属于公司普通股股东的净利润          | 20.53%     | 0.44      | 0.44      |
|        | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 17.33%     | 0.37      | 0.37      |
| 2009年度 | 归属于公司普通股股东的净利润          | 22.56%     | 0.39      | 0.39      |
|        | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 18.75%     | 0.32      | 0.32      |
| 2008年度 | 归属于公司普通股股东的净利润          | 21.19%     | —         | —         |
|        | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 19.18%     | —         | —         |

计算公式如下：

### 1、加权平均净资产收益率

加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 =  $P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中：P<sub>0</sub> 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增的、归

属于公司普通股股东的净资产； $E_j$ 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产； $M_0$ 为报告期月份数； $M_i$ 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数； $M_j$ 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数； $E_k$ 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动； $M_k$ 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

## 2、基本每股收益

基本每股收益= $P_0 \div S$

$$S=S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中： $P_0$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润； $S$ 为发行在外的普通股加权平均数； $S_0$ 为期初股份总数； $S_1$ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； $S_i$ 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； $S_j$ 为报告期因回购等减少股份数； $S_k$ 为报告期缩股数； $M_0$ 为报告期月份数； $M_i$ 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； $M_j$ 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

## 3、稀释每股收益

稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， $P_1$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

# 十、历次验资、评估情况

## （一）历次验资情况

公司历次验资情况详见本招股书第四节之“五、发行人历次股本变化的验资



情况”。

## **（二）历次评估情况**

报告期内公司资产评估情况如下：

### **1、2007 年无形资产出资的资产评估**

2007 年 1 月 21 日，深圳中联岳华会计师事务所接受刘萍、丹邦科技、丹依科技的委托，对 UV 固化可剥离压敏胶膜等 4 项发明专利进行了评估，出具了深中岳评报字[2007]第 007 号资产评估报告书，本次评估方法采用收益法，评估基准日为 2006 年 12 月 31 日，拟投资的发明专利评估值为 4,843 万元。

### **2、2009 年无形资产减值测试的资产评估**

2009 年 1 月 19 日，北京中盛联盟资产评估有限公司接受丹邦科技的委托，对 UV 固化可剥离压敏胶膜等 4 项发明专利于评估基准日 2008 年 12 月 31 日的预计未来现金流量的现值进行了评估，并出具了中盛联盟（北京）A 评报字（2009）第 010 号的评估报告。本次评估方法采用收益法，上述 4 项发明专利评估前的账面价值为 4,194.94 万元，评估值为 3,687.40 万元，增值额为-507.54 万元。导致评估值低于无形资产账面价值的主要原因为：企业销售的增速已经趋缓，已经进入稳定增长期。公司产品销售单价趋于稳定，产品已经完成市场定价过程，现有价格基本稳定合理，而产品单位成本进一步下降的空间在缩小。

### **3、2010 年无形资产减值测试的资产评估**

2010 年 8 月 25 日，开元资产评估有限公司接受丹邦科技的委托，为了给丹邦科技对其 UV 固化可剥离压敏胶膜等四项发明专利进行减值测试提供参考依据，对 UV 固化可剥离压敏胶膜等四项发明专利于评估基准日 2009 年 12 月 31 日的预计未来现金流量的现值进行了评估，并出具了开元深评报字[2010]第 096 号评估报告书。本次评估方法采用收益法，上述 4 项发明专利评估前的账面价值为 3,407.20 万元，评估值为 3,969.40 万元。

### **4、2008 年出售设备的资产评估**

2008 年 7 月 15 日，广东中广信资产评估有限公司接受丹邦科技委托，对丹邦科技拟转让的机器设备进行了评估，并出具了中广信报字[2008]第 043 号的评

估报告。拟转让的机器设备截至 2008 年 6 月 30 日的账面原值为 952.98 万元，账面净值为 794.05 万元，本次评估采用重置成本法，评估净值为 804.35 万元，评估增值 10.30 万元。

#### **5、2010 年资产评估专项复核**

2010 年 8 月 19 日，开元资产评估有限公司接受丹邦科技委托，对深圳中联岳华会计师事务所出具的深中岳评报字（2007）第 007 号《UV 固化可剥离压敏胶膜等 4 项发明专利资产评估报告书》进行了复核，并出具了开元（深）评复字[2010]第 008 号的专项复核报告。复核意见认为，《评估报告书》的格式符合规范；评估基准日的选择适当，且由双方约定；评估所依据的法律法规和政策合理；评估方法的应用恰当，评估过程步骤符合规范惯例的要求；《评估报告书》对 UV 固化可剥离压敏胶膜等 4 项发明专利于评估基准日 2006 年 12 月 31 日评估值为 4,843 万元，评估值公允合理；对评估结果产生重大影响的事项已明示。

2010 年 8 月 19 日，开元资产评估有限公司接受丹邦科技委托，对北京中盛联盟资产评估有限公司出具的中盛联盟（北京）A 评报字（2009）第 010 号“UV 固化可剥离压敏胶膜等 4 项发明专利减值测试评估报告书”（以下简称“评估报告书”）进行了复核，并出具了开元（深）评复字[2010]第 007 号的专项复核报告。复核意见认为，《评估报告书》的格式符合规范；评估基准日的选择适当，且由双方约定；评估所依据的法律法规和政策合理；评估方法的应用恰当，评估过程步骤符合规范惯例的要求，《评估报告书》对 UV 固化可剥离压敏胶膜等 4 项发明专利于评估基准日 2008 年 12 月 31 日评估值为 3,687.40 万元，评估值公允合理；对评估结果产生重大影响的事项已明示。

## 第十节 管理层讨论与分析

### 一、财务状况分析

#### (一) 资产结构分析

##### 1、资产规模

报告期内，本公司资产规模呈稳定增长趋势。2008-2010 年末，公司资产总额分别为 48,645.42 万元、50,817.81 万元、56,469.32 万元。

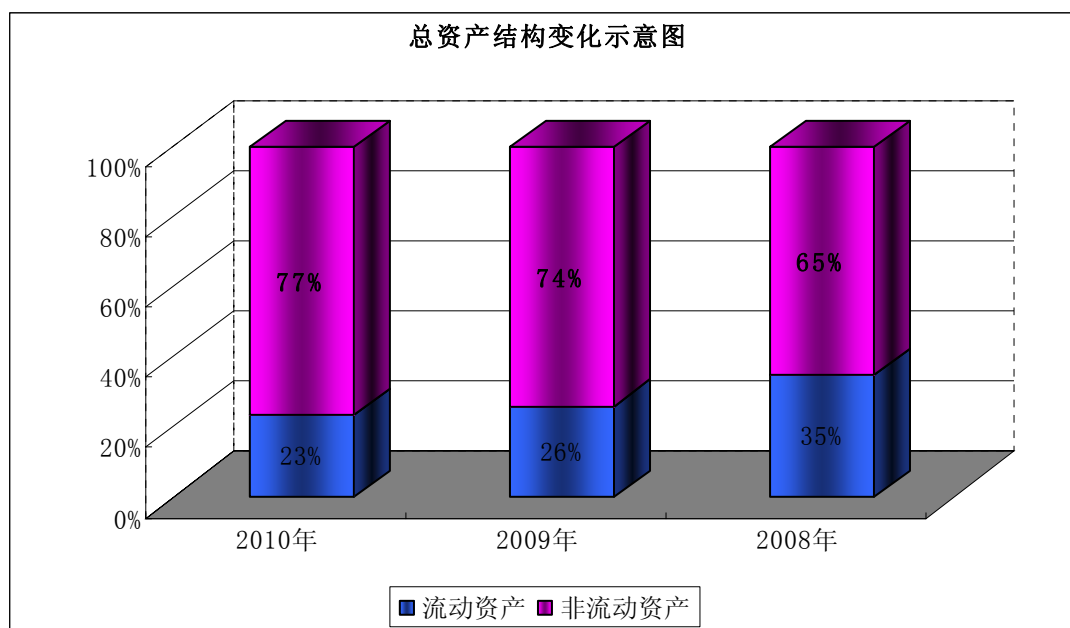
##### 2、总体资产结构

报告期各期末，公司各类资产占总资产比例如下表所示：

单位：万元

| 项目      | 2010 年 12 月 31 日 |         | 2009 年 12 月 31 日 |         | 2008 年 12 月 31 日 |         |
|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|
|         | 金额               | 比例      | 金额               | 比例      | 金额               | 比例      |
| 货币资金    | 2,050.44         | 3.63%   | 4,974.78         | 9.79%   | 3,949.32         | 8.12%   |
| 应收账款    | 4,592.96         | 8.13%   | 5,589.65         | 11.00%  | 6,521.74         | 13.41%  |
| 预付款项    | 4,507.55         | 7.98%   | 139.06           | 0.27%   | 5,426.55         | 11.16%  |
| 其他应收款   | 439.34           | 0.78%   | 283.89           | 0.56%   | 129.15           | 0.27%   |
| 存货      | 1,603.33         | 2.84%   | 2,276.99         | 4.48%   | 998.44           | 2.05%   |
| 流动资产小计  | 13,193.63        | 23.36%  | 13,264.37        | 26.10%  | 17,025.20        | 35.00%  |
| 固定资产    | 34,110.28        | 60.40%  | 31,034.46        | 61.07%  | 26,992.52        | 55.49%  |
| 在建工程    | -                | -       | 1,822.38         | 3.59%   | 402.79           | 0.83%   |
| 工程物资    | 3,803.32         | 6.74%   | 17.17            | 0.03%   | 1.18             | -       |
| 无形资产    | 4,452.01         | 7.88%   | 3,837.09         | 7.55%   | 4,138.22         | 8.51%   |
| 开发支出    | 800.29           | 1.42%   | 752.19           | 1.48%   | -                | -       |
| 递延所得税资产 | 109.78           | 0.19%   | 90.15            | 0.18%   | 85.51            | 0.18%   |
| 非流动资产小计 | 43,275.69        | 76.64%  | 37,553.44        | 73.90%  | 31,620.22        | 65.00%  |
| 资产合计    | 56,469.32        | 100.00% | 50,817.81        | 100.00% | 48,645.42        | 100.00% |

报告期各期末，公司总资产结构如图所示：



报告期各期末，公司流动资产占总资产的比例均低于 35%，流动资产主要是货币资金、应收账款及存货；非流动资产占总资产的比例均超过 65%，以固定资产、无形资产及在建工程为主，其中占比最高的固定资产主要是与生产经营密切相关的机器设备、检测设备、运输工具及房屋建筑物等，资产使用状况良好。

### 3、货币资金分析

2008-2010 年末，公司货币资金分别为 3,949.32 万元、4,974.78 万元、2,050.44 万元，占总资产的比例分别为 8.12%、9.79%、3.63%，公司货币资金占总资产的比例保持在 3%以上，保持在合理的水平，主要是公司经营状况良好，持续盈利不断流入现金所致。

2010 年末货币资金较 2009 年末减少 58.78%，主要是因为公司于 2010 年年底根据本次募集资金投资项目进度采购机器设备预付货款所致。

### 4、应收账款分析

#### (1) 销售结算方式

##### ①境内销售

报告期内，公司境内销售收入占主营业务收入比重在 1%左右，占比很低。对于境内销售，公司与客户签订合同后，一般要求客户先支付合同金额的 50%作为定金，待公司完成产成品、客户将剩余的 50%合同金额支付给公司后，公司才

予以发货。

## ②境外销售

报告期内，公司境外销售收入均超过公司主营业务收入的 98%。外销结算主要采用电汇（T/T）方式，T/T 结算分为前 T/T 和后 T/T。前 T/T 指客户付清全部货款后公司再开具提单；后 T/T 指客户在公司发货并开具提单后的一定期限内付款。由于公司境外客户多为资金实力较强且信誉良好的知名客户，包括夏普、日立、三协、电产等公司，故公司在外销中采用后 T/T 结算方式，一般给予客户 60-90 天不等的信用账期。报告期内，公司未发生坏账损失。

### （2）应收账款变动原因分析

报告期内，公司应收账款净额与流动资产、总资产、营业收入的比例如下：

单位：万元

| 项目            | 2010 年<br>12 月 31 日 | 2009 年<br>12 月 31 日 | 2008 年<br>12 月 31 日 |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 应收账款净额        | 4,592.96            | 5,589.65            | 6,521.74            |
| 占流动资产比例       | 34.81%              | 42.14%              | 38.31%              |
| 占总资产比例        | 8.13%               | 11.00%              | 13.41%              |
| 占当年营业收入比例     | 22.33%              | 30.47%              | 38.02%              |
| 占当年第四季度销售收入比例 | 93.07%              | 94.41%              | 97.76%              |

报告期内，公司应收账款占营业收入的比例较高，主要系公司外销采用后 T/T 的结算方式，且给予客户 60-90 天不等的信用账期，各期末截至前二至三个月的销售收入形成应收账款。

2008 年末，公司应收账款净额为 6,521.74 万元，占全年营业收入的比例达到 38.02%，主要原因为：

①受 2008 年世界金融危机的影响，部分客户由于其产品市场前景不够明朗，要求将 2008 年中签订的合同或订单推迟履行。在公司的催促下，2008 年下半年上述合同或订单继续履行，导致 2008 年下半年销售收入骤增，2008 年第四季度的销售收入达到 6,671.31 万元，占该年销售收入的 38.90%。因公司给予客户的信用账期一般为 60-90 天，故 2008 年第四季度实现的销售收入大多形成应收账款，使得 2008 年末应收账款金额较大，2008 年末信用账期为 90 天的应收账款

占比为 96.00%。

②受 2008 年金融危机的影响，公司为稳定销售规模，在不影响公司日常经营资金周转的前提下，自 2008 年 9 月 1 日起对信用级别高、合作时间长的优质客户，适当延长信用期至 120 天。信用账期的调整一定程度上增加了应收账款。

2009 年末，公司应收账款净额为 5,589.65 万元，比 2008 年减少 932.09 万元，下降 14.29%，主要是由于 2009 年经济好转，2009 年末没有出现 2008 年第四季度集中交货确认收入的情况。2009 年第四季度销售收入为 5,858.63 万元，2009 年末信用账期为 90 天的应收账款占比为 95.00%。

2010 年末的应收账款较 2009 年末减少 17.83%，主要是由公司销售模式决定的。公司执行以销定产的模式，根据下游客户的订单来生产，客户订单影响公司销售收入的月份分布。2010 年公司订单恢复到 2008 年金融危机前的分布情况，未出现 2008 年下半年、2009 年下半年订单激增的情况，使得 2010 年应收账款较 2009 年下降较大。

### （3）报告期各期应收账款与营业收入的对比分析

①报告期各期末应收账款余额及增长幅度如下：

单位：万元

| 项目          | 2010 年 12 月 31 日 | 2009 年 12 月 31 日 | 2008 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 应收账款账面余额    | 4,834.70         | 5,884.07         | 6,865.04         |
| 各年末较上年末增长额  | -1,049.37        | -980.98          | 3,508.05         |
| 各年末较上年末增长比例 | -17.83%          | -14.29%          | 104.50%          |

②报告期各期营业收入增长情况如下：

单位：万元

| 项目          | 2010 年度   | 2009 年度   | 2008 年度   |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 营业收入        | 20,567.36 | 18,347.60 | 17,151.52 |
| 各年度较上年度增长额  | 2,219.76  | 1,196.08  | 3,779.34  |
| 各年度较上年度增长比例 | 12.10%    | 6.97%     | 28.26%    |

从上表可以看出，2008 年应收账款超过营业收入的增长速度，其主要原因如下：

A、2008 年第四季度集中交货，收入骤增

受金融危机影响，公司部分客户要求订单延迟履行，将 2008 年上半年及中

期签订的订单推迟交货，2008 年第四季度为减少存货占用资金，在公司多次催促及要求下，上述未按期履行的订单在 2008 年下半年陆续履行，特别是在 10、11、12 月发货量骤增，仅此 3 个月累计确认收入的金额为 6,671.31 万元。在合理信用政策下，期末应收账款大幅增加。

#### B、合理延长信用期

2008 年由于金融危机对下游客户的影响，公司为稳定销售规模，在不影响公司日常经营资金周转的前提下，自 2008 年 9 月 1 日起对部分信用级别高、合作时间长的优质客户适当延长信用期至 120 天。2008 年 9-12 月的集中交货及信用期的适当延长，造成 2008 年末应收账款大幅上涨。

根据公司应收账款的信用账期政策，公司每年的9、10、11、12月份实现的营业收入主要体现为债权性的收益。此部分债权性的收益均于次年收回。公司的大部分客户均为信用良好、收益稳定的国外大型知名企业，且公司与其保持着良好的合作关系，未曾发生过质量纠纷，故公司的应收账款回收情况良好。

#### (4) 最近一年应收账款前五名的情况

截至 2010 年 12 月 31 日，公司应收账款前五名情况如下：

单位：万元

| 单位名称                                     | 应收金额     | 占比     | 账龄    |
|------------------------------------------|----------|--------|-------|
| Z. KURODAELECTRIC (HONGKONG) CO., LTD.   | 874.11   | 18.08% | 1 年以内 |
| EYE-LOT CO., LTD.                        | 642.94   | 13.30% | 1 年以内 |
| DMLSOURCING LTD.                         | 430.32   | 8.90%  | 1 年以内 |
| NIDEC. CORPORATION. SHIGATECHNICALCENTER | 277.29   | 5.74%  | 1 年以内 |
| 川奇光电科技(扬州)有限公司                           | 254.71   | 5.27%  | 1 年以内 |
| 合 计                                      | 2,479.37 | 51.29% | -     |

本公司 2010 年 12 月末应收账款余额中不存在持股 5%以上股东及关联单位欠款。

#### (5) 坏账准备计提政策和实际计提情况

公司按谨慎原则对应收账款进行坏账准备的计提，具体是：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试；对于单项金额不重大的应收款项，按照账龄分析法计提坏账准备，具体计提比例：账龄 1 年以内，计提比例为 5%；账龄 1-2 年，计提比例为 10%；账龄 2-3 年，计提比例为 20%；账龄 3-4 年，计提比例为

50%；账龄 4-5 年，计提比例为 80%；账龄 5 年以上，计提比例为 100%。2008-2010 年末按照账龄分析法计提坏账准备情况如下：

单位：万元

| 账龄               | 2010 年 12 月 31 日 |         |        |          | 计提比例  |
|------------------|------------------|---------|--------|----------|-------|
|                  | 账面余额             | 比例      | 坏账准备   | 账面净值     |       |
| 1 年以内            | 4,834.70         | 100.00% | 241.73 | 4,592.97 | 5%    |
| 1-2 年            | -                | -       | -      | -        | 10%   |
| 2-3 年            | -                | -       | -      | -        | 20%   |
| 3-4 年            | -                | -       | -      | -        | 50%   |
| 4-5 年            | -                | -       | -      | -        | 80%   |
| 5 年以上            | -                | -       | -      | -        | 100%  |
| 合 计              | 4,834.70         | 100.00% | 241.73 | 4,592.97 | 5%    |
| 2009 年 12 月 31 日 |                  |         |        |          |       |
| 1 年以内            | 5,882.45         | 99.97%  | 294.12 | 5,588.33 | 5%    |
| 1-2 年            | 1.28             | 0.02%   | 0.13   | 1.15     | 10%   |
| 2-3 年            | -                | -       | -      | -        | 20%   |
| 3-4 年            | 0.33             | 0.01%   | 0.17   | 0.17     | 50%   |
| 4-5 年            | -                | -       | -      | -        | 80%   |
| 5 年以上            | -                | -       | -      | -        | 100%  |
| 合 计              | 5,884.07         | 100.00% | 294.42 | 5,589.65 | 5%    |
| 2008 年 12 月 31 日 |                  |         |        |          |       |
| 1 年以内            | 6,864.71         | 99.99%  | 343.24 | 6,521.47 | 5%    |
| 1-2 年            | -                | -       | -      | -        | 10%   |
| 2-3 年            | 0.33             | 0.01%   | 0.06   | 0.27     | 20%   |
| 3-4 年            | -                | -       | -      | -        | 50%   |
| 4-5 年            | -                | -       | -      | -        | 80%   |
| 5 年以上            | -                | -       | -      | -        | 100%  |
| 合 计              | 6,865.04         | 100.00% | 343.30 | 6,521.74 | 5.00% |

2008-2010 年末，公司应收账款账龄在 1 年以内的占比均超过 99%，说明本公司应收账款综合账龄较短。报告期内公司未发生坏账损失。综上分析，公司坏账准备计提充分、合理，应收账款风险较小。

#### (6) 应收账款管理

公司针对不同规模的客户给予不同的信用账期。对于部分世界知名、资信良好的客户，公司在签订合同时即给予其 90 天的信用账期；对于一般的中小型客户，公司在与其交易初期给予 60 天的信用账期，同时公司会根据客户的回款情况进行信用评估并对其信用账期进行调整。

公司应收账款实行月结方式。每月 10 日前，公司财务部统计客户的应收账



款情况，对于已超过信用账期尚未回款的客户，财务部会通知市场开发与服务部及时催款。对于超过信用账期一个月还没有付款的客户，公司则暂停向其供货。

## 5、预付款项分析

公司的预付款项主要为设备款及工程款。2008-2010 年末，预付款项分别为 5,426.55 万元、139.06 万元、4,507.55 万元。

报告期内，公司预付款项前五名供应商如下：

单位：万元

| 年度      | 单位名称                        | 预付金额     | 占比     | 性质     |
|---------|-----------------------------|----------|--------|--------|
| 2010 年末 | A CELLAR LTD.               | 3,071.90 | 68.15% | 设备尚未入库 |
|         | LENDEX INVESTMENT LTD.      | 1,240.03 | 27.51% | 设备尚未入库 |
|         | 国浩律师集团(深圳)事务所               | 50.00    | 1.11%  | 律师费    |
|         | 天健会计师事务所                    | 25.00    | 0.55%  | 审计费    |
|         | 国信证券股份有限公司                  | 25.00    | 0.55%  | 上市辅导费  |
|         | 合 计                         | 4,411.93 | 97.88% | -      |
| 2009 年末 | 国浩律师集团（深圳）事务所               | 30.00    | 21.57% | 律师费    |
|         | 国信证券股份有限公司                  | 25.00    | 17.98% | 上市辅导费  |
|         | 天健会计师事务所                    | 20.00    | 14.38% | 审计费    |
|         | 源记贸易有限会社                    | 17.71    | 12.74% | 设备款    |
|         | 深圳市迈达尔工业工程有限公司              | 10.59    | 7.62%  | 工程款    |
|         | 合 计                         | 103.30   | 74.28% | -      |
| 2008 年末 | DBL International (HK) LTD. | 5,274.69 | 97.20% | 设备款    |
|         | 深圳市迈达尔工业工程有限公司              | 76.00    | 1.40%  | 工程款    |
|         | 神力集团机械有限公司                  | 23.44    | 0.43%  | 设备款    |
|         | 广州市环境保护工程设计院有限公司            | 12.00    | 0.22%  | 工程设计费  |
|         | 登泰电路机械股份有限公司                | 10.05    | 0.19%  | 设备款    |
|         | 合 计                         | 5,396.18 | 99.44% | -      |

2008 年末，公司预付款项余额为 5,426.55 万元，占同期总资产的比例为 11.16%，占比较大，主要原因为：公司 2007 年开始对 FPC 的生产设备进行更新改造，以满足扩大 COF 柔性封装基板的产能需要；以及为了提高 COF 柔性封装基板产能，公司于 2008 年采购了相关机器设备及检测设备，并按照采购合同约定预付了货款。

2009 年末，预付款项余额大幅减少，主要原因是前期已预付采购款的机器设备于本期到货并交付使用而转入固定资产所致。

2010 年 12 月末，预付款项为 4,507.55 万元，主要为支付给 A CELLAR LTD.

及LENDEX INVESTMENT LTD.的设备采购预付款，其中支付给A CELLAR LTD的款项主要是公司募投项目实施预付了机器设备采购款。

2008年末，公司的预付款项主要为预付给第比尔国际的原因：2009年8月以前，公司的部分境外设备采购在形式上经由关联方第比尔国际进行，公司根据采购合同约定先向第比尔国际支付款项，第比尔国际将收到的货款再转付给公司境外实际供应商。因此，2008年末预付款项主要为通过第比尔国际预付给境外供应商的设备采购款，2008年末，公司预付第比尔国际的设备采购款为5,274.69万元。

报告期内，预付款项的具体账龄结构如下表：

单位：万元

| 项目   | 2010年12月31日 |         | 2009年12月31日 |         | 2008年12月31日 |         |
|------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
|      | 金额          | 占比      | 金额          | 占比      | 金额          | 占比      |
| 1年以内 | 4,412.55    | 97.89%  | 54.06       | 38.88%  | 5,398.10    | 99.48%  |
| 1年以上 | 95.00       | 2.11%   | 85.00       | 61.12%  | 28.45       | 0.52%   |
| 合 计  | 4,507.55    | 100.00% | 139.06      | 100.00% | 5,426.55    | 100.00% |

从账龄来看，报告期内公司预付款项除了2009年末以外账龄绝大部分为1年以内，本公司预付款项的账期较短，风险较小。

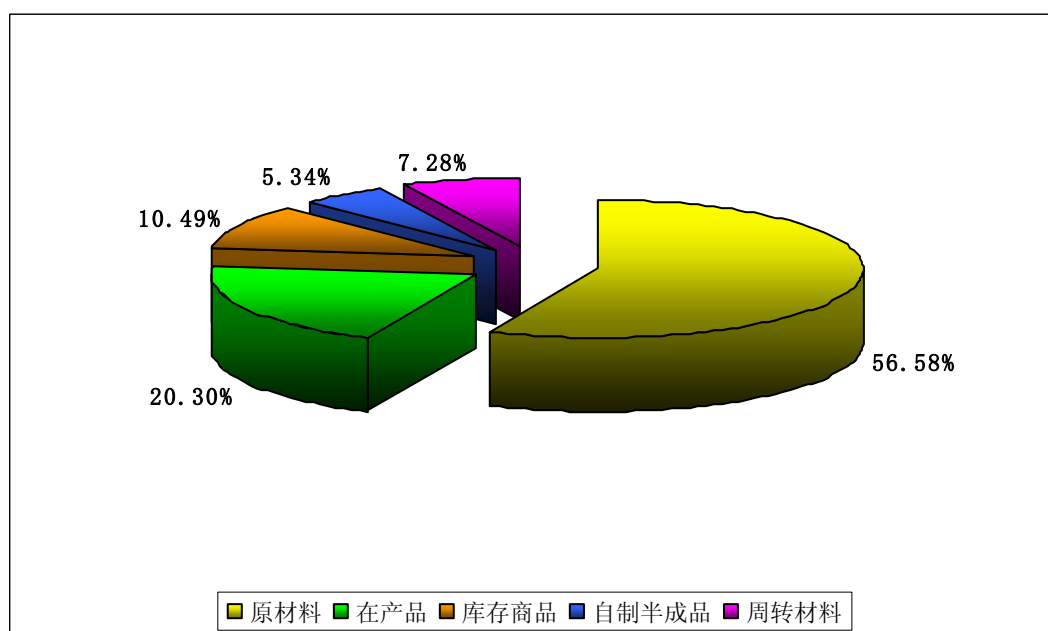
## 6、存货

公司的存货主要为原材料、在产品和产成品。报告期各期末，公司存货明细及占总资产及主营业务收入的比例如下：

单位：万元

| 项目         | 2010年<br>12月31日 | 2009年<br>12月31日 | 2008年<br>12月31日 |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 存货金额       | 1,603.33        | 2,276.99        | 998.44          |
| 其中：原材料     | 907.14          | 846.97          | 332.63          |
| 在产品        | 325.50          | 816.53          | 272.80          |
| 库存商品       | 168.25          | 382.22          | 340.85          |
| 自制半成品      | 85.68           | 158.53          | 32.00           |
| 周转材料       | 116.76          | 72.74           | 20.16           |
| 存货跌价准备     | -               | -               | -               |
| 占总资产的比例    | 2.84%           | 4.48%           | 2.05%           |
| 占主营业务收入的比例 | 7.87%           | 12.47%          | 5.83%           |

2010 年 12 月 31 日的存货构成比例情况如下图表示：



### (1) 存货结构分析

报告期各期末公司存货变动较大，但存货占总资产的比例较低。存货中以原材料及在产品为主，合计占比超过 60%。

原材料占比较大是由公司的采购模式所决定，公司资材部一般根据市场开发与服务部提供的订单信息制定采购计划以应对生产需求。公司超过 50% 的原材料需从国外进口，采购周期较长，比如原材料中占比较大的 PI 膜的采购周期大概为 2 个月。

库存产品占比较小是公司以销定产的生产模式所致。生产部门需根据订单的交货期制定生产计划，安排生产，以减少库存产品的在库时间。

### (2) 存货变动分析

2009 年末存货余额为 2,276.99 万元，明显高于 2008 年末水平，主要原因为：

①受金融危机影响，2008 年存货储备量低。

2008 年，受金融危机影响，公司大部分客户的经营活动不能按照既定计划进行，要求公司将 2008 年中签订的订单推迟交货。但由于此前公司已对接到的订单进行了备料，为减少公司存货占用过多资金，公司决定自 2008 年 9 月 1 日起，对部分信用级别高、合作时间长的优质客户，适当延长信用账期至 120 天的

宽松信用政策。上述措施使得未履行的订单在 2008 年下半年陆续得以履行，存货储备日趋减少。同时，在 2008 年年底公司接到的需在 2009 年年初履行的订单量大幅减少，为不占用资金，公司 2008 年末备货量低于公司正常生产经营需要的备货水平。

②2009 年末已签订需在 2010 年第一季度交付的订单大幅增长，存货贮备增加。

受金融危机影响，公司 2009 年第一季度销量较上年同期相比严重下滑，降幅高达 24.37%。随着经济的逐渐回暖，自 2009 年 5 月起，公司凭借技术、产品品质和成本等方面的优势，逐步消除金融危机的影响，客户订单量激增。

同时，在 2009 年第四季度，在原前三个季度大量订单未完成的情况下，又新增订单 5,101.75 万元，公司加大 2009 年末的生产，以备 2010 年初客户的集中提货。在满负荷生产的情况下，2010 年一季度扣除春节的影响，公司共履行订单相对应的不含税销售收入额为 3,038.39 万元。

③增加 02 专项研发材料储备。公司承担的国家重大专项（02 专项）的课题研究所需的研发材料较多，2010 年进入研发的突破性阶段，为加大研发力度，2009 年末增加研发材料储备 240 万元。

④正常的备货。公司主要原材料铜箔、PI 膜均需进口，从订单到验收入库，正常的采购周期约为 2 个月，一般情况下，公司会根据未来需履行交货情况，正常储备 2 个或 2 个半月生产经营所需的原材料。

2010 年末存货余额为 1,603.33 万元，较 2009 年末减少 673.66 万元，主要原因有：

①2010 年，因金融危机的影响已消除，公司及其客户的采购、生产、销售逐步回到正轨，不存在 2009 年 1-4 月份生产不饱和、5-12 月份超负荷生产的情形，以致大量未完成的订单压至次年初履行的现象，公司基本按照以销定产的策略合理安排生产，不存在大量订单需在 2011 年年初履行。至 2010 年 12 月 31 日，公司已签订未履行的订单额为 2,035.46 万元。

②02 专项研发储备减少。根据 02 专项预算，2011 年较 2010 年所需投入研

发用料大幅减少，全年所需材料仅为 170 万元，公司于 2010 年对研发材料储备为 70 万元。

公司按照期末单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。报告期各期末，公司产品销售情况良好，期末存货可变现净值高于成本，因此不存在减值情况，未计提减值准备。同时，公司实行以销定产的策略，报告期内公司产品销售状况良好，不存在滞销情况。

## 7、固定资产

报告期各期末，公司固定资产的具体情况如下：

单位：万元

| 项目      | 2010 年<br>12 月 31 日 | 2009 年<br>12 月 31 日 | 2008 年<br>12 月 31 日 |
|---------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 固定资产原值： |                     |                     |                     |
| 房屋及建筑物  | 14,050.01           | 10,044.70           | 9,907.15            |
| 机器设备    | 28,243.81           | 26,280.60           | 20,389.44           |
| 检查设备    | 618.95              | 612.80              | 360.10              |
| 运输工具    | 51.36               | 51.26               | 59.70               |
| 办公电子设备  | 252.12              | 249.53              | 243.38              |
| 其他设备    | 104.76              | 103.60              | 98.50               |
| 合 计     | 43,321.01           | 37,342.49           | 31,058.27           |
| 累计折旧：   |                     |                     |                     |
| 房屋及建筑物  | 1,444.64            | 1,126.36            | 855.50              |
| 机器设备    | 7,087.69            | 4,617.91            | 2,775.80            |
| 检查设备    | 352.59              | 291.25              | 211.91              |
| 运输工具    | 35.68               | 19.80               | 19.68               |
| 办公电子设备  | 203.26              | 174.96              | 142.69              |
| 其他设备    | 86.86               | 77.75               | 60.17               |
| 合 计     | 9,210.72            | 6,308.03            | 4,065.75            |
| 减值准备    | -                   | -                   | -                   |
| 固定资产净值  | 34,110.28           | 31,034.46           | 26,992.52           |
| 成新率     | 78.74%              | 83.11%              | 86.91%              |
| 已抵押固定资产 | 16,522.54           | 9,332.22            | 9,725.20            |

报告期内，公司固定资产账面净值占总资产的比重较大，其中主要是生产用机器设备、房屋及建筑物。报告期各期末，机器设备、房屋及建筑物占固定资产净值比例均超过 90%。报告期内，公司的固定资产占总资产的比重分别为 55.49%、61.07%、60.41%，主要是由于公司是典型的生产型企业，需投入较多的机器设备

和厂房，同时由于公司所生产的产品对机器设备的性能等指标要求较高，公司的机器设备依靠进口较多，单位价值较大。公司的机器设备主要是购自日本 GODO KIKO CO., LTD. 和 TORAY ENGINEERING CO., LTD. 等公司的专业生产设备，处于该行业国际先进水平。

2008 年，公司固定原值增加 12,894.99 万元，其中机器设备增加 12,814.50 万元，系公司为调整产品结构，扩大生产规模，增加高附加值 COF 柔性封装基板及 COF 产品产能而采购了印刷基板镀金装置、露光机、蚀刻去膜线机等机器设备，以及为提高用于生产 COF 柔性封装基板及 COF 产品的主要基材 FCCL 的生产能力而购买了微电子涂布机、电磁加热覆合机、特殊雾围 R-R 热处理工程装置等设备。

2009 年，公司固定资产原值增加 6,789.54 万元，其中机械设备增加 6,374.86 万元，系公司为扩大 COF 柔性封装基板产能而购买了 LCP 净化涂布机装置、蚀刻线、蚀刻线等机器设备。此外，公司增加研发投入，新购买了自动光学检测机等先进的检测设备，导致检测设备增加 254.72 万元。

2010 年，固定资产原值增加 5,978.52 万元，主要包括两部分：房屋建筑物、机械设备分别增加 4,005.31 万元、1,973.21 万元，主要是由于公司为了加强环境保护，在环保方面投入的 30T/DI 水系统设备工程、环保设备工程、车间净化整体改造工程完工验收转入固定资产。

2010 年 12 月末，本公司固定资产的成新率为 78.74%，资产状况良好，不存在固定资产账面价值低于可收回金额的情况，故未计提减值准备。

## 8、在建工程分析

2008-2010 年末，公司在建工程余额分别为 402.79 万元、1,822.38 万元、0 万元。各期末在建工程变动如下：

单位：万元

| 年度     | 变动   | 30T/DI 水<br>系统工程 | 环保工程     | 净化设备及<br>施工工程 | COF 生产线  | 其他       | 合计        |
|--------|------|------------------|----------|---------------|----------|----------|-----------|
| 2008 年 | 本年增加 | 35.08            | 1,828.89 | 43.26         | 501.11   | 2,231.12 | 4,639.46  |
|        | 本年减少 | -                | 1,806.65 | 5.64          | 6,458.13 | 2,226.66 | 10,497.08 |
|        | 年末余额 | 132.55           | 205.18   | 60.61         | -        | 4.46     | 402.79    |
| 2009 年 | 本年增加 | 1,459.44         | 46.61    | 91.84         | -        | -        | 1,597.89  |
|        | 本年减少 | 87.44            | 47.59    | 38.81         | -        | 4.46     | 178.30    |
|        | 年末余额 | 1,504.55         | 204.20   | 113.63        | -        | -        | 1,822.38  |

|        |      |          |          |          |   |   |          |
|--------|------|----------|----------|----------|---|---|----------|
| 2010 年 | 本期增加 | 460.00   | 2,015.54 | 1,567.02 | - | - | 4,042.58 |
|        | 本期减少 | 1,964.55 | 2,219.74 | 1,680.65 | - | - | 5,864.94 |
|        | 期末余额 | -        | -        | -        | - | - | -        |

2008 年，在建工程增加 4,639.46 万元，减少 10,497.08 万元，主要系 2007 年及以前采购的机器设备达到可使用状态转入固定资产，在建工程余额 402.79 万元，主要为零星工程。

2009 年，在建工程增加 1,597.89 万元，主要是由于公司为了提高污水处理能力，新构建了 30T/DI 水系统设备工程，此工程于 2010 年上半年竣工验收并投入使用。

2010 年，在建工程增加 4,042.56 万元，减少 5,864.94 万元，余额为 0 万元。公司产品对生产车间的环境要求高（比如浮尘数量、静电水平等参数标准），相应的资金投入较大，随着对环境要求更高的 COF 产品的投产，公司加大了生产车间环境的更新改造，主要包括环保工程、车间净化整体改造工程。报告期内，上述两项工程分别累计投入 3,844.44 万元、1,725.11 万元，均于 2010 年上半年竣工投入使用。

公司在建工程不存在资产减值情形，故未计提减值准备。

## 9、无形资产分析

本公司无形资产主要包括专利权、土地使用权、软件及其他等。报告期各期末，公司无形资产的具体情况如下：

单位：万元

| 项目    | 2010 年<br>12 月 31 日 | 2009 年<br>12 月 31 日 | 2008 年<br>12 月 31 日 |
|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 原值：   |                     |                     |                     |
| 土地使用权 | 488.55              | 488.55              | 488.55              |
| 专利权   | 4,623.00            | 4,623.00            | 4,623.00            |
| 软件    | 19.88               | 19.89               | 19.89               |
| 其他    | 914.45              | -                   | -                   |
| 合 计   | 6,045.89            | 5,131.44            | 5,131.44            |
| 累计摊销： |                     |                     |                     |
| 土地使用权 | 70.60               | 57.50               | 44.40               |
| 专利权   | 957.81              | 712.12              | 428.06              |
| 软件    | 19.82               | 17.19               | 13.21               |
| 其他    | 38.10               | -                   | -                   |

|      |          |          |          |
|------|----------|----------|----------|
| 合 计  | 1,086.33 | 786.81   | 485.67   |
| 减值准备 | 507.54   | 507.54   | 507.54   |
| 账面净值 | 4,452.01 | 3,837.09 | 4,138.22 |

公司的无形资产中，主要包括土地使用权、专利权、软件及其他。

(1) 土地使用权价值为公司所在地的土地出让金的金额。

(2) 专利权为控股股东丹邦投资集团于 2007 年 5 月出资入股的四项发明专利，分别为 UV 固化可剥离压敏胶膜、一种无胍刻蚀液、一种潜伏性固化剂的制造方法和用于芯片搭载及封装的电绝缘树脂浆。

上述四项发明专利出资情况请见本招股书第四节之“四、发行人的股本形成及重大资产重组情况”。

(3) 其他为公司自主研发形成的无形资产。公司于 2010 年 5 月 10 日向国家知识产权局申请注册上述两项发明专利。两项发明专利情况如下：

单位：万元

| 项目                        | 专利类型 | 原值     | 期末<br>账面净值 | 申请日期            | 未办妥的<br>原因 |
|---------------------------|------|--------|------------|-----------------|------------|
| 多叠层多芯片封装在柔性电路基板上的方法及封装芯片组 | 发明专利 | 483.94 | 463.78     | 2010 年 5 月 10 日 | 专 利 申 请 中  |
| 一种柔性封装载板焊盘金手指制作方法         | 发明专利 | 430.51 | 412.57     | 2010 年 5 月 10 日 | 专 利 申 请 中  |
| 合 计                       | /    | 914.45 | 876.35     | /               | /          |

## 10、工程物资

报告期内，公司工程物资余额为：

单位：万元

| 项目   | 2010 年 12 月 31 日 | 2009 年 12 月 31 日 | 2008 年 12 月 31 日 |
|------|------------------|------------------|------------------|
| 工程物资 | 3,803.32         | 17.17            | 1.18             |

本公司 2008-2009 年，工程物资金额很小，主要为零星的工程用材料的采购。2010 年工程物资余额为 3,803.32 万元，系子公司广东丹邦为实施募投项目采购的尚未安装的机器设备。

## 11、开发支出

单位：万元

| 项目                | 2009年末 | 2010年增加 | 2010年减少 |         | 2010年末 |
|-------------------|--------|---------|---------|---------|--------|
|                   |        |         | 计入损益    | 确认为无形资产 |        |
| 一种柔性封装载板焊盘金手指制作方法 | 357.86 | 72.65   | -       | 430.51  | -      |



|                          |        |        |   |        |        |
|--------------------------|--------|--------|---|--------|--------|
| 多叠层多芯片封装在柔性电路板上的方法及封装芯片组 | 394.33 | 89.62  | - | 483.94 | -      |
| 用于芯片与微器件载体材料             | -      | 800.29 | - | -      | 800.29 |
| 小计                       | 752.19 | 962.56 | - | 914.45 | 800.29 |

截至2010年12月31日，公司开发支出中共有3个项目支出，其中两项已经完成并转入无形资产。

(1) 企业会计准则中对研究与开发阶段的划分：

A、研究阶段，是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查、有关研究活动的例子包括：意于获取知识而进行的活动；研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择；材料、设备、产品、工艺、系统或服务替代品的研究；新的或经改进的材料、设备、产品、工序、系统或服务的可替代品的配置、设计、评价和最终选择等。研究阶段的特点包括：计划性、探索性。

B、开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。有关开发活动的例子包括：生产前或使用前的原型和模型的设计、建造和测试；含新技术的工具、夹具、模具和冲模的设计；不具有商业性生产经济规模的试生产设施的设计、建造和运营；新的或经改造的材料、设备、产品、工序、系统或服务所选定的替代品的的设计、建造和测试等。开发阶段的特点包括：a. 具有针对性；b. 形成成果的可能性很大。

由于开发阶段相对于研究阶段需进一步，相对于研究阶段来讲，进入开发阶段，则很大程度上形成一项新产品或新技术的基本条件已经具备，此时如果企业能够证明满足无形资产的定义及相关确认条件，所发生的开发支出可资本化。

(2) 公司计入开发成本项目资本化的具体依据：

根据企业会计准则的相关规定，开发支出阶段，可将有关支出资本化计入无形资产的条件包括：

- A、完成该无形资产以使其能够使用或者出售在技术上具有可行性。
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
- C、无形资产生产出的经济效益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的

产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性。

D、有足够的技术、财务资源或其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠的计量。

结合上述5个条件，本公司一种柔性封装载板焊盘金手指制作方法及多叠层多芯片封装在柔性电路基板上的方法及封装芯片组的有关开发情况如下：

A、2008年12月2日，公司召开了项目启动会议，会议确定了上述两个研发项目组成员及研发项目时间进度安排。以公司目前阶段的研发成果为基础，进行开发所需的技术条件等已经具备，不存在技术上的障碍或其他不确定性。

B、上述两个研发项目是基于COF柔性封装产业链的技术。第一个项目主要解决COF封装载板的金手指产生裂纹的问题；第二个项目主要解决了柔性封装基板上进行多叠层芯片封装问题。COF柔性封装产业是公司未来发展重要支柱，COF柔性封装基板及COF产品二者营业收入合计占比已经由2007年的43.50%提高到2010年的78.79%。待上述技术研发成功后，将大大增强COF柔性封装基板的性能，提高产品技术含量。

C、公司对COF柔性封装基板及COF产品市场进行了分析，通过分析认为，全球电子信息产品飞速发展，COF柔性封装基板及COF产品应用领域不断扩大，据中国电子材料行业协会统计数据显示，2015年全球COF柔性封装基板市场规模为15.39亿美元，市场需求将持续增长。公司进行COF柔性封装基板及COF封装产品相关技术的研究，可提高相关产品技术含量及性能，增强竞争优势，促进公司实现持续增长。

D、公司在COF柔性封装领域掌握多项核心技术，在该领域拥有行业专家及技术方面人才，可顺利完成上述项目的开发。另外，公司对上述项目的经费预算为2,000万元，以公司目前的财务资源，足以完成该项目的开发。

E、开发阶段中，针对此项目发生的开发相关人员的人工薪资、研发设备折旧费、水电费等支出均能够可靠计量。

## 12、公司资产减值准备提取情况符合公司资产实际状况

报告期各期末，公司资产减值准备具体情况如下：

单位：万元

| 项目    | 2010 年<br>12 月 31 日 | 2009 年<br>12 月 31 日 | 2008 年<br>12 月 31 日 |
|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 坏账准备： |                     |                     |                     |
| 应收账款  | 241.74              | 294.41              | 343.30              |
| 其他应收款 | 1.38                | 6.66                | 4.34                |
| 减值准备： |                     |                     |                     |
| 无形资产  | 507.54              | 507.54              | 507.54              |
| 合 计   | 750.66              | 808.61              | 855.18              |

本公司制定了具体可行的资产减值准备计提政策，并按照资产减值准备政策的规定以及各项资产的实际情况，足额地计提了各项资产减值准备。

报告期内，公司根据期末应收账款余额和期末其他应收款余额主要按照账龄分析法计提坏账准备。公司的存货、固定资产、在建工程等均不存在资产减值情况，未计提减值准备。公司的资产减值准备计提政策稳健，能够保障公司的资本安全和持续经营能力。

受 2008 年下半年的世界金融危机影响，公司所属行业受到巨大冲击，面对严峻的世界经济环境及行业变化形势，出于谨慎性考虑，公司于 2008 年末对四项发明专利进行减值测试。受丹邦有限委托，北京中盛联盟资产评估有限公司对丹邦有限拟进行减值测试的四项发明专利进行评估，并于 2009 年 1 月 11 日出具中盛联盟（北京）A 评报字（2009）第 010 号《深圳丹邦科技有限公司 UV 固化可剥离压敏胶膜等四项发明专利评估报告书》，经评估，截至评估基准日 2008 年 12 月 31 日，四项发明专利的账面价值为 4,194.94 万元，评估值为 3,687.40 万元。

因上述评估值为 3,687.40 万元低于无形资产账面价值，公司于 2008 年末计提了无形资产减值准备 507.54 万元。

根据评估报告及评估说明，企业销售的增速已经趋缓，已经进入稳定增长期。公司产品销售单价趋于稳定，产品已经完成市场定价过程，现有价格基本稳定合理，而产品单位成本进一步下降的空间在缩小。同时，随着柔性电路板生产技术整体生产水平提升，公司因拥有专利技术而享受到的净收益占销售收入比率有下

降的趋势，这与专利技术一般的规律性较为吻合。

### 13、财务性投资

报告期各期末，公司不存在交易性金融资产和可供出售金融资产等财务性投资。

## （二）负债结构分析

### 1、总体负债结构较稳定，且与公司的资产结构相匹配

报告期各期末，公司负债结构如下表所示：

单位：万元

| 项目      | 2010 年 12 月 31 日 |         | 2009 年 12 月 31 日 |         | 2008 年 12 月 31 日 |         |
|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|
|         | 金额               | 比例      | 金额               | 比例      | 金额               | 比例      |
| 应付账款    | 1,407.64         | 4.99%   | 1,233.73         | 4.44%   | 1,553.80         | 5.13%   |
| 预收款项    | 48.18            | 0.17%   | 23.27            | 0.08%   | 27.51            | 0.09%   |
| 应付职工薪酬  | 226.21           | 0.80%   | 268.70           | 0.97%   | 307.35           | 1.01%   |
| 应交税费    | 74.48            | 0.26%   | 97.45            | 0.35%   | 140.90           | 0.46%   |
| 应付利息    | 47.77            | 0.17%   | 47.01            | 0.17%   | 49.90            | 0.16%   |
| 其他应付款   | 141.49           | 0.50%   | 171.02           | 0.61%   | 152.45           | 0.50%   |
| 其他流动负债  | 21.84            | 0.08%   | -                | -       | -                | -       |
| 流动负债小计  | 1,967.61         | 6.98%   | 1,841.18         | 6.62%   | 2,231.91         | 7.37%   |
| 长期借款    | 26,000.00        | 92.26%  | 25,900.00        | 93.12%  | 28,000.00        | 92.40%  |
| 其他非流动负债 | 215.08           | 0.76%   | 72.00            | 0.26%   | 72.00            | 0.24%   |
| 非流动负债小计 | 26,215.08        | 93.02%  | 25,972.00        | 93.38%  | 28,072.00        | 92.63%  |
| 负债合计    | 28,182.69        | 100.00% | 27,813.18        | 100.00% | 30,303.91        | 100.00% |

本公司负债结构较稳定，非流动负债占比在 90%以上。流动负债主要为公司采购原材料及固定资产形成的应付账款，供应商给予本公司的信用账期一般为 60-90 天，表明公司在供应商的信用状况良好。非流动负债主要为公司向国家开发银行及招商银行的长期借款。本公司以非流动负债为主的负债结构与非流动资产为主的资产结构相匹配。

报告期各期末，公司负债总额较大，主要是公司处于产能扩张期，对资金需求量较大，长期借款金额较大所致，亦体现了公司具有良好的银行资信和融资能力。

### 2、应付账款分析

报告期各期末，公司应付账款主要为应付供应商的原材料款、设备采购款及工程款等。2010 年 12 月末，应付账款余额为 1,407.64 万元。原材料供应商一般给予本公司 60-90 天的信用账期。公司做好资金管理，在信用账期内及时付款，具有良好的商业信用。

报告期各期末，应付账款前 5 名供应商情况如下：

单位：万元

| 日期                  | 单位名称            | 应付金额     | 占比     | 性质  |
|---------------------|-----------------|----------|--------|-----|
| 2010 年<br>12 月 31 日 | 深圳市兴精益模具有限公司    | 118.57   | 8.90%  | 材料款 |
|                     | 三井电子薄膜(香港)有限公司  | 98.73    | 7.41%  | 材料款 |
|                     | 东莞华港国际贸易有限公司    | 56.01    | 4.20%  | 材料款 |
|                     | 深圳市宝安区公明下村岩佐荣华厂 | 54.73    | 4.11%  | 材料款 |
|                     | 利昌工业(无锡)化成有限公司  | 45.82    | 3.44%  | 材料款 |
|                     | 合 计             | 373.86   | 28.05% |     |
| 2009 年<br>12 月 31 日 | 深圳市宝安区公明下村岩佐荣华厂 | 115.69   | 9.38%  | 材料款 |
|                     | 广州海桥电子有限公司      | 71.42    | 5.79%  | 材料款 |
|                     | 上海盟星国际贸易有限公司    | 62.37    | 5.06%  | 材料款 |
|                     | 番禺南沙殷田化工有限公司    | 59.34    | 4.81%  | 材料款 |
|                     | 深圳市德镒盟电子有限公司    | 55.78    | 4.52%  | 材料款 |
|                     | 合 计             | 364.60   | 29.55% | -   |
| 2008 年<br>12 月 31 日 | 深圳市东部开发（集团）有限公司 | 379.94   | 24.45% | 工程款 |
|                     | 邦达集团有限公司        | 261.48   | 16.83% | 材料款 |
|                     | 宇宙 P.C.B 设备有限公司 | 225.40   | 14.51% | 设备款 |
|                     | 深圳市宝安区公明下村岩佐荣华厂 | 106.11   | 6.83%  | 材料款 |
|                     | 昆山聚元测试仪器有限公司    | 70.77    | 4.55%  | 设备款 |
|                     | 合 计             | 1,043.70 | 67.17% | -   |

2010 年末，随着本公司的经营业绩的持续增加，采购规模亦相应扩大，同时随着公司与供应商的合作关系更为紧密，可获得部分供应商相对宽松的付款条件，因此应付账款余额较 2009 年有所增加。

2008 年末应付账款包括部分工程款及模具采购款，导致应付账款金额较大。

### 3、预收款项分析

预收款项主要为公司在国内销售中向客户收取的定金。2008-2010 年末的余额分别为 27.51 万元、23.27 万元、48.18 万元，金额不大。

### 4、应付职工薪酬分析

报告期各期末的应付职工薪酬为当年 12 月份的工资。由于公司执行当月工资次月发放的制度，故每个月月末的应付职工薪酬主要与当月员工加班多少有关。

2009 年末、2010 年末，应付职工薪酬同比上年末变动不大，主要是由于 2009 年末、2010 年末没有出现 2008 年末订单集中履行的情况，员工加班减少，故应

付职工薪酬相对稳定。

## 5、应交税费分析

应交税费主要核算增值税、企业所得税、营业税、城市土地使用税。

2009 年末，应交税费余额比 2008 年末减少 43.45 万元，主要原因为 2009 年境内原材料采购金额较 2008 年增加较大，导致增值税进项税额增多。

2010 年末，应交税费余额比 2009 年末减少 22.99 万元，主要原因为 2010 年境内原材料采购金额较 2009 年增加较大，导致增值税进项税额增多。

## 6、长期借款分析

2010 年 12 月末，公司长期借款余额为 26,000 万元。本期末长期借款包括两部分：

（1）公司于 2007 年 7 月 30 日与国家开发银行签订编号为“4403401652007020305 号”的借款合同，借款金额为人民币 28,000 万元，用于偿还“丹邦科技园项目”建设贷款及建设“先进 COF 超微线路和封装产业化项目”，借款期限从 2007 年 3 月 30 日起至 2013 年 3 月 29 日止，借款利率为浮动利率，随中国人民银行公布的同时限档次人民币贷款基准利率的调整而调整。截至 2010 年 12 月末，该笔贷款余额为 21,000 万元。合同项下的具体提款计划和还款计划如下：

| 年度     | 提款日期             | 提款金额      | 贷款余额      |
|--------|------------------|-----------|-----------|
| 2007 年 | 2007 年 3 月 30 日  | 10,000 万元 | 10,000 万元 |
|        | 2007 年 4 月 2 日   | 5,000 万元  | 15,000 万元 |
|        | 2007 年 4 月 25 日  | 3,000 万元  | 18,000 万元 |
|        | 2007 年 5 月 18 日  | 5,000 万元  | 23,000 万元 |
| 2008 年 | 2008 年 2 月 20 日  | 5,000 万元  | 28,000 万元 |
| 年度     | 还款日期             | 还本金额      | 贷款余额      |
| 2009 年 | 2009 年 11 月 21 日 | 2,100 万元  | 25,900 万元 |
| 2010 年 | 2010 年 5 月 21 日  | 2,100 万元  | 23,800 万元 |
|        | 2010 年 11 月 21 日 | 2,800 万元  | 21,000 万元 |
| 2011 年 | 2011 年 5 月 21 日  | 2,800 万元  | 18,200 万元 |
|        | 2011 年 11 月 21 日 | 2,800 万元  | 15,400 万元 |
| 2012 年 | 2012 年 5 月 21 日  | 4,200 万元  | 11,200 万元 |
|        | 2012 年 11 月 21 日 | 5,600 万元  | 5,600 万元  |
| 2013 年 | 2013 年 3 月 29 日  | 5,600 万元  | 0 万元      |

“丹邦科技园项目”自 2003 年 6 月开始建设，2006 年 3 月建成完工，主要

包括土地购置，厂房、办公大楼建设以及装修工程等，项目总投资约 8,000 万元。

“先进 COF 超微线路和封装产业化项目”自 2006 年第一季度开始筹备建设，2008 年基本建设完成，项目主体工程主要包括 COF 材料车间、COF 封装车间、公用辅助设施等四部分。项目具体设备主要包括无胶基材生产线、COF 超微线路生产线及 COF 产品设备。项目投资约 14,900 万元。

(2) 公司于 2010 年 5 月 13 日与招商银行深圳高新园支行签订了为期 2 年的借款合同，合同金额为 5,000 万元，借款分次取得，本借款主要用于公司日常经营周转，截至 2010 年 12 月 31 日，该笔贷款余额为 5,000 万元。

### (三) 所有者权益分析

报告期内，公司股东权益各项目变动情况如下：

单位：万元

| 项目               | 股本/<br>实收资本 | 资本公积     | 盈余公积   | 未分配利润    | 外币报告<br>折算差额 | 所有者权益<br>合计 |
|------------------|-------------|----------|--------|----------|--------------|-------------|
| 2007 年 12 月 31 日 | 10,000.00   | 331.98   | 415.19 | 4,079.99 | -            | 14,827.16   |
| 2008 年新增         | -           | -        | 351.43 | 3,514.35 | -            | 3,865.78    |
| 2008 年减少         | -           | -        | -      | 351.43   | -            | 351.43      |
| 2008 年 12 月 31 日 | 10,000.00   | 331.98   | 766.62 | 7,242.91 | -            | 18,341.51   |
| 2009 年新增         | 2,000.00    | 6,341.51 | 470.07 | 4,663.14 | -            | 13,474.72   |
| 2009 年减少         | -           | 331.98   | 766.62 | 7,712.99 | 0.03         | 8,811.61    |
| 2009 年 12 月 31 日 | 12,000.00   | 6,341.51 | 470.07 | 4,193.07 | -0.03        | 23,004.63   |
| 2010 年新增         | -           | -        | 527.87 | 5,268.05 | 13.95        | 5,809.87    |
| 2010 年减少         | -           | -        | -      | 527.87   | -            | -           |
| 2010 年 12 月 31 日 | 12,000.00   | 6,341.51 | 997.95 | 8,933.25 | 13.92        | 28,286.63   |

股东权益各项目变动原因分析如下：

#### 1、股本变动分析

2009 年末，公司股本较 2008 年末增加 2,000 万股，系 2009 年 6 月 5 日整体变更设立股份公司时，按丹邦有限截至 2008 年 12 月 31 日经审计的净资产 18,871.17 万元按 1:0.6359 的比例折成股本 12,000 万股所致。

#### 2、资本公积变动分析

2009 年末，公司资本公积较 2008 年末 331.98 万元增加到 6,341.51 万元，系公司整体变更为股份有限公司时净资产折股后余额转入所致。

### 3、盈余公积变动分析

2008-2010 年，新增的盈余公积系按公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金所致。

2009 年，减少的盈余公积系 2009 年 6 月公司整体变更为股份有限公司时将以前年度提取的法定盈余公积转为股本、资本公积金所致。

### 4、未分配利润变动分析

报告期内，公司未分配利润每年增加数为归属于母公司股东的净利润的增加。

2008 年及 2010 年，公司未分配利润减少数是对当年提取的法定盈余公积金。2009 年末分配利润的减少系 2009 年 6 月公司整体变更为股份有限公司时将以前年度的未分配利润转为股本、资本公积金所致。

## （四）偿债能力分析

### 1、本公司偿债能力较强

报告期内，公司的流动比率、速动比率、母公司资产负债率、息税折旧摊销前利润及利息保障倍数指标如下：

| 主要财务指标        | 2010 年末/<br>2010 年度 | 2009 年末/<br>2009 年度 | 2008 年末/<br>2008 年度 |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 流动比率          | 6.71                | 7.20                | 7.63                |
| 速动比率          | 5.89                | 5.97                | 7.18                |
| 母公司资产负债率      | 49.81%              | 54.62%              | 62.30%              |
| 息税折旧摊销前利润（万元） | 10,506.98           | 9,459.67            | 7,310.66            |
| 利息保障倍数        | 4.67                | 3.99                | 3.10                |

#### （1）流动比率、速动比率分析

报告期各期末，公司的流动比率均大于 6.50，速动比率均大于 5.50。流动比率、速动比率保持较高水平，主要是公司以长期负债为主的负债结构所致。公司的长期借款保持较高水平，一定程度上保证了公司由于经营利润增加而产生的货币资金用于公司日常资金周转的需要，故没有再进行短期借款融资而保持了较低的流动负债水平，使得公司报告期内保持较高的流动比率及速动比率。

2009 年流动比率较 2008 年有小幅下降，主要系由于 2009 年经济好转，



2009 年末没有出现 2008 年第四季度集中交货确认收入的情况，2009 年末应收账款较 2008 年有所减少，导致流动比率小幅度下降。2009 年速动比率较 2008 年下降较大，主要是公司按借款合同约定偿还了国家开发银行的部分借款，货币资金减少，从而导致速动比率下降。

2010 年流动比率较 2009 年略有下降，主要是由于经济回暖，2010 年公司的销售订单恢复到正常水平，年底未出现大量订单集中履行交货的情况，第四季度销售收入较去年减少约 1,000 万元，应收账款也相应减少，影响了流动比率水平。

## **(2) 母公司资产负债率分析**

报告期内，公司资产负债率均处于较高水平，主要是由于公司作为生产 COF 柔性封装基本及 COF 产品等高端产品的企业，需要投入大量的机器设备、厂房，故需要大量的资金支持，由于受到上述行业特点及受资本规模的限制，本公司只能暂时通过银行借款的方式解决上述资金需求。本公司的负债主要是由于报告期内公司向国家开发银行及招商银行取得长期借款所致。向国家开发银行借入的款项主要用于偿还以前年度用于“丹邦科技园项目”的银行借款及建设“先进 COF 超微线路和封装产业化项目”；向招商银行的借款主要用于公司日常经营周转。公司资产负债率呈逐年下降趋势，主要是由于公司盈利能力逐年增强所致，长期偿债能力逐年增强。

## **(3) 息税折旧前利润分析**

报告期内，公司息税折旧摊销前利润较高，2008-2010 年，息税折旧摊销前利润逐年增加，表明公司盈利能力逐年增强，利息偿付有保障。

## **(4) 利息保障倍数分析**

报告期内，公司的利息保障倍数逐年增加，由 2008 年的 3.10 提高到 2010 年的 4.67，表明公司的偿债能力逐年增强，利息支付有保障。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额累计 24,724.28 万元，超过同期净利润 13,445.54 万元，同时经营活动现金流净额远高于当期利息支出额，还款能力较强。

此外，公司银行信用良好，多年来银行借款均能按期还本付息，与当地商业

银行建立了良好合作关系，公司于 2008 年被鹏元资信评估有限公司评审为“A+”资信等级，偿债能力较强。

综上，公司负债水平合理，公司负债结构与资产结构匹配，且经营性现金流量充足，银行资信状况良好，具有较强的偿债能力。

## 2、同行业上市公司的偿债能力比较分析

目前境内尚无专业生产 FPC、COF 柔性封装基板及 COF 产品的企业上市，境内印制电路板行业上市公司中兴森科技、天津普林、超声电子、沪电股份均以生产 PCB 为主，与公司所属大行业具有一定的相似性。

报告期，公司偿债能力指标与上述公司财务指标比较如下：

| 主要财务指标         |                  | 丹邦科技   | 行业平均   | 兴森科技   | 天津普林   | 超声电子   | 沪电股份   |
|----------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 流动比率           | 2010 年 12 月 31 日 | 6.71   | 3.09   | 5.07   | 2.62   | 1.38   | 3.29   |
|                | 2009 年 12 月 31 日 | 7.20   | 1.98   | 0.76   | 4.27   | 1.24   | 1.63   |
|                | 2008 年 12 月 31 日 | 7.63   | 2.74   | 1.16   | 7.25   | 1.17   | 1.38   |
| 速动比率           | 2010 年 12 月 31 日 | 5.89   | 2.78   | 4.85   | 2.19   | 1.06   | 0.67   |
|                | 2009 年 12 月 31 日 | 5.97   | 1.70   | 0.64   | 3.85   | 0.94   | 1.35   |
|                | 2008 年 12 月 31 日 | 7.18   | 2.43   | 1.06   | 6.63   | 0.90   | 1.14   |
| 资产负债率<br>(母公司) | 2010 年 12 月 31 日 | 49.81% | 18.28% | 12.03% | 15.65% | 24.59% | 20.78% |
|                | 2009 年 12 月 31 日 | 54.62% | 33.20% | 54.52% | 14.68% | 25.12% | 38.48% |
|                | 2008 年 12 月 31 日 | 62.30% | 32.75% | 50.67% | 11.55% | 22.00% | 46.78% |

注：（1）上市公司的数据来源：首次公开发行招股说明书及年报。

（2）行业平均为兴森科技、天津普林、超声电子、沪电股份四家公司的平均数。

上表显示，报告期内，公司流动比率及速动比率指标远远高于行业平均水平，同时也高于兴森科技、天津普林、超声电子、沪电股份，主要由于本公司于 2007 年与国家开发银行签订了总金额为 28,000 万元为期 6 年的长期借款合同，借款用于偿还公司前期建设“丹邦科技园项目”的银行借款及建设“先进 COF 超微线路和封装产业化项目”及后续项目支出，一定程度上保证了公司随着经营规模扩大而不断增长的日常资金周转的需要，故公司没有再向金融机构借入短期借款，公司流动负债保持在较低的水平。

公司的资产负债率（母公司）远高于行业平均水平，同时也远高于天津普林、超声电子及沪电股份，一方面是由于公司专注于高端产品的生产，需要投入大量

精度高、技术含量高的进口先进设备，在自有资金不足的情况下通过银行借款的方式满足上述资金需求；另一方面，上述对比公司通过上市进行了股权融资，资金相对充裕，减少了债权融资，总负债保持较低水平，而本公司融资渠道较为单一，仅可通过债务方式融资，一定程度拉高了公司的资产负债率。

### （五）资产周转能力分析

报告期内，本公司的资产周转能力指标如下：

| 主要财务指标       | 2010 年度 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|--------------|---------|---------|---------|
| 应收账款周转率（次/年） | 4.04    | 2.88    | 3.36    |
| 存货周转率（次/年）   | 4.93    | 5.16    | 8.42    |
| 流动资产周转率（次/年） | 1.55    | 1.21    | 1.18    |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.62    | 0.62    | 0.79    |
| 总资产周转率（次/年）  | 0.38    | 0.37    | 0.39    |

#### 1、应收账款周转能力分析

近三年，公司应收账款周转率保持在 2.8 次/年或以上，周转较快，主要原因为：（1）公司在对客户信用评估有着严格的制度。对于在世界上享有较高声誉的大客户，公司考虑到其资信状况给予 90 天的信用账期。对于中小客户，公司在与其交易初期给予 60 天的信用账期，之后会根据客户的应收款回款情况对其信用状况进行评估，适当调整信用账期；（2）公司的客户大部分为资金实力雄厚、资信状况良好的世界知名跨国企业，回款及时，一定程度上保证了公司保持较高的应收账款周转能力。报告期内，公司一年以内的应收账款占总应收账款的比重均在 99%以上，公司应收账款收款账期较短，质量较高。

#### 2、存货周转能力分析

报告期内，公司存货周转速度较快，保持在 4.5 次/年以上，主要得益于公司以销定产的销售策略，减少了库存商品在库时间，使存货保持较低水平。2008 年存货周转率明显高于报告期内其他期间，主要是由于受到金融危机影响，公司部分客户上半年的订单推迟履行。下半年，在公司的催促下，此部分订单继续履行，使得年末产品生产及出货较多，消耗了存货，对存货周转能力有一定的影响。

#### 3、固定资产周转能力分析

2008 年固定资产周转率较低主要系公司产品结构的调整，增加盈利能力强、

附加值高的 COF 柔性封装基板及 COF 产品的比例，在 2008 年底新增大型生产用机器设备如 COF 柔性封装基板生产线、COF 产品生产线，而该两条生产线在 2008 年效益创造期仅有两个月所致，对当年销售收入的贡献较小。

2009 年、2010 年固定资产周转率较 2008 年降低的原因主要是因为：（1）受深圳市对特区内的工业用水的排水量的限制，公司的产量受到限制，收入增长不大；一定程度上拉低了固定资产周转率。（2）2009 年，公司为调整产品结构，为提高盈利能力、附加值大的 COF 柔性封装基板及 COF 产品的比例，增加了相应的机器设备及配套设施，导致固定资产增加约 4,041 万元；2010 年固定资产增加主要是公司为了加强环境保护，在环保方面投入的 30T/DI 水系统设备工程、环保设备工程、车间净化整体改造工程完工验收转入固定资产。

#### **4、资产运营效率分析**

近三年，本公司应收账款周转速度和存货周转速度均较快，流动资产周转率保持在 1 次/年以上，公司应收账款及存货占流动资产的绝大部分，其流转状况对流动资产的周转状况具有决定性的作用。

近三年，本公司总资产周转率较低，主要受以下因素影响：

##### **（1）固定资产规模较大对资产周转能力的影响**

公司固定资产规模较大，一方面是由于公司为拥有稳定的生产经营及办公场所，购买了土地并投资建设了厂房、办公楼及职工宿舍；另一方面是因为公司是典型的高科技生产型企业，机器设备投入较大，公司生产的高端 FPC、COF 柔性封装基板及 COF 产品对机器设备要求很高，大部分用于生产的机器设备主要是购自日本的 GODO KIKO CO., LTD. 和 TORAY ENGINEERING CO., LTD. 等专业生产厂商。设备价值较高，处于行业国际先进水平。

2008-2010 年末，固定资产账面净值分别为 26,992.52 万元、31,034.46 万元、34,110.28 万元。报告期各期末分别较上期末增长 14.97%、9.91%，固定资产规模较大并持续增长增加了公司资产周转的压力。

##### **（2）应收账款增加对资产周转能力的影响**

2008-2010 年末，公司应收账款净额分别占流动资产的比例为 38.31%、

42.14%、34.81%。应收账款占流动资产的比例较大，一定程度上增加了公司的财务风险，对公司的应收账款管理能力提出了更高的要求。

2008 年末应收账款较大，主要受 2008 年世界金融危机的影响，部分客户由于其产品市场前景不够明朗，要求将 2008 年中签订的合同或订单推迟履行，且公司对于大部分客户执行 90 天的信用政策，故 2008 年第四季度集中履行的合同或订单确认收入形成应收账款。

## 5、同行业上市公司的资产周转能力比较分析

| 主要财务指标           |        | 丹邦科技 | 行业平均  | 兴森科技  | 天津普林  | 超声电子 | 沪电股份  |
|------------------|--------|------|-------|-------|-------|------|-------|
| 应收账款周转率<br>(次/年) | 2010 年 | 4.04 | 4.59  | 5.72  | 3.69  | 4.51 | 4.42  |
|                  | 2009 年 | 2.88 | 3.88  | 4.41  | 3.35  | 3.75 | 4.01  |
|                  | 2008 年 | 3.36 | 4.37  | 4.74  | 4.33  | 3.46 | 4.95  |
| 存货周转率<br>(次/年)   | 2010 年 | 4.93 | 10.25 | 11.96 | 12.48 | 6.01 | 10.71 |
|                  | 2009 年 | 5.16 | 8.64  | 10.13 | 10.61 | 5.68 | 8.13  |
|                  | 2008 年 | 8.42 | 9.41  | 13.13 | 11.34 | 5.75 | 7.43  |
| 总资产周转率<br>(次/年)  | 2010 年 | 0.38 | 0.80  | 0.68  | 0.68  | 0.93 | 0.92  |
|                  | 2009 年 | 0.37 | 0.72  | 0.73  | 0.45  | 0.77 | 0.93  |
|                  | 2008 年 | 0.39 | 0.83  | 0.86  | 0.56  | 0.79 | 1.10  |

注：（1）上市公司的数据来源：首次公开发行招股说明书及年报。

（2）行业平均数为兴森科技、天津普林、超声电子、沪电股份四家公司的平均数。

### （1）应收账款周转率对比分析

上表显示，报告期内，公司应收账款周转率略低行业平均水平及兴森科技、超声电子、沪电股份，主要由于公司立足于研发、生产及销售高端 FPC 及 COF 柔性封装基板及 COF 产品，公司 98%以上的产品均出口，公司给予客户的信用账期为 60-90 天。而兴森科技主要生产 PCB 样板、超声电子主要生产刚性 PCB，其产品大部分销往境内且给予客户的信用账期 30-90 天不等，账期较短；虽然沪电股份给予大部分客户的信用账期同样为 90 天，但其全年销售并无明显的季节性，未出现本公司第四季销售收入明显高于其他季度的情况，故其应收账款周转率略高于本公司。

### （2）存货周转率对比分析

公司存货周转率低于行业平均水平，主要是由于目前上市的 PCB 企业中多数

以生产刚性 PCB 及刚挠 PCB 为主，订单小，采购次数多，交货期短，行业存货周转率较高，公司为生产高端 FPC、COF 柔性封装基板及 COF 产品的企业，客户订货量大，工艺复杂，相对生产周期较长，交货期长，存货周转率相对较低。

公司存货周转率低于兴森科技，主要是由于兴森科技为生产 PCB 样板的企业，原材料采购频率高、单次采购量小、“快件”的比重较高，交货期短，导致存货周转率较高。

公司存货周转率在 2009-2010 年低于天津普林、超声电子，主要是由于天津普林、超声电子一直致力于多品种、中小批量的生产模式，全面、快速响应客户的需求，交货期短，周转率较高。

公司存货周转率在 2009-2010 年低于沪电股份，主要是由于沪电股份在原材料采购上大量采用寄售方式，大幅度减少了存货中的原材料存量，同时在销售上采用订单生产的方式，产成品保持在较低水平，一定程度上影响了存货周转率水平。

### （3）资产周转率对比分析

总资产周转率低于行业平均水平及对比的上市公司，主要原因因为公司从设立开始就从事高端 FPC、COF 柔性封装基板及 COF 产品的生产、研发及销售，对生产所需的机器设备、检查设备以及配套设施要求较高，大部分为进口，价值较大，资产规模比较大，影响了总资产周转率。

## 二、盈利能力分析

### （一）营业收入分析

报告期内，公司营业收入结构如下：

单位：万元

| 项目     | 2010 年度   |         | 2009 年度   |         | 2008 年度   |         |
|--------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
|        | 金额        | 占比      | 金额        | 占比      | 金额        | 占比      |
| 主营业务收入 | 20,368.09 | 99.03%  | 18,254.82 | 99.49%  | 17,139.84 | 99.93%  |
| 其他业务收入 | 199.27    | 0.97%   | 92.79     | 0.51%   | 11.69     | 0.07%   |
| 合 计    | 20,567.36 | 100.00% | 18,347.60 | 100.00% | 17,151.52 | 100.00% |

公司自成立以来，专注于 FPC、COF 柔性封装基板及 COF 产品的研发、生产

与销售。报告期内，主营业务收入占营业收入的比例均在 99%以上，主营业务突出。其他业务收入主要为租赁收入等，占比小，报告期内变动不大。

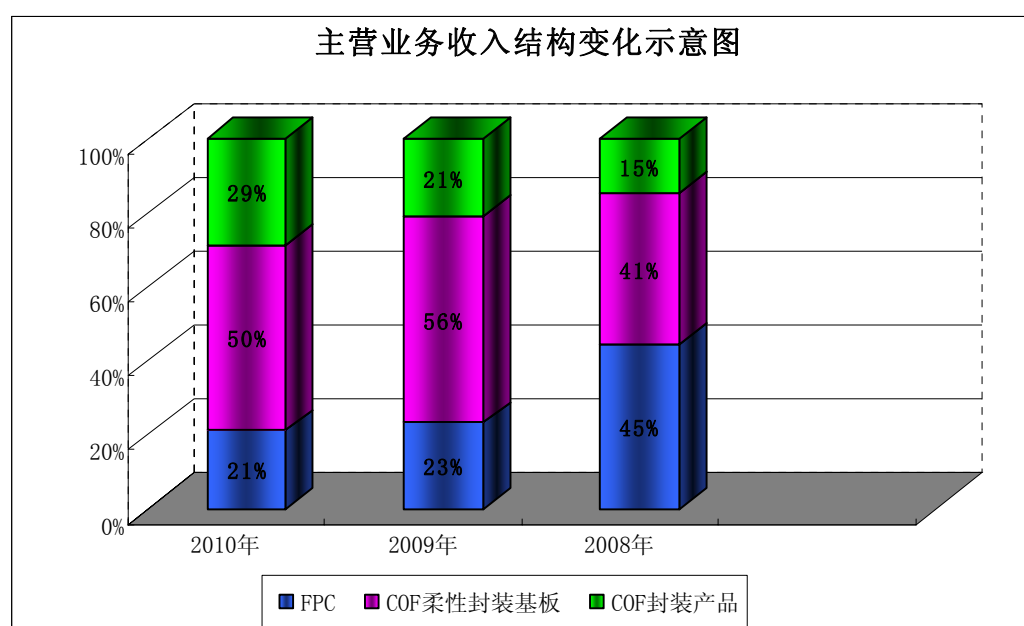
### 1、按产品构成分析

本公司主营产品包括 FPC、COF 柔性封装基板及 COF 产品。报告期内，主营业务收入按产品分类如下：

单位：万元

| 按产品分类      | 2010 年度   |         | 2009 年度   |         | 2008 年度   |         |
|------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
|            | 金额        | 占比      | 金额        | 占比      | 金额        | 占比      |
| FPC        | 4,319.12  | 21.21%  | 4,260.31  | 23.34%  | 7,627.19  | 44.50%  |
| COF 柔性封装基板 | 10,196.25 | 50.06%  | 10,161.15 | 55.66%  | 6,993.40  | 40.80%  |
| COF 产品     | 5,852.72  | 28.73%  | 3,833.36  | 21.00%  | 2,519.25  | 14.70%  |
| 合 计        | 20,368.09 | 100.00% | 18,254.82 | 100.00% | 17,139.84 | 100.00% |

报告期内，本公司主营业务收入结构变化示意图如下：



上表显示，报告期内，公司不断优化产品结构，持续提升高技术含量、高附加值产品的比重。COF 柔性封装基板及 COF 产品销售收入合计占比逐年上升，2010 年二者合计占比达 78.79%；FPC 销售收入占比逐年下降，由 2008 年占比 44.50% 下降到 2010 年的 21.21%。

(1) 高附加值 COF 柔性封装基板成为公司主导产品，主要原因为：

①公司是我国国内极少数掌握用于生产 COF 柔性封装基板的高端 2L-FCCL 制

造工艺和 COF 柔性封装基板产业链各环节主要材料制造工艺并大批量生产的企业。经过多年的技术攻关和生产实践，公司成功掌握具有国际先进水平的高性能薄膜成型技术、高密度微细线路制造技术并运用上述技术实现了高端 2L-FCCL、柔性封装基板的产业化。公司技术水平在国内同行业企业中居领先地位，并接近国际尖端水平。这有利于公司 COF 柔性封装基板产品为众多世界知名电子信息品牌制造商所接受。

②COF 柔性封装基板市场呈现高度集中的竞争格局，竞争相对缓和。

长期以来，世界 COF 柔性封装基板销售市场被日本、韩国领先企业完全占领。2009 年，全球有几十家 COF 柔性封装基板生产企业，销售额排名前七位的企业占全世界销售额的 97%，市场相对垄断，公司 2009 年 COF 柔性封装基板销售额达到 10,161.15 万元，约占全球市场总销售额的 1.55%，是全球第八大和中国最大的 COF 柔性封装基板生产商。

受产能约束以及深圳市对经济特区内的工业用水的排水量的严格限制，COF 柔性封装基板 2010 年销售收入与 2009 年基本持平。

（2）报告期内，COF 产品成功投产，销售收入占比快速增长，成为公司新的主营业务收入来源。

公司充分利用自产基材、COF 柔性封装基板的产业链优势，向产业链下游 COF 产品拓展，成功研发掌握 COF 封装技术，COF 产品技术含量较高、技术壁垒较强，竞争相对缓和。2007 年公司 COF 产品开始为客户打样试产，产品质量获得客户认可，2008 年 COF 产品处于投产后的前期批量生产阶段。

2008-2010 年，COF 产品销售收入快速增长，分别为 2,519.25 万元、3,833.36 万元、5,852.72 万元，占主营业务收入比重分别为 14.70%、21.00%、28.73%，COF 产品已经成为公司新的盈利增长点。随着公司募投项目实施，COF 产品销售收入将大幅提升。

（3）公司传统产品 FPC 销售收入占比逐年下降。

FPC 作为公司传统产品，在 2007 年以前是公司主营业务收入的最主要来源。报告期内，FPC 销售收入占比逐年下降，主要是由以下原因导致：



①随着 FPC 市场竞争越来越激烈，公司将产品结构逐渐转向附加值更高、盈利能力更强的 COF 柔性封装基板及 COF 产品。

②与 COF 柔性封装基板相比，FPC 在技术、设备等方面的进入门槛相对较低，FPC 市场逐渐变成完全竞争的市场，使得销售单价逐年降低，进而导致 FPC 毛利率降低。

③受现有产能限制，公司将产能更多的留给盈利能力、附加值相对较高、公司具有明显竞争优势的 COF 柔性封装基板和 COF 产品，对 FPC 销售收入占比不断下降也有一定影响。

## 2、分地区主营业务收入分析

报告期内，公司主营业务收入内销、外销变化情况如下：

单位：万元

| 项目   | 2010 年度   |         | 2009 年度   |         | 2008 年度   |         |
|------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
|      | 金额        | 占比      | 金额        | 占比      | 金额        | 占比      |
| 内销收入 | 356.17    | 1.75%   | 177.59    | 0.97%   | 96.79     | 0.56%   |
| 外销收入 | 20,011.92 | 98.25%  | 18,077.23 | 99.03%  | 17,043.04 | 99.44%  |
| 合 计  | 20,368.09 | 100.00% | 18,254.82 | 100.00% | 17,139.84 | 100.00% |

报告期内，公司主营业务收入主要来源于外销收入，且逐年增长。外销收入由2008年的17,043.04万元提高到2010年的20,011.92万元。

报告期内，本公司主营业务收入按销售地区分类如下表：

单位：万元

| 按销售区域<br>分类 |      | 2010 年度   |         | 2009 年度   |         | 2008 年度   |         |
|-------------|------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
|             |      | 金额        | 占比      | 金额        | 占比      | 金额        | 占比      |
| 境内          | 中国大陆 | 356.17    | 1.75%   | 177.59    | 0.97%   | 96.79     | 0.56%   |
|             | 小 计  | 356.17    | 1.75%   | 177.59    | 0.97%   | 96.79     | 0.56%   |
| 境外          | 日本   | 14,513.06 | 71.25%  | 13,479.32 | 73.84%  | 8,510.41  | 49.65%  |
|             | 香港   | 967.49    | 4.75%   | 962.05    | 5.27%   | 6,377.73  | 37.21%  |
|             | 东南亚  | 1,750.72  | 8.60%   | 1,399.64  | 7.67%   | 1,210.49  | 7.06%   |
|             | 欧美   | 2,780.65  | 13.65%  | 2,236.21  | 12.25%  | 944.41    | 5.51%   |
|             | 小 计  | 20,011.92 | 98.25%  | 18,077.23 | 99.03%  | 17,043.04 | 99.44%  |
| 合 计         |      | 20,368.09 | 100.00% | 18,254.82 | 100.00% | 17,139.84 | 100.00% |

注：此表未将通过第比利国际进行境外销售部分按最终客户的所属地进行划分。

### (1) 境外销售总体情况

报告期内，公司境外销售收入占主营业务收入比例一直保持在98%以上，公

司的产品主要销往日本、欧美、东南亚（包括韩国）、香港等国家和地区，主要是因为：

①公司产品的下游行业主要包括液晶电视、手机、掌上电脑、数码相机、笔记本电脑、医疗器械等各类电子信息产品，日本、韩国及欧美等国家和地区是全球电子信息品主要生产地，以公司的主导产品COF柔性封装基板为例，在市场需求方面，韩国的市场需求规模约为40%，台湾的市场需求规模约为30%，日本的市场需求规模约为23%，世界其他生产地区的市场需求规模约为7%。

②公司自成立起即定位于从事高端FPC、COF柔性封装基板等高端产品的研发、生产与销售，在选择国际客户时注重客户资信管理及毛利贡献，以提高公司产品影响力和利润水平。因此，公司客户多数为上述地区全球知名的电子信息产品生产厂商。

## （2）日本市场

日本一直是公司最重要的销售市场。作为当今世界电子产业最发达的国家之一，日本拥有索尼、夏普、日立、佳能等世界知名、产销量大的电子产品生产厂商，其对PFC、COF柔性封装基板及COF产品的需求也位列全球前列。目前，依托公司先进的技术水平，良好的产品性能及可靠的产品质量，公司已经成为日本夏普、日立、松下、三洋电机等公司的COF柔性封装基板及COF产品等产品稳定的供应商。

在2009年8月之前，公司部分外销是通过香港的第比尔国际进行，如果将通过第比尔国际进行的境外销售按最终客户的所属地进行划分，报告期内，来源于日本的销售收入占公司销售收入均在70%以上。具体统计如下表：

单位：万元

| 按销售区域<br>分类 |     | 2010 年度   |         | 2009 年度   |         | 2008 年度   |         |
|-------------|-----|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
|             |     | 金额        | 占比      | 金额        | 占比      | 金额        | 占比      |
| 境外          | 日本  | 14,513.06 | 71.25%  | 13,479.32 | 73.84%  | 12,662.91 | 73.88%  |
|             | 香港  | 967.49    | 4.75%   | 962.05    | 5.27%   | 1,177.99  | 6.87%   |
|             | 东南亚 | 1,750.72  | 8.60%   | 1,399.64  | 7.67%   | 1,210.49  | 7.06%   |
|             | 欧美  | 2,780.65  | 13.65%  | 2,236.21  | 12.25%  | 1,991.65  | 11.62%  |
|             | 小 计 | 20,011.92 | 98.25%  | 18,077.23 | 99.03%  | 17,043.04 | 99.44%  |
| 合 计         |     | 20,368.09 | 100.00% | 18,254.82 | 100.00% | 17,139.83 | 100.00% |

### （3）欧美地区市场

欧美地区亦是全球电子信息品重要生产地，为降低对少数国家或地区市场依赖的风险，公司不断拓展市场范围。2009年，来源于欧美市场的销售收入达2,236.21万元。2010年，欧美市场保持着良好的发展势头，收入达到2,780.65万元。

### （4）香港市场

香港是全球最大的贸易港口城市之一，为了采购及贸易上的便利，包括本公司的一些客户在内的全球众多跨国公司在香港设立办事处。报告期内，公司来源于香港地区的主营业务收入包括以下两部分：①公司对香港地区客户或经销商的直接销售，根据上表，来源于该类客户的销售收入占比在5%左右；②公司通过关联方第比尔国际进行的境外销售。公司通过关联方第比尔国际进行的境外销售情况详见本招股说明书第五节之“四、（四）6、报告期内向前五大客户销售情况”。

## 3、报告期内按季度销售分析

报告期内，公司各季度销售收入如下表：

单位：万元

| 季度   | 2010 年度   |         | 2009 年度   |         | 2008 年度   |         |
|------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
|      | 金额        | 占比      | 金额        | 占比      | 金额        | 占比      |
| 第一季度 | 5,028.32  | 24.69%  | 2,475.90  | 13.56%  | 3,251.73  | 18.97%  |
| 第二季度 | 5,295.25  | 26.00%  | 4,313.09  | 23.63%  | 3,222.36  | 18.80%  |
| 上半年  | 10,323.57 | 50.69%  | 6,788.99  | 37.19%  | 6,474.09  | 37.77%  |
| 第三季度 | 5,109.69  | 25.09%  | 5,545.37  | 30.38%  | 3,994.43  | 23.30%  |
| 第四季度 | 4,934.83  | 24.23%  | 5,920.44  | 32.43%  | 6,671.30  | 38.92%  |
| 下半年  | 10,044.52 | 49.31%  | 11,465.81 | 62.81%  | 10,665.73 | 62.22%  |
| 合 计  | 20,368.09 | 100.00% | 18,254.80 | 100.00% | 17,139.82 | 100.00% |

如上表显示，2008 年，公司上半年主营业务收入占全年主营业务收入的 37.77%，下半年主营业务收入明显多于上半年，主要是受金融危机影响，公司部分客户的要求订单延迟履行，将 2008 年上半年及中期签订的订单推迟交货，在公司多次催促及要求下，上述未按期履行的订单在 2008 年下半年陆续履行。

2009 年，公司上半年主营业务收入占全年主营业务收入的 37.19%，下半年主营业务收入明显多于上半年。主要是因为随着经济逐渐回暖，自 2009 年 5 月起，客户订单量激增，使得下半年发货量较大。

2010 年，公司上半年、下半年主营业务收入基本持平，主要是 2009 年经济逐渐复苏，采购订单增加较多，致使 2009 年的部分订单无法履行，经过与下游客户的沟通而推迟到 2010 年履行并交货，使得 2010 年第一季度及第二季度的销售收入同比增加较大。

## （二）营业成本分析

报告期内，公司营业成本结构如下：

单位：万元

| 项 目    | 2010 年度  |         | 2009 年度  |         | 2008 年度  |         |
|--------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|
|        | 金额       | 占比      | 金额       | 占比      | 金额       | 占比      |
| 主营业务成本 | 9,490.23 | 99.23%  | 8,447.97 | 99.91%  | 8,008.48 | 100.00% |
| 其他业务成本 | 73.61    | 0.77%   | 7.49     | 0.09%   | -        | -       |
| 合 计    | 9,563.84 | 100.00% | 8,455.46 | 100.00% | 8,008.48 | 100.00% |

公司营业成本结构保持稳定，主要由主营业务成本构成，占比在 99%以上。

### 1、按产品构成分析

2008-2010年，本公司的主营业务成本分别为8,008.48万元、8,447.97万元、9,490.23万元，主营业务成本按产品分类如下：

单位：万元

| 按产品分类      | 2010 年度  |         | 2009 年度  |         | 2008 年度  |         |
|------------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|
|            | 金额       | 占比      | 金额       | 占比      | 金额       | 占比      |
| FPC        | 2,560.23 | 26.98%  | 2,357.92 | 27.91%  | 3,854.81 | 48.13%  |
| COF 柔性封装基板 | 4,197.73 | 44.23%  | 4,241.86 | 50.21%  | 2,926.78 | 36.55%  |
| COF 产品     | 2,732.26 | 28.79%  | 1,848.18 | 21.88%  | 1,226.89 | 15.32%  |
| 合 计        | 9,490.23 | 100.00% | 8,447.97 | 100.00% | 8,008.48 | 100.00% |

报告期内，FPC、COF 柔性封装基板、COF 产品是公司主要产品，这三类产品的成本是本公司主营业务成本的主要部分。主营业务成本随着业务规模、产品结构的变化而变化。

### 2、按成本明细分析

报告期内，本公司主营业务成本按成本明细分类如下：

单位：万元

| 成本项目   | 2010 年度  |        | 2009 年度  |        | 2008 年度  |        |
|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
|        | 金额       | 占比     | 金额       | 占比     | 金额       | 占比     |
| 直接材料成本 | 2,438.04 | 25.69% | 2,248.00 | 26.61% | 2,247.38 | 28.06% |
| 直接人工成本 | 2,126.76 | 22.41% | 1,806.18 | 21.38% | 1,602.20 | 20.01% |

|      |          |         |          |         |          |         |
|------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|
| 辅助材料 | 1,350.46 | 14.23%  | 1,331.40 | 15.76%  | 1,443.03 | 18.02%  |
| 直接动力 | 1,148.32 | 12.10%  | 1,015.45 | 12.02%  | 941.80   | 11.76%  |
| 制造费用 | 2,426.65 | 25.57%  | 2,046.94 | 24.23%  | 1,774.09 | 22.15%  |
| 合 计  | 9,490.23 | 100.00% | 8,447.97 | 100.00% | 8,008.48 | 100.00% |

公司主营业务成本构成在报告期内保持稳定，以直接材料成本、制造费用为主，二者合计占比在 50%左右，直接人工成本占比保持在 20%左右，直接动力主要为可直接分配到各类产品中的水电费，不能直接分配到各类产品中的水电费划分到制造费用。

(1) 报告期内，主营业务成本中的直接材料成本具体构成如下表：

单位：万元

| 材料名称  | 2010 年度  |         | 2009 年度  |         | 2008 年度  |         |
|-------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|
|       | 金额       | 占比      | 金额       | 占比      | 金额       | 占比      |
| 铜箔    | 473.22   | 19.41%  | 471.28   | 20.96%  | 507.97   | 22.60%  |
| PI 膜  | 853.80   | 35.02%  | 859.04   | 38.21%  | 914.36   | 40.69%  |
| 保强板   | 254.78   | 10.45%  | 232.94   | 10.36%  | 247.72   | 11.02%  |
| 粘合剂   | 250.14   | 10.26%  | 255.83   | 11.38%  | 266.16   | 11.84%  |
| 芯片及器件 | 606.10   | 24.86%  | 428.91   | 19.08%  | 311.16   | 13.85%  |
| 合 计   | 2,438.04 | 100.00% | 2,248.00 | 100.00% | 2,247.38 | 100.00% |

上表显示，公司主要原材料包括铜箔、PI 膜、保强板、粘合剂、芯片及器件等，其中铜箔和 PI 膜合计占材料总成本的 50%以上，其他材料主要包括保强板、粘合剂、芯片及器件等。报告期内，铜箔、PI 膜占比逐年下降，主要原因为：一方面，铜箔、PI 膜的价格逐年下降；另一方面，公司 COF 产品的占比越来越高，使得生产 COF 产品所用的芯片及器件占比逐年上升。

报告期内，铜箔、PI 膜价格如下：

单位：元/千克

| 产品类别 |        | 2010 年度 |          | 2009 年度 |          | 2008 年度 |
|------|--------|---------|----------|---------|----------|---------|
|      |        | 单价      | 较上年变动百分点 | 单价      | 较上年变动百分点 | 单价      |
| 铜箔   | 35um   | 123     | -0.81    | 124     | -0.80    | 125     |
|      | 18um   | 242     | -1.22    | 245     | -3.16    | 253     |
| PI 膜 | 25um   | 612     | -0.33    | 614     | -6.40    | 656     |
|      | 12.5um | 1,611   | -5.62    | 1,707   | -7.73    | 1,850   |

注：铜箔、PI 膜价格取自公司报告期内采购价格的平均数。

(2) 报告期内，主营业务成本中制造费用占比保持在 20%左右。公司为典

型的高新技术生产型企业，公司大部分生产用机器设备是从日本、美国等国家进口，设备处于行业内国际先进水平，价值较高，故摊销到主营业成本中制造费用的金额较大，占比较高。

报告期内，主营业务成本中制造费用成本具体构成如下表：

单位：万元

| 项目     | 2010 年度  |         | 2009 年度  |         | 2008 年度  |         |
|--------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|
|        | 金额       | 占比      | 金额       | 占比      | 金额       | 占比      |
| 折旧     | 1,636.05 | 67.42%  | 1,388.01 | 67.81%  | 964.83   | 54.38%  |
| 水电费    | 92.46    | 3.81%   | 77.11    | 3.77%   | 63.59    | 3.58%   |
| 工资     | 338.52   | 13.95%  | 280.18   | 13.69%  | 289.62   | 16.33%  |
| 辅助物料消耗 | 192.43   | 7.93%   | 169.42   | 8.28%   | 251.52   | 14.18%  |
| 其他     | 167.20   | 6.89%   | 132.22   | 6.46%   | 204.52   | 11.53%  |
| 合 计    | 2,426.65 | 100.00% | 2,046.94 | 100.00% | 1,774.09 | 100.00% |

制造费用结构分析：

制造费用主要包括固定资产的折旧费用、不能直接分到各类产品中的水电费、车间管理人员工资等。其中水电费主要为生产车间的照明、车间公共区域用水等。

制造费用变动分析如下：

①报告期内，制造费用中的折旧费用占比保持在 50%以上。主要是因为公司作为生产 FPC、COF 柔性封装基板以及 COF 产品的高端产品的企业，对生产设备的技术指标要求相当高。目前，境内的设备不能满足其生产需要，而高端的设备都被境外的企业所垄断，设备价格高。公司生产用设备大部分为从境外进口，固定资产价值较大，进而折旧费用相应较大。报告期内，固定资产金额分别为 26,992.52 万元、31,034.46 万元、34,110.28 万元，占总资产的比例分别为 55.49%、61.07%、60.40%，占比逐年增长。

②辅助物料消耗逐年下降。

报告期内，辅助物料占比由 2008 年的 14.18%下降到 2010 年的 7.93%，主要是由于 2008 年 COF 产品还处于投产后的前期批量生产阶段，绝大部分为新产品、新型号，新产品、新型号就需要制造相应的模具，故辅助材料支出在 2008 年占比较大。随着 COF 产品的产量及销量的增大，辅助物料消耗占比逐年下降。

### （三）主营业务毛利分析

#### 1、主营业务毛利构成

报告期内，公司各类产品的毛利及占主营业务毛利的比重如下表：

单位：万元

| 产品类别       | 2010 年度   |         | 2009 年度  |         | 2008 年度  |         |
|------------|-----------|---------|----------|---------|----------|---------|
|            | 毛利        | 占比      | 毛利       | 占比      | 毛利       | 占比      |
| FPC        | 1,758.89  | 16.17%  | 1,902.39 | 19.40%  | 3,772.39 | 41.31%  |
| COF 柔性封装基板 | 5,998.51  | 55.14%  | 5,919.29 | 60.36%  | 4,066.61 | 44.53%  |
| COF 产品     | 3,120.46  | 28.69%  | 1,985.17 | 20.24%  | 1,292.35 | 14.15%  |
| 合 计        | 10,877.86 | 100.00% | 9,806.85 | 100.00% | 9,131.35 | 100.00% |

公司主营业务毛利来源于 FPC、COF 柔性封装基板及 COF 产品，报告期内，COF 柔性封装基板毛利占比最高，占比保持在 40%以上。

#### 2、综合毛利率分析

2008-2010年综合毛利率分别为53.28%、53.72%、53.41%，综合毛利率保持较高的水平且比较稳定，主要原因如下：

①公司技术及产业链协同等核心优势降低了产品成本，有利于综合毛利率保持较高水平。

首先，关键原材料自产降低了公司材料成本。FCCL 作为生产 FPC、COF 柔性封装基板及 COF 产品的关键原材料，长期以来被境外少数企业所垄断，外购上述材料大大增加了直接材料成本。公司通过自主研发，已成熟掌握 3L-FCCL 及 2L-FCCL 的制造技术与生产工艺并实现 FCCL 自给，与外购 FCCL 或 CCL 材料的企业相比，产品成本大幅降低，提高了毛利率水平。

报告期内，原材料成本占主营业务收入比重与类似行业上市公司沪电股份对比如下表：

| 公司名称 | 2010 年度 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|------|---------|---------|---------|
| 丹邦科技 | 11.97%  | 12.31%  | 13.11%  |
| 沪电股份 | -       | 47.26%  | 54.71%  |

注：其他类似行业上市公司年报未披露原材料成本，沪电股份2010年年报亦未披露原材料成本，故无法获得相关数据。

由上表可知，由于本公司实现了FCCL自产，2008-2010年原材料的成本占主营业务收入的比重不超过15%。沪电股份由于需要外购CCL而大大增加了其产品的

原材料成本占比。

其次，与日本、韩国等国家或地区的企业相比，中国的劳动力成本相对较低，具有一定的人工成本优势。据统计，2008 年我国生产工人的平均工资仅为日本生产工人的 8%。

最后，报告期内主要原材料的价格总体呈小幅下降趋势，也稳定了毛利率水平。

②公司主导产品技术壁垒较强，公司具有较强的议价能力。目前，全球范围内只有日本、韩国、台湾及美国等国家和地区的少数企业掌握 COF 柔性封装基板的生产技术，与普通 FPC 产品相比，该产品竞争较缓和，公司议价能力较强。报告期内，公司主导产品 COF 柔性封装基板的价格保持相对稳定。

③高附加值的 COF 柔性封装基板、COF 产品占比不断上升使综合毛利率保持在较高水平。报告期内，公司加大了 COF 柔性封装基板等产品的研发、生产及销售，COF 柔性封装基板占主营业务收入的比重由 2008 年的 40.80%提高到 2010 年的 50.06%。该产品技术含量、产品附加值、毛利率均较高，比公司的 FPC 产品毛利率约高 8 至 18 个百分点；同时，毛利率较高的 COF 产品占主营业务收入的比重也不断提高。COF 柔性封装基板及 COF 产品的比重不断提高有利于综合毛利率稳定在较高水平。

2009 年、2010 年综合毛利率较 2008 年分别提高 0.44、0.13 个百分点，主要是由于公司 COF 产品毛利率持续提高所致。2009 年、2010 年 COF 产品毛利率较 2008 年分别提高 0.49、2.02 个百分点，导致综合毛利率相应提高。

### 3、按产品类别的主营业务毛利率分析

报告期内，本公司按产品类别的销售毛利率及其变化情况如下表：

| 产品类别       | 2010 年度 |          | 2009 年度 |          | 2008 年度 |
|------------|---------|----------|---------|----------|---------|
|            | 毛利率     | 较上年变动百分点 | 毛利率     | 较上年变动百分点 | 毛利率     |
| FPC        | 40.72%  | -3.93    | 44.65%  | -4.81    | 49.46%  |
| COF 柔性封装基板 | 58.83%  | 0.58     | 58.25%  | 0.10     | 58.15%  |
| COF 产品     | 53.32%  | 1.53     | 51.79%  | 0.49     | 51.30%  |
| 综合毛利率      | 53.41%  | -0.31    | 53.72%  | 0.45     | 53.28%  |



### (1) COF 产品毛利率变动分析

报告期内，COF 产品的平均单价与单位成本的变动情况如下：

单位：元/块

| 项目   | 2010 年度 |        | 2009 年度 |        | 2008 年度 |
|------|---------|--------|---------|--------|---------|
|      | 金额      | 变化率    | 金额      | 变化率    | 金额      |
| 平均单价 | 23.66   | 30.14% | 18.18   | 28.53% | 14.14   |
| 单位成本 | 11.04   | 26.03% | 8.76    | 27.24% | 6.89    |

单位价格及单位成本变动对 COF 产品毛利率的影响如下表：

| 项目                 | 2010 年度 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|--------------------|---------|---------|---------|
| 单位价格波动使毛利率变动的幅度（1） | 14.08%  | 13.75%  | 5.59%   |
| 单位成本波动使毛利率变动的幅度（2） | -12.55% | -13.26% | -5.79%  |
| COF 产品毛利率变动幅度      | 1.53%   | 0.49%   | -0.20%  |

注：（1）=（本年单位价格-本年单位成本）/本年单位价格-（上年单位价格-本年单位成本）/上年单位价格；（2）=（本年单位成本-上年单位成本）/上年单位价格

2008-2010年，COF产品毛利率分别为51.30%、51.79%、53.32%，毛利率保持较高水平，主要原因为：

首先，报告期内COF产品价格逐年增长，主要原因为：

A、多芯片封装的COF产品占比逐年增加。公司在2007年打样试产时，产品主要为单芯片封装，随着公司对COF芯片封装技术的不断提高以及满足客户的下游产品升级需求，公司多芯片封装COF产品占比逐年增多，增加了COF产品的单位成本，公司相应的提高了产品价格。

B、公司是国内少数能够生产高端COF产品的企业之一，公司生产的COF产品线宽线距最细可达到25 μ m，接近世界尖端水平，产品质量和技术性能处于国际先进水平。公司COF产品的高技术含量为公司拥有较强的议价能力奠定了基础。

C、与国外COF产品生产企业相比，公司具有较明显的成本优势，公司COF产品的价格亦处于中等水平，随着公司产品质量的持续提升，以及稳定的产品性能获得客户的认可，在保证公司产品价格竞争力的同时，公司亦根据市场情况提高了产品价格。

其次，报告期内，COF产品平均成本逐年增长，但增长率略低于产品价格增长率。COF产品平均成本逐年增长，主要有以下两方面原因：

A、COF产品作为COF柔性封装基板的产品线的延伸，相应生产线的机器设备

折旧增加导致制造费用增加。

B、COF产品结构的调整。2007年，COF产品还处于打样试产阶段，产品均为单芯片封装，随着公司封装技术的成熟及下游客户的需求，公司多芯片封装COF产品逐年增加，原材料成本增加。

## (2) COF柔性封装基板毛利率变动分析

报告期内，COF 柔性封装基板的平均单价与单位成本的变动情况如下：

单位：元/平方米

| 项目   | 2010 年度  |        | 2009 年度  |       | 2008 年度  |
|------|----------|--------|----------|-------|----------|
|      | 金额       | 变化率    | 金额       | 变化率   | 金额       |
| 平均单价 | 1,321.43 | -0.24% | 1,324.65 | 1.67% | 1,302.89 |
| 单位成本 | 544.03   | -1.62% | 552.99   | 1.42% | 545.27   |

单位价格及单位成本变动对 COF 柔性封装基板毛利率的影响如下表：

| 项目                 | 2010 年度 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|--------------------|---------|---------|---------|
| 单位价格波动使毛利率变动的幅度（1） | -1.30%  | 0.70%   | -0.02%  |
| 单位成本波动使毛利率变动的幅度（2） | 0.68%   | 0.60%   | -0.07%  |
| COF 柔性封装基板毛利率变动幅度  | 0.58%   | 0.10%   | 0.09%   |

注：（1）=（本年单位价格-本年单位成本）/本年单位价格-（上年单位价格-本年单位成本）/上年单位价格；（2）=（本年单位成本-上年单位成本）/上年单位价格

2008-2010 年，COF 柔性封装基板的毛利率分别为 58.15%、58.25%、58.83%，保持较高水平且稳中有升，主要原因为：

①报告期内，COF 柔性封装基板的价格保持稳定。

A、公司明显的成本优势使得 COF 柔性封装基板的价格相对主要竞争对手具有较强的竞争力，与 FPC 产品相比，COF 柔性封装基板技术壁垒较强，竞争相对缓和，报告期内公司未对 COF 柔性封装基板销售价格作较大调整，价格一直保持在 1,300 元/平方米以上。

B、公司持续加大 COF 柔性封装基板的研发，目前公司可生产厚度为 12 μm 的基膜和线宽线距为 25 μm 的 COF 柔性封装基板，产品质量和技术水平不断提高，产品附加值逐步提升，增强了公司的议价能力，使得产品价格保持相对稳定。

②主要原材料 PI 膜、铜箔的价格逐年下降。直接材料成本下降抵消了由制造费用、直接人工成本上升导致单位主营业务成本上升的影响。其中，规格为 12.5um 的 PI 膜价格由 2008 年的 1,850 元/千克下降到 2010 年的 1,611 元/千克；

厚度为 18um 的铜箔价格由 2008 年的 656 元/千克下降到 2010 年的 612 元/千克。主要原材料价格逐年下降降低了单位成本，有利于提升了 COF 柔性封装基板的毛利率水平。

③报告期内，COF 柔性封装基板的良品率不断提高。公司采取的加大研发投入、优化生产流程、2L-FCCL 生产制造水平及改进制造工艺等一系列提高良品率的措施成效明显，良品率的不断提高也有利于提升 COF 柔性封装基板的毛利率水平。

④随着公司 COF 柔性封装基板产能快速增加，生产规模扩大，规模效应相应加大，提升了 COF 柔性封装基板的毛利率水平。

### （3）FPC 毛利率变动分析

报告期内，FPC 的平均销售价格与单位成本的变动情况如下：

单位：元/平方米

| 项目   | 2010 年度 |        | 2009 年度 |        | 2008 年度 |
|------|---------|--------|---------|--------|---------|
|      | 金额      | 变化率    | 金额      | 变化率    | 金额      |
| 平均单价 | 844.62  | -1.18% | 854.71  | -1.75% | 869.93  |
| 单位成本 | 500.67  | 5.84%  | 473.05  | 7.59%  | 439.66  |

单位价格及单位成本变动对 FPC 毛利率的影响如下表：

| 项目                 | 2010 年度 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|--------------------|---------|---------|---------|
| 单位价格波动使毛利率变动的幅度（1） | -0.70%  | -0.97%  | -4.08%  |
| 单位成本波动使毛利率变动的幅度（2） | -3.23%  | -3.84%  | -0.60%  |
| FPC 毛利率变动幅度        | -3.93%  | -4.81%  | -4.68%  |

注：（1）=（本年单位价格-本年单位成本）/本年单位价格-（上年单位价格-本年单位成本）/上年单位价格；（2）=（本年单位成本-上年单位成本）/上年单位价格

报告期内，FPC 毛利率逐年下降，由 2008 年的 49.46%下降到 2010 年的 40.72%，主要原因为：

①报告期内，FPC 价格持续下降。

FPC 市场集中度较低，进入门槛相对较低，呈现高度分散的竞争格局，近年来，境外的 FPC 生产厂商亦在中国大陆大规模投资建厂，包括广州安费诺诚信软性电路有限公司、珠海元盛电子科技股份有限公司在内的多家中国大陆本土著名的刚性印制电路板企业也相继改建、新建 FPC 工厂，FPC 市场竞争越来越激烈，使得 FPC 价格逐年下降。

②报告期内，单位成本持续上升。

单位成本的上升，主要是制造费用增加所致。公司为了扩大 COF 柔性封装基板、COF 产品的产能及提高生产设备的先进水平，陆续增加了相应的设备。2008-2010 年，公司新增固定资产中机器设备分别增加 12,814.50 万元、6,374.86 万元、1,980.61 万元，由于用于生产 COF 柔性封装基板所需的 2 层型柔性覆铜板与生产 FPC 所需的 3 层型柔性覆铜板共享新增的同一条生产线，分摊到 FPC 产品中的折旧费用相应增加，一定程度上增加了主营业务成本，使得毛利率降低。

#### 4、主营业务毛利率变化的量化分析

2010 年公司主营业务毛利率由 2009 年的 53.72% 下降到 53.41%，下降了 0.31 个百分点，各产品对主营业务毛利率的贡献以及对其变动值的贡献列表分析如下：

| 产品类别       | 毛利率     |        | 各类产品收入<br>占主营业务收入比重 |         | 对主营业务毛利率贡献 |        | 主营业务<br>毛利率变<br>动值 |
|------------|---------|--------|---------------------|---------|------------|--------|--------------------|
|            | 2010 年度 | 2009 度 | 2010 年度             | 2009 度  | 2010 年度    | 2009 度 |                    |
|            | A       | B      | C                   | D       | E=A*C      | F=B*D  |                    |
| FPC        | 40.72%  | 44.65% | 21.21%              | 23.34%  | 8.64%      | 10.42% | -1.78%             |
| COF 柔性封装基板 | 58.83%  | 58.25% | 50.06%              | 55.66%  | 29.45%     | 32.42% | -2.97%             |
| COF 产品     | 53.32%  | 51.79% | 28.73%              | 21.00%  | 15.32%     | 10.88% | 4.44%              |
| 合 计        | 53.41%  | 53.72% | 100.00%             | 100.00% | 53.41%     | 53.72% | -0.31%             |

由上表可知，2010 年主营业务毛利率 53.41% 中 COF 柔性封装基板贡献最大，达 29.45%，其次为 COF 产品，为 15.32%。而 2010 年主营业务毛利率同比下降 0.31 个百分点，COF 产品对其变动的贡献为 4.44 个百分点，COF 柔性封装基板为 -2.97 个百分点，FPC 贡献很小。

2009 年，公司主营业务毛利率由 2008 年的 53.28% 上升到 53.72%，提高了 0.44 个百分点，各产品对主营业务毛利率的贡献以及对其变动值的贡献列表分析如下：

| 产品类别 | 毛利率     |         | 各类产品收入<br>占主营业务收入比重 |         | 对主营业务毛利率贡献 |         | 主营业务<br>毛利率变<br>动值 |
|------|---------|---------|---------------------|---------|------------|---------|--------------------|
|      | 2009 年度 | 2008 年度 | 2009 年度             | 2008 年度 | 2009 年度    | 2008 年度 |                    |
|      | A       | B       | C                   | D       | E=A*C      | F=B*D   |                    |
| FPC  | 44.65%  | 49.46%  | 23.34%              | 44.50%  | 10.42%     | 22.01%  | -11.59%            |

|            |        |        |         |         |        |        |       |
|------------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|-------|
| COF 柔性封装基板 | 58.25% | 58.15% | 55.66%  | 40.80%  | 32.42% | 23.73% | 8.69% |
| COF 产品     | 51.79% | 51.30% | 21.00%  | 14.70%  | 10.88% | 7.54%  | 3.34% |
| 合 计        | 53.72% | 53.28% | 100.00% | 100.00% | 53.72% | 53.28% | 0.44% |

由上表可知，2009 年主营业务毛利率 53.72%中 COF 柔性封装基板贡献最大，达 32.42%，其次为 COF 产品，为 10.88%。而 2009 年主营业务毛利率同比上升 0.44 个百分点，COF 柔性封装基板对其变动的贡献为 8.69 个百分点，COF 产品为 3.34 个百分点，FPC 为-11.59 个百分点。

2008 年主营业务毛利率 53.28%中 COF 柔性封装基板贡献最大，达 23.73%，其次为 FPC，达到 22.01%。

综上，由于公司产品结构的调整，在报告期各期，各类产品对公司主营业务毛利率的贡献变化较大，COF 柔性封装基板逐渐取代 FPC 成为对主营业务毛利率贡献最大的产品，同时 COF 产品将来必将成为公司的主要盈利增长点。

#### 5、同行业上市公司毛利率对比分析

| 公司名称 | 2010 年度 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|------|---------|---------|---------|
| 丹邦科技 | 53.41%  | 53.92%  | 53.31%  |
| 行业平均 | 21.71%  | 23.08%  | 21.97%  |
| 兴森科技 | 38.16%  | 37.36%  | 36.43%  |
| 超声电子 | 19.75%  | 20.13%  | 17.68%  |
| 沪电股份 | 22.27%  | 25.13%  | 19.26%  |
| 天津普林 | 6.68%   | 9.71%   | 14.52%  |

注：（1）上市公司的数据来源：首次公开发行股票招股说明书及其公告的年度报告。

（2）行业平均数为行森快捷、天津普林、超声电子、沪电股份四家公司的平均数。

（3）上述毛利率是营业毛利率，与产品毛利率有微小差别。

由上表，公司的销售毛利率远远高于行业平均及同行业上市公司，主要有以下几方面原因：

（1）产品档次不同。公司主要生产技术含量高、应用领域相对高端的 COF 柔性封装基板、COF 产品，该类产品技术门槛高，国内只有极少数企业能够生产。同行业上市公司目前普遍以普通 PCB、刚性印制电器板等低端产品为主业，竞争比较激烈。

（2）主要原材料自产程度不同。FCCL 是生产 FPC 及柔性封装基板的主要原材料，其成本占整个产品成本的 40%-50%。由于公司实现了上游关键原材料柔性封

装基板用高端2L-FCCL、FPC用3L-FCCL和低端2L-FCCL的自产，与同行业上市公司相比，大大降低了材料成本占比，从而使公司产品具有较大的成本优势，对毛利率有较大的影响。

报告期内，原材料成本占主营业务收入比重如下表：

| 公司名称 | 2010 年度 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|------|---------|---------|---------|
| 丹邦科技 | 11.97%  | 12.31%  | 13.11%  |
| 沪电股份 | -       | 47.26%  | 54.71%  |

注：其他类似行业上市公司年报未披露原材料成本，沪电股份2010年年报亦未披露原材料成本，故无法获得相关数据。

由上表，由于本公司实现了FCCL自产，2008-2010年原材料的成本占主营业务收入的比重不超过15%。沪电股份由于需要外购CCL而大大增加了其产品成本。

(3) 产品技术含量不同。公司生产的FPC、COF柔性封装基板及COF产品具有配线密度高、厚度薄、重量轻、配线空间限制少、可折叠、灵活度高等优点，广泛应用于空间狭小、可移动、可折叠的各类电子信息产品，虽然与同行业上市公司同属PCB行业，但属于PCB中柔性电路板领域的高端产品，具有更高的技术含量，从而具有更高的附加值，销售价格也相应较高。

#### (四) 期间费用分析

报告期内，公司的销售费用、管理费用、财务费用变动情况如下表：

单位：万元

| 项目   | 2010 年度   |        | 2009 年度   |        | 2008 年度   |
|------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|      | 金额        | 变动率    | 金额        | 变动率    | 金额        |
| 销售费用 | 406.85    | 71.00% | 238.06    | 38.25% | 172.20    |
| 管理费用 | 3,924.25  | 14.00% | 3,447.18  | 20.46% | 2,861.60  |
| 财务费用 | 1,739.13  | -9.00% | 1,919.95  | 5.44%  | 1,820.88  |
| 合 计  | 6,070.23  | 8.00%  | 5,605.19  | 15.46% | 4,854.68  |
| 营业收入 | 20,567.36 | 12.00% | 18,347.60 | 6.97%  | 17,151.52 |

报告期内，公司的销售费用、管理费用、财务费用占营业收入比重如下表：

| 项目   | 占营业收入比重 |         |         |
|------|---------|---------|---------|
|      | 2010 年度 | 2009 年度 | 2008 年度 |
| 销售费用 | 1.98%   | 1.30%   | 1.00%   |
| 管理费用 | 19.08%  | 18.79%  | 16.68%  |
| 财务费用 | 8.46%   | 10.46%  | 10.62%  |
| 合 计  | 29.51%  | 30.55%  | 28.30%  |

## 1、销售费用

公司销售费用主要包括销售人员工资、办公费、差旅费、业务招待费等。报告期内，公司销售费用明细如下：

单位：万元

| 项目      | 2010 年度 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|---------|---------|---------|---------|
| 工资      | 179.48  | 124.39  | 87.97   |
| 办公费、运输费 | 171.54  | 89.77   | 54.20   |
| 其他      | 14.35   | 12.45   | 15.77   |
| 差旅费     | 38.63   | 10.65   | 13.38   |
| 快递费     | 2.85    | 0.79    | 0.88    |
| 合 计     | 406.85  | 238.06  | 172.20  |

2008-2010 年，公司销售费用逐年增加，2009 年、2010 年分别同比增长 38.25%、70.90%，高于营业收入的增长速度，主要是因为近几年公司加大客户服务力度，使得销售费用中的工资、办公费上升较快，具体如下：（1）2009 年、2010 年工资较上年分别增加 36.42 万元、55.09 万元，主要是由于公司增加招聘了一些营销骨干与一线员工，同时公司不断完善薪酬制度，增加绩效工资比例，增强个人业绩与工资水平的关联度，以促进公司业绩增长；（2）2009 年、2010 年办公费、运输费有所增加，一方面是由于丹邦香港承接了之前由第比尔国际代理公司进出口的部分业务，增加了相应的人员及相关费用；另一方面是外销中直接出口的比例增加，转厂出口的比例下降，使得境外运输费增加较大。

## 2、管理费用

公司管理费用主要包括研发费用、管理人员工资、办公费、折旧费、社保费、福利费、无形资产摊销、维修保养费、差旅费等。报告期内，公司管理费用明细如下：

单位：万元

| 项目     | 2010 年度  | 2009 年度  | 2008 年度  |
|--------|----------|----------|----------|
| 研发费用   | 2,005.46 | 1,633.32 | 1,241.47 |
| 工资     | 532.11   | 442.2    | 435.40   |
| 折旧费    | 403.13   | 418.11   | 410.91   |
| 无形资产摊销 | 299.53   | 301.13   | 273.89   |
| 办公费    | 227.49   | 202.70   | 163.67   |
| 维修保养费  | 98.96    | 120.78   | 99.61    |
| 差旅费    | 38.42    | 82.69    | 26.50    |
| 社保费    | 45.00    | 35.70    | 34.62    |

|          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| 房产及土地使用税 | 46.88    | 10.69    | 19.24    |
| 业务招待费    | 57.33    | 48.43    | 50.97    |
| 福利费      | 4.05     | 17.69    | 16.64    |
| 运杂费      | 2.94     | 8.27     | 3.22     |
| 其他       | 162.95   | 125.47   | 85.46    |
| 合 计      | 3,924.25 | 3,447.18 | 2,861.60 |

2008-2010 年公司管理费用逐年增加，2009 年、2010 年同比分别增长了 20.46%、13.84%，高于营业收入的增长速度，主要是研发费用、无形资产摊销、工资等增幅较大。具体分析如下：

(1) 2009 年、2010 年研发费用较上年分别增加 391.85 万元、372.14 万元，占管理费用增加金额的比例分别为 66.92%、22.78%。近三年，公司不断加大研究与开发费用的投入。研发费用的增加主要包括两部分：A、公司研发人员增加致使工资费用增加；B、公司在报告期内购置了检测仪、分析仪、疲劳测试仪等研发设备，导致研发设备的折旧费用逐年上升。

(2) 管理人员工资及管理费用的比重也较大，保持在 10%以上，2010 年管理人员的工资较上年增加 89.91 万元，主要是由于随着公司业务规模扩大，新聘任了管理人员，且不断改进薪酬结构，使工资上升较快。

管理费用其他项目主要包括咨询费、质量认证检测费等杂项支出。

### 3、财务费用

报告期内，公司财务费用明细如下：

单位：万元

| 项目     | 2010 年度  | 2009 年度  | 2008 年度  |
|--------|----------|----------|----------|
| 利息支出   | 1,565.86 | 1,684.00 | 1,787.25 |
| 减：利息收入 | -6.66    | -8.52    | -44.17   |
| 手续费支出  | 14.22    | 9.72     | 5.59     |
| 汇兑损益   | 165.71   | 234.75   | 72.21    |
| 合 计    | 1,739.13 | 1,919.95 | 1,820.88 |

财务费用主要包括利息支出、银行手续费、利息收入和汇兑损益等。报告期内，公司的利息支出占财务费用的 80%以上。

报告期内，财务费用的变动主要由利息支出、汇兑损益变动引起。

(1) 利息支出为公司长期借款的利息支出。2008-2010 年末，公司长期借



款余额分别为 28,000 万元、25,900 万元、26,000 万元。

(2) 汇兑损益的变动主要由公司各报告期持有的外币资产所致。

A、2009 年汇兑损失较 2008 年增加 162.54 万元，主要是由于公司在 2008 年持有外币资产美元约为 1,300 万，而 2009 年公司持有 818.60 万美元及 239.99 万日元的预付款项，2008-2009 年美元持续走低而日元对人民币持续走强，上述二者使得公司 2009 年产生较大的汇兑损失而 2008 年汇兑损失较少。

B、2010 年汇兑损失较 2009 年减少 69.05 万元，主要原因为：(1) 公司在 2010 年持有外币资产美元、港币分别不同程度的减少；(2) 人民币持续走强，美元、港币兑人民币的汇率分别由 2009 年末的 6.8282、0.8805 分别下降到 6.6227、0.8509。

## (五) 营业外收支分析

### 1、营业外收入

报告期内，公司营业外收入明细如下：

单位：万元

| 项目          | 2010 年度 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|-------------|---------|---------|---------|
| 非流动资产处置利得合计 | -       | 2.02    | -       |
| 其中：固定资产处置利得 | -       | 2.02    | -       |
| 政府补助        | 752.42  | 703.60  | 189.70  |
| 罚没收入        | -       | -       | 0.86    |
| 其他          | 1.79    | 0.13    | 0.05    |
| 合 计         | 754.21  | 705.75  | 190.61  |

报告期内，公司的营业外收入主要为政府补助，具体情况如下：

单位：万元

| 年度      | 项目               | 金额     | 文件                                    |
|---------|------------------|--------|---------------------------------------|
| 2010 年度 | 经济发展专项资金         | 30.00  | 南山区贸易工业局《2009 年度南山区经济发展专项资金第二批资助项目公示》 |
|         | 国家重大专项(02 专项)补助款 | 690.35 | 根据《国家科技重大专项课题任务合同书》，拨付课题经费            |
|         | 递延收益分摊           | 32.07  | 与资产相关的政府补助分摊转入                        |
|         | 小 计              | 752.42 | -                                     |
| 2009 年度 | 专利资助项目款          | 0.60   | 深圳知识产权局《关于公布 2008 年底专利资助拨款的通知》        |
|         | 科学技术三等奖奖金        | 2.00   | 深圳市科技和信息局《关于发放 2006 年度广东              |

|         |                             |        |                                                                                |
|---------|-----------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|         |                             |        | 省科学技术奖金的通知》(粤科奖字[2007]24号)                                                     |
|         | 民营领军骨干企业发展项目资助款             | 101.00 | 深圳市贸易工业局、财政局《关于下达 2008 年度深圳市民营及中小企业发展专项资金民营领军骨干企业发展项目资助计划的通知》(深贸工企字[2009]56 号) |
|         | 技术改造项目贷款贴息款                 | 600.00 | 深圳市贸易工业局、财政局《关于下达深圳市 2009 年度产业技术进步贷款项目贴息计划(第一批)的通知》(深贸工技字(2009)98 号)           |
|         | 小 计                         | 703.60 | -                                                                              |
| 2008 年度 | 市民营及中小企业发展专项资金企业信息化建设项目资助经费 | 57.00  | 深圳市贸易工业局、财政局《关于下达 2008 年度深圳市民营及中小企业发展专项资金企业信息化建设项目资助计划的通知》(深贸工企字[2008]41 号)    |
|         | 技术改造项目贷款贴息款                 | 132.70 | 深圳市贸易工业局、财政局《关于下达深圳市 2008 年度产业技术进步贷款项目贴息计划(第一批)的通知》(深贸工技字(2008)91 号)           |
|         | 小 计                         | 189.70 | -                                                                              |

## 2、营业外支出

报告期内，公司营业外支出明细如下：

单位：万元

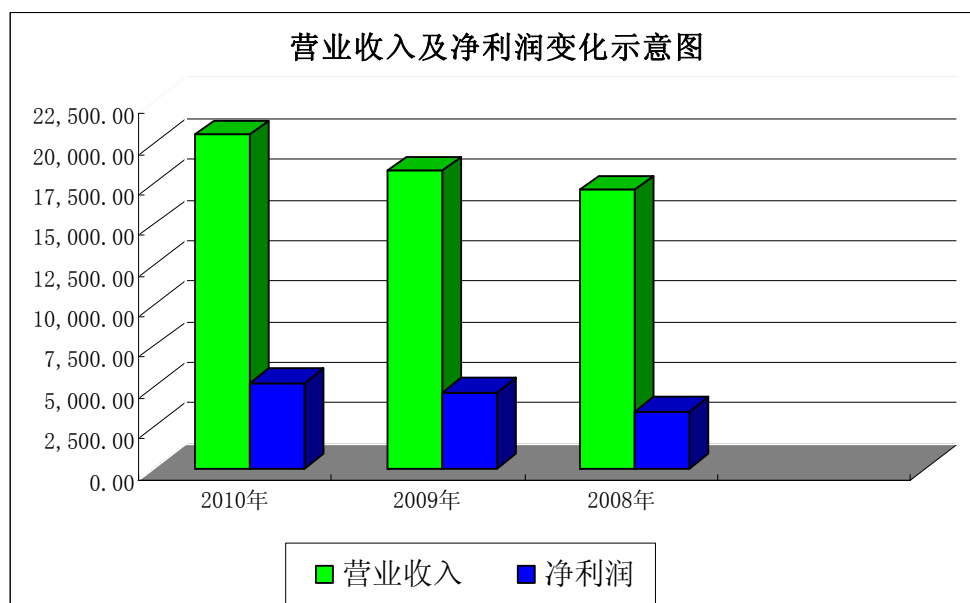
| 项目          | 2010 年度 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|-------------|---------|---------|---------|
| 非流动资产处置损失合计 | 2.79    | 0.62    | 32.38   |
| 其中：固定资产处置损失 | 2.79    | 0.62    | 32.38   |
| 对外捐赠        | -       | -       | 10.00   |
| 其他          | -       | 0.05    | 0.15    |
| 合 计         | 2.79    | 0.67    | 42.53   |

公司营业外支出包括非流动资产处置损失、对外捐赠及其他。2009 年公司对外捐赠为支付给中国红十字协会的向汶川地震的赈灾款。公司营业外支出金额很小，对公司利润影响不大。

## (六) 经营成果分析

### 1、归属于母公司的净利润逐年增长

2008-2010 年，归属于母公司的净利润分别为 3,514.35 万元、4,663.14 万元、5,268.05 万元。公司净利润保持逐年上升。报告期内公司营业收入及净利润增长趋势图如下：



## 2、经营成果变化趋势分析

报告期内，公司利润表主要项目的变动情况如下：

单位：万元

| 项目           | 2010 年度   |         | 2009 年度   |          | 2008 年度   |           |
|--------------|-----------|---------|-----------|----------|-----------|-----------|
|              | 金额        | 同比增减    | 金额        | 同比增减     | 金额        | 同比增减      |
| 营业收入         | 20,567.36 | 12.10%  | 18,347.60 | 6.97%    | 17,151.52 | 28.26%    |
| 减：营业成本       | 9,563.84  | 13.11%  | 8,455.46  | 5.58%    | 8,008.48  | 35.37%    |
| 营业税金及附加      | 3.77      | 10.23%  | 3.42      | -        | -         | -         |
| 期间费用合计       | 6,070.23  | 8.30%   | 5,605.19  | 15.46%   | 4,854.68  | 37.54%    |
| 资产减值损失       | -57.95    | 24.46%  | -46.56    | -106.86% | 679.15    | 919.90%   |
| 营业利润         | 4,987.47  | 15.18%  | 4,330.09  | 19.97%   | 3,609.21  | -6.50%    |
| 加：营业外收入      | 754.21    | 6.87%   | 705.75    | 270.26%  | 190.61    | -31.19%   |
| 减：营业外支出      | 2.79      | 316.42% | 0.67      | -98.42%  | 42.53     | 3,837.96% |
| 利润总额         | 5,738.89  | 13.98%  | 5,035.17  | 34.01%   | 3,757.28  | -9.16%    |
| 净利润          | 5,268.05  | 12.97%  | 4,663.14  | 32.69%   | 3,514.35  | -15.35%   |
| 归属于母公司股东的净利润 | 5,268.05  | 12.97%  | 4,663.14  | 32.69%   | 3,514.35  | -15.35%   |

2009 年，公司营业收入比 2008 年增长 6.97%，增速放缓。主要是因为公司现有生产厂房位于深圳市经济特区内，深圳市对经济特区内的工业用水的排水量有严格限制，公司的排水量已近饱和，限制了产量的进一步扩张；2009 年，营业成本增长 5.58%，低于营业收入增长，主要是公司对产品结构优化，增加高端产品的占比；2009 年期间费用增长 15.46%，主要是研发费用及财务费用增加所致；2009 年公司利润总额、净利润分别增长 34.01%、32.69%，主要是因为公司不断优化产品结构，高附加值、高毛利率的 COF 柔性封装基板及 COF 产品销售占

比不断提高。

2010 年，营业收入较上年增长 12.10%，增幅较 2008 年放缓，主要原因是受到现有深圳特区内的工业用水的排水量的严格限制及公司现有产能的限制。2010 年，营业成本增加 13.11%，略高于营业收入的增长，主要是由于公司调整产品结构，增加高端产品 COF 产品的比例而需要增加相应机器设备的投入，从而制造费用增加。2010 年期间费用增长 8.30%，主要是研发费用的增加所致。2010 年公司利润总额及净利润增长分别增长 13.98%、12.97%，主要是由于公司进一步调整产品结构，增加盈利能力更强的 COF 产品的比例所致。

### **3、主要利润来源分析和可能影响发行人盈利能力连续性和稳定性的主要因素分析**

报告期内公司利润主要来源于公司从事 FPC、COF 柔性封装基板及 COF 产品的研发、生产及销售产生的营业利润，营业外收入对公司的利润影响很小。

可能影响公司盈利能力连续性和稳定性的主要因素分析如下：

#### **（1）国家产业政策**

2009 年，国家发展改革委、工业和信息化部联合发布了《国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅关于进一步做好电子信息产业振兴和技术改造项目组织工作的通知》，要求重点支持高端印制电路板及覆铜板材料，高端印制电路板包括高密度互联多层印制电路板、多层挠性板、刚挠印制电路板、IC 封装载板、特种印制电路板；鼓励节能减排工艺发展，重点发展环保型的高性能覆铜板、特殊功能覆铜板、高性能挠性覆铜板和基板材料等研发和产业化。国家产业政策支持为公司未来发展提供了有利的政策环境。

#### **（2）全球宏观经济环境**

FPC、COF 柔性封装基板、COF 产品广泛应用于消费电子、通讯设备、医疗器械、仪表仪器、航天航空等众多领域，这些终端产品的需求受全球宏观经济变化影响。比如 2008 年，受世界金融危机的影响，TFT-LCD 的下游应用液晶电视、手机、笔记本电脑、数码相机等产品需求量大幅下降，导致全球 COF 柔性封装基板销售额近年来首次出现负增长。目前，全球宏观经济逐渐复苏，为公司未来发

展提供了良好的市场机遇。

### （3）技术创新能力

公司所生产的产品综合运用了高分子材料学、光电子材料学、固体物理学、微电子学、光学及自动化控制学等诸多学科,公司在多学科综合技术掌握的全面性方面具有优势,是国内极少数掌握产业链各环节主要产品制造工艺的企业之一。公司非常注重研发和技术创新,公司的技术储备项目如线宽线距 20  $\mu\text{m}$  的超微细化线 COF 柔性封装基板和厚度小于 10  $\mu\text{m}$  的高端 2L-FCCL 基膜是根据国际上最新的技术、标准的发展方向所做的前瞻性研究,符合电子信息产品轻薄短小的发展趋势,是公司在未来几年内持续保持技术领先的保证。

### 4、出口退税政策影响分析

公司主营业务属于国家优先发展的高新技术产业,高端印制电路板材料属于国家重点支持出口的产品,可按照国家相关规定享受出口退税的优惠政策。报告期内公司产品出口一直适用 17% 的出口退税率。报告期内公司出口退税金额及占利润总额的比重如下:

单位: 万元

| 项目     | 2010 年度  | 2009 年度  | 2008 年度  |
|--------|----------|----------|----------|
| 出口退税金额 | 763.19   | 413.60   | 425.29   |
| 利润总额   | 5,738.89 | 5,035.17 | 3,757.28 |
| 占比     | 13.30%   | 8.21%    | 11.32%   |

尽管国家政策支持推动出口稳定增长,保持外需政策的连续性和稳定性,但仍有可能发生出口退税政策变化的风险。若未来出口退税率下调,将会对公司产生一定影响。

公司针对出口退税政策变化将采取以下措施:

#### （1）运用较强的议价能力消化出口退税率调整对成本的影响

公司拥有多年的海外市场开拓经验,公司的规模实力、产品研发、制造水平、质量控制、及时交货以及综合管理水平等方面均获得了客户的高度认可,在同行业中具有相对竞争优势,拥有较强的议价能力,公司具备随出口退税率变化对产品报价作相应调整的能力。

#### （2）进一步增强研发能力、开发新产品、调整产品结构、提高产品附加值、

优化生产流程，以消化成本上升影响

随着公司研发实力的增强，报告期内公司成功开发了生产工艺先进、技术含量高、附加值更高的 COF 柔性封装基板及 COF 产品。报告期内，公司科技含量更高、竞争力更强的产品销售收入占比不断提高，成功地消化了成本上升的影响。今后，公司仍将继续增强研发能力、开发新产品、调整产品结构、提高产品附加值、优化生产流程及生产工艺，以消化成本上升的影响。

### （七）非经常性损益和合并报表范围以外的投资收益分析

公司无合并报表范围以外的投资收益，2008-2010 年扣除所得税、少数股东损益后的非经常性损益净额分别为 334.27 万元、787.64 万元、817.06 万元，分别占各期归属于母公司股东净利润的 9.51%、16.89%和 15.51%，并不构成公司盈利的主要来源，对公司盈利能力的持续性和稳定性影响较小。

## 三、现金流量分析

报告期内，本公司现金流量简表如下：

单位：万元

| 项目                | 2010 年度    | 2009 年度   | 2008 年度   |
|-------------------|------------|-----------|-----------|
| 经营活动产生的现金流量净额     | 10,774.78  | 9,251.43  | 4,698.07  |
| 投资活动产生的现金流量净额     | -12,192.10 | -4,413.70 | -6,662.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额     | -2,005.10  | -3,796.89 | 2,738.13  |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -16.92     | -15.37    | -130.65   |
| 现金及现金等价物净增加额      | -3,439.34  | 1,025.46  | 643.41    |

### （一）经营活动产生的现金流量分析

报告期内，公司经营现金流量逐年增加，经营活动产生的现金流量净额分别是 4,698.07 万元、9,251.43 万元、10,774.78 万元，分别占对应期间实现净利润的 133.68%、198.39%、204.53%，三年累计数为 24,724.28 万元，占三年累计净利润的 183.88%，超过净利润 11,278.74 万元，经营活动产生的现金流量充足。2008-2010 年经营活动现金流量充足主要得益于报告期内应收账款回收正常，存货库存控制良好，以及公司的谈判地位和议价能力不断提高。

## **（二）投资活动产生的现金流量分析**

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额报告期内均为负数，且逐年减少，分别为-6,662.13万元、-4,413.70万元、-12,192.10万元，主要是公司近几年正处于持续扩大产能、调整产品结构阶段，为增加高附加值的COF柔性封装基板及COF产品产能而新购置了机器设备及检测设备等。

2008年投资活动金流量流出主要包括以下两方面：（1）随着公司COF柔性封装基板及COF产品的销量逐渐增大，生产上述产品基材FCCL的生产线已不能满足扩产要求，公司新购买了相应生产设备，总投入2,231万元；（2）公司为了做好减排工作，开始更新改造生产车间的环保设施，本年总投入为1,806万元。

2009年投资活动现金流出主要包括以下两个方面：（1）公司为提高废水处理能力以满足环保要求，新构建了30T/DI水系统工程；（2）公司为扩大COF柔性封装基板产能而购买了LCP净化涂布机装置、蚀刻线、自动光学检测机等机器设备。

2010年投资活动金流量流出主要是公司为了改善生产车间的工作环境，以达到更严的质量控制标准，对生产车间的环保设施及净化设施进行了改造升级以及以广东丹邦为募投项目实施主体的项目实施进度款，包括采购机器设备等，2010年合计支出12,389.10万元。

## **（三）筹资活动产生的现金流量分析**

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量逐年减少，分别为2,738.13万元、-3,796.89万元、-2,005.10万元。

2008年，公司筹资活动所产生的现金流量净额为2,738.13万元，主要由以下各项构成：收到国家开发银行借款5,000万元、偿还深圳发展银行本年到期的100万元短期借款及各种贷款利息。

2009年，公司筹资活动所产生的现金流量净额为-3,796.89万元，主要由以下各项构成：收到国家开发银行借款13,000万元、偿还国家开发银行借款5,100万元、偿还中信银行深圳分行的借款13,000万元及借款利息1,686.89万元。

2010年，公司筹资活动所产生的现金流量净额为-2,005.10万元，主要由以

下各项构成：收到招商银行借款 5,000 万元、偿还国家开发银行借款 4,900 万元及偿还借款利息 1,565.86 万元。

报告期内，本公司的生产经营规模迅速扩大，对资金的需求也相应地不断增加，除经营活动产生的现金流入外，公司还以银行借款方式筹集营运资金。

## 四、资本性支出分析及其他事项说明

### （一）报告期内重大资本性支出情况

单位：万元

| 年度      | 项目             | 金额        |
|---------|----------------|-----------|
| 2010 年度 | 环保设备工程         | 2,000.00  |
|         | 净化设备工程         | 1,540.00  |
|         | COF 生产线        | 1,469.66  |
|         | COF 设备         | 6,475.06  |
|         | 合 计            | 11,484.72 |
| 2009 年度 | 30T/DI 水系统设备工程 | 1,372.00  |
|         | CCL 生产线        | 1,801.38  |
|         | 合 计            | 3,173.38  |
| 2008 年度 | COF 生产线工程      | 4,603.88  |
|         | CCL 生产线工程      | 2,424.03  |
|         | 合 计            | 7,027.91  |

随着下游产品不断升级换代，其对公司产品的质量、技术指标要求越来越高。为适应市场发展需要，报告期内，公司从日本进口了更先进的机器设备，主要包括印刷基板镀金装置、蚀刻露光机、去膜线机、微电子涂布机，电磁加热覆合机，特殊雾围 R-R 热处理工程装置、软镀金线、净面线、卷到片蚀刻线、卷到片去膜线等，新设备的投入使得公司产品在良品率及精度上均有较大幅度提升。

公司凭借产品良品率、精度的提高以及稳定的产品性能，2008 年、2009 年新增了无锡夏普、航空电子、NISCA、川奇光电、欧姆龙等一批高端客户，例如，2009 年公司对无锡夏普实现收入 2,012.85 万元。

同时，不断投入更先进的设备还可保证公司不断研发和生产技术含量更高的产品以满足高端客户对产品的要求，从而使产品毛利率维持在较高水平。



## **（二）未来可预见的重大资本性支出计划及资金需要量**

在未来两到三年，公司重大资本性支出主要为本次发行股票募集资金投资项目，项目新增固定资产投资约 33,000 万元。在募集资金到位后，公司将按拟定的投资计划分期进行投资，具体情况详见本招股说明书第十二节之“一、（三）募集资金投资进度”。

## **（三）其他事项说明**

1、近三年，公司重大会计政策及会计估计与可比上市公司基本一致，不存在较大差异。根据目前国家法律法规，公司重大会计政策及会计估计不需要进行变更，公司不会因为重大会计政策或会计估计的差异或变更而对公司利润产生影响。

2、公司的或有事项为：截至 2010 年 12 月 31 日，公司不存在其他或有事项，也不存在重大担保、诉讼和其他重大期后事项。

## **五、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析**

近几年和未来几年影响公司财务状况和盈利能力的因素主要有四个方面，各方面因素对公司未来财务状况和盈利能力的影响如下：

### **（一）公司产品下游市场需求的不断增长为公司提供了良好的发展空间**

公司产品 FPC、COF 柔性封装基板、COF 产品广泛应用于液晶显示器、液晶电视、计算机、照相机、打印机及汽车音响等消费电子产品中。通信设备、电子计算机等电子产品需求的持续增长为其上游行业的快速增长提供了强劲动力。

本公司作为 COF 柔性封装基板及 COF 产品的生产厂商，能够独立自主研发产品的技术，形成自主知识产权，并逐步在国际市场上与跨国公司争夺高端市场份额。

### **（二）公司较强的国际竞争力为公司持续发展提供了有效的市场保障**

COF 柔性封装基板及 COF 产品广泛应用于各类电子信息产品，从市场竞争格局上看，COF 柔性封装基板生产企业呈现高度集中的竞争格局，COF 产品竞争也

相对集中集中的格局,公司通过多年的技术积累,是国内极少数掌握高端 2L-FCCL 制造工艺并大批量生产的厂商之一,填补了我国在高端柔性印制电路板领域的空白,在一定程度上影响着中国 COF 柔性封装基板产业的发展方向。在 COF 柔性封装基板及 COF 产品领域形成了较高的知名度和良好的信誉度。庞大的优质客户群体为公司的持续发展提供了有效的市场保障。

### **(三) 国内其他从事 COF 柔性封装基板、COF 产品的企业尚处于初期的起步阶段,未来几年公司可继续保持国内 COF 柔性封装基板产品的领军地位**

国内 COF 柔性封装基板产业还处于初期的起步阶段,目前国内仅有少数企业有能力自主生产 COF 柔性封装基板,这些企业大致可以分成两类,外资企业和内资企业。国内其他企业的 COF 柔性封装基板目前还处于基础研发阶段,相关的认证也在申请中,比本公司落后至少 2~3 年。

我国部分 FPC 生产商,如广东、华东地区有多家 FPC 企业开始进行少量 COF 产品的生产,但生产的 COF 产品档次较低,适用于较低端的终端产品。

### **(四) 公司技术储备充分并紧密跟踪行业未来技术发展趋势开展前瞻性技术研发,有利于公司进一步强化公司核心竞争力,保持持续盈利能力**

COF 柔性封装基板和 COF 生产涉及的技术主要包括无胶基材生产技术、微粘膜制造技术、微孔加工技术、超微细线路制作技术、焊盘金手指制作技术、表面涂覆工艺、COF 封装技术,上述技术均为丹邦科技自主研发掌握并已成熟运用的技术。

当前,COF 柔性封装基板主要向着线路微细化和薄型化方向发展。在电子信息产品轻、薄、短、小化趋势带动下,芯片之间的节距越来越小,线路输入输出接口越来越多,对线路精细化要求越来越高。未来几年,COF 柔性封装基板在技术方面将继续向着线路微细化和薄型化方向发展。

此外,COF 封装技术已经成为显示驱动 IC 封装的主流趋势之一。基于柔性封装基板技术的 COF 封装技术是指将芯片直接封装在柔性印制电路板上的一种封装形式,产品主要用于高档消费电子领域。随着便携式电子设备需求的剧增,

加速了电子产品小型化、轻量化、高性能化的进程，电子产品的轻薄短小发展趋势要求必须有高密度、小体积、能自由安装的新一代封装技术来满足以上需求。而 COF 技术正是在这样的背景下迅速发展壮大，成为 LCD 平板显示器的驱动 IC 的一种主要封装形式，COF 技术已经成为未来平板显示器的驱动 IC 封装的主流趋势之一。

目前，公司正在从事的包括二层无胶基材基膜厚度减薄与表面电阻增强技术研究等多个项目正是围绕线路微细化、薄型化及 COF 封装等技术进行的研究，符合行业技术的发展方向，为公司的长远发展提供技术储备，可保证公司的技术领先优势及核心竞争能力。

## **第十一节 业务发展目标**

### **一、公司中长期发展目标**

#### **（一）公司总体发展战略**

公司设立以来，积极开拓国外市场，公司凭借先进的技术水平、稳定的产品质量和可靠的产品性能，在下游客户中赢得了良好的声誉。未来几年，公司将立足于高端FPC、COF柔性封装基板及COF产品的良好市场前景，立志于把自身打造成高端柔性电路板、COF柔性基板及芯片柔性封装产业的民族品牌，力争把公司建设成一家国内领先、国际一流的以技术创新为核心价值的横跨高端柔性电路板及芯片柔性封装领域的自主创新型企业。

#### **（二）公司未来三年的发展目标**

为实现总体发展战略，公司未来三年的发展目标为：

1、进一步提升公司柔性封装基板的研发水平与制造能力。按计划、有步骤地发展技术含量高、产品附加值大、市场前景广阔的高端柔性封装基板，不断扩大柔性封装基板产能，优化产品结构；积极实施募集资金投资项目，在解决产能瓶颈的同时，顺应市场需求发展趋势，扩大高端产品生产能力。

2、进一步完善公司产业链优势，持续扩大COF产品产能。在进一步巩固和强化公司在柔性封装基板研发与制造优势的前提下，向产业链下游——芯片柔性封装延伸，不断提高芯片柔性封装工艺水平，通过募集资金投资项目的实施扩大芯片封装产能；同时，开展基于柔性封装基板技术的芯片三维封装的技术研发。

随着本次募集资金的到位，募投项目逐步投产，公司产品结构进一步优化，公司产品将在国内外市场享有更高知名度，产品技术、性能和质量均达到国际一流水平。

### **二、实现上述发展规划拟采取的措施**

根据上述公司发展目标，公司制订了发行当年及未来两年内拟采取的具体措

施，具体如下：

### **（一）技术研发计划**

围绕COF柔性基板技术升级及芯片封装产业化，公司将继续开展柔性材料及相关微加工技术的研究与开发，以保持公司在业内的技术领先优势。在柔性材料方面，将研发膜厚小于9 $\mu\text{m}$ 的二层无胶基材，线宽线距达10 $\mu\text{m}$ 的高密度布线技术，线宽线距为30 $\mu\text{m}$ 、基板厚度为80至100 $\mu\text{m}$ 、基板层数为4至6层、叠层数为2至3层、封装体厚度小于1.2mm的柔性封装技术；在微加工技术方面，研发三维多层内连高频高密度柔性线路，以实现大批量生产。

### **（二）市场营销计划**

巩固和扩大已经形成的国际市场，抓住国际市场对消费电子不断升级换代的有利时机，加强日本、欧美、东南亚及香港的市场建设和管理。同时公司将继续积极扩大和世界知名的电子信息产品生产厂商合作，发挥公司强大的研发和创新能力及成本优势，努力与客户建立持久稳固的合作关系。

加强销售队伍的建设，完善激励措施，大力引入海内外市场营销人员，为公司营销网络的建设计划扩充更多新的力量；在日本等主要海外市场设立办事处，以开展售后服务、客户关系维护及开拓客户等工作。

### **（三）人才开发计划**

1、重视管理和技术科研人才的培养和引进工作。公司将在未来的三年内，继续引进一批中高层管理人才和技术专家，培养一批技术和管理的骨干，使公司的人才结构更加完善和优化。

2、完善人力资源方面的激励与考核制度。结合双向选择、公开招聘、公平竞争、量化考核、末位淘汰，不断完善企业内部的人才流动机制和动态的管理机制，促进人力资源素质、结构的优化，追求人力资源与公司整体需要的科学匹配。

3、加大培训力度，不断提高公司员工素质。坚持全员培训为基础、分层培训为重点，通过开展岗前培训、内部培训、选派人员外出培训等方式，加速提高人员技术水平、业务素质和道德素质，培养公司发展需要的各类人才。

#### **（四）信息技术计划**

公司将全面加强信息化建设，不断提高公司信息化水平。继续抓好企业计算机管理网络的建设、提高应用水平，在产品开发、生产计划、物资采购、市场营销、产品质量控制、设备管理等主要环节和关键领域，积极应用企业资源计划（ERP），并以其作为平台，开发出更多有利于流程优化的管理系统，建立信息资源共享数据库，实现信息流、资金流、物流、人员流动高效运作和数据共享，建立客户关系管理、合同管理、信用管理、风险管理等综合IT信息系统，提高企业整体工作效率。

#### **（五）公司治理计划**

1、公司将通过股票发行上市，建立完善的法人治理结构和充分的信息披露制度，严格按照上市公司的要求规范运作，强化各项决策的科学性和透明度，促进公司的机制创新和管理水平升级。

2、公司将根据企业发展的不同时期，灵活调整组织架构，使组织架构保持弹性和高效，使之与公司经营发展规模互相适应，最大限度提高公司整体运营效率。

#### **（六）筹资计划**

公司将利用公开发行股票并上市的有利时机，走生产经营和资本经营相结合的发展道路，保持良好的经营业绩，为全体股东带来更好的回报，不断增强再融资能力。在未来三年内公司将根据自身实际情况和发展需要，充分利用金融市场包括增发新股、向银行贷款等方式筹集资金，为公司把握市场发展机遇提供资金保障。

### **三、发行人拟定上述计划所依据的假设条件**

- 1、公司所遵循的国家现行相关的法律法规、方针政策等无重大变化；
- 2、公司所处行业处于正常发展状态，无重大不利的市场突变情形；
- 3、国家现行的税收、利率及汇率政策无重大变化；
- 4、公司所在地区的社会经济环境不存在重大不利变动；

- 5、公司生产经营能力不受能源、动力、原材料短缺等重大不利因素影响；
- 6、公司本次股票发行成功，募集资金及时到位；
- 7、无不可抗拒因素或不可预见因素对本公司造成重大不利影响。

#### **四、发行人实施上述计划将面临的主要困难**

1、本次募集资金投资项目的实施和公司未来市场拓展等都需要大量资金投入，仅依靠公司自身积累和银行授信已不能满足需要，资金不足是公司面临的最主要困难。

2、在公司持续发展的情况下，公司未来如果不能继续增加人力资源储备，可能出现技术、营销、管理及财务等人才短缺的情况。

3、经营规模持续扩张和实力持续增强对公司管理水平提出了更高的要求，公司在运营机制、资源配置、内部控制管理等方面都面临一定挑战。

#### **五、发行人确保实现上述计划拟采用的方式、方法或途径**

1、本次发行股票为公司实现上述业务目标提供了资金支持，公司将加大研发投入，认真组织募集资金投资项目的实施，争取尽快投产，促进公司生产规模的扩大和设备技术水平提高；推进国际国内营销网络建设，增强公司的综合竞争力。

2、严格按照上市公司的要求规范运作，完善公司的法人治理结构，强化各项决策的科学性和透明度，促进公司的机制创新和管理升级。

3、加快对人才特别是研发人员、高级管理人员和市场营销人员的引进，进一步提高公司的研发水平、管理水平和销售能力，确保公司业务发展目标的实现。

4、逐步提高公司的市场知名度和营销渗透力，积极拓展国际国内市场，提高公司产品市场占有率。

#### **六、上述业务发展规划与现有业务的联系**

发行人主要从事FPC、COF柔性封装基板及COF产品的生产和销售，在同行业

中占有优势地位，产品具有可靠的性能、良好的市场声誉及稳定的销售渠道，具有实力较强的技术研发机构和充足的技术储备，生产技术不断提高，生产工艺不断改善，取得了良好的经济效益和社会效益，为公司的进一步发展创造了有利条件。

上述业务发展计划是以本公司现有主营业务为基础，以现有的技术和客户资源为依托，实施产品档次的提升、技术工艺的升级、产能扩大及产业链的延伸。上述业务若得以实现，不仅将进一步发挥公司现有核心竞争优势，扩大公司的经营规模，还将增加产品附加值，推进公司产品的结构优化，全面提升公司的核心竞争能力。



## 第十二节 募集资金运用

随着消费类电子产品愈来愈走向轻薄短小化，新的电子材料及组装技术不断推陈出新，COF产品在市场应用和技术上日渐成熟，特别是在液晶显示制造领域上获得很大的迈进。COF封装作为一种新型、先进的柔性封装形式在电子产品小型化和液晶显示电子产品高速发展的驱动下面临市场不断扩大的机遇。

为抓住市场机遇，进一步发挥公司自产关键配套材料、COF柔性封装基板的优势，做强公司主营业务，本公司拟通过上市募集资金，投资建设“基于柔性封装基板技术的芯片封装产业化项目”，该项目是公司现有主营业务的升级与扩大再生产，有利于进一步发挥公司现有优势，优化公司产品结构并扩大产能，是提升公司市场竞争力，实现公司发展战略的重要举措之一。

### 一、募集资金总量及其运用计划

#### （一）本次发行募集资金总量及专户存储安排

公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股4,000万股，占发行后总股本的25%，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于与公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。

根据《深圳丹邦科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户集中管理，实行募集资金专项存储制度。

#### （二）募集资金具体用途

2010年9月15日，公司2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于深圳丹邦科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》。本次发行的股票将投资于“基于柔性封装基板技术的芯片封装产业化项目”。募集资金投资项目的审批情况如下：

单位：万元

| 项目名称           | 项目总投资     | 项目核准机关       | 项目核准文号           | 环评核准文号            |
|----------------|-----------|--------------|------------------|-------------------|
| 基于柔性封装基板技术的芯片封 | 42,500.00 | 东莞松山湖科技产业园区经 | 东发改松<br>[2010]8号 | 粤环审<br>[2011]130号 |

|        |           |        |   |   |
|--------|-----------|--------|---|---|
| 装产业化项目 |           | 济贸易发展局 |   |   |
| 合计     | 42,500.00 | —      | — | — |

上述项目投资总额为42,500.00万元，拟全部运用本次发行募集资金。若实际募集资金少于募集资金计划使用额，公司将通过银行贷款和自筹资金予以解决；若实际募集资金超过募集资金计划使用额，超出部分将用于补充公司流动资金。

### （三）募集资金投资进度

本次募集资金投资项目投资进度情况如下：

单位：万元

| 项目名称                 | 募集资金投资    | 第一年       |        | 第二年       |        | 第三年       |        |
|----------------------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
|                      |           | 投资额       | 比例     | 投资额       | 比例     | 投资额       | 比例     |
| 基于柔性封装基板技术的芯片封装产业化项目 | 42,500.00 | 13,600.00 | 32.00% | 11,400.00 | 26.82% | 17,500.00 | 41.18% |

注：第一年指从项目开始建设起至其后第12个月的期间，第二年、第三年依此类推。

本项目建设期3年，建设期第3年开始投产，投产后的第3年达产。

本次募集资金投资项目由本公司全资子公司广东丹邦实施，广东丹邦成立于2009年8月25日，位于广东省东莞市松山湖科技产业园区北部工业城C区BC-18。

根据广东丹邦与广东东邦签署的《资产收购协议》及《补充协议》，广东丹邦以经审计的账面值为参考作价63,482,104.02元购买广东东邦拥有的座落于东莞市松山湖北部工业城的土地使用权（宗地号为1935030100045）和厂房等在建工程用以实施募投项目。广东丹邦已向广东东邦支付全部转让价款，2011年5月9日，广东丹邦取得东莞市人民政府颁发的1935030100045号宗地的《国有土地使用证》（东府国用[2009]第特66号），完成该土地使用权的过户变更登记。

此外，针对产品需求持续增长的市场形势，为争取项目早日建成投产，广东丹邦通过自筹资金方式已购买部分募集资金投资项目所需的生产设备，截至2010年12月31日，已累计投入6,475.06万元。

募集资金到位后，广东丹邦将用募集资金置换上述已发生的用于募集资金投资项目的全部支出，剩余部分用于项目的后续建设。

## 二、募集资金投资项目的必要性与可行性

### （一）募集资金投资项目的必要性

从行业发展趋势、市场需求的增长、优化产品结构、公司目前产销情况及提升竞争优势等方面来看，公司募投项目的投资是非常必要的，其理由如下：

#### 1、COF封装已经成为显示驱动IC封装的主流趋势之一

##### （1）COF柔性封装基板主要向着线路微细化和薄型化方向发展

超微细化线路是指COF柔性封装基板线宽线距小于50 $\mu\text{m}$ ，当前，在电子信息产品轻、薄、短、小化趋势带动下，芯片之间的节距越来越小，线路输入输出接口越来越多，对线路精细化要求越来越高。比如，大型液晶平板显示器驱动芯片用的COF柔性封装基板线宽线距从2005年的50 $\mu\text{m}$ 减少到现今的35 $\mu\text{m}$ ，行业领军企业日本三井金属现今已能生产线宽线距仅20 $\mu\text{m}$ 的COF柔性封装基板。

超微细化线路制造工艺复杂，涉及铜箔减薄、铜箔表面处理、图形转移、铜箔蚀刻、表面涂覆等多种技术融合应用。本公司通过多年的技术积累，已熟练掌握高微细化线路制作技术，采用减薄工艺将采购的铜箔厚度减至9 $\mu\text{m}$ ，以保证精细线路的均匀性，提高信号传输的完整性；通过调控化学药水及工艺参数，使线路达到最佳图形转移和蚀刻效果；通过表面涂覆工艺提高基板表面散热功能、耐磨性以及降低接触电阻。

在COF柔性封装基板的制造中，基板材料主要采用2L-FCCL。与3L-FCCL相比，它在制造中无需使用胶粘剂，由于COF的微细线路、高精度对引线位置精度、高介电性能、挠曲性等的性能要求，目前世界上制作COF基板普遍采用2L-FCCL。未来几年，COF柔性封装基板在技术方面将继续向着线路微细化和薄型化方向发展。

##### （2）COF封装技术已经成为显示驱动IC封装的主流趋势之一

基于柔性封装基板技术的COF封装技术是指将芯片直接封装在柔性印制电路板上的一种封装形式，产品主要用于高档消费电子领域。随着便携式电子设备需求的剧增，加速了电子产品小型化、轻量化、高性能化的进程，特别是在显示领域，随着LCD的广泛应用及OLED的迅速发展，COF产品越来越被更多的企业采用，从而推动了COF技术以及产品向更多技术领域的渗透，例如，大尺寸如液晶显示

器、液晶电视、中小尺寸如手机、数码相机、数码摄像机以及其他3G产品，这些产品都是以轻薄短小为发展趋势的，这就要求必须有高密度、小体积、能自由安装的新一代封装技术来满足以上需求。而COF技术正是在这样的背景下迅速发展壮大，成为LCD平板显示器的驱动IC的一种主要封装形式，进而成为这些显示模组的重要组成部分。COF技术已经成为未来平板显示器的驱动IC封装的主流趋势之一。

## 2、完善公司产业链，优化产品结构

公司现已形成从FCCL→FPC、FCCL→COF柔性封装基板→COF产品的完整产业链，随着电子信息产品的轻、薄、短、小化发展趋势，COF柔性封装基板及COF产品的需求将持续增长。通过公开发行人上市并实施本项目，将进一步扩大附加值高、技术壁垒高的COF柔性封装基板及COF产品的产能，可进一步充分利用公司自产FCCL、COF柔性封装基板的优势，提高COF柔性封装基板及COF产品收入占比，不断完善公司的产业链优势。项目实施后，公司产品技术含量和竞争力将进一步提升，产品结构进一步优化。

## 3、公司产能利用趋于饱和

报告期内，公司产品产能、产量和产能利用率如下：

| 产品类别                | 时间     | 产能        | 产量        | 产能利用率  |
|---------------------|--------|-----------|-----------|--------|
| COF 柔性封装基板<br>(平方米) | 2010 年 | 80,000.00 | 74,726.69 | 93.41% |
|                     | 2009 年 | 80,000.00 | 77,475.44 | 96.84% |
|                     | 2008 年 | 70,000.00 | 54,471.20 | 77.82% |
| COF 产品<br>(万块)      | 2010 年 | 250.00    | 243.78    | 97.51% |
|                     | 2009 年 | 250.00    | 213.91    | 85.56% |
|                     | 2008 年 | 200.00    | 182.96    | 91.48% |

如上表所示，报告期内公司业务规模保持较快的增长速度，COF柔性封装基板和COF产品的产能、产量持续提高。2010年COF柔性封装基板和COF产品的产能利用率分别达到93.41%和97.51%，均已接近饱和。

因此，从报告期公司的产能、产量、产能利用率指标来看，公司扩张产能是必要的。

## 4、巩固既有优势，提升我国COF柔性封装基板及COF产品的国际竞争力

公司自成立以来一直专注于FPC、COF柔性封装基板的研发与生产，现已形成了从FCCL→FPC、FCCL→COF柔性封装基板→COF产品的完整产业链，具有该领域多年的生产工艺技术和生产管理经验积淀，COF柔性封装基板制造技术和有关新材料开发水平在国内处于领先地位，公司是我国国内极少数掌握高端2L-FCCL制造工艺并大批量生产的厂商，公司所用基材全部通过自主研发生产，且技术达到国际先进水平，具备了参与国际竞争的實力。

目前世界上COF的关键材料技术、生产能力和原材料的供给主要由日本、韩国、美国的几家大型公司掌握，形成了一定的技术市场垄断。面对COF柔性封装基板及COF产品的良好发展空间及持续增长的市场需求，为了应对日本、韩国等国家和地区竞争对手的竞争压力，保持公司现有优势，进一步参与国际竞争，公司需要在经营规模、生产能力、产品结构与技术实力等方面进行全方位的提升。通过公开发行上市并实施募投项目，可巩固并充分利用公司在COF柔性封装基板方面的优势，进一步打破国外竞争对手在技术、原材料及市场等方面的垄断，提升公司的市场份额及竞争力，提升我国COF柔性封装基板及COF产品的制造技术水平，缩小与国际一流厂商的差距。

## **（二）募集资金投资项目的可行性**

### **1、市场前景广阔**

近年来，在电子信息产品轻、薄、短、小化趋势带动下，COF柔性封装基板被广泛应用于各种尺寸的TFT-LCD驱动芯片封装，目前，TFT-LCD驱动芯片封装占COF柔性封装基板应用市场份额85%以上，TFT-LCD能够实现从2英寸以下小尺寸到60英寸以上大尺寸的各种尺寸的显示，下游应用范围广阔，主要应用领域包括液晶电视、手机、笔记本电脑、MP3、车载电视、PDA、高端手持游戏机等，其中，液晶电视、手机、笔记本电脑对TFT-LCD需求量最大，随着这三类产品的技术升级和消费升级，产品将继续保持增长。

除了上述领域外，COF柔性封装基板及COF产品在电子读写磁头、扫描仪、笔记本电脑、数码相机、打印机、喷墨打印头、影碟机、发动机控制器、IC测试仪器、武器制导系统、空中导航设备、激光系统控制器、医学诊断设备、助听器、

磁盘驱动器、Modem、ISDN、网卡、集线器，交换机，ADSL、VDSL、电源设备、汽车及航天仪表、手机配件、对讲机、微型马达、玩具等其他电子产品中COF柔性封装基板及COF产品也将逐步得到广泛的应用。

## 2、技术储备充分

通过产学研结合及吸收消化国际先进技术的特色自主创新之路，公司在高性能薄膜成型技术、高密度微细线路制造技术及基于柔性基板的芯片封装技术等领域取得多项科研成果，现已拥有9项发明专利，另有6项封装技术的发明专利正在申请之中。

本项目产品COF柔性封装基板和COF生产涉及的技术主要包括无胶基材生产技术、微粘膜制造技术、微孔加工技术、超微细线路制作技术、焊盘金手指制作技术、表面涂覆工艺、COF封装技术，上述技术均为丹邦科技自主研发掌握并已成功运用。

## 3、机器设备及原材料供应保障

本项目所需的机器设备可从日本、美国等国家采购，主要原材料为PI膜、铜箔、保强板、粘合剂、非导电胶（NCP）、芯片及器件等，上述原材料市场供应充足，可以从国内外市场采购。本公司与设备及原材料供应商有多年的合作经验，项目所需机器设备和原料供应有保障。

## 4、公司产销情况良好，市场需求持续增长

报告期内，公司COF柔性封装基板及COF产品的销量逐年增长，而且产销率均保持在97%以上的高水平。

报告期内，COF柔性封装基板及COF产品的销量增长情况如下：

| 项 目                   | 2010 年度   | 2009 年度   | 2008 年度   |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| COF 柔性封装基板销量<br>(平方米) | 77,160.64 | 76,708.43 | 53,675.92 |
| COF 柔性封装基板产销<br>率 (%) | 103.26    | 99.01     | 98.54     |
| 同比增长率 (%)             | 0.59      | 42.91     | 25.16     |
| COF 产品销量 (万块)         | 247.38    | 210.89    | 178.13    |
| COF 产品产销率 (%)         | 101.48    | 98.59     | 97.36     |
| 同比增长率 (%)             | 17.30     | 18.39     | 902.42    |

公司COF柔性封装基板及COF产品技术水平先进，产品质量可靠，市场反应良好，销量稳步递增。2009年COF柔性封装基板销量同比增长42.91%，COF产品同比增长18.39%，受产能限制排水量的约束，2010年COF柔性封装基板及COF产品销量增长放缓。在产量持续提高，产能利用率接近饱和的同时，公司产品产销情况良好，2008-2010年公司COF柔性封装基板和COF产品的产销率持续提高。

随着客户需求规模扩大和需求品种的多样化，以及下游客户对公司产品的认可度不断提高，公司产品销量呈现持续增长的态势，有利于为项目实施提供有效市场保障。

## 5、项目产品的营销保障

经过多年的经营积累，公司产品在下游客户中赢得了良好的声誉并获得客户的广泛认可，目前，公司与多家世界500强企业及全球知名的电子信息产品品牌制造商建立了持久稳定的客户关系，产品远销亚洲、欧洲、美洲等20多个国家和地区，在FPC、柔性封装基板及COF封装领域形成了较高的知名度和良好的信誉度。庞大的优质客户群体为公司的持续发展提供了有效的市场保障：

| 客户所在国家/地区 | 客户名称及所属行业                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日本        | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 夏普(Sharp)，电子、电器设备，世界500强</li> <li>● 日立(Hitachi)，电子、电器设备，世界500强</li> <li>● 佳能(Canon)，影像器材、办公设备，世界500强</li> <li>● 日本电产(NIDEC)，电机制造，2008年营业收入达到63亿美元</li> <li>● 松下(Panasonic)，电子、电气设备，世界500强</li> <li>● 三洋电机(SanyoElectric)，电子、电气设备，世界500强</li> <li>● 胜利公司(JVC)，视频、音频设备，世界500强</li> <li>● 欧姆龙(OMRON)，自动化控制及电子设备，亚洲500强</li> <li>● 阿尔卑斯电气(ALPS)，磁性模具、通信及汽车电子产品</li> <li>● 三美电子(Mitsumi Electric)，PC配件和元器件生厂商</li> <li>● 立志凯(NISCA)，ID卡打印机</li> </ul> |
| 亚洲其他地区    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 鸿富锦精密电子(Foxcoon)，消费类电子信息产品，世界500强</li> <li>● 元太科技(Prime View International)，TFT-LCD、LED显示和电子书</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

公司定期安排到日本等地区拜访重点客户，了解产品的下游市场情况，并随客户了解其同行，征求客户对公司产品性能与质量的建议，在维护现有客户的基础上，开拓新的市场份额，及时把握市场动态。同时，公司加强客户服务力量，在日本等主要销售区域建立市场及客户信息收集反馈渠道，及时获得客户需求信

息，完善产品性能和结构，以满足不断变化的客户需求。

### 三、募集资金投资项目产品的市场前景分析

#### （一）项目产品受国家产业政策鼓励

公司产品所属行业受国家产业政策鼓励，具体鼓励政策如下：

| 发布部门<br>及时间                            | 主要政策                                         | 主要规定                                                                                                                                                        | 涉及的公司<br>主导产品                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 发改委<br>2005年12月                        | 《产业结构调整<br>指导目录（2005<br>年本）》                 | 新型电子元器件，如高密度印制<br>电路板和柔性电路板等制造属<br>鼓励类产业                                                                                                                    | 高密度印制电路<br>板和柔性电路板                                         |
| 工业和信息化部<br>2006年9月                     | 《信息产业科技<br>发展“十一五”规<br>划和2020 年中长<br>期规划纲要》  | 发展重点技术包括多层、柔性、<br>柔刚结合和绿色环保印制电路<br>板技术                                                                                                                      | 绿色环保柔性印<br>制电路板技术                                          |
| 发改委、科技部、<br>商务部、国家知<br>识产权局<br>2007年1月 | 《当前优先发展<br>的高技术产业化<br>重点 领域 指 南<br>（2007年度）》 | 优先发展高密度印制电路板和<br>柔性电路板                                                                                                                                      | 高密度柔性印制<br>电路板                                             |
| 发改委、商务部<br>2007年1月                     | 《外商投资产业<br>指导目录(2007)》                       | 高密度互连积层板、多层柔性<br>板、刚柔印制电路板属鼓励外商<br>投资类                                                                                                                      | 多层柔性板                                                      |
| 科技部、财政部、<br>国家税务总局<br>2008年4月          | 《国家重点支持<br>的高新技术领域》                          | 刚柔结合板和高密度积层板为<br>国家重点支持的高新技术领域<br>产品                                                                                                                        | 高密度积层板                                                     |
| 发改委、工业和<br>信息化部<br>2009年9月             | 《电子信息产业<br>技术进步和技术<br>改造投资方向》                | 重点支持高端印制电路板及覆<br>铜板材料，高端印制电路板包括<br>高密度互联多层印制电路板、多<br>层挠性板、刚挠印制电路板、IC<br>封装基板、特种印制电路板；鼓<br>励节能减排工艺发展，重点发展<br>环保型的高性能覆铜板、特殊功<br>能覆铜板、高性能挠性覆铜板和<br>基板材料等研发和产业化 | 多层挠性板、<br>IC封装基板（包括<br>COF 柔性 封装 基<br>板）、高性能挠性<br>覆铜板、基板材料 |

#### （二）市场前景及市场容量

##### 1、COF柔性封装基板市场前景及市场容量

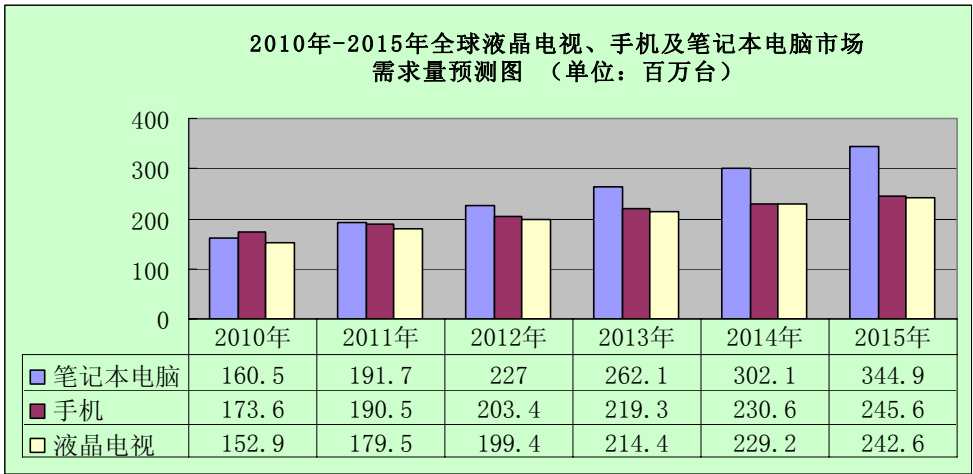
COF柔性封装基板在LCD的驱动IC中主要起承载IC芯片、电路连通、绝缘支撑



的作用，属于柔性印制电路板一个特殊类别的基板，它具有高微细线路、高安装引线位置精度及采用2L-FCCL三大突出的特点。由于COF的微细线路、高精度对引线位置精度、高介电性能、挠曲性等的性能要求，目前世界上制作COF基板普遍采用无胶粘剂型的2L-FCCL。

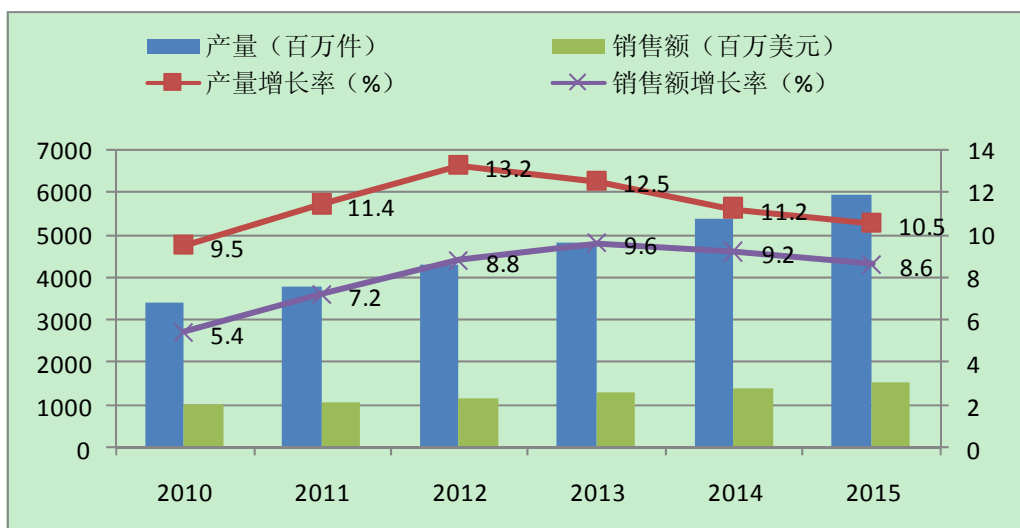
近年来，在电子信息产品轻、薄、短、小化趋势带动下，COF柔性封装基板被广泛应用于各种尺寸的TFT-LCD驱动芯片封装，目前，TFT-LCD驱动芯片封装占COF柔性封装基板应用市场份额85%以上，因此，COF柔性封装基板市场前景与下游TFT-LCD应用市场前景息息相关。TFT-LCD能够实现从2英寸以下小尺寸到60英寸以上大尺寸的各种尺寸的显示，下游应用范围广阔，主要应用领域包括液晶电视、手机、笔记本电脑、MP3、车载电视、PDA、高端手持游戏机等，其中，液晶电视、手机、笔记本电脑对TFT-LCD需求量最大，这三类产品在技术升级和消费升级带来的产品结构调整推动下将继续保持增长，市场前景广阔。

2010 年-2015 年全球液晶电视、手机及笔记本电脑市场需求量预测如下图：



资料来源：Displaysearch，2009 年 4 月

2010 年-2015 年 COF 柔性封装基板全球市场规模的预测如下图：



资料来源：（日）《半导体产业新闻》；中国电子材料行业协会，2010.7

## 2、COF产品市场前景

COF是指将芯片直接封装在柔性封装基板上的一种封装形式。为适应电子产品小型化、轻量化、高性能化的进程，早在20世纪90年代，日本企业就已经掌握了COF技术，产品主要用于高档消费电子领域。近年来，便携式电子设备需求的剧增推进了电子产品小型化、轻量化、高性能化的进程，COF产品越来越被更多的企业采用，从而推动了COF技术以及产品向更多技术领域的渗透。

COF作为一种新兴的封装技术，具有如下特点：（1）尺寸缩小化、更薄、更轻；（2）芯片正面朝下，线距细微化，可增加可靠度；（3）在基板上可做区域性回焊；（4）折弯强度较高；（5）可增加被动组件；（6）接脚数可降至TAB的一半。目前COF技术已经成功应用在LCD面板上，并在手机、笔记本电脑、LCD显示器等产品的持续带动下，已经成为市场上的基于柔性基板IC封装的主流形式。

作为目前驱动IC最新的封装技术，COF可支持新一代液晶显示模组上的驱动IC封装，其市场可分为小尺寸LCD面板，及中大尺寸LCD面板的应用。小尺寸面板主要的应用为手机，手机为高整合性的产品，LCD模组需要整合多个元件，且在系统的连接需具有高挠曲、轻量化等特性，COF可满足此要求，且可支持越来越复杂的结构设计。针对较高端的手机产品，LCD显示模块形态逐渐往COF发展。中大尺寸的TFT LCD的应用有手提电脑、液晶显示器及液晶电视等。由于该类产品的面板要求轻薄短小，高画质，高解析度，其显示板的模组封装以COF为未来的主要趋势。

随着电子、通讯产业的蓬勃发展,液晶平板显示器,特别是高清晰液晶显示器的需求与日剧增,大尺寸的液晶显示器、液晶电视,中小尺寸的手机、数码相机、数码摄像机以及其他3G产品都以轻薄短小为发展趋势,这就要求必须有高密度、小体积、能自由安装的新一代封装技术来满足以上需求。而COF技术正是在这样的背景下迅速发展壮大,成为LCD平板显示器的驱动IC的一种主要封装形式,进而成为这些显示模组的重要组成部分。总之,COF技术已经成为未来平板显示器的驱动IC封装的主流趋势之一。

### **(三) 行业竞争情况**

#### **1、本项目产品的主要竞争对手**

##### **(1) COF柔性封装基板主要竞争对手**

从世界范围内来看,世界COF柔性封装基板市场主要被日本、韩国企业完全占领。2009年,世界上COF柔性封装基板生产企业销售额排名前七位的依次是日本日立电线、日本三井金属矿业、韩国LG微电子、韩国STEMCO、日本住友金属矿山、日本新藤电子工业及韩国三星Gtechwin,这七家企业在COF柔性封装基板关键材料技术、生产能力和原材料供给上形成了市场垄断,其COF柔性封装基板总销售额占全世界销售额的97%,呈现高度集中的竞争格局。

我国仅有少数企业有能力独立生产COF柔性封装基板,这些企业大致可以分成两类,外资企业和内资企业,外资企业主要包括日本索尼在苏州设立的全资子公司索尼凯美高电子(苏州)有限公司,日本株式会社MISUZU工业在无锡设立的全资子公司明思作机电(无锡)有限公司,外资企业依托母公司强大的实力,在研发、产业链及技术等方面具有明显优势,一定程度上影响着中国COF柔性封装基板的发展方向。近年来,受到国内外液晶显示器市场迅速扩大的驱动,国内多家FPC厂商开始涉足COF柔性封装基板的生产,如珠海元盛电子科技有限公司、厦门宏信电子科技有限公司、厦门爱普生科技有限公司等,但后进入企业的COF柔性封装基板目前还处于基础研发阶段,相关的认证也在申请中,比本公司落后至少2~3年。

本项目产品主要竞争对手简要情况如下:

| 企业名称             | 主打产品                     | 细分行业地位                                                                                                                                         |
|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日本日立电线株式会社       | 电线电缆、信息通讯网络、高性能材料、封装基板   | 成立于 1956 年，2008 年收购了当时封装基板产量在世界排名第二的日本卡西欧微电子有限公司全部封装基板生产线，使其综合实力及产能大增，2009 年全球 COF 柔性封装基板销售额排名第一                                               |
| 日本三井金属矿业株式会社     | 铜箔、封装基板                  | 主要生产基地在日本国内的山口县、福岡县、埼玉县；2007 年初，三井金属率先在世界上开发出 25 $\mu$ m 线宽线距的 COF 柔性封装基板，2007 年下半年又开发出 20 $\mu$ m 线宽线距的 COF 柔性封装基板；2009 年全球 COF 柔性封装基板销售额排名第二 |
| 韩国 LG Micron Ltd | 电视机及计算机显像管用荫罩板、引线框架、封装基板 | 是 LG 集团三大事业领域中电子和通信事业领域的直属企业，是全球专业生产超精密电子零部件的领导企业，2009 年全球 COF 柔性封装基板销售额排名第三                                                                   |
| 韩国 STEMCO Ltd    | 带式电路、封装基板                | 成立于 1995 年，是由日本东丽公司与韩国三星电机公司共同合资创建的，2004 年开始生产 COF 柔性封装基板，2009 年全球 COF 柔性封装基板销售额排名第四                                                           |

资料来源：根据各公司网站整理获得

## （2）COF产品主要竞争对手

COF产品最主要应用市场是TFT-LCD驱动芯片封装，占COF产品应用市场份额85%以上，目前全球TFT-LCD驱动芯片主要生产厂商为韩国三星、现代，日本日立、日本电气，台湾奇美、联咏、华邦等。上述驱动芯片厂家均能够自产COF产品，但为了加快产业结构的调整和优化升级，这些厂商逐渐向发展中国家或地区转移COF产品制造环节，并努力强化自身对COF产品核心技术的研发与控制。

目前，我国广东、华东地区有多家COF产品生产厂商，但生产的COF产品档次较低，适用于较低端的终端产品。本公司是国内少数能够生产高端COF产品的企业之一，本公司生产的COF产品线宽线距最细可达到25 $\mu$ m，接近世界尖端水平，适用于各种尺寸的高分辨率LCD，主要客户为日本日立等全球TFT-LCD驱动芯片生产商。

## 2、公司主要竞争优势

公司主要竞争优势详见本招股说明书第五节之“三、（二）发行人的竞争优势”。

#### （四）产能消化分析

##### 1、产能逐步释放，可缓解产能消化的压力

###### （1）新增产能、产量情况

募集资金投资项目达产后，产能增加情况如下：

| 产品类别             | 2010 年产能 | 项目新增产能   | 增幅（%）  |
|------------------|----------|----------|--------|
| COF 柔性封装基板（万平方米） | 8.00     | 30.00    | 375.00 |
| COF 产品（万块）       | 250.00   | 1,080.00 | 432.00 |

###### （2）产能逐步释放，产能增加带来的销售压力较小

为及时满足市场需求的增长，本项目采用边建设边生产的方式，尽快投入生产。但项目全面达产的过渡时间相对较长，公司新增产能释放是一个逐步、渐进的过程，这将缓冲产能扩张带来的销售压力。

募集资金投资项目达产计划如下：

| 项目               | 第一年       | 第二年       | 第三年       |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| COF 柔性封装基板（万平方米） | 9.00      | 18.00     | 30.00     |
| COF 产品（万块）       | 324.00    | 648.00    | 1,080.00  |
| 销售收入（万元）         | 21,222.00 | 42,444.00 | 70,740.00 |
| 达产率（%）           | 30.00     | 60.00     | 100.00    |

由上表，在3年的过渡期内，募集资金投资项目逐年达产，销售收入逐年增长，公司面临的短期产能增加带来的销售压力较小。

##### 2、公司的产能、产量、产能利用率和产销率情况

报告期内，公司COF柔性封装基板、COF产品的产能、产量、产能利用率和产销率情况如下：

| 产品类别                    | 时间     | 产能        | 产量        | 产能利用率  | 销量        | 产销率     |
|-------------------------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|
| COF 柔性封装基板<br>(单位: 平方米) | 2010 年 | 80,000.00 | 74,726.69 | 93.41% | 77,160.64 | 103.26% |
|                         | 2009 年 | 80,000.00 | 77,475.44 | 96.84% | 76,708.43 | 99.01%  |
|                         | 2008 年 | 70,000.00 | 54,471.20 | 77.82% | 53,675.92 | 98.54%  |
| COF 产品<br>(单位: 万块)      | 2010 年 | 250.00    | 243.78    | 97.51% | 247.38    | 101.48% |
|                         | 2009 年 | 250.00    | 213.91    | 85.56% | 210.89    | 98.59%  |
|                         | 2008 年 | 200.00    | 182.96    | 91.48% | 178.13    | 97.36%  |

公司产能日益不能满足客户需求增长是实施募投项目的主要原因，募投项目的新增产能设计正是以产品市场的发展趋势以及公司与客户的实际业务增长情况为依据。

如上表所示，报告期内公司业务规模保持较快的增长速度，COF柔性封装基板和COF产品的产能、产量持续提高。2010年COF柔性封装基板和COF产品的产能利用率分别达到93.41%和97.51%，均已接近饱和。

报告期内COF柔性封装基板和COF产品产量持续提高，产能利用率接近饱和的同时，公司产品产销情况良好，2008-2010年公司COF柔性封装基板和COF产品的产销率保持在97%以上，2010年，COF柔性封装基板和COF产品的产销率均超过100%。

因此，从报告期内公司的产能、产量、销量、产能利用率、产销率指标来看，公司扩张产能是十分必要的，产品市场前景良好。

### **3、公司市场占有率有较大提升空间**

本次募集资金投资项目达产后公司的全球市场占有率显著提升，但仍处于较低水平，以COF柔性封装基板为例，2009年全球市场占有率为1.55%，达产后随着公司业务规模的扩大，全球市场占有率将进一步提升。基于公司以往持续增长的趋势及公司在技术工艺、研发投入及成本等方面的优势，且公司已与国外下游主流客户建立了稳定的合作关系，募集资金投资项目相关产品的市场空间充足，产能可以被市场消化。此外，亦符合产能向中国转移的趋势。

### **4、新增产能消化具体举措**

基于公司以往良好的经营业绩和良好的客户关系，并随着公司市场营销工作的不断深化，本项目产品具备较好的营销基础，具体营销措施如下：

#### **(1) 深度挖掘现有客户需求**

①目前，公司部分单个客户实现的销售收入较低，公司将对该类客户需求进行深度挖掘，逐渐提升单个客户的销售收入。

公司与众多世界知名的电子信息产品生产厂商建立稳定的合作关系，建立了长期稳定的合作关系，国外客户主要包括日本电产、夏普、佳能、日立、JVC、

三洋电机等。该类知名客户对供应商选择大多比较严格，一般要通过严格的认证、打样或试用等程序，在获得其认可后，采购量则会逐步增加。以夏普、松下、元太科技等集团成员企业为例，无锡夏普电子元器件有限公司自2008年成为公司客户以来，公司对其销售快速增长，2007年公司开始为其打样，2010年对其实现销售收入超过2,100万元；松下航空电子于2009年成为公司客户，2010年本公司对其实现销售收入超过500万元；元太科技下属企业川奇光电于2010年下半年成为公司客户，当年即实现销售收入超过250万元。

目前，飞利浦、佳能等世界知名电子信息产品的集团成员企业已开始与公司合作，随着上述企业业绩保持良好的增长趋势以及公司产品质量、性能不断获得知名客户的订可，双方的合作将进一步加深，未来几年公司对现有知名客户的销售额有望持续快速增长。

②与长期合作客户签署战略合作协议，同等条件下优先选用本项目的产品。

③深入了解客户在产品研发和技术改造过程中对产品技术能力的要求，全面拓宽合作渠道与合作范围。

## **(2) 加大区域市场开拓力度**

公司目前的销售收入主要集中在日本、欧美、东南亚及香港等国家和地区，2010年，上述国家或地区实现的销售收入分别占主营业务收入的71.25%、13.65%、8.60%、4.75%，针对重点市场，公司制定如下市场开拓计划：

①深度挖掘日本市场。日本是全球电子信息产业最密集的地区，一直是公司销售收入的最大来源地。公司将稳定并增加日本的客户资源，重点维持与日本大客户的合作关系，保持在该地区销售业绩的持续增长。此外，公司将在日本设立办事处、建立市场信息收集反馈渠道，以开展客户关系维护，进行售后服务，及时获得客户需求信息，完善产品性能和结构以满足不断变化的客户需求及开拓客户。

②重点开拓欧美市场。欧美地区也是全球电子信息产业密集的地区之一，2010年来源于欧美地区的销售收入占公司主营业务收入的13.65%，占比超过东南亚地区，但公司在该市场占有率相对偏低，具有较大的提升空间。未来几年公司将把欧美地区作为市场开拓的重点，增加对该市场销售资源的投入，优化公司销

售区域结构。

③进一步发挥香港子公司丹邦香港专攻海外市场的职能，使其与海外客户加强联系，提升国际竞争力。

### **（3）开拓国内市场**

公司生产的COF柔性封装基板、COF产品的各项指标接近国际先进水平，可以替代进口材料，国内市场的开拓空间较大。目前已有国内公司提出送样要求或咨询供应状况，国内用户进行测试和试用后反映良好，公司已和个别国内企业达成COF封装产品的供货意向。公司将重视与国内市场中资金实力较强、资信水平良好的企业开展合作。

### **（4）扩大销售团队规模，提升销售管理能力**

公司已开始着手选拔和储备相关人才，拟扩大销售人才队伍；进一步完善销售人员的激励机制和考核机制，加强销售人员的专业知识和销售能力培训力度，提高销售人员的积极性和业务素质。

此外，公司计划在现有的销售布局结构中，按重点区域分设办事处，配置更多的销售资源，加强区域市场的管理，完善销售体系建设，形成全方位、多层次的销售体系。

## **四、募集资金投资项目情况简介**

### **（一）项目实施主体**

#### **1、项目实施主体的基本情况**

本次募集资金投资项目实施主体为位于东莞松山湖科技产业园的子公司广东丹邦，募集资金到位后，公司将通过向广东丹邦独家增资的方式投入，广东丹邦根据募集资金使用计划具体实施。

广东丹邦注册资本5,000万元，实收资本5,000万元。其中，本公司占75%的股权，本公司全资子公司丹邦香港占25%的股权，因此，本公司通过直接与间接方式合计持有该公司100%的股权。广东丹邦的基本情况详见本招股说明书第四节之“七、（二）广东丹邦科技有限公司”。



## 2、增资方案

根据广东丹邦于2010年9月15日董事会审议通过，本次增资由本公司用募集资金独家增资，丹邦香港不增资。

## 3、项目实施主体的资产负债表及利润表

经天健会计师天健审[2011]3-43号《审计报告》审计，广东丹邦最近一年的资产负债表和利润表如下：

### （1）资产负债表

单位：元

| 资产      | 2010年12月31日   |
|---------|---------------|
| 流动资产：   |               |
| 货币资金    | 392,573.71    |
| 预付款项    | 30,656,899.33 |
| 流动资产合计  | 31,049,473.04 |
| 非流动资产：  |               |
| 工程物资    | 37,945,466.58 |
| 递延所得税资产 | 97,195.34     |
| 非流动资产合计 | 38,042,661.92 |
| 资产总计    | 69,092,134.96 |

### 资产负债表（续）

单位：元

| 负债及股东权益   | 2010年12月31日   |
|-----------|---------------|
| 流动负债：     |               |
| 应付账款      | 3,851,724.00  |
| 其他应付款     | 15,531,996.97 |
| 流动负债合计    | 19,383,720.97 |
| 非流动负债：    |               |
| 非流动负债合计   |               |
| 负债合计      | 19,383,720.97 |
| 股东权益：     |               |
| 实收资本      | 50,000,000.00 |
| 未分配利润     | -291,586.01   |
| 股东权益合计    | 49,708,413.99 |
| 负债及股东权益总计 | 69,092,134.96 |

### （2）利润表

单位：元

| 项目     | 2010年度 |
|--------|--------|
| 营业收入   | -      |
| 减：营业成本 | -      |

|         |             |
|---------|-------------|
| 营业税金及附加 | -           |
| 销售费用    | -           |
| 管理费用    | 105,850.97  |
| 财务费用    | 12,099.38   |
| 营业利润    | -117,950.35 |
| 利润总额    | -117,950.35 |
| 减：所得税费用 | -29,487.59  |
| 净利润     | -88,462.76  |
| 其他综合收益  |             |
| 综合收益总额  | -88,462.76  |

## （二）建设用地

项目建设地点在位于东莞松山湖科技产业园区北部工业城C区。东莞松山湖科技产业园区规划面积72平方公里，位于广东省中南部，2001年11月经广东省人民政府批准正式成立，是东莞市国内外著名企业聚集中心、研发服务中心、人才教育中心和高新技术产业基地，园区内已具备城市道路、通讯、水、电、煤气、雨水排放等市政配套条件，用地及周围环境能满足项目建设和生产的要求。2002年5月松山湖科技产业园区被评为“中国最具发展潜力的高新技术产业开发区”。松湖北部工业城是松山湖集产业经济、城市生活等功能于一体的重要功能区，重点发展电子信息产业、生物技术产业和装备制造产业，聚集高新技术企业及拥有自主知识产权和自有品牌的企业，是东莞的高新技术产业基地。

本次募集资金投资项目建设用地的落实情况说明如下：

### 1、本公司同一实际控制人控制的广东东邦于2009年2月取得募投项目用地的土地使用权

2009年2月27日，广东东邦与东莞市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》（东国土出让（市场）合[2009]第16号），通过招拍挂程序受让座落于松湖北部工业城，编号为2009T014的宗地，宗地面积56,964平方米。广东东邦于2009年4月28日取得东莞市国土资源局颁发的《国有土地使用证》（东府国用[2009]第特66号），土地用途为工业用地，使用期限50年。广东东邦取得上述土地使用权后，开始投资建设实施募投项目所需的厂房、研发大楼及其他配套设施。

### 2、广东丹邦购买广东东邦的土地使用权及其地上建筑物用以实施募投项目

2009年8月10日，东莞松山湖科技产业园区管理委员会出具了《关于同意广东丹邦科技有限公司入园的批复》，同意广东丹邦入驻松山湖科技产业园区。

2010年8月25日，东莞松山湖科技产业园区管理委员会出具松山湖函[2010]189号《关于同意东邦科技拟转让土地使用权的复函》，同意广东东邦将上述土地使用权及其地上建筑物、附着物（包括厂房、研发大楼及相关生产、办公、生活配套设施等）转让给广东丹邦用于实施募投项目。

广东丹邦与广东东邦于2010年9月13日签署《资产收购协议》，并于2011年4月15日签署《补充协议》，双方约定，以2011年3月31日为审计基准日对广东东邦拥有的土地使用权及其地上建筑物等资产进行专项审计，广东丹邦以经审计的账面值为收购价格收购该等资产。

### 3、募投项目用地的土地使用权已过户至募投项目实施主体广东丹邦

根据双方签署的《资产收购协议》及《补充协议》，广东丹邦以经审计的账面值为参考作价63,482,104.02元购买广东东邦的土地使用权和在建工程。广东丹邦已向广东东邦支付全部转让价款，2011年5月9日，广东丹邦取得东莞市人民政府颁发的1935030100045号宗地的《国有土地使用证》（东府国用[2009]第特66号），完成该土地使用权过户的变更登记。至此，广东丹邦已落实募投项目用地。

## （三）项目投资概算及实施进度安排

### 1、投资概算

项目总投资42,500.00万元，其中：建设投资33,000.00万元、铺底流动资金9,500.00万元。建设投资构成明细如下：

单位：万元

| 项 目      | 第一年       | 第二年       | 第三年      | 合计        |
|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 前期预备费    | 200.00    | 175.00    | 125.00   | 500.00    |
| 土地购置费    | 3,700.00  | —         | —        | 3,700.00  |
| 建筑工程及装修  | 4,800.00  | 4,850.00  | 900.00   | 10,550.00 |
| 勘察、设计、监理 | 250.00    | —         | —        | 250.00    |
| 安装工程及设备  | 4,650.00  | 6,375.00  | 6,975.00 | 18,000.00 |
| 合 计      | 13,600.00 | 11,400.00 | 8,000.00 | 33,000.00 |

项目主要建设内容包括：

- (1) 购置生产厂房、研发大楼及生活配套设施。
- (2) 对生产厂房、研发大楼空调、给排水系统、电力供给、照明系统、火灾报警系统、公司内外部通信系统以及室外工程等进行建设。
- (3) 购置生产设备、仪器131台/套。
- (4) 配套和完善相应的公用辅助设施，改善生产环境。
- (5) 对生产过程中产生的废气、废水和噪声等进行有效的治理。

2、实施进度安排

本项目建设期3年，建设期内第一年投入13,600万元，第二年投入11,400万元，第三年投入8,000万元。在建设期第三年投入铺底流动资金9,500万元。

本项目建设期为3年，建设期第3年开始投产，投产后的第3年可全面达产。项目达产后可年产COF柔性封装基板30万平方米、COF封装产品1,080万片。具体如下表：

| 产品名称       | 单位   | 生产运营期          |                |                      |
|------------|------|----------------|----------------|----------------------|
|            |      | 第 1 年<br>(30%) | 第 2 年<br>(60%) | 第 3 年及以后各年<br>(100%) |
| COF 柔性封装基板 | 万平方米 | 9.00           | 18.00          | 30.00                |
| COF 芯片封装体  | 万片   | 324.00         | 648.00         | 1,080.00             |

(四) 产品的质量标准、技术水平和工艺流程

1、COF柔性封装基板构成材料主要技术参数

| 材料名称  | 厚度值 (μm) |       |       |       |
|-------|----------|-------|-------|-------|
| 铜箔    | 18.00    | 18.00 | 12.00 | 9.00  |
| PI 薄膜 | 25.00    | 12.50 | 12.50 | 12.50 |

2、无胶基材主要技术参数

|       |                                     |
|-------|-------------------------------------|
| 剥离强度  | 1.8 kg/cm                           |
| 线膨胀系数 | $2 \times 10^{-5} / ^\circ\text{C}$ |
| 弹性模量  | 3 GPa                               |
| 拉伸强度  | 100 MPa                             |
| 伸长率   | 39%                                 |
| 表面电阻  | $1 \times 10^{14} \Omega$           |

### 3、COF柔性封装基板主要技术参数

| 产品      | COF 柔性封装基板    |            |
|---------|---------------|------------|
| 规格      | 单面 COF        | 两面 COF     |
| 最小线路幅宽  | 25 $\mu$ m    | 50 $\mu$ m |
| 最小线路间隙  | 25 $\mu$ m    | 50 $\mu$ m |
| 最小导通孔直径 | $\Phi$ 0.05mm |            |
| 主要构成材料  | 无胶型单面/两面基材    |            |

### 4、COF封装技术主要特点

(1) 使用金-锡共晶连接工艺和非导电胶（NCP）等连接工艺将芯片连接在柔性电路板上。

(2) 适用于高密度配线微电子产品、手机、平面显示器等领域。

(3) 极适合高密度多插脚芯片（大于200pin）的应用。可缩小芯片面积，灵活安排降低成本。

### 5、工艺流程

项目产品的工艺流程详见本招股说明书第五节之“四、（二）生产工艺流程”。

#### （五）项目保障措施

为切实保障本项目顺利实施，公司在技术、市场、人员方面进行了充分准备：

#### 1、技术准备方面

本项目产品 COF 柔性封装基板和 COF 生产涉及的技术主要包括无胶基材生产技术、微粘膜制造技术、微孔加工技术、超微细线路制作技术、焊盘金手指制作技术、表面涂覆工艺、COF 封装技术，上述技术均为丹邦科技自主研发掌握并已成功运用的技术。详见本招股说明书第五节之“六、（二）主要的核心技术”。

#### 2、市场准备方面

详见本招股说明书第十二节之“三、（四）4、新增产能消化具体举措”。

#### 3、人员准备方面

本项目需要劳动定员为1,500人，所需人员通过招聘解决。生产线为两班制，管理、技术人员单班制。人员配置情况如下所示：

| 序号 | 部门        | 人数（人） | 备注                                  |
|----|-----------|-------|-------------------------------------|
| 1  | 柔性封装基板事业部 | 692   | 管理人员 52 人、员工 640 人                  |
| 2  | 封装事业部     | 540   | 管理人员 40 人、员工 500 人                  |
| 3  | 研发部       | 60    | 外籍专家、技术人员、实验人员                      |
| 4  | 市场开发部     | 10    | —                                   |
| 5  | 客服部       | 28    | —                                   |
| 6  | 品管部       | 22    | 品质管理人员                              |
| 7  | 资材部       | 37    | 管理人员 10 人，仓库工 27 人                  |
| 8  | 财务部       | 21    | —                                   |
| 9  | 人事部       | 8     | —                                   |
| 10 | 行政部       | 82    | 管理人员 15 人、保安、设施维护技工、环保技工、清洁工合计 67 人 |
|    | 合计        | 1,500 | —                                   |

人员培训是生产技术的来源及质量保证的重要手段，本项目人员培训内容主要是岗位操作，设备维修保养、产品的质量控制等。培训的对象主要面向操作人员。为使操作人员更好的掌握国内外设备的操作技能和安全生产，发挥设备的最大的生产效率，本项目将进行的培训工作主要有：

（1）由国外设备制造厂家的技术人员，介绍和讲解设备的结构、操作、维修、保养等方面的知识和应验。

（2）请国内设备制造厂家的工程技术人员及相关的专家培训有关项目生产的理论和实际操作方面的经验和技能。

（3）由企业内部技术骨干对项目人员进行指导，就如何保证安全运转和产品质量等进行全面的培训。

上岗前对项目人员进行考核，合格后持证上岗。

#### 4、设备配置

项目生产线为全流程工序配置，COF柔性封装基板产品的主要设备有COF工程装置、微孔镀铜设备、高精度显像蚀刻及退膜自动线、自动丝网印刷机、R-R露光装置、自动贴膜机、自动靶冲机、层压机、冲床、等离子清洗机、激光钻孔机、贴片机、自动分切机、特殊雾围R-R热处理工程装置、红外无胶覆合机、基板裁断机及测试仪器设备等；COF产品的主要设备包括引线键合机（自动）、倒装芯片

键合机、芯片粘合机、塑封封装器件开封机、点胶机及测试仪器设备等。

上述设备主要从日本、美国等国家和地区的专业设备生产厂商进口，本公司与设备供应商有多年的稳定合作关系，项目所需机器设备具有供应保障。

## **5、原辅材料与能源供应情况**

项目所需主要原辅材料包括各种规格型号的PI膜、铜箔、保强板、粘合剂、非导电胶（NCP）、芯片及器件等。公司已与主要原材料供应商建立了良好合作关系，原材料来源稳定，质量可靠，可满足公司的生产需求。

项目消耗的能源主要为电和水，年用电量约为3,450万千瓦时，年用水量约70万吨。园区内已具备水、电等市政配套条件，能满足项目建设和生产的要求。

## **（六）项目环境保护**

### **1、环保问题及解决措施**

本项目生产过程中产生的污染物有：废水、废气、噪声及固体废物等。

#### **（1）废水**

生产废水。本项目生产废水主要有：无胶基板生产过程中产生的含NaOH的碱性废水、COF柔性封装基板生产过程中产生的含氰废水、含络合物废水等。废水可通过公司已购置的废水处理装置处理后排放。

生活污水。生活污水主要来自办公室、卫生间、洗手池等各处，主要含有机污染物，经化粪池处理后排放。

#### **（2）废气**

生产中产生的含酸废气、有机废气经设施处理后通过管道高空排放，可以满足国标GB44/27-2001二级标准。

#### **（3）固体废物**

固定废物由深圳市环保局指定专业单位回收处理。

#### **（4）噪声**

本项目高噪声源主要为层压机、冲床、空压机等。对产生噪声设备安装时进行基础减振处理，并通过合理布置减轻对厂界噪声的影响；对于噪声较高的空压机，设计采取安装消音器、并配置在单独的房内进行隔声、墙体采用吸声材料

贴面等措施以降低噪声对外界环境的影响；经采取消声、隔音、基础减振等措施后，厂界噪声可以满足GB3096-93 II类区标准要求。

### （5）绿化

厂房道路两旁及建筑物之间的空地种植树木、花卉和草皮等进行绿化，并定期维护，绿化面积为20,650平方米。

### 2、环保投入情况

本项目环保投资约1,500万元，主要包括废气处理系统、污水和回用水处理系统、中央真空吸尘系统、消防设备等，可确保公司达到法定环境保护标准。

### 3、项目环评意见

广东省环境保护厅针对本公司募投项目环境影响报告书出具了粤环审[2011]130号批复，据此，上述募集资金投资项目符合我国环保法律法规的相关规定。

### （七）项目效益分析

本项目产品缴纳增值税税率为17%，城市维护建设税为增值税的1%，教育费附加为产品增值税的3%，所得税为利润总额的15%。

项目达产后将实现年平均销售收入62,959.00万元，生产期年平均利润总额16,087.00万元，年平均税后利润13,894.00万元。各项财务指标见下表：

| 指 标          | 单位 | 计算值       | 备注        |
|--------------|----|-----------|-----------|
| 年营业收入（年平均）   | 万元 | 62,959.00 |           |
| 年总成本费用（年平均）  | 万元 | 46,305.00 |           |
| 年总税金（年平均）    | 万元 | 2,760.00  | 年营业税金与所得税 |
| 年利润总额（年平均）   | 万元 | 16,087.00 |           |
| 年税后利润（年平均）   | 万元 | 13,894.00 |           |
| 总投资收益率       | %  | 40.17     |           |
| 项目资本金净利润率    | %  | 32.69     |           |
| 财务内部收益率      | %  | 26.26     | 全投资，税后    |
| 财务净现值(i=12%) | 万元 | 35,993.00 | 全投资，税后    |
| 投资回收期        | 年  | 6.46      | 含建设期3年，税后 |
| 盈亏平衡点        | %  | 42.88     | 生产能力利用率   |



可以看出，本项目投资内部收益率高于必要收益率，投资回收期较短，项目的盈利能力较强，资本可获得良好的收益。

## 五、固定资产投资及其对生产经营影响情况

### （一）固定资产投资必要性分析

本公司募集资金投资项目中的固定资产投资为33,000.00万元，占项目投资总额的比例为77.64%，固定资产投资较大。募集资金投向项目的固定资产投资较大的主要原因有：

- 1、公司现有厂房难以满足公司新增生产线规划的需要，目前公司亟需新建生产线提升产能以满足市场需求，而现有厂房难以达到生产线的整体布局科学规划。
- 2、公司现有厂房位于深圳市经济特区内，深圳市对经济特区内的工业用水的排水量有严格限制，公司现有排水额度难以满足项目扩产的需要。
- 3、公司所处行业与产品特点决定了项目固定资产投入较大，公司所处行业为资金与技术密集型行业，产品的生产需要投入大量资金购入各种专业生产设备和高精度现代化检测设备，资金投入规模较大，一次性投入的设备较多，导致固定资产投资加大，项目设备投资为18,000.00万元，占项目投资总额的比例为42.35%。
- 4、本项目将新增厂房和配套用房等合计65,990.36平方米，建成后年折旧额450万元。如按照项目实施地可比租金10元/平方米测算，假设房屋全部租赁则每年需支付租金约792万元。因此，公司自建生产基地可有效降低经营费用。

### （二）新增固定资产变化与业务的匹配关系

募投项目达产年度新增固定资产产生的收入和利润等指标与公司2010年度相应的指标对比情况如下表所示：

| 指 标           | 2010 年度 | 新增产能达产年度 |
|---------------|---------|----------|
| 主营业务收入/固定资产原值 | 0.47    | 1.91     |
| 利润总额/固定资产原值   | 0.13    | 0.49     |
| 净利润/固定资产原值    | 0.12    | 0.42     |

上表显示，新增产能达产年度的主营业务收入/固定资产原值、利润总额/固定资产原值和净利润/固定资产原值与2010年相比均明显提高，募集资金投资项目达产年度的设备投入产出比率明显高于2010年，主要是因为：

1、募投项目产品为附加值较高的COF柔性封装基板及COF产品，COF柔性封装基板及COF产品单价较高，使得募投项目可实现的销售收入规模较大。而公司现有产品主要包括FPC、COF柔性封装基板及COF产品，其中，FPC单价较低，而附加值较高的COF产品在目前主营业务收入中占比不高。因此，募投项目达产后的销售收入规模明显高于目前。

2、公司主要生产用机器设备大多从日本等国家的设备生产商订制，设备生产商按照本公司设计的工艺路线和技术要求制作成套设备，实现生产全过程自动化，设备先进性达到国际领先水平。该类设备在初次订制时需要支付较高的开发和设计费用，采购价格较高，在后续的同类设备采购中，价格有较明显的下降，使得设备采购支出相应减少。

3、自2008年金融危机以来，公司的主要设备供应商开工率不足，主动下调设备销售价格，亦使得公司购买同类设备的成本相应降低。

4、公司生产用机器设备大多从国外进口，其中部分设备采购以美元结算。现有机器设备主要在2006-2008年期间采购，2006年至今人民币持续升值，导致公司目前采购同类机器设备的支出有所下降。

### （三）固定资产折旧对公司未来经营成果的影响

公司本次募集资金新增固定资产以公司现行固定资产折旧政策采用直线法计算折旧，其中房屋及建筑物按30年折旧，设备按10年折旧，年折旧费具体预计如下：

单位：万元

| 新增厂房的年折旧 | 其他固定资产年折旧 | 年折旧合计    |
|----------|-----------|----------|
| 450.00   | 1,620.00  | 2,070.00 |

本次募集资金投资项目新增固定资产 33,000.00 万元。根据本公司的折旧政策，达产后公司每年新增固定资产折旧 2,070.00 万元，新增主营业务收入 62,959.00 万元，新增利润总额 16,087.00 万元，足以消除新增固定资产投资导

致折旧费用增加的影响，从而确保公司的盈利水平稳定增长。因此新增固定资产折旧不会对公司未来经营成果造成不利影响。

## **六、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响**

### **（一）对资产结构的影响和每股净资产的影响**

本次募集资金到位后，公司流动比率和速动比率将大大提高，公司短期内资产负债率将大幅下降，防范财务风险的能力将得到进一步的提高。随着投资项目的实施，大部分货币资金将按照进度转化为在建工程，随着项目的竣工投产，再逐步转化为房屋和设备等固定资产。

募集资金到位后，将使公司的货币资金和股东权益增加，公司的净资产额和每股净资产均较发行前有大幅增加。

### **（二）对公司净资产收益率和盈利能力的影响**

募集资金到位后，公司的净资产将大幅上升，净资产收益率在短期内将会有所摊薄。

本次募集资金的成功运用将扩大公司生产经营规模，提高公司的综合竞争实力和抗风险能力。项目建成投产后，公司的生产规模显著扩大，设备和技术水平将有较大提升，产品工艺水平得到全面改善，产品结构进一步优化，公司的盈利能力将随着产品的技术含量和附加值的提高而得以增强。

## **第十三节 股利分配政策**

### **一、股利分配政策**

1、公司依据国家有关法律法规和《公司章程》所载明的股利分配原则进行股利分配。

2、公司缴纳有关税项后的利润，按下列顺序分配：

- （1）弥补上一年度的亏损；
- （2）提取法定公积金10%；
- （3）提取任意公积金，按照股东大会决议从公司利润中另外提取；
- （4）按照股东持股比例分配股利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

### **二、近三年的股利分配情况**

报告期内，公司未进行股利分配。

### **三、本次发行前未分配利润的分配政策**

经公司2010年第二次临时股东大会决议：同意本次发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后由公司发行后新老股东按持股比例共享。截至2010年12月31日，母公司未分配利润为8,981.52万元。

### **四、本次发行后的股利分配政策**

公司发行后的股利分配政策与发行前股利分配政策保持一致。为体现对股东的合理投资回报，确保一定的现金分红比例，发行人2010年第二次临时股东大会通过的《公司章程（草案）》中对发行后的股利分配政策修订如下：

1、公司利润分配应重视对投资者的合理回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司利润分配不得超过累计可分配利润；

2、公司可以采取现金或者股票方式分配股利；

3、在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司每连续三年至少有一次现金红利分配，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定；

4、公司每一会计年度如实现盈利，则董事会应向股东大会提出现金股利分配预案；如实现盈利但未提出现金股利分配预案，则董事会应在定期报告中详细说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途；

5、公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得公开发行证券；

6、存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

## 第十四节 其他重要事项

### 一、信息披露制度及投资者服务计划

董事会秘书办公室负责本公司的信息披露和投资者关系事宜，对外咨询电话为 0755-26511518。

公司制定了《董事会秘书工作规范》，董事会秘书是公司与监管机构、证券交易所之间的指定联络人，负责公司与监管机构及交易所之间的及时沟通和联络，依法准备和及时递交中国证监会、公司注册地证监局、政府有关部门及证券交易所要求董事会、股东大会出具的报告和文件，以及《公司法》和交易所要求履行的其他职责。

公司制定了《信息披露制度》，对需要披露的信息、信息披露的具体要求、信息披露的程序、信息披露管理等内容进行了详细的规定。

公司还制定了《投资者关系管理制度》，通过充分的信息披露，加强与投资者的沟通，增加信息披露透明度，改善公司治理。

### 二、重要合同

截至2010年末，发行人及发行人合并报表范围内的子公司已签署、正在履行或将要履行的重大合同如下：

#### （一）借款合同

1、为建设“丹邦科技园项目”及“先进 COF 超微线路和封装产业化项目”，公司于 2007 年 7 月 30 日与国家开发银行签订编号为“4403401652007020305 号”的借款合同，借款金额为人民币 28,000 万元，借款期限从 2007 年 3 月 30 日起至 2013 年 3 月 29 日止，借款利率为浮动利率，随中国人民银行公布的同时限档次人民币贷款基准利率的调整而调整。合同项下的提款计划和还款计划如下：

| 年度     | 提款日期            | 提款金额      | 贷款余额      |
|--------|-----------------|-----------|-----------|
| 2007 年 | 2007 年 3 月 30 日 | 10,000 万元 | 10,000 万元 |
|        | 2007 年 4 月 2 日  | 5,000 万元  | 15,000 万元 |

|           |                  |             |             |
|-----------|------------------|-------------|-------------|
|           | 2007 年 4 月 25 日  | 3,000 万元    | 18,000 万元   |
|           | 2007 年 5 月 18 日  | 5,000 万元    | 23,000 万元   |
| 2008 年    | 2008 年 2 月 20 日  | 5,000 万元    | 28,000 万元   |
| <b>年度</b> | <b>还款日期</b>      | <b>还本金额</b> | <b>贷款余额</b> |
| 2009 年    | 2009 年 11 月 21 日 | 2,100 万元    | 25,900 万元   |
| 2010 年    | 2010 年 5 月 21 日  | 2,100 万元    | 23,800 万元   |
|           | 2010 年 11 月 21 日 | 2,800 万元    | 21,000 万元   |
| 2011 年    | 2011 年 5 月 21 日  | 2,800 万元    | 18,200 万元   |
|           | 2011 年 11 月 21 日 | 2,800 万元    | 15,400 万元   |
| 2012 年    | 2012 年 5 月 21 日  | 4,200 万元    | 11,200 万元   |
|           | 2012 年 11 月 21 日 | 5,600 万元    | 5,600 万元    |
| 2013 年    | 2013 年 3 月 29 日  | 5,600 万元    | 0 万元        |

截至 2010 年 12 月 31 日，本合同项下的贷款余额为 21,000 万元。

2010 年 9 月 17 日，丹邦投资集团、丹依科技和益关寿与国家开发银行签署《国家开发银行股份有限公司人民币资金借款合同变更协议》，解除为上述借款提供的股权质押担保。

2、2010 年 5 月 13 日，公司与招商银行股份有限公司深圳高新园支行签订编号为“2010 年高字第 1010198115 号”的借款合同，借款金额为 5,000 万元，合同约定的贷款期限为 2010 年 5 月 14 日起至 2012 年 5 月 14 日止，如贷款实际发放日期与上述起始日不一致，则贷款起止日期以借款借据载明的起止日期为准，借款利率为浮动利率。截至 2010 年 12 月 31 日，本合同项下的贷款余额 5,000 万元。

## （二）担保合同

1、2007 年 3 月 30 日，公司与国家开发银行签订房地产抵押合同，将公司拥有的房地产证编号为深房地字第 4000332352 号的土地使用权及地上房屋建筑物抵押给该行，为其与该行签订的编号为“4403401652007020305 号”的借款合同项下本金 28,000 万元、借款期限 6 年的长期借款提供担保。上述房地产抵押已于 2008 年 3 月 17 日依法在深圳市房地产产权登记中心办理了抵押登记，抵押编号为“深房地押字第 008001531 号”。

2、2007 年 3 月 30 日，公司与国家开发银行签订专利权质押合同，并于 2007 年 9 月 11 日签订该质押合同的补充协议，将公司拥有的专利号分别为“ZL 2003

1 0111758.4”、“ZL 2003 1 0111849.8”、“ZL 2003 1 0110798.7”、“ZL 2003 1 0110797.2”、“ZL 2004 1 0022029.6”、“ZL 2003 1 0111842.6”的六项专利权质押给该行，为其与该行签订的编号为“4403401652007020305 号”的借款合同项下本金 28,000 万元、借款期限 6 年的长期借款提供担保。上述专利权质押已于 2008 年 2 月 15 日依法在国家知识产权局办理了质押登记。

3、2007 年 3 月 30 日，公司与国家开发银行签订《国家开发银行人民币资金贷款机器设备抵押合同（用于海关监管的设备）》及《国家开发银行人民币资金贷款机器设备抵押合同（用于非海关监管的设备）》，将公司拥有的原值为 74,445,844.78 元的机器设备抵押给该行，为其与该行签订的编号为“4403401652007020305 号”的借款合同项下本金 28,000 万元、借款期限 6 年的长期借款提供担保。

4、2010 年 5 月 31 日，公司与国家开发银行签订《单位定期存单质押合同》，将其在国家开发银行深圳市分行的 440 万元定期存单质押给该行，为其与该行签订的编号为“4403401652007020305 号”的借款合同项下本金 28,000 万元、借款期限 6 年的长期借款提供担保。

5、2010 年 5 月 13 日，公司与招商银行股份有限公司深圳高新园支行签订编号为“2010 年高字第 1010198115 号”的抵押合同及补充协议，将公司拥有的包括房地产证编号为“深房地字第 4000421138 号”的松坪山高新宿舍 32 栋等 100 处房产抵押给该行，为其与该行签订的编号为“2010 年高字第 1010198115 号”的借款合同项下本金 5,000 万元、借款期限 2 年的长期借款提供抵押担保。上述房地产抵押已于 2010 年 6 月 21 日依法在深圳市房地产权登记中心办理了抵押登记。

6、2010 年 9 月 20 日，公司与国家开发银行股份有限公司深圳市分行签订《机器设备抵押合同》，将其拥有的原值为 109,449,412.11 元的机器设备抵押给国家开发银行股份有限公司深圳市分行，为其与国家开发银行股份有限公司深圳市分行签订的 4403401652007020305 号借款合同项下本金 28,000 万元、借款期限 6 年的长期借款提供担保。



### **（三）设备采购合同**

1、为实施本次募集资金投资项目，公司子公司广东丹邦通过子公司丹邦香港从境外采购超薄自动电气 Ni-Au 软质镀金线等设备，2010 年 9 月 30 日，丹邦香港与 A Cellar Ltd. 签订编号为 DB-AD-10-004B 的采购合同，采购超薄自动电气 Ni-Au 软质镀金线、超薄自动电气 Ni-Au 硬质镀金线、微孔沉铜线、微孔镀铜线等设备，合同价款合计 289,273,201.00 日元。2010 年 10 月 11 日，广东丹邦与丹邦香港签订了编号为 DB100001 的设备采购合同，合同标的、合同价款与 DB-AD-10-004B 采购合同一致。

2、为实施本次募集资金投资项目，公司子公司广东丹邦通过子公司丹邦香港从境外采购高精度 R-R 自动贴膜机 FPC-DFW-250-R，2010 年 9 月 30 日，丹邦香港与 A Cellar Ltd. 签订编号为 DB-AD-10-003B 的采购合同，合同标的为高精度 R-R 自动贴膜机 FPC-DFW-250-R，合同价款为 87,996,050.00 日元。2010 年 10 月 11 日，广东丹邦与丹邦香港签订了编号为 DB100002 的设备采购合同，合同标的、合同价款与 DB-AD-10-003B 采购合同一致。

### **（四）承销协议、保荐协议**

公司与国信证券股份有限公司签订《主承销协议》、《保荐协议》，协议就公司首次公开发行并上市的承销及保荐的事宜作出了规定，内容包括：发行数量、票面金额、发行价格、承销方式、佣金及支付、声明、保证和承诺、违约责任及争议的解决等，协议符合《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定。

## **三、重大诉讼及仲裁事项**

截至本招股说明书签署之日，本公司无任何对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生重大影响的诉讼或仲裁事项。

截至本招股说明书签署之日，本公司控股股东及控股子公司、本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，均没有作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

截至本招股说明书签署之日，本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员未曾有受到刑事诉讼的情况。

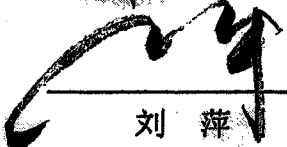
## 第十五节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明

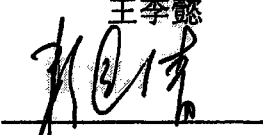
（附后）

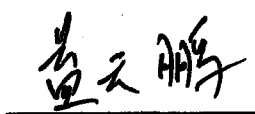
## 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

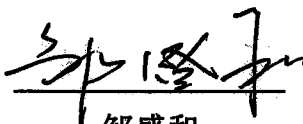
全体董事签名：

  
刘 萍  
  
龚 艳

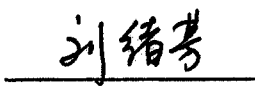
  
王李懿  
  
赖延清

  
益天鹏

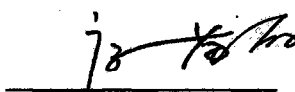
全体监事签名：

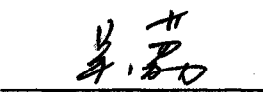
  
邹盛和

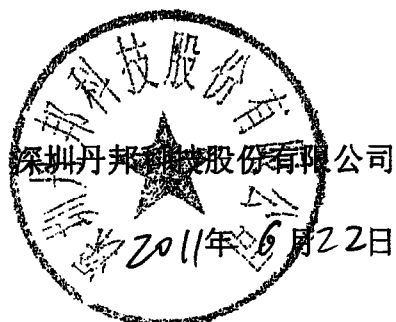
  
殷 鹰

  
刘绪芳

其他高级管理人员签名：

  
唐苗丽

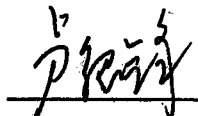
  
吴 荔



## 保荐机构(主承销商)声明

本公司已对招股说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目协办人:

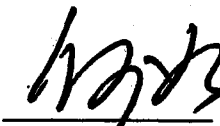
  
卢绍锋

保荐代表人:

  
甘燕鲲

  
崔威

法定代表人:

  
何如

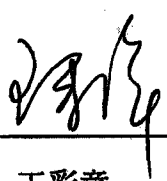


2011年6月22日

## 发行人律师声明

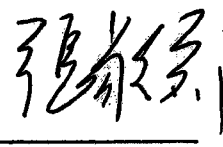
本所及经办律师已阅读招股说明书及其摘要,确认招股说明书及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师:

  
王彩章

  
朱永梅

律师事务所负责人:

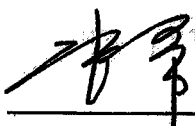
  
张敬前



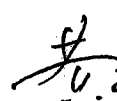
## 审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读深圳丹邦科技股份有限公司招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办会计师签字：



张希文



黄琼

会计师事务所负责人签字：



胡少先

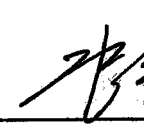


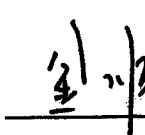
2011年6月22日

## 验资机构声明

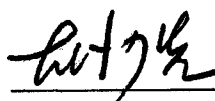
本所及签字注册会计师已阅读深圳丹邦科技股份有限公司招股说明书及其摘要, 确认招股说明书及其摘要与本所出具的验资报告及验资复核报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的验资报告及验资复核报告的内容无异议, 确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办会计师签字:

   
张希文

   
金顺兴

会计师事务所负责人签字:

   
胡少先



天健会计师事务所有限公司

2011年6月22日

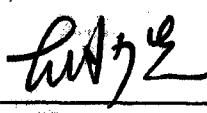


## 验资机构情况说明

原开元信德会计师事务所有限公司，已于2009年9月与浙江天健东方会计师事务所有限公司合并为天健会计师事务所有限公司。

特此说明。

会计师事务所负责人签字：

胡少先



2011年6月22日

## 评估机构声明

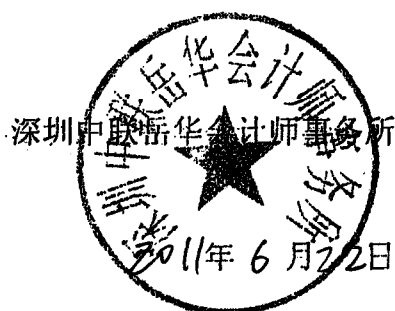
本机构及签字注册资产评估师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册资产评估师签字：



高术峰

评估机构负责人签字：



## 评估机构情况说明

本机构原注册资产评估师高术峰已于2007年9月离职，离职后不再担任本机构注册资产评估师。

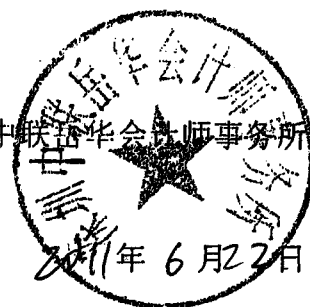
特此说明。

评估机构负责人签字：



王思年

深圳中联信华会计师事务所



## 评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册资产评估师签字：



郭春阳



郭 颀

评估机构负责人签字：



郭春阳

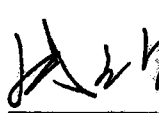
北京中盛联盟资产评估有限公司

2011年6月22日

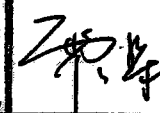
## 评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读深圳丹邦科技股份有限公司招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本机构出具的资产评估复核报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的资产评估复核报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册资产评估师签字：

  
中国注册  
资产评估师  
张云鹤  
47000267

张云鹤

  
中国注册  
资产评估师  
霍黎萍  
11001021

霍黎萍

评估机构负责人签字：

  
胡劲为



## 第十六节 备查文件

投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文件，该等文件也在指定网站上披露，具体如下：

- 1、发行保荐书及发行保荐工作报告；
- 2、财务报表及审计报告；
- 3、内部控制鉴证报告；
- 4、经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
- 5、法律意见书及律师工作报告；
- 6、公司章程（草案）；
- 7、中国证监会核准本次发行的文件；
- 8、其他与本次发行有关的重要文件。

查阅时间：工作日上午 8：00-11：30；下午 14：00-17：30。

文件查阅地点：

- 1、发行人：深圳丹邦科技股份有限公司

办公地址：深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼

电话：0755—26511518

联系人：吴荔

- 2、保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

办公地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 20 楼

电话：0755-82130581

联系人：曾军灵、卢绍锋、彭超、张云祥、陈驹